

弘塑科技股份有限公司

Grand Process Technology Corporation

一一二年度 年 報

中 華 民 國 一 一 三 年 四 月 三 十 日 刊 印

查詢本年報網址：<https://mops.twse.com.tw/>

本公司網址：<https://www.gptc.com.tw/>

一、本公司發言人及代理發言人

發言人姓名：梁勝銓
職稱：副總經理
電話：(03)5183030
電子郵件信箱：travis_liang@gptc.com.tw
代理發言人姓名：黃富源
職稱：總經理
電話：(03)5183030
電子郵件信箱：Jao_Huang@gptc.com.tw

投資人信箱：invest@gptc.com.tw
電話：(03)5183030 分機 2002 莊先生

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司及工廠地址：
30095 新竹市香山區中華路六段 89 號 電話：(03)5183030
分公司：無

三、辦理股票過戶機構

名稱：群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
地址：106 台北市大安區敦化南路二段 97 號地下二樓
網址：<https://www.capital.com.tw/>
電話：(02)27023999

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師名稱：李典易會計師、謝智政會計師
事務所名稱：資誠聯合會計師事務所
地址：30075 新竹市科學園區工業東三路 2 號 5 樓
網址：<https://www.pwc.tw/zh>
電話：(03)5780205

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：不適用。

六、公司網址

<http://www.gptc.com.tw/>

— 目 錄 —

	頁次
壹、致股東報告書	1
貳、公司簡介	3
一、設立日期	3
二、公司沿革	3
參、公司治理報告	5
一、組織系統	5
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	8
三、公司治理運作情形	18
四、簽證會計師公費資訊	40
五、更換會計師資訊	40
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間	40
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	40
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	41
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	42
肆、募資情形	43
一、資本及股份	43
二、公司債辦理情形	48
三、特別股辦理情形	48
四、海外存託憑證辦理情形	48
五、員工認股權憑證辦理情形	48
六、限制員工權利新股辦理情形	48
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	48
八、資金運用計畫執行情形	48
伍、營運概況	49
一、業務內容	49
二、市場及產銷概況	76
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	87
四、環保支出資訊	87
五、勞資關係	88
六、資通安全管理	89
七、重要契約	90
陸、財務概況	91

— 目 錄 —

	頁次
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表	91
二、最近五年度財務分析	95
三、最近年度財務報告之監察人或審計委員會審查報告	100
四、最近年度財務報告，含會計師查核報告、兩年對照之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及附註或附表	100
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告，但不含重要會計項目明細表	100
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，是否有發生財務週轉困難情事	100
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	221
一、財務狀況	221
二、財務績效	221
三、現金流量	222
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	222
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	223
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估	223
七、其他重要事項	227
捌、特別記載事項	228
一、關係企業相關資料	228
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由及自股款或價款收足後迄資金運用計畫完成，私募有價證券之資金運用情形及計畫執行進度	228
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形	228
四、其他必要補充說明事項	228
玖、對股東權益或證券價格有重大影響之事項	228
附件一 內部控制制度聲明書	235

壹、致股東報告書

各位股東大家好，感謝各位股東對公司的支持，在百忙之中撥空親臨本公司一一三年股東常會。

一一二年度本公司營收跟獲利較上一年度微幅衰退，整體而言成績單相對平穩。

在此感謝全體同仁的辛勞及各位股東及董事的支持與信任，茲就一一二年度經營結果及一一三年營運的展望在此做報告。

一、一一二年度營運報告：

- (一) 營運計劃實施成果(合併財務報告)：本公司一一二年營收淨額為 3,543,994 仟元，較一一一年營收淨額 3,723,376 元，年減 4.82%；一一二年的稅後純益 616,340 仟元，稅後每股盈餘為新台幣 21.56 元，與一一一年的稅後純益 722,106 仟元及稅後每股盈餘新台幣 25.32 元相比較，純益年減 14.65%，每股盈餘年減 14.85%。

2021~2022 年半導體產業需求爆發性成長，高階半導體封裝產業產能同步擴張，然自 2022 年第四季至 2023 年上半年，景氣趨緩，直至 2023 年下半年方顯復甦。因景氣影響需求，本公司一一二年度較前一年度相關獲利數字均稍有衰退。然藉由營運策略持盈保泰，一一二年度成績單尚能維持應有水準。

- (二) 預算執行情形、財務收支及獲利能力分析：

1. 預算執行情形：本公司未編列一一二年度財務預測，故不適用。

2. 財務收支及獲利能力分析：請參閱以下簡表及完整財務報告。

單位：新台幣仟元

項 目		年 度	111 年度	112 年度	增(減)比例
財務收支	營業收入		3,723,376	3,543,994	(4.82%)
	營業毛利		1,617,809	1,487,933	(8.03%)
	稅後淨利		722,106	616,340	(14.65%)
獲利能力 分析	資產報酬率(%)		11.16	8.58	(23.14%)
	股東權益報酬率(%)		22.23	17.49	(21.36%)
	佔實收資本 比率(%)	營業利益	259.88	237.87	(8.47%)
		稅前純益	319.76	256.25	(19.86%)
	純益率(%)		19.39	17.39	(10.33%)
	每股盈餘 (元)		25.32	21.56	(14.85%)

- (三) 研發成果：

1. 本公司針對客戶的 SoIC 製程開發濕式光阻去除設備，挑戰線寬與線距小於 2 μ m 導線光阻去除製程。

由於客戶採用的銅導線之線寬與線距皆小於 2 μ m 且互連密度高，因此製程條件接近前段晶片製造等級。本研發案對於製程精密度與潔淨度要求超越先前研發的封裝製程設備規格。本研發案從：「製程先期模擬測試→製程設備設計與製作→客戶端整機終端驗證」，有助於日後發展半導體前段濕製程設備技術，並強化布局 3D IC 製程與設備的智慧財產權。

本研發案並已申請經濟部科專-「SoIC 濕式銅導線製程設備開發計畫」，計畫期間為 110~112 年，業已經經濟部審核通過。

2. 一一二年度研發成果如下：

- (1) Si Via 濕式蝕刻製程設備開發。
- (2) Frame Wafer 鈦蝕刻製程與設備開發。
- (3) Frame Wafer Polymer 清洗製程與設備開發。
- (4) 無金屬鹽類鈦蝕刻液開發。

(5)先進製程控制系統(FDC)產品開發。

二、一一三年營運計劃概述：

(一)經營方針：

1.銷售計劃：

- (1) 加強與既有國內客戶之配合，並積極開發海外客戶訂單。
- (2) 運用兩岸各服務據點，提供即時售後支援，提昇客戶滿意度。
- (3) 整合既有的產業優勢與供應商，以現有的行銷網路為基礎，強化行銷，提供客戶更完整的服務，為企業創造更多的營收與價值。
- (4) 加強與客戶的互動，隨時掌握客戶產品開發的最新資訊，配合進行相關製程的 DESIGN IN，加快產品之研發、產製速度，創造雙贏的合作模式。
- (5) 以新技術、新製程的應用，開發新領域的客戶。
- (6) 與目前投資、結盟之公司及弘塑集團子公司，透過整合雙方公司/集團關係企業資源，結合彼此技術資源，提升營運效益，以因應未來產業變化，提升競爭優勢。
- (7) 積極尋求國外先進與技術領先的同質性公司進行策略聯盟。

2.生產計劃：

- (1) 與客戶共同開發新製程機台、化學品及關鍵零組件等，朝向產品多元化發展。並且為確保研發成果符合客戶及市場需求，採取與客戶就新產品或製程依客戶需求共同開發。與目前結盟之公司，整合雙方專業，強化研發及技術能力，提升產品競爭力。
- (2) 在與國內許多客戶合作上，皆能於有限時間達交並提供製程解決方案，持續於國內自動化濕式製程設備佔有領先地位。
- (3) 產品交期與售後服務：產品交期與開案速度是能跟客戶緊密合作的關鍵優勢，因應電子產業交期短、良率高之行業特性，能否提供如期、如質之設備乃成為客戶於選擇設備供應商之最重要因素之一。本公司自成立後即投入濕製程設備之研發，為國內最早投入該產品領域之公司，在歷經多年之研究開發工作後，已累積厚實之自有技術專利，加上提供即時且彈性之售後支援服務團隊，可確保滿足客戶所需。

3.產品競爭力：比較美、日等國之國際大廠之產品，本公司生產之產品，已具有品質及價格競爭優勢，並取得業界領導廠商之認可及購置。

(二)預期銷售數量及其依據：

- 1.因本公司未編列一一三年度財務預測，故不予以預測營業額。整體而言係依據產業環境、客戶產品與產能需求、市場供需、競爭狀況而定。
- 2.持續關注總體經濟變化，與集團各子公司、各供應商充分合作，改善關鍵料件交期，妥善完成已接單客戶交機時程，並留意半導體市場資本支出動態與產品的新應用。

(三)重要的產銷政策：

- 1.有效運用現有客戶基礎，共同開發新製程，讓產品線更具多樣化。
- 2.加強工程品質與降低成本一直是公司管理階層與同仁長期努力的目標。透過產品零件標準化，以減少庫存及提高存貨週轉率。
- 3.依業務發展策略，有效規劃產能，提昇產品品質，拓展行銷版圖。

最後敬祝 各位股東
身體健康 萬事如意

董事長

張鴻



敬上

貳、公司簡介

一、設立日期：民國 82 年 5 月 7 日

二、公司沿革：

82 年 5 月：弘塑科技有限公司成立，額定資本額 3,000 仟元，實收資本額 3,000 仟元。

84 年 12 月：辦理現金增資 9,000 仟元，增資後實收資本額為 12,000 仟元。

86 年 11 月：組織型態由有限公司變更為股份有限公司。

86 年 12 月：辦理現金增資 18,000 仟元，增資後實收資本額為 30,000 仟元。

87 年 9 月：辦理現金增資 35,000 仟元，增資後實收資本額為 65,000 仟元。

87 年 12 月：辦理盈餘轉增資 5,000 仟元，增資後實收資本額為 70,000 仟元。

88 年 1 月：經 DNV 認證公司稽核取得 ISO 9002 認證資格。

88 年 9 月：與工研院機械所成功開發出第一台 8 吋單晶圓濕式旋轉清洗設備，符合 0.13um 線寬銅製程所需。

89 年 1 月：辦理現金增資 22,000 仟元，增資後實收資本額為 92,000 仟元。

89 年 4 月：辦理現金增資 58,000 仟元，增資後實收資本額為 150,000 仟元。

89 年 5 月：遷入新廠—新竹縣湖口鄉大同路 13 號。

89 年 9 月：開發出第一套 12 吋全自動濕式晶圓清洗設備及第一套 12 吋單晶圓濕式清洗設備。

89 年 10 月：辦理現金增資 50,000 仟元，增資後實收資本額為 200,000 仟元。

91 年 3 月：經 SGS 認證取得 ISO 9001 資格。

91 年 7 月：投資第三地區公司 Anelva China Semiconductor Equipment Inc.(持股 35.6%)，並經由該公司轉投資設立安內華弘塑（上海）半導體設備有限公司。

92 年 10 月：辦理現金增資 90,000 仟元，增資後實收資本額為 290,000 仟元。

93 年 1 月：投資第三地區公司 Tokyo Kakoki CO., LTD.(持股 40%)，並經由該公司轉投資設立弘塑電子設備（上海）有限公司。

93 年 11 月：開發出第一套銅電鍍(Cu plating)機台。

94 年 9 月：開發出第一套鎳電鍍(Ni plating)機台。

94 年 12 月：出售第三地區投資之 Anelva China Semiconductor Equipment Inc.及 Tokyo Kakoki CO., LTD.。

95 年 8 月：開發出第一套化鍍(electro-less plating)機台。

95 年 10 月：辦理減資彌補虧損 158,527 仟元，減資後實收資本額為 131,473 仟元。

96 年 8 月：辦理盈餘轉增資 13,147 仟元、員工紅利轉增資 4,430 仟元暨現金增資 10,950 仟元，增資後實收資本額為 160,000 仟元。

97 年 5 月：成立 100%持有之香港子公司 Grand Plastic Technology Limited。

97 年 7 月：辦理盈餘轉增資 30,000 仟元暨現金增資 10,000 仟元，增資後實收資本額為 200,000 仟元。

97 年 9 月：證期局核准公開發行，證券代號 3131。

97 年 11 月：經由 100%持有之香港子公司 Grand Plastic Technology Limited 轉投資設立 100%持有之弘懋光電科技(上海)有限公司，註冊資本金為美金伍拾萬元整。

98 年 5 月：獲核准登錄興櫃交易，證券代號 3131。

99 年 2 月：台南辦公室成立。

99 年 3 月：董事會通過買進不動產或土地以作為新廠房之資本支出預算案。

99 年 7 月：因應營運所需，增加租賃湖口實踐路廠房。

99 年 11 月：證券櫃檯買賣中心正式核准通過本公司上櫃案。

100 年 1 月：辦理上櫃現金增資 20,000 仟元，增資後實收資本額為 220,000 仟元，弘塑科技正式掛牌上櫃。

100 年 3 月：成立 GSD 部門(Glass Slimming Division)。

100 年 9 月：正式生產玻璃薄化設備。

100 年 9 月：12 吋酸槽設備取得 Semi S2-0310 與 S8-0308E 產品認證。

101 年 9 月：董事會通過增資發行新股收購添鴻科技股份有限公司。

101 年 9 月：12 吋單晶片旋轉機台取得 Semi S2-0310 與 S8-0310 產品認證。

101 年 10 月：股東臨時會通過增資發行新股收購添鴻科技股份有限公司。

101 年 11 月：公司遷址至新廠-新竹市香山區中華路六段 89 號(現址)。

102 年 1 月：開始依據國際財務報導準則(IFRSs)編制公司合併財務報告。

102 年 1 月：增資發行新股收購添鴻科技股份有限公司，添鴻科技成為弘塑百分之百持有之子公司。增資後實收資本額為 246,838 仟元。

102 年 8 月：董事會通過投資境外公司 AQUA Talent Co.,LTD.美金 45 萬元。

104 年 11 月：董事會通過投資日本 TAZMO CO., LTD. 10.5%股權，投資金額上限為日幣四億伍仟萬元整。

105 年 1 月：子公司添鴻科技董事會通過購置土地用以興建新廠房之資本支出預算案。

105 年 3 月：子公司添鴻科技簽約購置土地用以興建新廠房。

105 年 3 月：董事會通過投資境外公司 AQUA Talent Co.,LTD.美金 55 萬元。

105 年 5 月：開始進行輔導，預計導入 ISO 14001 與 ISO 45001。

105 年 10 月：公司開始出具企業社會責任報告書(GRI/G4)。

106 年 12 月：開始進行 ISO 9001:2015 改版輔導。

107 年 1 月：子公司添鴻科技遷廠完成。

107 年 3 月：董事會通過增資發行新股收購佳霖科技股份有限公司。

107 年 6 月：董事會通過投資 Silicon Valley X-Ray Inc.，投資金額上限為美金伍佰萬元整。

107 年 6 月：股東常會通過增資發行新股收購佳霖科技股份有限公司。

107 年 9 月：取得 ISO 9001:2015 認證。

107 年 11 月：董事會通過投資太引資訊系統股份有限公司，投資金額上限為新台幣 1.85 億元整。

108 年 1 月：取得 ISO 14001 與 ISO 45001 認證。

108 年 3 月：增資發行新股收購佳霖科技股份有限公司，佳霖科技成為弘塑百分之百持有之子公司。增資後實收資本額為 292,160 仟元。

110 年 6 月：集團長期策略發展及內部管理之需要，更換簽證會計師事務所為資誠聯合會計師事務所。

111 年 1 月：子公司添鴻科技獲准進入南部科學園區。

112 年 10 月：弘塑科技二期廠房動工。

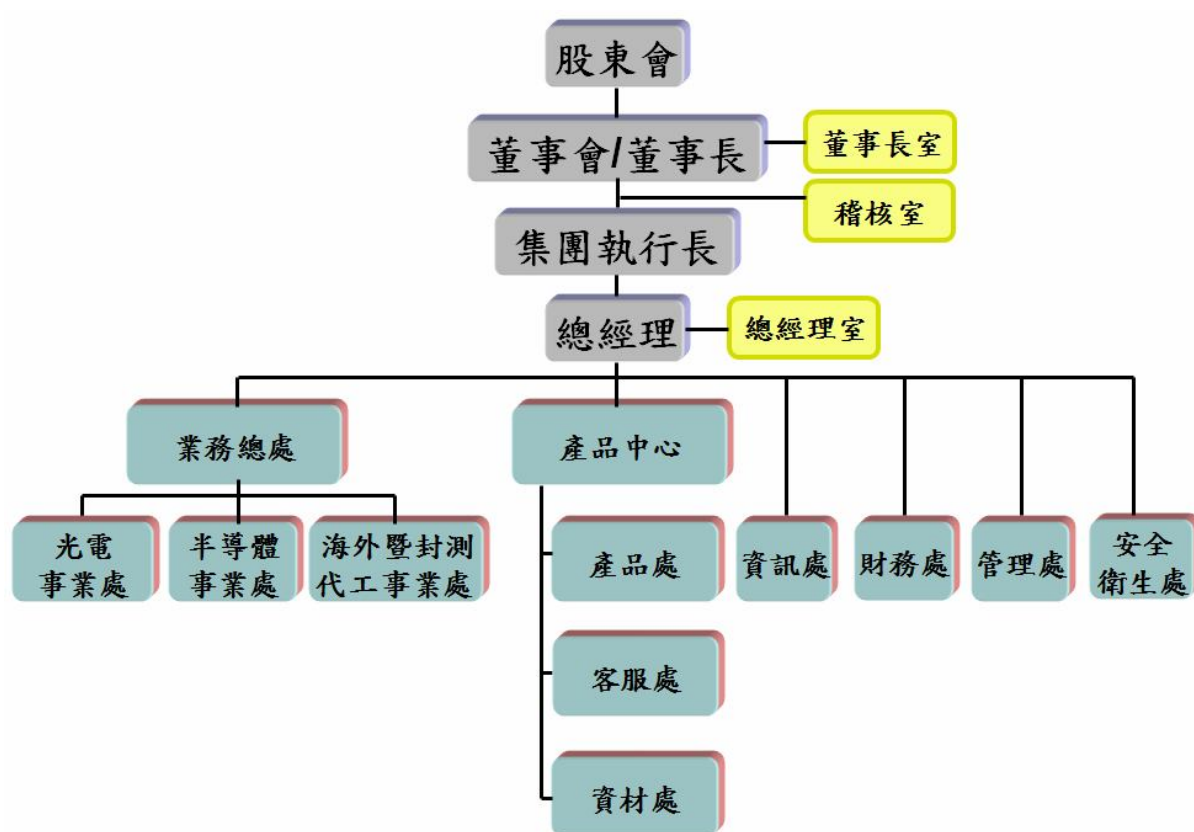
參、公司治理報告

一、組織系統：

(一)組織結構：

弘塑科技股份有限公司

組織圖(113年3月31日)



(二)各主要部門所營業務：

113 年 3 月 31 日

部門	工作執掌
董事長室	◎公司願景及經營策略制度規劃，協助公司營運目標達成。 ◎承股東會及董事會決議與董事長命令綜理本公司一切事務。
總經理室	◎綜合各單位組織業務之執行、協調及核定組織結構與制度規劃，提升營運績效。
稽核室	◎擬訂年度稽核計畫，確實執行並作成稽核報告。 ◎督促各單位辦理自行檢查，覆核各單位之自行檢查報告。 ◎適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施。
業務總處	◎統整三大業務群：半導體事業、海外暨封測代工事業、光電事業，制定行銷策略、業務拓展、產品行銷及營業管理等業務。
半導體事業處	◎負責產品交期之掌握與跟催、協助應收帳款之催收。 ◎負責提供市場發展資訊，導引研發方針與資源配置。 ◎協助產品交貨、產品品質管理、售後服務與客訴事件之處理。
海外暨封測代工事業處	◎負責產品交期之掌握與跟催、協助應收帳款之催收。 ◎協助產品交貨、產品品質管理、售後服務與客訴事件之處理。 ◎國外客戶之業務拓展、產品行銷及客戶關係等業務。 ◎國外客戶之產品交貨及安裝、產品品質管理、售後服務與客訴事件之處理。
光電事業處	◎負責產品交期之掌握與跟催、協助應收帳款之催收。 ◎負責提供市場發展資訊，導引研發方針與資源配置。 ◎協助產品交貨、產品品質管理、售後服務與客訴事件之處理。
產品中心	◎統管產品相關三大部門：產品處、客服處、資材處，暨品保部。 ◎品保部負責產品品質保證事宜，製程品質巡檢、品質優劣原因分析、判定及改善成效追蹤，處理品質異常與客戶抱怨事件；檢測設備的管理與保養、校正。
產品處	◎負責產品技術開發、規格制定、組裝與製造過程品管與專案控管。 ◎負責製程技術改善、產品功能設計改善、下包商之管理與協助客戶產品應用。 ◎協助產品交貨、安裝。 ◎負責廠房管理、無塵室管理等業務。 ◎負責製程技術改善、產品功能設計改善、研發產品新應用。 ◎專利申請、關鍵技術建立、新技術引進與開發、前瞻技術資料之收集與管理。 ◎公司產品之自動化應用程式規劃、軟體開發、程式撰寫與協助客戶產品應用。 ◎研發專案設備相關應用程式之開發。

部門	工作執掌
客服處	◎協助處理品質異常與處理客戶抱怨事件。 ◎協助產品交貨、安裝、售後維修服務，機台維修與備品銷售安裝、管理。
資材處	◎負責產品之生產管控與滿足客戶所需之交期及品質。 ◎負責倉儲、物流管理、存貨庫存管理與盤點。 ◎各項資產、原物料、設備之採購，交期追蹤，與供應商管理等業務。
財務處	◎負責財務資金調配、公司整體預算規劃。 ◎負責建立及維護有關會計管理業務與成本之結算。 ◎每月報表之審核與彙總，各項會計、財務與稅務作業之規劃與執行。
管理處	◎負責公司整體總務、行政服務、固定資產管理等業務。 ◎負責廠房消防及安全、環境清潔、各類修繕。 ◎人力資源管理、人事行政管理、員工薪資福利、教育訓練等事務。 ◎負責人事政策及組織編制之規劃與執行。
資訊處	◎負責公司整體電腦化作業之規劃與推展，電腦軟硬體的規劃、維護。 ◎系統工具導入之評估規劃、執行與管理，資安之規劃、執行與管理。 ◎公司網站平台維護管理。
安全衛生處	◎安全衛生作業之擬訂、規劃、督導及推動安全衛生管理事項。 ◎指導有關部門實施教育訓練、資訊宣導、檢查及檢點並做記錄。 ◎工作環境危險/有害物標示、設備或器具或護具使用管理、施工安全評估、職災等事件調查處理。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一)董事及監察人：

1.董事及監察人資料：

113 年 4 月 21 日 單位：股

職 稱	國 籍 或 註 冊 地	姓 名	性 別 年 齡	選(就)任 日期	任 期	初次選 任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管 、董事或監察人		
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係
董事長	中 華 民 國	張鴻泰	男 61~70	111.06.23	三年	89.05.02	3,625,338	12.41%	3,625,338	12.41%	0	0.00%	詳下之 定業投資	略	北阿拉巴馬州立大學碩士 弘塑科技董事長 佳霖科技董事長	註 1	董事	張泰山	弟
董事	中 華 民 國	石本立	男 51~60	111.06.23	三年	105.06.16	8,000	0.03%	9,000	0.03%	0	0.00%	0	0.00%	政治大學高階主管管理碩士 清華大學材料科學碩士 弘塑科技總經理、董事 新日光能源科技資深處長 旺宏電子處長 弘塑科技總經理	註 2	無	無	無
董事	中 華 民 國	張泰山	男 51~60	111.06.23	三年	111.06.23	10,000	0.03%	15,000	0.05%	10,000	0.03%	0	0.00%	陽明交通大學高階主管管理碩 士(在學中) 中國科技大學土木工程系 弘塑集團董事長特助 佳霖科技副總經理、董事	註 3	董事長	張鴻泰	兄
董事	中 華 民 國	定業投資 代表人： 任克川	男 61~70	111.06.23 111.06.23	三年 三年	111.06.23 111.06.23	2,282,000 0	7.81% 0.00%	2,052,000 0	7.02% 0.00%	0 0	0.00% 0.00%	0 0	0.00% 0.00%	無 美國麻省大學羅爾分校物理學博 士 弘塑科技監察人 漢辰科技總經理 美國應用材料資深處長	無 美商亞舍立科技資 深副總經理	董事長 無	張鴻泰 無	不適用 無
獨立 董事	中 華 民 國	施聖亭	男 51~60	111.06.23	三年	108.06.19	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	北阿拉巴馬州立大學碩士 左右國際董事長 左右設計董事長 左右旅行社董事 長	左右國際董事長 左右設計董事長 左右旅行社董事 長	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	何幼梅	女 51~60	111.06.23	三年	108.06.19	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	交通大學高階主管管理碩士 清華大學材料科學系 應用材料台灣區資深處長 科林研發台灣區總經理	唯峰科技董事	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	陳俊合	男 51~60	111.06.23	三年	111.06.23	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學會計學博士 台灣大學財務金融碩士 中興大學會計系專任副教授	無	無	無	無

註 1：弘塑集團總裁、佳霖科技董事、群呈科技監察人、定業投資董事長、定睿投資董事、Challenge Technology Corp. 董事長、Grand Plastic Technology Limited 董事長。

註 2：弘塑集團執行長、添鴻科技董事長、太引資訊董事長、佳霖科技董事兼總經理、弘懋光電科技(上海)董事長、佳霖電子(上海)董事長、AQUA Talent Co., Ltd. 董事長

註 3：弘塑集團董事長特助、佳霖科技董事長、添鴻科技監察人、群呈科技董事長、定業投資董事、定睿投資董事長、佳霖電子(上海)董事。

2.法人股東之主要股東：

113 年 4 月 21 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例(%)
定業投資股份有限公司	張鴻泰	91.28
	張智翔	2.76
	蘇世玲	2.16
	張竣傑	1.64
	張泰山	1.08
	蔡素滿	1.08

3.主要股東為法人者其主要股東：不適用。

4.董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
張鴻泰	具備商務及公司業務所需之工作經驗，簡歷請參閱董監資料表	為本公司負責人，與董事張泰山為二親等關係人。未有公司法第 30 條各款情事之一；未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
石本立	具備商務及公司業務所需之工作經驗，簡歷請參閱董監資料表	為弘塑集團執行長。未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係；未有公司法第 30 條各款情事之一；未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
張泰山	具備商務及公司業務所需之工作經驗，簡歷請參閱董監資料表	與本公司負責人張鴻泰為二親等關係人。未有公司法第 30 條各款情事之一；未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
任克川	具備商務及公司業務所需之工作經驗，簡歷請參閱董監資料表	為董事代表人。未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係；未有公司法第 30 條各款情事之一。	0
施聖亭	具備商務及公司業務所需之工作經驗，簡歷請參閱董監資料表	擔任獨立董事，符合獨立性： 1.符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所有規定。 2.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 3.未有公司法第 30 條各款情事之一。 4.未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
何幼梅	具備商務及公司業務所需之工作經驗，簡歷請參閱董監資料表	擔任獨立董事，符合獨立性： 1.符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所有規定。 2.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 3.未有公司法第 30 條各款情事之一。 4.未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
陳俊合	具備商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗，且為會計系專任副教授(已退休)，簡歷請參閱董監資料表	擔任獨立董事，符合獨立性： 1.符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所有規定。 2.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 3.未有公司法第 30 條各款情事之一。 4.未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0

5.董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：本公司提倡、尊重董事會多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、各自具有產業經驗（如：科技產業、經營、財務、會計及跨產業...等），以及與相關技能（如：營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理...等）。為強化董事會職能，本公司「董事選舉辦法」載明依「上市上櫃公司治理實務守則」選任，且須具備以下條件：

A.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

B.專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

C.董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力為：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

D.董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事計七位成員，其中女性董事為一位，所有董事平均任期年資約9年，獨立董事平均年資為3年，符合法令規定，年齡組成及學經歷請參閱本年報之董監資料表，其餘多元化資訊請參閱下表：

多元 項目 董監 姓名	基本組成			產業經驗				專業能力			
	國籍	性別	兼任本公司 員工	營運事業 發展	經營 管理	國際 市場	大專院 校講師	商務	法律	會計	風險 管理
張鴻泰	中華民國	男	集團總裁	V	V	V		V			V
石本立	中華民國	男	集團執行長	V	V	V		V			V
張泰山	中華民國	男	集團董事長 特助	V	V	V		V			V
任克川	中華民國	男	無	V	V	V		V			V
施聖亭	中華民國	男	無	V	V	V		V			V
何幼梅	中華民國	女	無	V	V	V		V			V
陳俊合	中華民國	男	無		V	V	V	V	V	V	V

(2)董事會獨立性：本公司獨立董事有三席，占董事總人數七席達43%，關於獨立董事與其他董事之獨立性如下：

A.獨立董事：

三席獨立董事均符合：

- 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所有規定。
- 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- 未有公司法第30條各款情事之一。

d.未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

e.未連續擔任獨立董事超過三屆。

B.其他董事：

a.董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係有二席，其餘則無。

b.未有公司法第 30 條各款情事之一。

c.董事半數非為關係人。

d.董事長與總經理非為同一人，且無相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係。

6.董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施等相關資訊：無此情形。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管：

1.主管資料：

113 年 4 月 21 日，單位：股

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
集團執行長	中華民國	石本立	男	103.01.02	9,000	0.03%	0	0.00%	0	0.00%	政治大學高階主管管理碩士 清華大學材料科學碩士 弘塑科技總經理 新日光能源科技資深處長 旺宏電子處長	詳董事資料附表之附註說明	無	無	無
總經理 產品中心最高主管(兼)	中華民國	黃富源	男	102.05.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中央大學資管所碩士 弘塑科技執行副總經理 星科金朋 Bumping 處副處長 華宸科技工程部課長 台灣積體電路製造蝕刻設備工程師	添鴻科技董事 弘懋光電(上海)監察人	無	無	無
業務總處-總處長 (5/1 升任副總) 半導體事業處主管(兼) 光電事業處主管(兼)	中華民國	梁勝銓	男	100.03.07	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	交通大學工業工程所碩士 弘塑科技半導體事業處處長 台灣積體電路製造採購主任 台灣積體電路製造 IE 工程師	添鴻科技董事	無	無	無
產品處處長	中華民國	張修凱	男	111.04.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	弘塑科技資深經理 中華大學工業管理學系	無	無	無	無
資訊處處長 資材處處長	中華民國	周雲程	男	100.06.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	交通大學高階主管管理碩士 交通大學機械工程系 台灣國際商務機器資訊整合顧問 劍麟公司製造部經理	佳霖科技董事兼副總經理 趨勢照明董事	無	無	無
客服處處長	中華民國	王明忠	男	95.03.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	黎明工專電機科 伯東通商高級工程師 科程科技維修工程師	無	無	無	無
海外暨封測代工事業處處長	中華民國	顏榮偉	男	99.07.20	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	政治大學高階主管管理碩士 中興大學機械工程學系 日月光半導體製造副理 利機企業經理 華泰電子經理	添鴻科技董事	無	無	無

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
財務處處長 公司治理主管	中華民國	曾繁斌	男	99.04.09	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國俄亥俄州立大學企管碩士 中興大學企管系 航欣科技財務長 台精科技處長	添鴻科技監察人 佳霖科技監察人 太引資訊監察人	無	無	無
管理處處長 安全衛生處主管	中華民國	黃志達	男	104.01.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	成功大學企管系 台灣飛利浦電子人資經理 奇美電子(群創)中央人資經理 冠捷科技集團人資副處長	無	無	無	無
稽核室經理 總經理特助	中華民國	莊凱吉	男	97.05.21	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	交通大學工業工程與管理碩士 中原大學會計系 碩達科技稽核室課長 緯晶光電稽核室課長	無	無	無	無

2.總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：無此情形。

(三)最近年度支付董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金

1.一般董事及獨立董事之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)：

單位：新台幣仟元

職稱	姓名(註1)	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註10)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註10)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註11)
		報酬(A)(註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D)(註4)				薪資、獎金及特支費等(E)(註5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註6)						
		本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司		財務報告內所有公司(註7)		本公司	財務報告內所有公司(註7)			
																現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
董事長兼集團總裁	張鴻泰	0	0	0	0	1,709	1,709	0	0	1,709 0.28%	1,709 0.28%	1,690	2,190	0	0	1,477	0	1,477	0	4,876 0.79%	5,376 0.87%	無
董事兼集團執行長	石本立	0	0	0	0	1,709	2,255	0	120	1,709 0.28%	2,375 0.39%	5,998	6,708	108	108	7,987	0	7,987	0	15,803 2.56%	17,178 2.79%	無
董事兼集團董事長特助	張泰山	0	0	0	0	1,709	2,255	0	120	1,709 0.28%	2,375 0.39%	700	4,020	0	108	1,200	0	1,200	0	3,609 0.59%	7,702 1.25%	無
董事	定業投資(股)公司 代表人：任克川	0	0	0	0	1,709	1,709	120	120	1,829 0.30%	1,829 0.30%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,829 0.30%	1,829 0.30%	無
獨立董事	施聖亭	0	0	0	0	1,709	1,709	120	120	1,829 0.30%	1,829 0.30%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,829 0.30%	1,829 0.30%	無
獨立董事	何幼梅	0	0	0	0	1,709	1,709	120	120	1,829 0.30%	1,829 0.30%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,829 0.30%	1,829 0.30%	無
獨立董事	陳俊合	0	0	0	0	1,709	1,709	120	120	1,829 0.30%	1,829 0.30%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,829 0.30%	1,829 0.30%	無

(1)獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：支付獨立董事之酬金係指獨立董事執行業務之報酬或相關費用，依其所擔任之職務權責及其貢獻度，包括投入之心力與時間，並參考同業對於獨立董事水準訂定，尚屬合理。

(2)除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：0元。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司(註 8)	財務報告內所有公司(註 9) H	本公司(註 8)	財務報告內所有公司(註 9) I
低於 1,000,000 元				
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)				
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)				
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)				
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)				
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)				
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)				
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)				
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)				
100,000,000 元以上				
總計	(採個別揭露者，無須填列酬金級距表，故本表不適用)			

註 1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係 112 年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3：係 112 年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 4：係 112 年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 5：係 112 年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 6：係 112 年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)金額。

註 7：應揭露財務報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 9：財務報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 10：稅後純益係指本公司 112 年度個體財務報告之稅後純益新台幣 616,340 仟元。

註 11：酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞及業務執行費用等相關酬金。

2.監察人之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)：本公司設置審計委員會，故不適用。

3.總經理及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)：

單位：新台幣仟元

職稱	姓名 (註 1)	薪資(A) (註 2)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等等(C) (註 3)		員工酬勞金額(D) (註 4)				A、B、C 及 D 等四 項總額及占稅後純 益之比例(%) (註 8)		領取來自子 公司以外轉 投資事業或 母公司酬金 (註 9)
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	本公 司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	本公司		財務報告內所 有公司(註 5)		本公 司	財務報告 內所有公 司 (註 5)	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
集團執行長 總經理	石本立 黃富源	5,688	6,288	216 (提撥)	216 (提撥)	7,669	7,779	13,418	0	13,418	0	26,990 4.38%	27,700 4.49%	無

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註 6)	財務報告內所有公司(註 7) E
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	—	—
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	—	—
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	—	—
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	—	—
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	石本立、黃富源	石本立、黃富源
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	—	—
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	—	—
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	2	2

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係 112 年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係 112 年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係 112 年度總經理及副總經理取得員工酬勞（含股票及現金）金額。

註 5：應揭露財務報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 7：財務報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：稅後純益係指本公司 112 年度個體財務報告之稅後純益新台幣 616,340 仟元。

註9：酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞及業務執行費用等相關酬金。

4.前五位酬金最高主管之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）：

單位：新台幣仟元

職稱	姓名 (註 1)	薪資(A) (註 2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等 (C)(註 3)		員工酬勞金額(D) (註 4)				A、B、 C 及 D 等四項總額及 占稅後純益之比例(%) (註 6)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金 (註 7)
		本公司	財務報告 內所有公 司 (註 5)	本公司	財務報告 內所有公 司 (註 5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	本公司		財務報告內所有 公司(註 5)		本公司	財務報告內 所有公司 (註 5)	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
集團執行長	石本立	3,059	3,659	108	108	2,940	3,050	7,987	0	7,987	0	14,093 2.29%	14,803 2.40%	無
總經理	黃富源	2,629	2,629	108	108	4,729	4,729	5,431	0	5,431	0	12,897 2.09%	12,897 2.09%	無
集團董事長特助	張泰山	600	3,153	0	108	100	867	1,200	0	1,200	0	1,900 0.31%	5,328 0.86%	無
第四、五非經理人														

註1：「前五位酬金最高主管」係指公司經理人，有關經理人之認定標準，依據前財政部證券暨期貨管理委員會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定「經理人」之適用範圍辦理。本表「前五位酬金最高」計算認定原則，係以公司經理人領取來自合併財務報告內所有公司之薪資、退職退休金、獎金及特支費等，以及員工酬勞金額之合計數(亦即A+B+C+D四項總額)，並予以排序後之前五位酬金最高者認定之。經詢問上櫃監理部，僅須揭露前五位酬金最高主管且為經理人之身分，本公司符合經理人身分者計三位。

註2：係112年度前五位酬金最高主管之薪資、職務加給、離職金。

註3：係112年度前五位酬金最高主管各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註4：係112年度前五位酬金最高主管取得員工酬勞（含股票及現金）金額。

註5：應揭露財務報告內所有公司(包括本公司)給付本司前五位酬金最高主管各項酬金之總額。

註6：稅後純益係指本公司112年度個體財務報告之稅後純益新台幣616,340仟元。

註7：酬金係指本公司前五位酬金最高主管擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞及業務執行費用等相關酬金。

5.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元

經 理 人	職稱	姓名	股票金額	現金金額(註1)	總計	總額占稅後純益之比例(%)
	集團總裁	張鴻泰	0	17,337	17,337	2.81%
	集團執行長	石本立				
	集團董事長特助	張泰山				
	總經理	黃富源				
	會計主管	曾繁斌				

註1：係112年度經理人取得員工酬勞（含股票及現金）金額。

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

(1)董事及監察人

本公司 112 及 111 年度支付董事酬金總額占稅後純益比例分別為 2.02%及 2.10%，其酬金係指董監執行業務之報酬或相關費用，不包括兼任員工者所支領之員工薪酬，依其所擔任之職務權責及其貢獻度，並參考同業對於同類職位水準訂定。

(2)總經理及副總經理

本公司 112 及 111 年度支付總經理及副總經理之酬金總額占稅後純益比例分別為 4.38%及 4.03%，其酬金係指薪資、獎金及特支費及員工酬勞，依其所擔任之職位及所承擔的責任，參考同業對於同類職位水準訂定。此外，本公司於年度決算有盈餘可供分派時，依公司章程提撥之員工紅利中，考量其年度工作績效，決定員工紅利之配發數額。

三、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形：

(1)最近年度董事會開會 4 次(A)，董事、監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出席(列)席率(%)【B/A】	備註
董事長	張鴻泰	4	0	100%	
董事	石本立	4	0	100%	
董事	張泰山	4	0	100%	
董事	定業投資股份有限公司 代表人：任克川	3	0	75%	
獨立董事	施聖亭	3	1	75%	
獨立董事	何幼梅	4	0	100%	
獨立董事	陳俊合	3	1	75%	
其他應記載事項：					
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：					
(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：無。					
(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。					
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：本年度尚無發生董事需要利益迴避之議案。					
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：本公司董事會已包括獨立董事三席且依法具備獨立性，符合公司治理。					

(2)董事會評鑑執行情形：112 年度評鑑完成，本公司採自評方式，平均各指標分數介於 4.5~5.0 分之間(指標最低為 1 分、最高為 5 分)。評鑑內容如下表：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	112 年全年度	(1)董事會及董事成員 (2)功能性委員會	(1)董事會內部自評 (2)董事成員自評 (3)委員自評	(1)董事會績效評估：對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。 (2)個別董事成員績效評估：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。 (3)功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

1.審計委員會運作情形：

(1)最近年度審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出席(列)席率(%)【B/A】	備註
獨立董事	陳俊合	4	1	80%	
獨立董事	施聖亭	4	1	80%	
獨立董事	何幼梅	5	0	100%	
其他應記載事項： 一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理： (一)證券交易法第14條之5所列事項：無。 (二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無相關之議案。 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）： (一)本公司113年3月8日審計委員會，與會列席之簽證會計師與獨立董事溝通：關於「112年度查核後與治理單位溝通事項」，會計師依據中華民國審計準則公報第62號「與受查者治理單位之溝通」，同時參酌查核過程中所辨識之重要項目，於本次查核結束後，於113年3月8日與董事會/審計委員會溝通及報告，主要內容包括：1.查核範圍、重大性及擬出具之查核意見書；2.關鍵查核事項說明；3.會計師獨立性；4.審計品質指標(AQIs)，結論為本公司					

職稱	姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出 席次數	實際出(列)席 率(%)【B/A】	備註
查核無內控顯著缺失、會計師於查核過程中，並無與管理階層意見不一致之情形。另外，該次審計委員會，獨立董事評估會計師之獨立性、專業性及適任性，經委員會評估後，簽證會計師事務所具備獨立性、專業性及適任性。 (二)獨立董事參與審計委員會與董事會，定期核閱本公司稽核報告、審查財務營運表冊，每年查核公司內控情況，每季就公司財務、業務狀況進行了解。獨立董事與內部稽核主管及會計師間均以電話或E-mail、通訊軟體方式進行溝通，內部稽核主管及會計師均能充分尊重獨立董事之建議。					

2.監察人參與董事會運作情形：本公司依法設置審計委員會取代監察人職務。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？		V	無。	本公司目前尚未訂定公司治理實務守則，但公司對待股東及對股東權利的尊重與上市上櫃公司治理實務守則的精神一致。公司皆依據相關法規揭露公司重大訊息、定期揭露財務資訊；董事會亦遵照股東賦與之責任，引導公司經營策略、監督經營階層之管理。
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(一) 股東可於股東會提出建議；平時亦有發言人負責相關事宜。 (二) 本公司主要股東大都為本公司董事及經營團隊，每月定期向公司申報持股異動情形。 (三) 本公司訂有「子公司營運管理辦法」與「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」，並依本司內部控制制度辦理，確實執行風險控管及防火牆機制。 (四) 本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(一)本公司董事會成員背景為跨領域專長，並設置獨立董事二席。請參閱本年報段落：參、二、(一)、5.董事會多元化及獨立性。 (二)111年依法設置審計委員會，其他則視情形。 (三)109年度開始施行。 (四)本公司審計委員會會定期評估簽證會計師獨立性之情形，最近一次評估為113年3月8日之會議。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
四、公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		(一)本公司已於112年委任公司治理主管，公司治理相關人員為公司治理主管或董事會指派專人處力相關事務。 (二)董事會及股東會有關之工作為投資人關係專人負責，由董事會指派。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司依規定揭露公司財務業務資訊，本公司往來銀行、債權人、股東、員工、客戶及供應商等利害關係人，可透過本公司發言人(或其指派專人)或各業務窗口瞭解公司營運狀況。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任專業股務代辦機構為群益金鼎證券，辦理股東會事務。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		(一)本公司已架設網路，定期更新與增加其內容。有關本公司財務、業務及公司治理之資訊，均依規定於公開資訊觀測站揭露。 (二)公司網站亦有英文版、設說法說會專區，並已設有專人負責公司資訊蒐集及揭露工作，並已建立發言人制度。 (三)目前公司尚未提早上傳財務報告，已在規劃中。每月營運資訊則在隔月9號上傳，較法定期限提早。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		(一)對公司之員工權益除依勞基法及相關法令辦理並成立職工福利委員會、實施退休金制度外，鼓勵員工參與各項訓練課程與技術研討、規劃員工團體保險及安排定期健康檢查，重視勞工關係，與員工維繫良好互動及溝通。 (二)本公司每季舉辦聚餐(疫情期間則暫停)，每年定期辦理員工健康檢查，員工婚喪喜慶均有補助，員工心聲皆可透過部門主管或是部門職福委員、勞資會議之勞方代表，予以向上反應。 (三)本公司依法及時公告重大訊息於公開資訊觀測站，財務資訊依規定準時申報，攸關投資者之訊息均刊載於年報。本公司已設立發言人及代理發言人，另公司設有股務溝通窗口。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
	V		(四)與供應商溝通管道暢通，執行情形良好。 (五)本公司與關係企業間曾之業務往來，已訂有「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「子公司營運管理辦法」並確實遵循。另本公司制定有「董事會議事規範」，董事對董事會議案如涉及有利害關係時需予以迴避，不得加入討論及表決。 (六)董事及監察人進修之情形：本公司董事均具有專業背景，且依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」持續進修相關課程。最近二年度董事進修情形如下： (1)112 年： a.不實報導、假消息-公司如何做好企業風險管理及危機處理(3 小時)：所有董事。 (2)111 年：因疫情未辦理進修。 (七)本公司業已制定各種內部規章，進行各種風險管理及評估。 (八)本公司已訂有「授信管理辦法」並執行之，並落實執行 ISO 9001 制度中針對客戶權益之程序，例如「售後服務作業程序」、「客戶滿意度調查程序」等，以保障客戶之權益。 (九)公司為董事(董監)購買責任保險之情形：本公司於 99 年 1 月 1 日起，截至本年度及年報刊印年度，持續不間斷，每年度均替董事(董監)購買責任保險，以配合公司治理，強化股東權益之保障。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
九、最近年度之公司治理評鑑結果，已改善情形及就尚未改善項目之優先加強事項與措施。	V		(一)本公司強化網路內容。 (二)本公司自願編制企業社會責任報告書，並上傳公司網站。 (三)本公司提早公告上傳股東會相關資訊，例如股東會年報。 (四)本公司未來擬將強化董事會職能列為優先事項。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。

(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1.本公司薪酬委員會，其組成與成員資料：

身份別 (註 1)	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	施聖亭	具備商務及公司業務所需之工作經驗，相關年資 20 年以上，獨立董事簡歷請參閱董監資料表	身分為獨立董事，符合獨立性： 1.符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所有規定。 2.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 3.未有公司法第 30 條各款情事之一。 4.未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
獨立董事	何幼梅	具備商務及公司業務所需之工作經驗，相關年資 20 年以上，獨立董事簡歷請參閱董監資料表	身分為獨立董事，符合獨立性： 1.符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所有規定。 2.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 3.未有公司法第 30 條各款情事之一。 4.未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
獨立董事	陳俊合	具備商務及公司業務所需之工作經驗，且為會計系專任副教授(已退休)，相關年資 20 年以上，獨立董事簡歷請參閱董監資料表	身分為獨立董事，符合獨立性： 1.符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所有規定。 2.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 3.未有公司法第 30 條各款情事之一。 4.未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0

2.本公司薪酬委員會之職責：

本公司依法於 100 年 10 月 26 日成立薪酬委員會，成員人數為三人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人，目前三位成員均為現任獨立董事。委員會主要職責與運作情形為：(1)以專業客觀之地位，就本公司董事、經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考；(2)審核年度員工酬勞總數是否符合公司章程規範；(3)運作情形為每年至少召開二次會議，但有緊急情事者，不在此限。

3.本公司薪酬委員會運作情形：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：111 年 6 月 27 日至 114 年 6 月 22 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 次，本年度截至年報刊印日止，本公司薪酬委員會開會 1 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	施聖亭	3	0	100	
委員	何幼梅	3	0	100	
委員	陳俊合	3	0	100	
其他應記載事項： 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無相關之議案。 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無相關之議案。					

(五)公司如有設置提名委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：公司無設立。

- 1.本公司提名委員會成員之委任資格條件及其職責：不適用。
- 2.本公司提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：不適用。

(六)推動永續發展執行情形：

1.推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？ (上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)	△		1.本公司於111年開始預備推動永續發展，並由管理處先向一級主管開會說明金管會推動永續發展之時程，具體計畫將於時限前規劃完成並賦以施行，預計永續發展之治理架構將由總經理擔任總召集人，管理處為推動永續發展兼職單位，推行單位為各處級部門、品保部、稽核室。董事會為最高監督指導單位。 2.公司各組織之執行情形(規劃中)： (1)推動永續發展兼職單位：管理處。 (2)設置時點及董事會授權：尚未決定。 (3)推動單位成員之組成：各處級部門、品保部、稽核室。 (4)運作及當年度執行情形：尚未開始。 (5)推動單位向董事會報告：尚未開始。 3.董事會對永續發展之督導情形(管理方針、策略與目標制定、檢討措施等)：尚未開始。	無重大差異。 (△表尚未完全符合)
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？ (上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)	△		1.風險評估之邊界：為本公司，尚未涵蓋子公司。 2.辨別環境、社會、公司治理相關重大性議題之風險管理政策或策略： (1)本公司訂有「風險與機會管理程序」，各部門每年需更新相關計畫表單； (2)在環境面訂有「環境考量面鑑別程序」、「安衛危害鑑別與風險評估程序」等； (3)本公司訂有各項人資管理辦法、資訊管理辦法(如：「資訊保密政策」)等管理制度。 3.風險評估標準、過程、結果：本公司依經營現況，考量外部環境和內部環境與經營目的、策略方向有關、影響管理系統達成預期結果的能力與客戶要求，運用權責分析、管理系統處境分析、利害相關者需求及期望鑑別分析，由各單位執行之。	本公司目前尚未訂定本身之永續發展實務守則，但規劃設置推動永續發展兼職單位，且公司對永續發展的重視與上市上櫃公司永續發展實務守則的精神一致。公司營運符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。 (△表尚未完全符合)

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		1.環境管理制度及所依據之法規：依據本國環保相關法規，本公司訂有「環安衛政策、目標標的與方案管理程序」、「環境考量面鑑別程序」、「廢棄物管制作業規範」、「危害通識計畫」、「化學物質管理作業規範」、「作業環境監測作業規範」...等程序或作業規範。 2.本公司已於108年取得ISO 14001環境管理系統認證，並已於111年完成更新驗證。ISO 14001認證機構：SGS；證書編號：TW19/10072；本認證有效期自111年1月28日至114年1月28日。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		1.本公司為設備商，產製過程屬於低耗能、低耗水，因此管理上的節能政策著重在庶務營運上，例如：使用節能照明、省水龍頭、影印紙雙面使用及運用資訊系統推行無紙化、垃圾減量、落實資源回收、宣導員工落實節能減碳省水、空調定溫...等管理措施。 2.本公司實驗室產生之化學品，均委由合格廠商清運，並訂有「環保承攬商評核管制作業規範」、「廢棄物管制作業規範」。 3.因本公司產業為半導體設備專業製造商，原物料較無法使用再生物料，故亦無相關數據、推動措施、目標及達成情形。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		1.本公司在ISO 14001「環境考量面鑑別程序」訂有針對溫室氣體的評估，如：效益、環境衝擊、風險判定等，將溫室氣體列入風險管理程序。 2.本公司積極推動節能減碳(例如空調)、溫室氣體減量、減少用水、減少廢棄物等管理措施，設備定期維修換新，減少溫室氣體排放。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。

推動項目	執行情形				與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																														
	是	否	摘要說明																																																
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		1.溫室氣體排放量： <table><tr><th rowspan="2">排放量 (單位： 公噸)</th><th colspan="2">直接排放</th><th colspan="2">間接排放/其他</th></tr><tr><th>排放量</th><th>比例(%)</th><th>排放量</th><th>比例(%)</th></tr><tr><td>112 年度</td><td>60</td><td>1.35</td><td>4,400</td><td>98.65</td></tr><tr><td>111 年度</td><td>17</td><td>1.56</td><td>1,070</td><td>98.44</td></tr></table> 111年為自行盤查，故差異較大。 2.用水量： <table><tr><th>控管項目 (單位：噸)</th><th>112 年度</th><th>111 年度</th></tr><tr><td>自來水用水量</td><td>4,108</td><td>4,761</td></tr><tr><td>生活污水</td><td>1,318</td><td>1,239</td></tr><tr><td>回收水</td><td>1,006</td><td>1,215</td></tr></table> 3.廢棄物： <table><tr><th>項目 (單位：噸)</th><th>112 年度</th><th>111 年度</th></tr><tr><td>員工生活垃圾</td><td>30.58</td><td>28.32</td></tr><tr><td>資源性廢棄物</td><td>4.37</td><td>8.83</td></tr><tr><td>一般性事業廢棄物</td><td>13.39</td><td>12.17</td></tr><tr><td>有害性事業廢棄物</td><td>106.26</td><td>103.47</td></tr></table> 4.管理政策：本公司在ISO 14001「環安衛政策、目標標的與方案管理程序」、「環境考量面鑑別程序」、「廢棄物管制作業規範」訂有相關風險評估、目標、措施等。 5.驗證情形：無。		排放量 (單位： 公噸)	直接排放		間接排放/其他		排放量	比例(%)	排放量	比例(%)	112 年度	60	1.35	4,400	98.65	111 年度	17	1.56	1,070	98.44	控管項目 (單位：噸)	112 年度	111 年度	自來水用水量	4,108	4,761	生活污水	1,318	1,239	回收水	1,006	1,215	項目 (單位：噸)	112 年度	111 年度	員工生活垃圾	30.58	28.32	資源性廢棄物	4.37	8.83	一般性事業廢棄物	13.39	12.17	有害性事業廢棄物	106.26	103.47	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。
排放量 (單位： 公噸)	直接排放		間接排放/其他																																																
	排放量	比例(%)	排放量	比例(%)																																															
112 年度	60	1.35	4,400	98.65																																															
111 年度	17	1.56	1,070	98.44																																															
控管項目 (單位：噸)	112 年度	111 年度																																																	
自來水用水量	4,108	4,761																																																	
生活污水	1,318	1,239																																																	
回收水	1,006	1,215																																																	
項目 (單位：噸)	112 年度	111 年度																																																	
員工生活垃圾	30.58	28.32																																																	
資源性廢棄物	4.37	8.83																																																	
一般性事業廢棄物	13.39	12.17																																																	
有害性事業廢棄物	106.26	103.47																																																	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		1.本公司依據現行法令例如勞動基準法、就業服務法、性別工作平等法等相關勞動法規，及參照國際人權公約標準，已訂定各項人事管理規則及員工工作規則，並依法辦理員工勞工保險、全民健康保險及退休金事宜。另依據性騷擾防治法及性別工作平等法訂定「性騷擾防治措施暨申訴作業辦法」，提供員工免於性騷擾之工作及服務環境。 2.本公司訂有「員工意見申訴及處理作業準則」，提供員工申訴管道，維護同仁權益，確保每位員工能受到平等對待與尊重。		符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。																																														

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		1. 本公司訂有各項符合法令或優於法令之福利措施：休假制度(例如帶薪的疫苗接種假)、健康保險、勞工保險、提撥勞工退休準備金、員工團保、年節及績效獎金、員工教育訓練計劃、員工子女獎學金、人身及意外保險、定期健康檢查、職工福利委員會提供各項獎金與津貼、員工進修與訓練(包含補貼或免費的外訓)、依法計算加班費(非施行工作責任制)...等。 2. 職場多元化與平等：本公司女性員工約佔三成，優於科技業水平；經理級以上員工人數計24位，其中女性為4位，占比為16.7%，比例偏低，係因本公司產業屬性為設備業之故。員工依據「績效管理作業準則」、「晉升管理辦法」，能有公平晉升機會。 3. 本公司依據年度營運績效，每年固定調薪及提撥/發放年度員工酬勞；依據每季營運狀況，發放季獎金；固定發放2個月年終獎金(保障年薪14個月)。參照金管會發布之上市櫃公司員工薪酬數據，本公司員工薪酬優於同業水平、非擔任主管之員工薪酬亦優於同業水平，將半導體產業成長帶來的營收/獲利成長，實質回饋到同仁薪酬。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		1. 本公司辦理員工定期健康檢查，訂有「公傷慰問作業程序」、「員工團體保險辦法」、「安全衛生工作守則/作業規範」、「勞工健康保護作業規範」、「健康管理與健康促進計畫」、「工作場所母性健康保護計畫」...等管理辦法，提供員工安全與健康的工作環境。本公司訂有「教育訓練作業程序」，新進同仁於報到日即進行教育訓練，對其宣導相關措施並需考核通過；一般同仁則施以不定期教育訓練，或由環安衛專責部門不定期宣導周知。 2. 本公司已於108年取得ISO 45001職業健康與安全管理系統認證，並已於111年完成更新驗證。ISO 45001認證機構：SGS；證書編號：TW19/10071；本認證有效期自111年1月28日至114年1月28日。 3. 本公司112年員工職災有0件/0人次，由環安衛專責部門不定期宣導員工應注意相關勞工健康安全。 4. 本公司遵行職業安全衛生法暨相關法令；每月均配合內政部職業安全衛生署規定，實行醫護人員之臨廠服務(護理師：每月2次；醫生：每季1次)措施。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
	V		5.本公司112年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率均為0。因應火災之相關改善措施：不適用。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		1.本公司訂有「教育訓練作業程序」，內容涵蓋新人訓練、專業進修、主管訓練、及『接班人計劃/導師制度/儲備管理人才』，搭配「績效管理作業準則」、「晉升管理辦法」，注重員工在公司的職涯能力發展與培訓。 2.本公司訂有「獎懲規定」，敘明員工對公司之貢獻，以功獎方式/獎金加成，實際回饋給員工。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		1.產品與服務：本公司於91年即取得ISO 9001品質管理系統認證，並已於110年完成更新驗證。ISO 9001認證機構：SGS；證書編號：TW06/03178；本認證有效期自110年9月21日至113年9月7日。 2.本公司目前的ISO 9001品質管理系統認證為最新版ISO 9001:2015，涵蓋產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示...等構面，例如產品實現，即包括鑑別客戶要求、產品要求的審查、與客戶的溝通(例如「客訴管制作業程序」、「客戶滿意度調查程序」、「售後服務作業程序」等)。 3.本公司之產品並非銷售予終端消費者，故並無須訂定相關消費者保護之管理辦法。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		1.本公司訂有「原物料採購作業程序」、「供應廠商評鑑與考核作業程序」、「環保承攬商評核管制作業規範」、「承攬商環安衛管理作業規範」，重視供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等範疇的落實。 2.公司定期對供應商考評。 3.通過相關評鑑之新進供應商，例如通過ISO相關評鑑、或產品優良之評鑑，優先列入合格供應商名錄。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	△		公司自願編制111年「永續報告書」，並已上傳本公司網站。然報告書並未委請第三方單位驗證。112年「永續報告書」預計於113年下半年完成。	無重大差異。 (△表尚未完全符合)
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司目前尚未訂定本身之永續發展實務守則，但公司對永續發展的重視與上市上櫃公司永續發展實務守則的精神一致。本公司本於尊重社會倫理與注意其他利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理與營運。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：請參照下表「2.永續發展執行情形補充說明」。				

2. 永續發展執行情形補充說明：

永續發展執行項目	執行情形			已執行情形或規劃情形之具體說明
	未執行	已執行	規劃中	
1.人權				
(1)符合勞基法等勞工相關法令規定		V		本公司依據勞動基準法制定「員工上班須知」，以及訂定任用招募、獎懲、離職、退休、陞遷等管理辦法。本公司定期或不定期舉辦勞資會議。
(2)其他(如維護員工及應徵者之就業機會平等、確保員工免於騷擾及歧視等)		V		本公司每年定期召開人評會，審核員工晉升，並訂定有「性騷擾防治措施暨申訴作業辦法」、「員工滿意度調查程序」等管理辦法。本公司招募員工，對於應徵者之就業機會，均遵循勞動基準法、性別工作平等法等相關法令。
2.員工權益				
(1)提供員工充分之教育訓練		V		本公司新人報到時均接受新人教育訓練，本公司訂定有「教育訓練作業程序」，針對在職員工工作上所需之技能或個人之自我發展，每年編列有教育訓練預算與員工教育訓練計畫，且皆能達到有效的執行度。
(2)提供員工充分反應意見之權利		V		本公司對公司員工設有意見管道由專人處理員工對公司的建言並將意見反應至上層。
(3)其他(如職業安全衛生管理系統方面經 ISO 45001 或相關機構之認證、提供員工合理之福利與報酬等)		V		1.本公司員工薪資符合法令最低工資之規定，且公司員工之福利與報酬，管理者皆能參照同業予以適當調整。本公司並在金融海嘯、COVID-19 等失業率攀升之氛圍下，充分響應政府就業政策，不動輒以資遣員工為手段。而在半導體景氣復甦之際，以增聘員工為實際作為，提高就業率。 2.本公司成立「安全衛生處」，專責人員負責維護與改善勞工職業安全衛生。 3.本公司已於 108 年取得 ISO 14001 與 ISO 45001 之認證，並已於 111 年完成更新驗證。ISO 45001 認證機構：SGS；證書編號：TW19/10071；本次證書有效起迄：111/01/28~114/01/28。
3.僱員關懷				
(1)確保工作環境之安全		V		本公司訂定有「安全衛生工作守則」、「無塵室進出管理程序」等管理辦法，管理單位確實監督員工遵循。對於工作環境、設備儀器、有害物質的管理，遵守相關環保法規，保障員工工作上的安全與健康。本公司已於 108 年取得 ISO 14001 與 ISO 45001 之認證。
(2)訂定書面之勞工衛生安全相關政策		V		本公司訂定有「安全衛生工作守則」、「緊急應變組織作業程序」等管理辦法。
(3)其他(如重視勞工身心發展及家庭生活等)		V		1.本公司依法提撥勞退金，繳納勞保費、健保費，並辦理員工團保，若發生職災時可以增加保障員工。 2.本公司每年提供員工免費健檢，每年讓員工自行編列教育訓練計畫。 3.本公司依法成立職工福利委員會，定期辦理聚餐，表揚資深員工。不定期辦理球類運動、旅遊踏青，補助員工婚喪喜慶，發放三節禮券或禮金。
4.環保				
(1)訂定書面環保政策		V		本公司訂定有「廢棄物處理作業管理程序」與「危害物質分類及圖示指導作業程序」等管理辦法。

永續發展執行項目	執行情形			已執行情形或規劃情形之具體說明
	未執行	已執行	規劃中	
(2)遵行環保相關法令		V		本公司對內除落實遵循管理辦法外，對外遵守環保法令規定，一般廢棄物與事業廢棄物均委託合法業者清運並訂有委任契約。
(3)其他(如發展節能、減污及防污之技術、設備及活動；資源之再利用、廢棄物回收及減量、有害物質的禁用等)		V		本公司除積極配合法令及政府政策外，對內提倡省電、省水節約能源及 5S 環境政策以響應環保。委任之廢棄物清運業者均能協助資源之回收分類與再利用。本公司已於 108 年取得 ISO 14001 認證。
5.社區參與				
(1)參與社區服務及慈善活動		V		本公司鼓勵員工參與社區公益或慈善活動，或擔任志工。
(2)其他(如實行社區援助及投資【包括人力、物力、知識及技能等】、確保社區健康與安全等)		V		本公司鼓勵員工實行社區援助及捐助，例如本公司董事長以身作則固定每年捐款予不特定單位，例如：新竹女中、文昌國中、新竹縣峨眉國小、竹東高中、新竹高中家長會等機關團體。
6.社會貢獻				
(1)捐助慈善事業及教育、醫療、藝術等活動		V		1.本公司不定期捐款予下列機構：喜憨兒社福基金會、陽光基金會、人安基金會、華山基金會、仁愛社會福利基金會等社福團體。 2.本公司定期/不定期捐款予學術機構，例如新竹地區國小、苗栗幼安教養院、北一女、新竹市西門國小。 3.本公司董事長固定每年捐款予不特定單位，例如：嘉義聖心教養院、法鼓山佛教基金會、台東天主教聖母醫院、新竹市天主教仁愛社會福利基金會、蘋果日報慈善基金、伊甸社會福利基金會、家扶中心、中華民國紅十字會等社福團體。
(2)其他(如援助落後地區國家、提供弱勢團體就業機會等)		V		本公司董事長固定每年捐款予不特定單位，例如：好好好家庭教育基金會、龍潭啟智教養院、海鷗春陽文教基金會、TVBS 關懷台灣文教基金會、周大觀文教基金會、財團法人犯罪被害人保護協會等社福團體。
7.社會服務				
(1)推動社會福利		V		本公司鼓勵員工擔任義工或志工，並鼓勵員工參加社福團體的公開活動。
(2)其他		V		無。
8.投資者關係				
(1)提高營運透明度		V		1.本公司已架設網路，定期更新與增加其內容。有關本公司財務、業務及公司治理之資訊，均依規定於公開資訊觀測站揭露。 2.本公司已設有專人負責公司資訊蒐集及揭露工作，並已建立發言人制度。
(2)重視公司治理		V		1.公司皆依據相關法規揭露公司重大訊息、定期揭露財務資訊；董事會亦遵照股東賦與之責任，引導公司經營策略、監督經營階層之管理。 2.本公司七席董事中，設置有獨立董事三席且符合法令規範之獨立性。 3.本公司每季均召開董事會，並制定有「董事會議事規範」，董事對董事會議案如涉及利害關係時需予以迴避，不得加入討論及表決。 4.本公司於 99 年 1 月 1 日起替董事(及監察人)購買責任保險，迄今均未中斷，以配合公

永續發展執行項目	執行情形			已執行情形或規劃情形之具體說明
	未執行	已執行	規劃中	
				司治理，強化股東權益之保障。
(3)其他		V		本公司已設有發言人、代理發言人及股務窗口，確保股東權益與對應事宜。
9.供應商關係				
(1)重視採購價格之合理性		V		本公司與往來供應商皆能保持良好的關係和互動。本公司請購、採購流程均落實詢、比、議價，並訂有「供應廠商評鑑與考核作業程序」，定期對供應商考核。
(2)其他		V		本公司訂有「採購作業程序」。
10.與利害關係人之權益				
(1)尊重智慧財產權		V		本公司尊重他人之智慧財產權，截至目前為止並無侵權之情事。
(2)重視與顧客之關係(如保護消費者權益、重視產品品質、安全性及創新、重視並立即處理客訴、提供完整產品資訊等)		V		1.本公司重視成品檢驗、不合格品管制等品質程序。 2.本公司落實執行 ISO 9001 制度中針對客戶權益之程序，例如「客戶滿意度調查程序」，以保障客戶之權益。 3.本公司訂有「售後服務作業程序」、「客訴管制作業程序」，及時處理售後服務或客訴事件，以保障客戶之權益與維持與客戶之良好關係。
(3)遵守法令規範		V		本公司業已制定各種內部規章與管理辦法，均能遵守相關法令之規定。
(4)其他(如於公司網站揭露永續發展政策之執行情形等)		V		本公司網站已放置相關資訊。
11.其他		V		無。

(七)上市上櫃公司氣候相關資訊：

1.氣候相關資訊執行情形：

項 目	執 行 情 形
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	1.本公司於 111 年 6 月 27 日董事會通過「溫室氣體盤查計畫書」，因本公司主要業務為設備組裝、設備代理、化學品混酸，氣候變遷對公司營運風險與機會較無直接影響，未來將視產業變化，董事會與管理階層持續關注本議題。
2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	2.如上述 1.，氣候變遷產生之風險與機會對公司之業務、策略及財務等尚無重大影響。
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	3.因本公司營運位置於台灣本島，極端氣候發生機率甚低，故應無影響。
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	4.氣候風險對公司營運影響甚低，故尚無相關風險管理制度。
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	5.無此情形。
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	6.無此情形。
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說	7.無此情形。

項 目	執 行 情 形
明價格制定基礎。	
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	8.尚無設定相關目標。
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	請參閱下一段落之說明。

2.溫室氣體盤查及確信情形：本公司實收資本額未達五十億元，依法應自民國 115 年起完成盤查資訊揭露，117 年起完成確信資訊揭露，故本表暫不適用。

(八)公司履行誠信經營情形及採行措施：

1.履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		已執行，本公司具體之政策均已訂立在公司之各項管理辦法。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		已執行，本公司具體之政策均已訂立在公司之各項管理辦法。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		已執行，本公司具體之政策均已訂立在公司之各項管理辦法。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		已執行，本公司具體之政策均已訂立在公司之各項管理辦法。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		已執行，本公司具體之政策均已訂立在公司之各項管理辦法。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		已執行，本公司具體之政策均已訂立在公司之各項管理辦法。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		已執行，本公司具體之政策均已訂立在公司之各項管理辦法。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		已執行，本公司具體之政策均已訂立在公司之各項管理辦法。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		已執行，本公司具體之政策均已訂立在公司之人事管理辦法。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		已執行，本公司具體之政策均已訂立在公司之人事管理辦法。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		已執行，本公司具體之政策均已訂立在公司之人事管理辦法。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？		V	本公司目前尚未將誠信經營相關資訊揭露於公司網站。	本公司目前尚未將誠信經營相關資訊揭露於公司網站，但本公司對誠信經營的重視與上市上櫃公司一致。未來將視公司營運所需，改善後，將符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司目前尚未訂定本身之誠信經營守則，但公司對誠信經營責任的重視與上市上櫃公司誠信經營守則的精神一致。本公司本於誠信經營之精神，在追求永續經營與獲利之同時，亦將其納入公司管理與營運。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）：無。				

(九) 公司治理守則及相關規章查詢方式：本公司尚未訂定公司治理守則及相關規章，未來將視公司營運狀況之需要適時訂定之。

(十) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

1. 公司治理主管、經理人參與公司治理有關之進修與訓練：

(1) 經理人兼任董事者，參加 112 年度董事持續進修課程。

(2) 管理處主管兼任安衛主管，參加在職教育訓練課程。

(3) 112 年新任公司治理主管，參加初任公司治理主管進修課程。

2. 與財務資訊透明有關人員，其取得主管機關指明之相關證照：

(1) 會計主管：發行人證券商證券交易所會計主管合格證書、112 年會計主管持續進修合格證書。

(2) 會計主管代理人：112 年會計主管持續進修合格證書。

(3) 內部稽核主管：國際內部稽核師證書、中華民國內部稽核師證書、112 年稽核人員持續進修合格證書。

(4) 內部稽核代理人：公開發行公司內部稽核人員初任合格證書、112 年稽核人員持續進修合格證書。

3. 員工行為或倫理守則：本公司訂有員工守則與獎懲規定等管理辦法。

4. 內部重大資訊處理作業程序：本公司訂有「財務及非財務資訊管理辦法」、「財務報表編製管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」等管理辦法。

5. 公司董事會評估簽證會計師獨立性：

(1) 112 年會計師獨立性及適任性評估結果：本公司之簽證會計師具備獨立性及專業適任性。

(2)本公司 112 年簽證會計師：資誠聯合會計師事務所李典易會計師、謝智政會計師。

(3)會計師工作內容：每季財報核閱、年度財報簽證、不定期財務稅務諮詢服務。

(4)董事會/審計委員會依據審計品質指標(AQIs)與會計師法第 47 條、會計師職業道德規範第 10 號公報等，本年度評估結果如下：

項次	評估項目	是	否
1.	截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。	✓	
2.	與委託人無重大財務利害關係。	✓	
3.	避免與委託人有任何不適當關係。	✓	
4.	會計師應使其助理人員確守誠實、公正及獨立性。	✓	
5.	執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	✓	
6.	會計師名義不得為他人使用。	✓	
7.	未握有本公司及關係企業之股份。	✓	
8.	未與本公司及關係企業有金錢借貸之情事。	✓	
9.	未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。	✓	
10.	未兼任本公司或關係企業之經常工作，支領固定薪酬。	✓	
11.	未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。	✓	
12.	未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	✓	
13.	與本公司管理階層人員無配偶或二親等以內之親屬關係。	✓	
14.	未收取任何與業務有關之佣金。	✓	
15.	截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事。	✓	

6.公司董事會/審計委員會參考審計品質指標(AQIs)每年定期評估簽證會計師過程如下：

會計師依據中華民國審計準則公報第 62 號「與受查者治理單位之溝通」，同時參酌查核過程中所辨識之重要項目，於本次查核結束後，於 113 年 3 月 8 日與董事會/審計委員會溝通及報告，主要內容包括：1.查核範圍、重大性及擬出具之查核意見書；2.關鍵查核事項說明；3.會計師獨立性；4.審計品質指標(AQIs)。公司董事會/審計委員會並據以評估，本年度會計師符合獨立性、專業性及適任性。

(十一)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1.內部控制制度聲明書：請參閱附件一第 235 頁。

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.一一二年股東常會(112.06.21)重要決議內容及執行情形

項次	重 要 決 議 事 項	執 行 情 形
1	(報告案)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案。	不適用。
2	(報告案)一一一年度營業報告。	不適用。
3	(報告案)審計委員會審查報告。	不適用。
4	(報告案)一一一年度現金股利分派情形案。	配發股東現金股利每股 18 元，共 525,888,270 元，並已於 112 年 8 月 25 日發放完畢。
5	(承認案)一一一年度營業報告書暨財務報告案。	照案表決通過(贊成 97.54%)。
6	(承認案)一一一年度盈餘分配案。	照案表決通過(贊成 96.68%)。

2.一一二年度及截至年報刊印日止董事會之重要決議

日 期	會 議	重 要 決 議 事 項
112.03.20	第十一屆第四次董事會	- 通過一一一年度員工酬勞、董監酬勞。 - 通過一一一年度營業報告書暨財務報告。 - 通過一一一年度盈餘分配案。 - 通過一一一年度內部控制制度聲明書。 - 通過一一二年度預算案。 - 通過出售 TAZMO CO., LTD.股票案。 - 通過對子公司添鴻科技向玉山銀行申請之綜合額度背書保證案。 - 通過對子公司太引資訊向玉山銀行申請之綜合額度背書保證案。 - 通過對子公司佳霖電子(上海)向華南銀行申請之綜合額度背書保證案。 - 通過對子公司添鴻化學科技(上海)向臺灣土地銀行上海分行申請之綜合額度背書保證案。 11~13.分別通過土地銀行/玉山銀行/元大銀行融資案。 - 通過一一二年股東常會召開事宜。 - 通過一一二年股東常會受理股東提案作業。
112.05.08	第十一屆第五次董事會	- 通過一一二年第一季度財務報告。 - 通過新任公司治理主管之委任及報酬案。 - 通過弘懋光電科技(上海)營業執照展延案。 4~5.分別通過對子公司添鴻科技向華南銀行/土地銀行申請之綜合額度背書保證案。 - 通過對子公司太引資訊向華南銀行申請之綜合額度背書保證案。
112.08.07	第十一屆第六次董事會	- 通過一一二年第二季財務報告。 - 通過國泰世華銀行融資案。 - 通過對子公司添鴻科技向彰化銀行申請之綜合額度背書保證案。 - 通過對子公司太引資訊向國泰世華商業銀行申請之綜合額度背書保證案。

日期	會議	重要決議事項
112.11.06	第十一屆第七次董事會	1. 通過一一二年度第三季財務報告。 2. 通過一一三年度稽核計畫。 3~5.分別通過對子公司添鴻科技向兆豐銀行/元大銀行/玉山銀行申請之綜合額度背書保證案。 6. 通過對子公司太引資訊向玉山銀行申請之綜合額度背書保證案。 7~8.分別通過對子公司添鴻化學科技(上海)向兆豐銀行蘇州/華南銀行上海申請之放款額度背書保證案。 9. 通過華南銀行融資案。 10.通過玉山銀行綜合融資及出口押匯額度案。 11.興建二期廠房之總預算追加案。
113.03.08	第十一屆第八次董事會	1. 通過新任集團執行長、新任總經理之委任及報酬追認案。 2. 通過改派子公司佳霖科技董事追認案。 3. 通過一一三年度財務報表簽證會計師委任案。 4. 通過一一二年度員工酬勞、董監酬勞。 5. 通過一一二年度營業報告書暨財務報告。 6. 通過一一二年度盈餘分配案。 7. 通過一一二年度內部控制制度聲明書。 8. 通過一一三年度預算案。 9. 通過對子公司太引資訊向兆豐銀行申請之中期放款額度背書保證案。 10.通過對子公司佳霖電子(上海)向華南銀行申請之綜合額度背書保證案。 11.通過對子公司添鴻化學科技(上海)向臺灣土地銀行上海分行申請之貸款額度背書保證案。 12~13.分別通過土地銀行/元大銀行融資/出口押匯額度案。 14.通過一一三年股東常會召開事宜。 15.通過一一三年股東常會受理股東提案作業。

(十四)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十五)最近年度及截至年報刊印日止，公司如有證券交易法第 14 條之 3 或其他獨立董事有反對或保留意見之議案、證券交易法第 14 條之 5 或其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

(十六)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無。

四、簽證會計師公費資訊：

(一)簽證會計師公費資訊：

金額單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	李典易 謝智政	112.01.01~ 112.12.31	2,022	150	2,172	無
		合計	2,022	150	2,172	

(二)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：不適用。

(三)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。

(四)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：112 年審計公費 2,022 仟元，111 年為 2,040 仟元，故無此情形。

五、更換會計師資訊：無此情形。

(一)關於前任會計師：不適用。

(二)關於繼任會計師：不適用。

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無此情形。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

職 稱	姓 名	112 年度		113 年度截至 4 月 21 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長兼大股東	張鴻泰	0	0	0	0
董事兼集團執行長	石本立	0	0	0	0
董事	張泰山	0	0	0	0
董事	定業投資(股)公司	(145,000)	0	(130,000)	0
獨立董事	施聖亭	0	0	0	0
獨立董事	何幼梅	0	0	0	0
獨立董事	陳俊合	0	0	0	0
總經理	黃富源	0	0	0	0
會計部門主管	曾繁斌	0	0	0	0

(二)股權移轉資訊：最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事、監察人、經理人及持股比例超過 10%之股東，無股權移轉之交易相對人屬於關係人身分之情形。

(三)股權質押資訊：最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事、監察人、經理人及持股比例超過 10%之股東，無股權質押情形。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

113 年 4 月 21 日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱或姓名	關係	
張鴻泰	3,625,338	12.41%	0	0.00%	2,052,000	7.02%	定業投資 定睿投資 群呈科技	張鴻泰擔任定業投資董事長 張鴻泰擔任定睿投資董事 張鴻泰擔任群呈科技監察人	
定業投資(股)公司	2,052,000	7.02%	0	0.00%	0	0.00%	張鴻泰	張鴻泰擔任定業投資董事長 張鴻泰以股作價成立定業投資	
群呈科技(股)公司	1,387,351	4.75%	0	0.00%	0	0.00%	張鴻泰	張鴻泰擔任群呈科技監察人	
定睿投資(股)公司	1,341,819	4.59%	0	0.00%	0	0.00%	張鴻泰	張鴻泰擔任定睿投資董事	
匯豐(台灣)商銀受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶	746,800	2.56%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
華南商銀信託部受託保管安聯台灣科技證券投資信託基金專戶	691,000	2.37%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
王月霞	532,000	1.82%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
富邦人壽保險(股)公司	455,000	1.56%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
凱基人壽保險(股)公司	410,000	1.40%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
馬德麟	402,000	1.38%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

單位：仟股；113 年 4 月 21 日

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Grand Plastic Technology Limited	600	100.00%	0	0%	600	100.00%
添鴻科技股份有限公司	10,000	100.00%	0	0%	10,000	100.00%
佳霖科技股份有限公司	20,000	100.00%	0	0%	20,000	100.00%
太引資訊系統股份有限公司	2,831	78.10%	0	0%	2,831	78.10%
弘懋光電科技(上海)有限公司	不適用	0%	不適用	100.00% (註 1)	不適用	100.00% (註 1)
AQUA TALENT CO., LTD.	0	0%	350	100.00% (註 2)	350	100.00% (註 2)
添鴻化學科技(上海)有限公司	不適用	0%	不適用	100.00% (註 3)	不適用	100.00% (註 3)
Challenge Technology Corp.	0	0%	1,000	100.00% (註 4)	1,000	100.00% (註 4)
佳霖電子(上海)有限公司	不適用	0%	不適用	100.00% (註 5)	不適用	100.00% (註 5)
太引信息科技(南京)有限公司	不適用	0%	不適用	100.00% (註 6)	不適用	100.00% (註 6)

註 1：弘懋光電科技(上海)係 Grand Plastic Technology Limited 100%持股之子公司。

註 2：AQUA TALENT CO., LTD. 係添鴻科技 100%持股之子公司。

註 3：添鴻化學科技(上海) 係 AQUA TALENT CO., LTD. 100%持股之子公司。

註 4：Challenge Technology Corp. 係佳霖科技 100%持股之子公司。

註 5：佳霖電子(上海) 係 Challenge Technology Corp. 100%持股之子公司。

註 6：太引信息科技(南京)係太引資訊系統 100%持股之子公司。

肆、募資情形

一、資本及股份：

(一)股本來源：

1.股本形成經過：

單位：新台幣仟元/仟股；113年4月21日

年 月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源(仟元)	以現金以外之財產抵充股款者	其他
82年05月(註一)	—	—	3,000	—	3,000	創立募集 3,000	無	註二
84年12月(註一)	—	—	12,000	—	12,000	現金增資 9,000	無	註三
86年12月	10	3,000	30,000	3,000	30,000	現金增資 18,000	無	註四
87年09月	12	7,000	70,000	6,500	65,000	現金增資 35,000	無	註五
87年12月	10	7,000	70,000	7,000	70,000	盈餘轉增資 5,000	無	註六
89年01月	14	9,200	92,000	9,200	92,000	現金增資 22,000	無	註七
89年04月	14	15,000	150,000	15,000	150,000	現金增資 58,000	無	註八
89年10月	20	20,000	200,000	20,000	200,000	現金增資 50,000	無	註九
92年10月	10	30,000	300,000	29,000	290,000	現金增資 90,000	無	註十
95年10月	10	30,000	300,000	13,147	131,473	減資彌補虧損(158,527)	無	註十一
96年08月	10	30,000	300,000	16,000	160,000	現金增資 10,950 盈餘轉增資 17,577	無	註十二
97年07月	20	30,000	300,000	20,000	200,000	現金增資 10,000 盈餘轉增資 30,000	無	註十三
100年01月	62	30,000	300,000	22,000	220,000	現金增資 20,000	無	註十四
102年01月	74.52	30,000	300,000	24,684	246,838	增資發行新股 26,838 用以合併添鴻科技	無	註十五
108年03月	167.69	30,000	300,000	29,216	292,160	增資發行新股 45,322 用以合併佳霖科技	無	註十六
110年07月	—	50,000	500,000	29,216	292,160	不適用(僅提高核定股本)	無	註十七

註一：86年11月以前組織型態為有限公司。

註二：核准日期及文號：82.05.07 八二建三丁字第二九〇五六一號。

註三：核准日期及文號：84.12.15 八四建三庚字第四七七四五號。

註四：核准日期及文號：86.12.26 八六建三庚字第二八六二八二號。

註五：核准日期及文號：87.09.29 經(〇八七)商字第〇八七一三〇二四四號。

註六：核准日期及文號：87.12.16 經(〇八七)商字第〇八七一四〇八五四號。

註七：核准日期及文號：89.01.05 經(〇八九)中字第八九三五七六七八號。

註八：核准日期及文號：89.04.12 經(〇八九)商字第〇八九一一〇九六三號。

註九：核准日期及文號：89.10.21 經(〇八九)商字第〇八九一三八八一八號。

註十：核准日期及文號：92.10.01 經授中字第〇九二三二七三九〇一〇號。

註十一：核准日期及文號：95.10.16 經授中字第〇九五三二九九二三三〇號。

註十二：核准日期及文號：96.08.16 經授中字第〇九六三二六二三七八〇號。

註十三：核准日期及文號：97.07.11 經授中字第〇九七三二六六一七六一〇號。

註十四：核准日期及文號：100.01.24 經授中字第 10031587690 號。

註十五：核准日期及文號：102.01.30 經授中字第 10233119500 號。

註十六：核准日期及文號：108.03.12 經授中字第 10833144720 號。

註十七：核准日期及文號：110.07.14 經授中字第 11033422550 號。

2.已發行股份種類：

單位：股

股 種	份 類	核定股本			備註
		流 通 在 外 股 份	未發行股份	合計	
普	通	29,216,015	20,783,985	50,000,000	

3.總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)股東結構：

113 年 4 月 21 日

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	外國機構 及 外 人	個 人	合 計
人 數	3	111	272	87	13,844	14,317
持 有 股 數	314,630	8,528,600	6,294,027	3,298,068	10,780,690	29,216,015
持 股 比 例	1.08%	29.19%	21.54%	11.29%	36.90%	100.00%

1.第一上市（櫃）公司及興櫃公司應揭露其陸資持股比例：不適用。

(三)股權分散情形：

113 年 4 月 21 日

持 股 分 級	股 東 人 數	持 有 股 數	持 股 比 例
1 至 999	12,413	250,657	0.86%
1,000 至 5,000	1,558	2,478,831	8.48%
5,001 至 10,000	109	867,803	2.97%
10,001 至 15,000	45	577,610	1.98%
15,001 至 20,000	43	778,303	2.66%
20,001 至 30,000	26	639,602	2.19%
30,001 至 40,000	16	580,750	1.99%
40,001 至 50,000	20	893,092	3.06%
50,001 至 100,000	37	2,675,177	9.16%
100,001 至 200,000	22	3,081,882	10.55%
200,001 至 400,000	18	4,749,000	16.26%
400,001 至 600,000	4	1,799,000	6.15%
600,001 至 800,000	2	1,437,800	4.92%
800,001 至 1,000,000	0	0	0.00%
1,000,001 以上	4	8,406,508	28.77%
合 計	14,317	29,216,015	100.00%

(四)特別股持股分級表：無此情形。

(五)主要股東名單：

持股比例達百分之五以上之股東或或股權比例占前十名之股東

113 年 4 月 21 日

主要股東名稱	股 份	持 有 股 數	持 股 比 例
張鴻泰		3,625,338	12.41%
定業投資股份有限公司		2,052,000	7.02%
群呈科技股份有限公司		1,387,351	4.75%
定睿投資股份有限公司		1,341,819	4.59%
匯豐(台灣)商銀受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶		746,800	2.56%
華南商銀信託部受託保管安聯台灣科技證券投資信託基金專戶		691,000	2.37%
王月霞		532,000	1.82%
富邦人壽保險(股)公司		455,000	1.56%
凱基人壽保險(股)公司		410,000	1.40%
馬德麟		402,000	1.38%

(六)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料：

單位：新台幣元；仟股

項目 \ 年度		111 年 (112 年分配)	112 年 (113 年分配)	刊印年度截至 3 月 31 日止
每股市價	最 高	385	714	1075
	最 低	171.5	223.5	525
	平 均(加權)	261.27	520.41	797.86(註 8)
每股淨值	分 配 前	115.30	125.99	註 3
	分 配 後	97.30	109.99(註 1)	不適用(註 4)
每股盈餘	加權平均股數	28,521	28,636	註 3
	每 股 盈 餘	25.32	21.56(註 2)	註 3
每股股利	現 金 股 利	18	16	不適用(註 4)
	無償	0	0	不適用(註 4)
	配股	0	0	不適用(註 4)
	累積未付股利	0	0	0
投資報酬分析	本益比	10.54	24.14	不適用(註 5)
	本利比	14.82	32.53	不適用(註 6)
	現金股利殖利率	6.75%	3.07%	不適用(註 7)

註 1：112 年分配後之每股淨值，係經董事會決議通過，將列為 113 年 6 月 19 日股東常會報告案之調整後數字。

註 2：112 年每股盈餘為 21.56 元，盈餘分配係經董事會決議通過，將列為 113 年 6 月 19 日股東常會報告案。

註 3：截至年報刊印日止，第一季財務報告尚未經會計師核閱完成。

註 4：因 114 年方會決定 113 年股利數字，故不適用。

註 5：本益比=股價/每股盈餘，係以 113 年第一季之平均市價，除以第一季每股盈餘換算全年度計算而得，因截至年報刊印日止，第一季財務報告尚未經會計師核閱完成，故不適用。

註 6：本利比=市價/每股現金股利，因 114 年方會決定 113 年股利數字，故不適用。

註 7：現金股利殖利率=每股現金股利/每股股價，因 114 年方會決定 113 年股利數字，故不適用。

註 8：為今年 1/1~3/31 均價(加權平均)。

(七)公司股利政策及執行狀況：

1.公司章程所訂之股利政策：

本公司股東紅利分派得以現金或股票方式發放，惟股東現金紅利分派之比例以不低於股東紅利總額之百分之一為原則，惟此現金紅利分派比例仍得視當年度營運狀況調整之。

本公司所屬產業正處於成長階段，分派股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。

2.董事會最近五年度實際之股利政策：

本公司最近五年度(108~112 年)實際配息率分別為：75%、81%、74%、73%、76%，且全數配發現金。顧及股東權益報酬率及股本膨脹速度，本公司原則上股利分派之政策：(1)考量股東權益，配息率原則介於當年度可供分配盈餘之 50%~75%(所謂當年度可供分配盈餘，不包含以前年度未分配盈餘)，優於多數上市櫃公司。(2)現金股利與股票股利之比例，若無其他重大營運規畫，原則上以前述(1)之全額 100%配發現金股利為主，避免過度膨脹股本。

3.本次股東會擬議股利分派之情形：

本公司 112 年盈餘分配案，業經 113 年 3 月 8 日第十一屆第八次董事會中通過，如下表所示。依據本公司章程及經濟部函釋，本案僅發放現金股利，則由董事會授權董事長決定除息基準日等相關事宜，現金股利分派情形將列為 113 年 6 月 19 日股東常會報告案。本案其他調整項目，將列為 113 年 6 月 19 日股東常會承認案。

一一二年度盈餘分配表

項 目	金額	備 註
期初可供分配盈餘	806,795,460	
當年度-112 年稅後淨利	616,339,553	
加(減)：精算(損)益列入保留盈餘	2,341,506	確定福利計畫精算利益
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	126,486,885	
當年度可供分配盈餘	745,167,944	
減：提列 10%法定盈餘公積	(74,516,794)	
截至 112 年可供分配盈餘	1,477,446,610	
分配項目：		
股東現金股利	467,456,240	每股現金 16 元
期末未分配盈餘	1,009,990,370	

(八)本年度擬議之無償配股對公司營運績效及每股盈餘之影響：

112 年度盈餘分配案不擬配發股東股票股利與員工股票酬勞，故並無對公司營運績效及每股盈餘造成影響。

另依有關準則規定，本公司尚無須公佈財務預測，故本項不適用。

(九)員工、董事及監察人酬勞：

1.公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司當年度如有獲利，應提撥員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；並以當年度獲利數額，由董事會決議提撥董事酬勞；前開所稱獲利，係指稅前利益尚未扣除員工酬勞與董事酬勞。員工酬勞不得低於百分之七點五，董事酬勞不得高於百分之三。若尚有累積虧損時，應先保留彌補虧損數額，尚有餘額時再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

2.本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

112 年度之員工酬勞、董事酬勞，均與 112 年度帳上估列數一致。本期之估列基礎，除依據公司章程之規定外，尚考量當年度產業狀況、公司營運情形，以及參考以前年度之實際配發金額。

112 年度不擬配發員工股票酬勞，故並無實際配發金額與估列數有差異之情形。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1)決議以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額：

本公司 112 年員工酬勞及董事酬勞，業經 113 年 3 月 8 日第十一屆第八次董事會中決議通過，員工酬勞現金 59,823,952 元及董事酬勞 11,964,792 元。本案將送 113 年 6 月 19 日股東常會報告。

112 年度之員工酬勞、董事酬勞均與認列費用年度 112 年度帳上估列數一致。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：

本公司 112 年度之員工酬勞不擬配發股票，故不適用。

4.前一年度(111 年度)員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司 111 年員工酬勞及董事酬勞，業於 112 年 6 月 21 日股東常會報告，員工酬勞現金 73,676,800 元及董事酬勞 14,735,360 元，實際配發情形與股東常會報告相同。

111 年度之員工酬勞、董監酬勞均與認列費用年度 111 年度帳上估列數一致。

111 年度未配發員工股票紅利，故並無實際發放數與帳上估列數產生差異之情形。

(十)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：

(一)最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股者，應揭露事項：無。

(二)最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者，應揭露執行情形及被併購或受讓公司之基本資料。辦理中之併購或受讓他公司股份發行新股應揭露執行情形及對股東權益之影響：無。

八、資金運用計畫執行情形：

(一)計畫內容：

1.截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者，應詳細說明前開各次發行或私募有價證券計畫內容，包括歷次變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因、變更前後效益及變更計畫提報股東會之日期，並應刊載輸入本會指定資訊申報網站之日期：本公司截至年報刊印日之前一季止，尚無發生計畫未完成，或計畫已完成但效益尚未顯現之情形，故本項不適用。

(二)執行情形：

- 1.本年度及截至年報刊印日之前一季止，各次發行或私募有價證計畫之用途，逐項分析其執行情形及與原預計效益之比較：無。
- 2.本年度及截至年報刊印日之前一季止，各次發行或私募有價證計畫執行進度或效益未達預計目標者，應具體說明其原因、對股東權益之影響及改進計畫：無。
- 3.本年度及截至年報刊印日之前一季止，如為併購或受讓其他公司、擴建或新建不動產、廠房及設備者，應就不動產、廠房及設備、營業收入、營業成本及營業利益等項目予以比較說明：無。
- 4.本年度及截至年報刊印日之前一季止，如為轉投資其他公司，應就該轉投資事業之營運情形、對公司投資損益之影響加以說明：無。
- 5.本年度及截至年報刊印日之前一季止，如為充實營運資金、償還債務者，應就流動資產、流動負債及負債總額之增減情形、利息支出、營業收入等科目及每股盈餘予以比較說明，並分析財務結構：無。

伍、營運概況

一、業務內容：

(一)業務範圍：

1.所營業務之主要內容：

半導體及積體電路製造設備之工程承包、製造、買賣及維修工程；半導體相關之機械安裝、電子零組件製造、代理業務。

2.主要產品之營業比重：

服務項目 商品產值	112 年度	
	營業額(仟元)	營業比重(%)
機台設備產品	1,507,948	42.55
化學產品	873,441	24.65
半導體及電子設備銷售代理	985,792	27.81
維修服務及其他	116,587	3.29
軟體銷售及安裝	60,226	1.70
合 計	3,543,994	100.00

3.公司目前之商品(服務)項目：

A.機台設備產品：單晶圓旋轉設備(Single Wafer Spin Processor)、批次式酸槽設備(Batch type Wet Bench System)、複合式製程設備(Combo System)...等，依製程應用可分為清洗、顯影、蝕刻及去光阻...等；另外尚有化學品調配供應系統(Chemical Supply System)等設備。

B.化學產品：工業級、試藥級、電子級混酸（蝕刻液）、電鑄藥液等等。

C.維修服務及其他：半導體及積體電路製造設備之維修及其材料、零件之代理及買賣業務。

D.軟體銷售及安裝。

E.半導體及電子設備銷售代理。

4.計畫開發(或已開發)之新商品(服務)項目：

本公司秉持提供客戶客製化及高品質之產品為原則，近年主要目標仍以持續改善原有之單晶圓旋轉設備、批次式酸槽設備、複合式製程設備等設備產品為主。隨著 3D IC 構裝技術之發展，發展功能達到與國外無電鍍鎳金設備商相同水準之 3D IC 無電鍍金屬化鍍製程設備；及整合型扇型封裝(InFO)；Square Fanout 封裝設備等。

主要發展方向如下：

研 發 項 目	用 途 說 明
3D IC 無電鍍金屬化 鍍製程設備	化鍍 Ni, Pb, Au 及 Au。
製程設備新應用研 發	因應客戶新製程所需，例如：Square Fanout UBM Etcher、Square Fanout RP Stripper、UFO 300 4CH Al/Ti UBM Etchin。
玻璃薄化設備/邊緣 強化	採用濕式製程，同時去除玻璃兩面之特定厚度，以達玻璃減薄之需求；採用濕式製程，強化玻璃之邊緣。
LED 特殊製程設備	採用濕式製程，以高溫磷酸製程應用於上游磊晶製程需求為主。

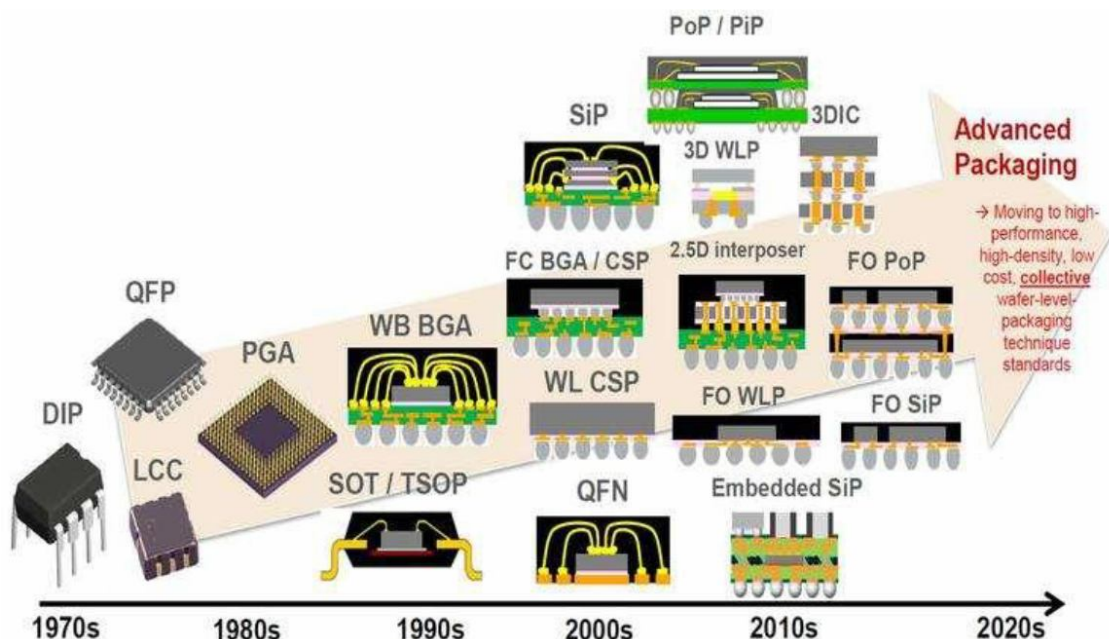
(二)產業概況：

1.產業之現況與發展：

(a)先進封裝技術漸成主流，帶來新製程設備商機

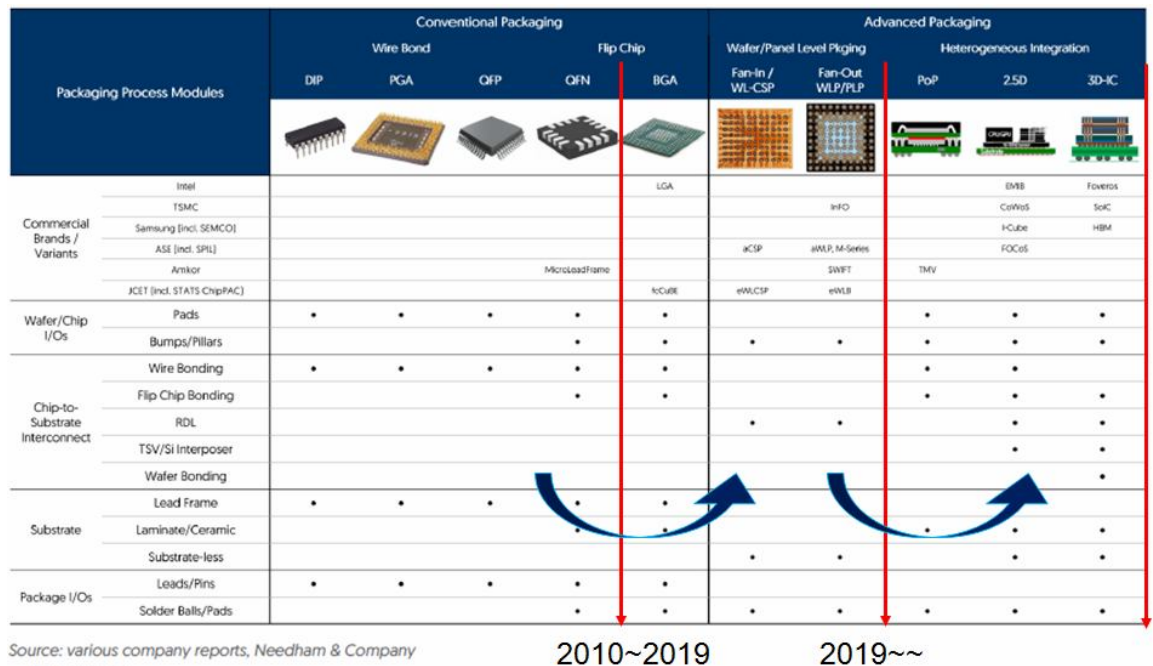
半導體產品在由二維向三維發展，從技術發展方向，半導體產品出現了系統級封裝(SiP)等新的封裝方式，從技術實現方法出現了覆晶(Flip Chip)，凸塊(Bumping)，晶圓級封裝(Wafer Level Package)，2.5D 封裝(interposer, RDL等)，3D 封裝(TSV)...等先進封裝技術(圖 1、圖 2)。隨著摩爾定律的放緩，半導體行業逐漸步入後摩爾時代，SiP 的優勢在靈活性更高，更廣泛的兼容兼容性，成本更低，生產周期更短。面積小的產品，SiP 更有優勢，靈活性較高。以下就封裝技術面簡介之。

圖 1 封裝技術發展歷程-1



資料來源：Yole Developpement (2020/02)

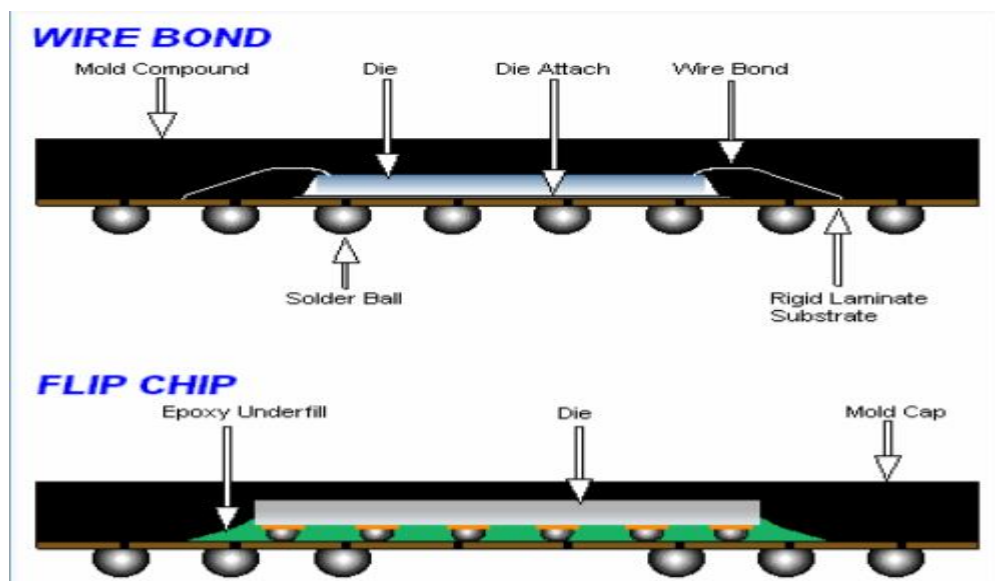
圖 2 封裝技術發展歷程-2



(a)-1 覆晶(Flip Chip) & 凸塊(Bumping)

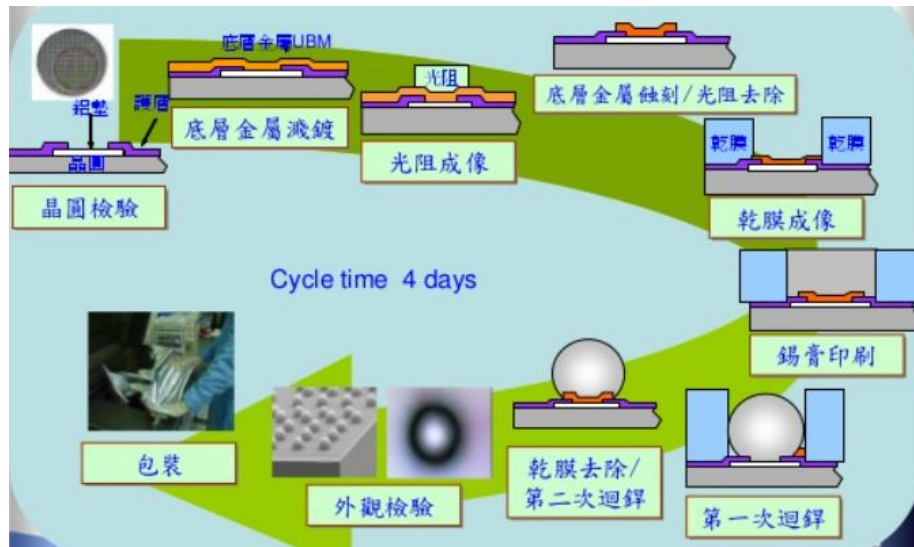
覆晶(Flip Chip)指的是晶片倒裝，以往的封裝技術都是將晶片的有源區面朝上，背對基板並貼後鍵合。而 Flip Chip 則將晶片有源區面對著基板，通過晶片上呈陣列排列的焊料凸點 (Bumping) 實現晶片與襯底的互聯。矽片直接以倒扣方式安裝到 PCB 從矽片向四周引出 I/O，互聯長度大大縮短，減小了 RC (Resistance-Capacitance) 延遲，有效的提高了電性能(圖 3)。Flip Chip 的優勢主要在於以下幾點：小尺寸，功能增強 (增加 I/O 數量)，性能增強 (互聯短)，提高了可靠性 (倒裝晶片可減少 2/3 的互聯引腳數)，提高了散熱能力 (晶片背面可以有效進行冷卻)。

圖 3 覆晶(Flip Chip)圖示



凸塊(Bumping)是一種新型的晶片與基板間電氣互聯的方式。可以通過小的球形導電材料實現，這種導電球體被稱為 Bump，製作導電球這一工序被稱為 Bumping。當黏有 Bump 的晶粒被覆晶(Flip Chip)並與基板對齊時，晶粒便很容易的實現了與基板 Pad(觸墊)的連接(圖 4)。相比傳統的引線連接，Flip-Chip 有著諸多的優勢，比如更小的封裝尺寸與更快的器件速度。

圖 4 凸塊(Bumping)製程圖示

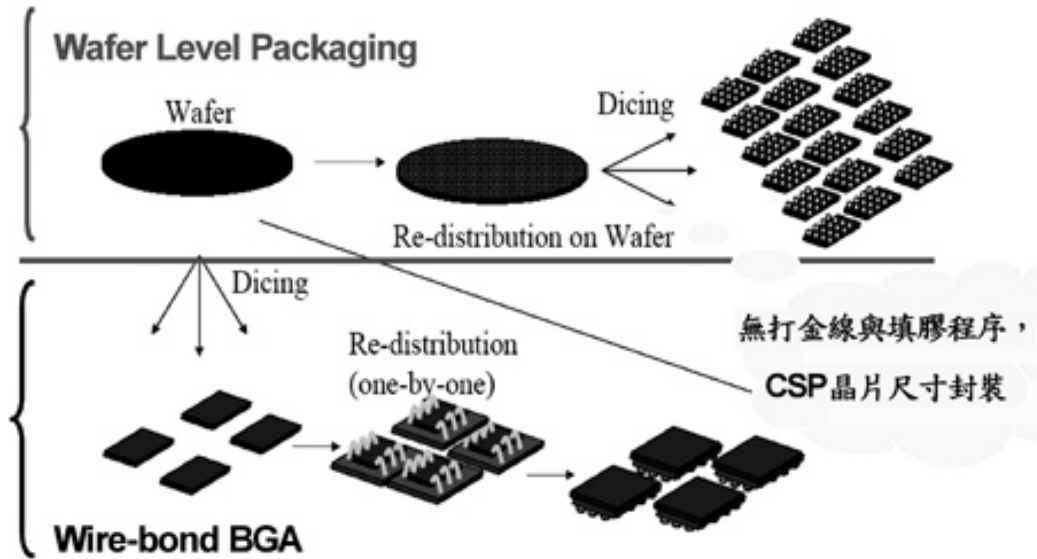


(a)-2 晶圓級封裝(Wafer-Level Package, WLP)

在傳統封裝概念中，晶圓是先被切割成小的晶粒，之後再進行連接和塑封，而晶圓級封裝(Wafer-Level Package, WLP)工序恰好相反，晶圓級封裝將晶粒在被切割前封裝完成，保護層將會被附著在晶圓的正面或是背面，電路連接在切割前已經完成。晶圓級封裝可滿足電子產品對功耗、成本與輕薄短小等多項要求，尤其在微機電元件應用日益普及下，更將成為晶圓級封裝產業成長的主要推手，因而吸引專業晶圓製造與封測代工業者大舉投入。

所謂晶圓級封裝是直接在晶圓上進行全部或大多數的封裝測試程序後，再進行切割(Singulation)製成單顆元件(圖 5)，因此毋須經過打線與填膠程序，而且封裝後的晶片尺寸等同晶粒原來大小，因此也稱為晶圓級晶片尺寸封裝(Wafer-Level Chip Scale Package, WLCSP)。

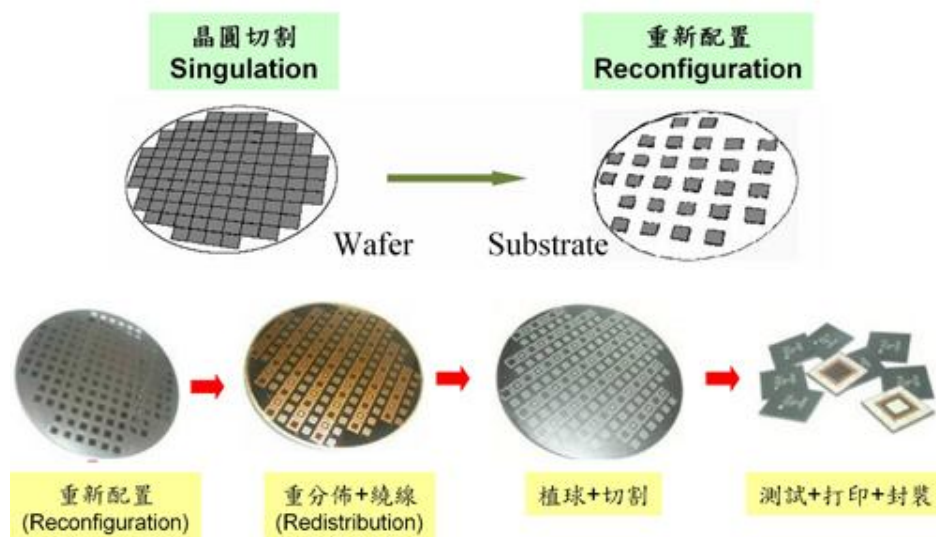
圖 5 晶圓級封裝製造流程



資料來源：Georgia Institute of Technology，IBT Research 整理

理論上，晶圓級封裝由於不需要中介層(Interposer)、填充物(Underfill)與導線架，並且省略黏晶、打線等製程，因此能夠大幅減少材料以及人工成本；除此之外，WLP 大多採用重新分布(Redistribution)與凸塊(Bumping)技術(圖 6)作為 I/O 繞線手段，因此 WLP 具有較小的封裝尺寸與較佳電性表現的優勢，目前多見於強調輕薄短小特性的可攜式電子產品 IC 封裝應用。

圖 6 英飛凌擴散型晶圓級封裝製造流程

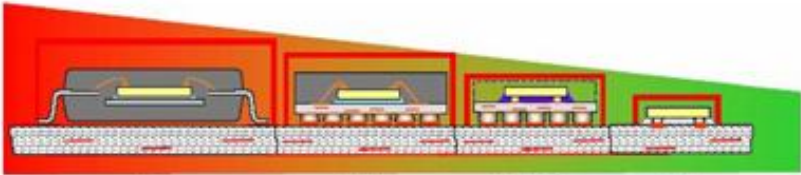


資料來源：Infineon，IBT Research 整理

以 WLP 初期發展而言，WLP 的主要應用範圍為類比 IC、手機放大器(PA)與射頻前端模組(RF Front-end)，以及 CMOS 影像感測器(CMOS Image Sensor, CIS)等各式半導體產品(圖 7)，其需求主要來自於可攜式產品對輕薄短小特性的要求，而部分 NOR Flash/SRAM 也採用 WLP 封裝。此外，基於電氣性能考量，DDR III 也採用 WLP 或覆晶(Flip Chip)封裝，海力士(Hynix)於 2007 年 1 月曾經發表採 WLP 封裝的 2Gb DDR II，而三星(Samsung)與爾必達(Elpida)等國際大廠實際銷售產品仍都為細密球型網陣列封裝(Fine-pitch Ball

Grid Array, FBGA)。至於系統級封裝(SiP)應用則屬於長期發展目標。

圖 7 各種封裝型態比較

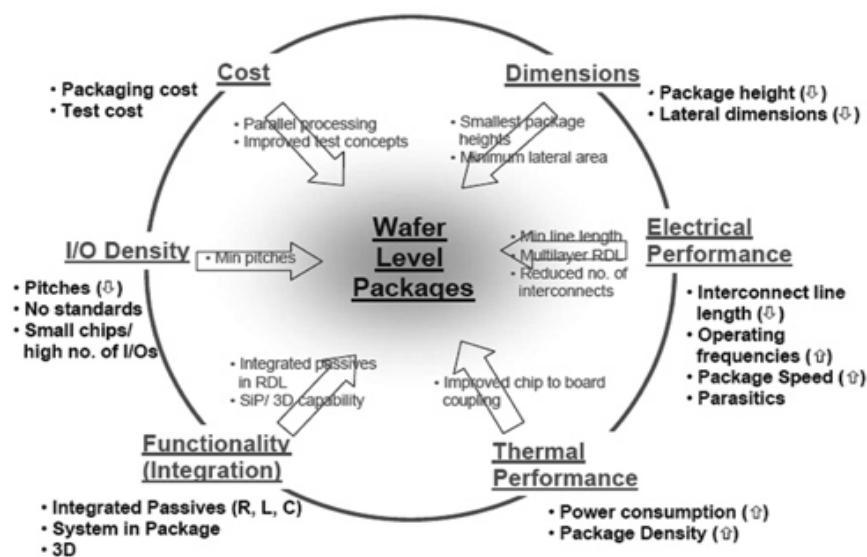


Family	QFP	BGA	FC-BGA	WLP
1st level IC	wire bond	wire bond	solder ball	none
interposer 中介層	lead frame	substrate	substrate	thin-film
2nd level IC	lead frame	solder ball	solder ball	solder ball
面積 # SI : # PCB	<1:3	<1:2	<1:1,5	1:1
高度 ⌀ Pck : ⌀ SI (X)	>3,5	>2,5	>2,5	≤2

資料來源：Infineon，IBT Research 整理

WLP 封裝優點(圖 8)包括成本低、散熱佳、電性優良、信賴度高，且為晶片尺寸型封裝，尺寸與厚度皆可達到更小要求等。WLP 封裝另一項優勢在於封裝製程採取整批作業，因此晶圓尺寸越大，批次封裝數量越多，成本能壓得更低，符合晶圓廠由 8 吋轉進 12 吋發展趨勢，WLP 專業封測廠利潤空間也可提高。

圖 8 晶圓級封裝主要優點



資料來源：Infineon，IBT Research 整理

早期 WLP 主要廠商包括具有一貫化整合製造優勢的整合元件製造商 (IDM)，如意法半導體(STMicroelectronics)，以及具有凸塊技術與產能優勢的封測委外代工廠(OSAT)，如日月光，以及聚焦 WLP 技術的專業封測廠如台積電與豪威(OmniVision)合資的精材科技，最大股東為 SST 的育需科技(2012 年 群豐科技轉投資之公司群成科技與育需科技合併，育需為消滅公司)，以及長江電子(長江電子另外亦與新加坡 APS 合資成立江陰長電先進封裝)與

IPAC(Integrated Packaging Assembly Corporation)等廠商。

根據工研院 IEK 產業分析整理之資料，由江蘇長江電子和新加坡 APS 合資的江陰長電先進封裝(已於 2015 年合併星科金朋(新加坡 STATS ChipPAC))，已擁有 12 吋晶圓凸塊量產能力，而除了江陰長電外，目前全球具備 12 吋晶圓錫銀銅凸塊產能的廠商有數家，台積電產能位居第一，日月光、矽品、艾克爾(Amkor)、南茂、台星科(已於 2015 年合併星科金朋在台子公司台灣星科)和耐派斯(Nepes)(韓國)，都具備 12 吋晶圓凸塊量產能力。

由於 IDM 對於 WLP 封裝中電鍍與薄膜等製程關鍵技術的掌握度，要比半導體專業委外封測廠商來得成熟，因此目前 WLP 封裝市場多半是以 IDM 業者為主。

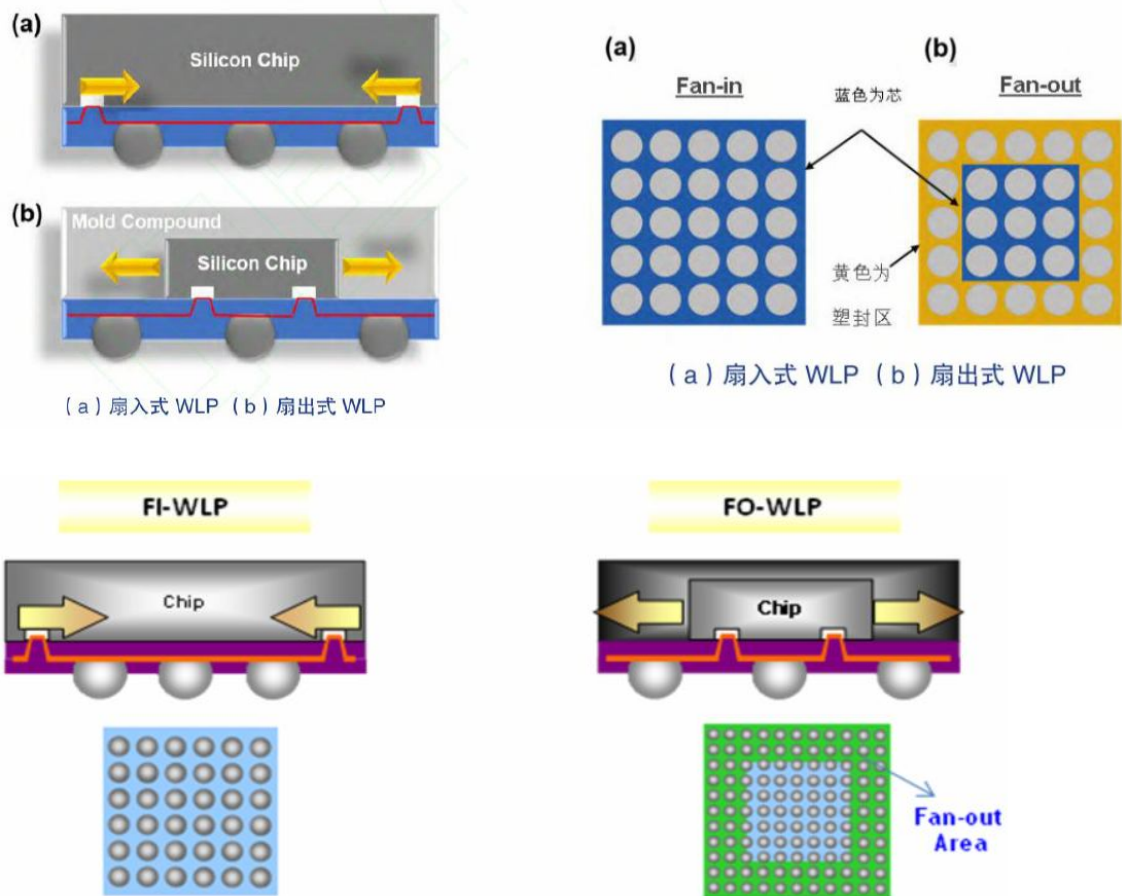
然而，半導體產業鏈中，晶圓製造與封測的界線日趨模糊，技術進步與產品架構的演進使 IC 設計、IC 製造與 IC 封測等不同領域廠商競合的模式將更趨明顯且重要，而 WLP 封裝技術正是 IC 製造與封測領域界線模糊的代表性標的。目前看來 IDM 大廠挾其整合優勢在 WLP 市場居於領先，但隨著晶圓代工與 IC 設計業者競逐此市場，加上專業委外封測大廠的投入，未來 WLP 產業的發展將更為蓬勃，預期將帶動更大的半導體設備需求。

另一方面，隨著行動通訊市場與雲端運算發展，IC 對高速運算與低電流的需求與日俱增，隨著晶片設計益趨複雜，其所搭配的封裝製程難度也同步提高，IEK 認為高階覆晶封裝(Flip Chip)在近年的成長性將大於銅打線封裝，大型封測廠近年不約而同地將資本支出重點放在建置高階的覆晶封裝產能。IEK 並表示，由於覆晶封裝技術門檻高，投資金額大，國際整合元件廠(IDM)和二、三線封測廠已無力投資，前 5 大封測廠在近年進入覆晶封裝的資本支出競賽，包括日月光、Amkor、矽品和星科金朋、力成等主要封測廠，都已在 2012 年下半年開始正式提升高階封裝產能。IEK 指出，NVIDIA、超微(AMD)和高通(Qualcomm)等晶片大廠皆相繼採用 28 奈米以下製程，以提供給市場更高效能、更省電的晶片，各家有能力提供高階覆晶封裝的一線封測廠，亦皆已獲得客戶端明確的要求，希望擴大建置高階覆晶封裝產能，封測廠資本支出動向均同步出現聚焦覆晶封裝的鮮明趨勢。

(a)-3 扇入型封裝(Fan-In Wafer-Level Package, FIWLP)、扇外型封裝(Fan-Out Wafer-Level Package, FOWLP)

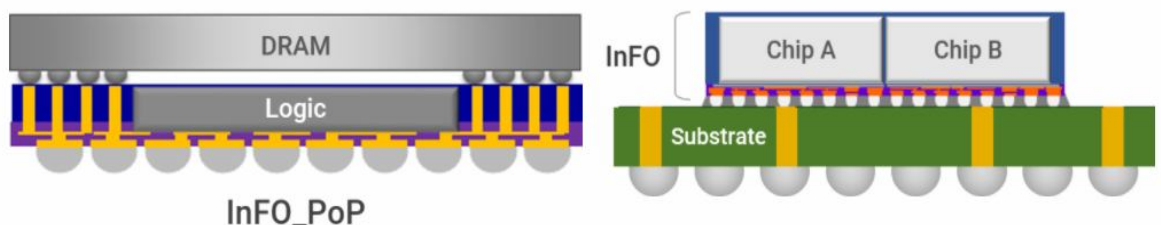
扇入型晶圓級封裝，也就是傳統的晶圓級封裝，切割晶粒在最後進行，適用於低引腳數的積體電路。隨著積體電路信號輸出的引腳數目的增加，焊錫球的尺寸也就變得越來越嚴格，PCB 對積體電路封裝後尺寸以及信號輸出接腳位路的調整需求得不到滿足，因此衍生出了扇外型晶圓級封裝(圖 9)，扇入晶圓級封裝的特徵是封裝尺寸與晶粒同大小。扇外型晶圓級封裝，開始就將晶粒切割，再重布在一塊新的人工模塑晶圓上。它的優勢在於減小了封裝的厚度，增大了扇出(更多的 I/O 接口)，獲得了更優異的電學性質及更好的耐熱表現。

圖 9 扇入型與扇出型對比圖



台積電於 2014 年 5 月推出 InFo(Integrated Fan-out，整合型扇型封裝)製程(圖 10)，進軍跨入 2.5/3D IC 製造封測市場，導入量大產品，InFO 優勢在於可省去載板，因而成本可較傳統的封裝降低約 2~3 成以上，大幅節省晶片封裝的成本，並可應用於手機 AP 或其他 RF、電源管理 IC 等大宗應用市場。台積電的 InFo 能讓封裝後的晶片變得較薄、效能又較佳，能一舉拉高技術門檻，與三星等競爭對手做出區隔，有助於台積電取得美系手機公司下世代應用處理器及其他高階智慧手機處理器的多數訂單。

圖 10 InFO(台積電)-InFO_PoP & InFO_oS



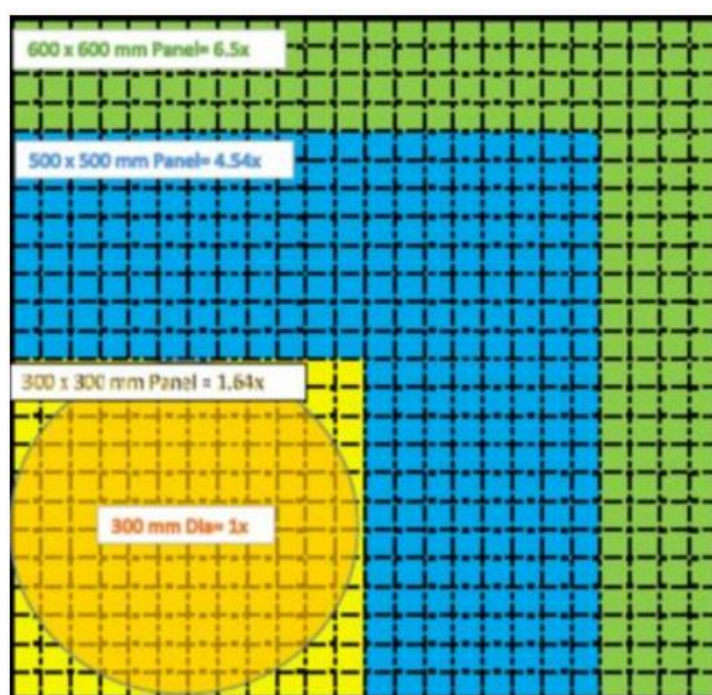
FIWLP 與 FOWLP 用途不同，均為今後的主流封裝手段。FIWLP 在模擬和混合信號晶片中用途最廣，其次是無線互聯，CMOS 圖像傳感器也採用 FIWLP 技術封裝。FOWLP 將主要用於移動設備的處理器晶片中。根據 Yole 的預測，2018 年以前 FOWLP 的主要驅動為蘋果智慧型手機的處理器晶片，

2018 年以後的 FOWLP 的主要驅動除了其他安卓手機處理器的增長，主要是高密度 FOWLP 在其他處理晶片的應用，如 AI、機器學習、物聯網等領域。

(a)-4 面板級封裝(Panel-Level Package, PLP)

面板級封裝方法與 FOWLP 類似，只不過將晶粒重組於更大的矩形面板上，而不是圓形的晶圓。更大的面積意味著節約更多的成本，更高的封裝效率。而且切割的晶粒為方形，晶圓封裝會導致邊角面積的浪費，矩形面板恰恰解決了浪費問題。但也對光刻及對準提出了更高的要求。以主流 12"/300mm 晶圓與 300mm 正方形玻璃為載具做扇外型封裝，方型載具產量為晶圓的 1.4 倍；再以主流 12" 晶圓與主流方形載具尺寸約 600mm 相比，方形載具產量為晶圓的 5.7 倍(圖 11)。

圖 11 面板級封裝示意圖



隨著人工智慧(AI)、物聯網(IoT)和 5G 的興起，帶動了大量的 IC 晶片需求，而許多應用所需的 Sensor 感測器 IC 對於線寬/線距要求較低，加上終端產品晶片同質、異質整合需求提升，使得扇外型持續朝多晶片大封裝尺寸邁進，而扇外型晶圓級工藝面積使用率較低(晶圓面積使用率 95%)，在加速生產週期及降低成本考慮下，封裝技術開發方向已由 FOWLP 轉向可在比 300 毫米晶圓更大面積的面板(方形面積的載具)上進行的 FOPLP。目前分為兩大技術：(1)採用 FPD 製程設備為基礎。(2)採用 PCB 載板製程為基礎。期望藉由 FOPLP 的技術研發，帶來更高的生產效益及成本競爭力。

(a)-5 先進封裝產業競爭趨勢

根據美國喬治城大學安全與新興技術中心(CSET)的調查，過去 3 個世代，台積電做出的晶粒平均價格都大幅下滑，但是最新的 5 奈米製程製造出的晶片，平均價格不降反升，比前一代多出了 5 美元。5 奈米製程投資成本較前一代增加近 1 倍，要製造 5 奈米晶片，不但要用到昂貴的 EUV(極紫外光)

設備，而且每一片 5 奈米晶片要用到多達 14 道 EUV 光罩加工。因此，為了讓未來晶片的性能繼續提升，價格持續降低，台積電等半導體廠早已研發晶圓級先進封裝；因為，如果整顆 IC 都用最先進的製程製造不划算，新的方法是，只有晶片最重要的部分用最先進製程製造，其他次要功能，像電源管理、天線元件，則沿用舊的製程，透過封裝技術，整合成一顆晶片。台積電董事長劉德音 2020 年就公開表示，微縮加 3D IC 技術，未來能讓每單位運算密度每 2 年成長 2 倍。

2018 年日月光與矽品合併成立日月光投控，要結合兩家公司的能量，展現全球封測龍頭的領先優勢，好不容易待中國商務部同意兩家公司合併，通過了整合的最後一道關卡，卻在產業、市場變遷劇烈的 2020 年下半年，迎來三大新挑戰。首先，先進製程快速發展，讓晶片製造商台積電迅速搶進先進封裝市場，過往台積電、日月光是上下游關係，台積電完成晶片製造與上游封裝後，交由日月光進行下游封裝測試；然而隨著晶片先進製程對先進封裝的需求愈來愈高，台積電、英特爾(Intel)、三星等晶片製造業者近年皆跨入先進封裝技術研發，搶進傳統封測廠的生意地盤。其次，從市場衝擊面觀察，中美貿易戰讓日月光出貨華為受限，市場估算，華為占日月光近一成營收，無法供貨華為將使訂單出現缺口，該缺口能否迅速補上？對營運帶來多大的影響？市場也在持續觀察。最後，新冠肺炎疫情未平，雖全球積極布建 5G，但是全球景氣疲弱，恐影響發展表現。

晶片製造商跨領域布局，不免讓市場議論起傳統封測廠面臨的威脅，特別是全球封測龍頭日月光，恐在高階產品訂單的競爭加劇。不過，日月光投控多次強調，日月光與台積電在封裝技術與客戶上有所差異，不完全是在同一個領域。拓墾產業研究院觀察目前晶片製造商與傳統封測廠的競爭，主要是在 HPC(高效能運算)晶片封裝，HPC 主要是應用於資料中心、雲端設備的高效能運算系統。由於需要具備高運算能力並兼顧低功耗，從前段製程到後段封裝，都力求以先進技術改善。在這項需求下，晶片製造商、特別是台積電，很容易成為 HPC 晶片客戶的首選，會選擇台積電，是因為它有製造加封裝的一條龍服務。HPC 晶片幾乎都選用先進製程製造，封裝上必須考慮與先進製程技術搭配，藉此提升封裝後的良率表現。資策會進一步解釋，以 HPC 晶片來講，需要很精密的接合，擁有先進製程的台積電，完整掌握晶片生產架構，在後段封裝更容易取得較佳的精準度表現，這對缺乏先進製程的傳統封裝廠而言，顯然需要額外學習成本。

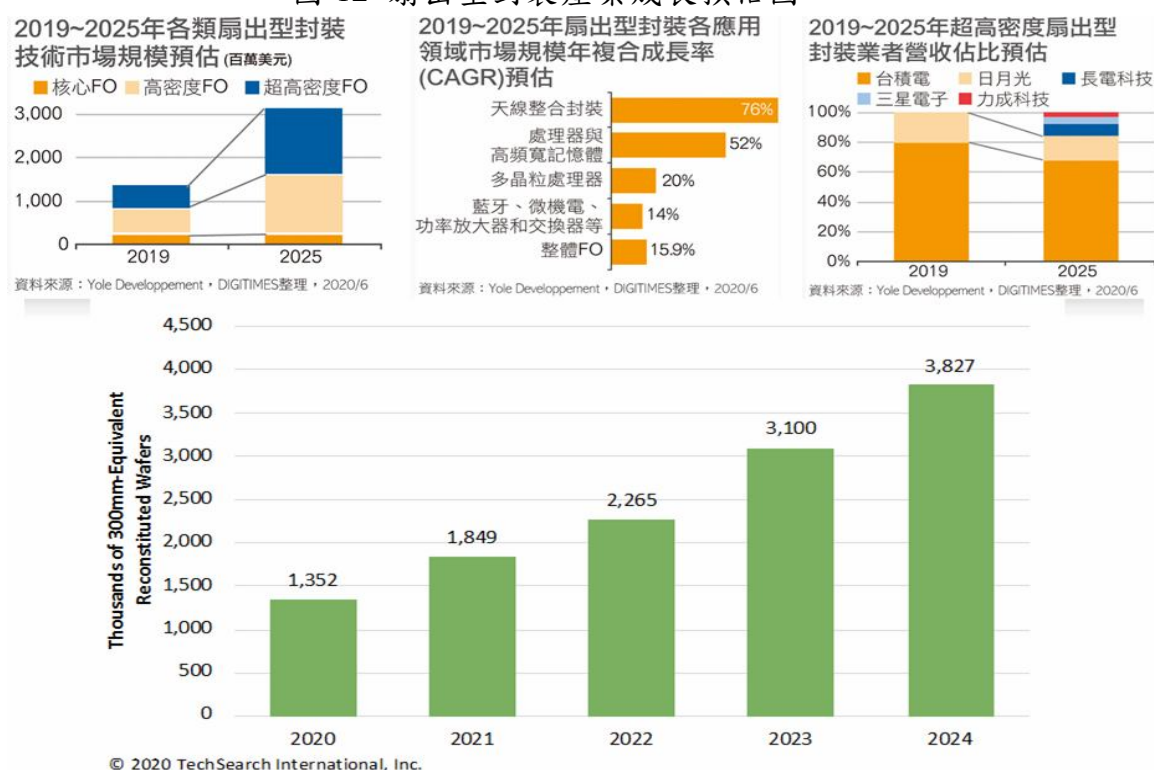
不過，市場的競爭總是一體兩面，看似晶片製造商跨入了先進封測技術領域，對封測市場帶來影響，但是，當台積電擴大 HPC 市場的發展後，超微半導體(AMD)、輝達(NVIDIA)、英特爾等晶片設計商的布局加速，也讓日月光、矽品等傳統封測廠有了更大的分食機會。

美國知名市場調查公司 Prismark 資深顧問 Brandon Prior，接受財訊採訪時指出，全球封裝產業，不包含測試，市場規模為 570 億美元(約新台幣 1.61 兆元)；2019 年到 2024 年，全球封裝市場每年會有 5.6%複合成長率，「封裝

會比整個半導體市場成長速度還快」。若只看先進封裝，目前市場規模約為 57 億美元，其中，覆晶封裝會以半導體市場的 2 倍速度成長；此外，高密度扇出型封裝(屬於晶圓級封裝)也會翻倍成長。他認為，即使是成熟的打線封裝製程，需求也會增加，「但年成長率約在 5% 以下」；同時短期內大部分半導體產品不會有供過於求的狀況。AI 和 5G 對運算能力的需求極為巨大，而且半導體製程微縮愈來愈困難，成本愈來愈高。

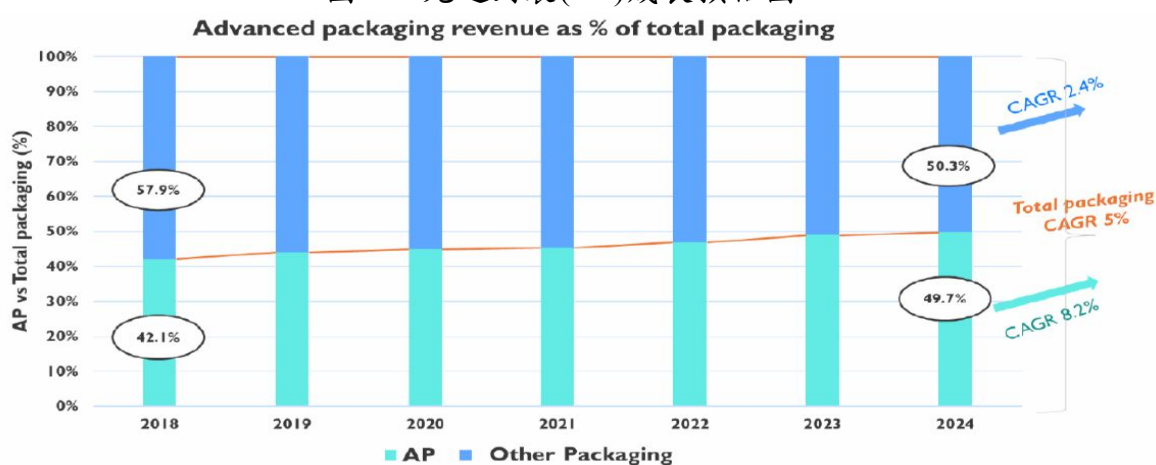
另外，隨著產業發展與市場需求，Yole Developpement 預估至 2025 年扇出型晶圓級封裝將逐年成長(圖 12)。全球半導體先進封裝於 2024 年將達 49.7%(圖 13)。

圖 12 扇出型封裝產業成長預估圖



資料來源：Yole Developpement, Digitimes 整理、TechSearch International (2020/06)

圖 13 先進封裝(AP)成長預估圖



Total packaging market grows by 5% whereas AP market grows by 8.2%

資料來源：Yole Developpement(2020/02)

(a)-6 CoWoS 封裝

近年在半導體製程發展已逼近極限，先進封裝必成趨勢，電晶體上的閘極寬度代表半導體製程的進步程度，稱「閘極線寬」，當線寬越小，表示同樣面積下，電晶體密度越高，效能也就越好。隨著製程推進至 3 奈米(以下)，單一晶片電晶體的密度已經逼近極限，因此半導體業除了持續向先進製程推進外，同時也尋找其他既能使晶片維持小體積，又能保有高效的方式，異質整合的概念因而萌芽。異質整合廣義來說，就是將兩種不同的晶片透過封裝、3D 堆疊技術整合再一起，如邏輯晶片+記憶體、光電+電子元件等，將 2 種不同製程、不同性質的晶片整合再一起，皆可以稱為異質整合，基於此衍生出 2.5D、3D、Chiplets 等封裝技術(圖 14)。以 CoWoS 而言，主要是應用於先進製程的封裝上，故稱為「先進封裝」，但由於過往該技術較昂貴較少被提及，反而是成本相對低的 InfO 封裝較受關注，然在 AI 議題興起後，由於 AI 需要大量的運算，在電晶體達極限後，市場轉而關注先進封裝。繼 Nvidia 公司採用 CoWoS 後，AMD 公司在其最新一代 AI 伺服器也導入 CoWoS 技術，使其成為市場焦點。

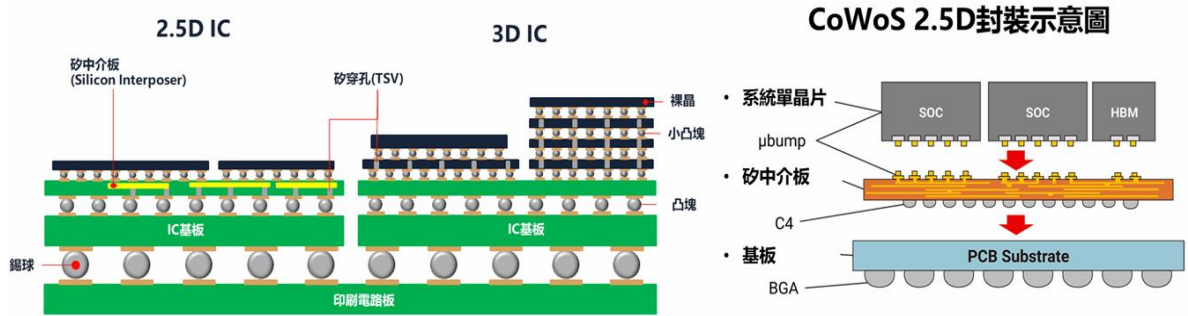
圖 14 異質整合封裝示意圖



資料來源：IEEE，MIC 整理(2023/05)

CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)是一種 2.5D、3D 的封裝技術，其主要差在堆疊的方式，可以拆成「CoW」、「WoS」兩個面向。CoW(Chip-on-Wafer)是指將晶片堆疊，而 WoS(Wafer-on-Substrate)則是把晶片堆疊在基板上。CoWoS 封裝原理為將晶片堆疊起來，並封裝在基板上，並根據排列的形式，分為 2.5D 與 3D 兩種，此封裝技術的好處是能夠減少晶片的空間，同時還能減少功耗與成本(圖 15)。

圖 15 2.5D、3D、CoWoS 2.5D 封裝示意圖



資料來源：豐雲學堂參考台積電網站(2023/08)

2.5D 封裝最為人所知的就是台積電的 CoWoS，其技術概念就是以水平堆疊的方式，將半導體晶片放在中介層之上或透過矽橋連接晶片，最後再透過封裝製程連接到底層的基板上，讓多顆晶片可以封裝一起，達到封裝體積小、功耗低、引腳少的效果，本質上仍然是水平封裝，只是讓晶片間的距離更加靠近。

3D 封裝則是採用立體式的封裝結構，將多個晶片同層或不同層交叉封裝在同一個晶片內，其中使用矽穿孔(TSV)來連結上下不同晶片的電子訊號，使訊號延遲降低，是真正的垂直封裝，但目前矽穿孔的工藝不管在設計、量產、供應鏈方面皆還不構成成熟，基於成本考量，當前業界多採用 2.5D 封裝。

CoWoS/HBM 先進封裝技術發展已久，直到 AI 趨勢形成才被大量使用，AI 晶片均須搭配 HBM，就目前 AI 晶片架構來看，均需搭配超高頻寬記憶體 HBM，HBM 是由超微、三星、海力士發起一種基於 3D 堆疊工藝的高效能 DRAM，適用於高記憶體頻寬需求。

(b)半導體產業近年受經濟與非經濟大事件影響全球 GDP 成長率，連動影響設備需求

2008 年迄今受到美國次貸危機、歐債風暴等金融風暴及日本 311 地震之影響，導致我國半導體大廠在終端消費市場需求減少之情形下，紛紛採取減少產能減少庫存損失，需多廠商財務出現嚴重虧損及流動資金不足，甚至極需要政府進行財務舒困。從總體經濟發展情形觀察，當時根據市場研究機構 IC Insights 歷史資料顯示，基於全球經濟景氣衰弱，調降了對 2011 年半導體產業營收預測數據。該機構將原先對全球半導體產業 2011 年營收成長率的 10%預測值，下修為 5%；此外將 2011 年 IC 出貨成長率由原先預測的 10%，下修為 4%。其報告列舉了一連串引發經濟景氣衰退的事件，包括 311 日本大地震、中東政局動盪、美國的天災以及歐、美政府債務危機等等；這些事件讓 2011 上半年的全球經濟成長率與前一年同期相較明顯趨緩，也拖累了電子與半導體市場的成長。全球國內生產毛額(GDP)成長率在 2010 年達到 4.3%之後，已經開始下滑，但 IC Insights 仍表示，全球 GDP 成長率在 2012 年下半年開始好轉，主要是因為日本震後的投資需求，以及美國經濟景氣轉

強。整體而言，歐、美、日等先進國家的 GDP 比重就佔了全球的一半左右，經濟要復甦還是要靠其來帶動。在新興市場與開發中國家方面，大陸與印度是經濟成長率較高的地區，讓廠商有開發新市場的機會。

研調機構 IC Insights 估計，全球半導體產值於 2020 年成長 13%，2021 年全球半導體產值再成長 26%，攀高至 5,098 億美元後，2022 年將進一步達 5,651 億美元，再成長 11%，續創歷史新高紀錄，也將是 25 年來首度連續 3 年產值成長 2 位數百分比。IC Insights 表示，COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情導致世界生活方式轉變，個人、企業、教育及政府進行數位轉型，推動半導體產值強勁成長。半導體產業過去曾經歷驚人的高點，也經歷過令人震驚的低點，但沒能比得上 2020 年 Covid-19 冠狀病毒大流行席捲全球的挑戰，2020 年疫情初期對個人、區域及全球經濟造成顯著衝擊，然而筆記型電腦、大螢幕智慧手機的需求，和資料中心電腦的擴充，帶動 2020 年 IC 市場成長 10%，長期以來，電腦是半導體產業的成長引擎，不過，新興的通信、消費、汽車、工業及醫療應用推動新型複雜、高速及低功耗晶片的發展。隨著雲端運算、5G、人工智慧、虛擬實境、物聯網、自動駕駛及機器人等技術迅速發展，將帶動半導體產業強勁成長。基於這些新興技術，帶來 IC 產業強勁增長。

國際貨幣基金 2023/10 下修 2024 年全球經濟成長預測，並警告通膨仍很頑強，各國央行應保持政策緊縮直到物價壓力持續緩解為止。該組織的首席經濟學家並表示，目前評估以巴衝突的影響為時過早，但若油價每桶上漲 10%，接下來的一年全球通膨率將上升約 0.4%，而世界經濟成長將減少 0.15%。其發布的《世界經濟展望》秋季報告，將 2024 年全球消費者物價增速由 7 月更新報告所預估的 5.2%調高至 5.8%，並預測在 2025 年前大多數國家的通膨率仍將高於央行設定的目標(表 1)。

表 1 全球主要地區 GDP 預測圖

	2023年	2024年
全球	3.0	2.9
美國	2.1	1.5
歐元區	0.7	1.2
日本	2.0	1.0
中國大陸	5.0	4.2
印度	6.3	6.3
台灣	0.8	3.0

資料來源：IMF (2023/10)

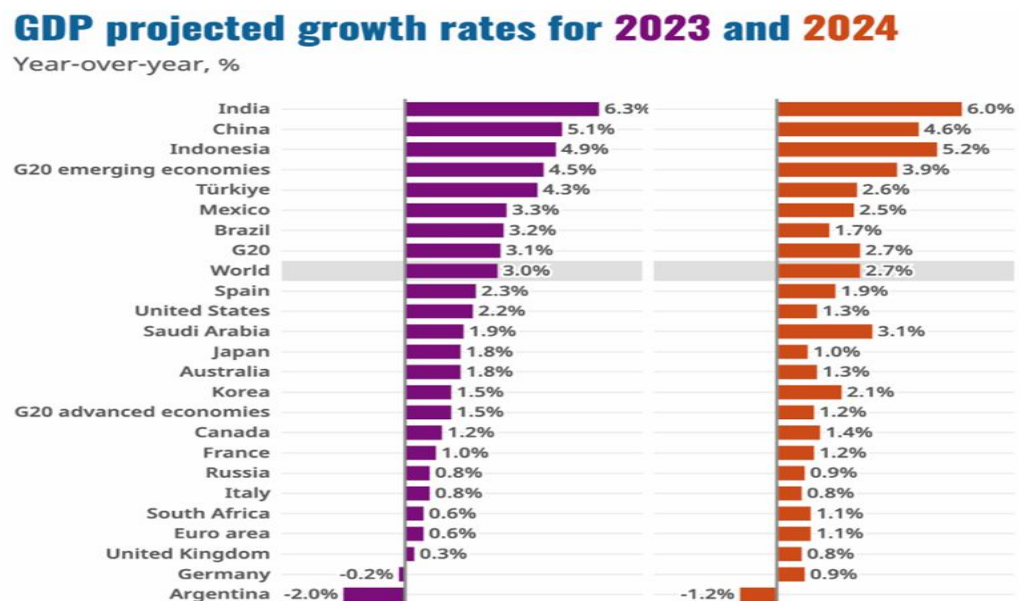
國際貨幣基金(IMF)2024/01 表示，繼 2023 年表現優於預期後，全球經濟成長將在今年繼續保持韌性，不過，想要在中期內將成長率提高到 3%以

上，還需要再努力。IMF 發言人科扎克(Julie Kozack)表示，隨著通膨消退和勞動力市場恢復活力，全球經濟似乎正在走向軟著陸，但低度開發國家可能進一步落後。而世界銀行(World Bank)則發布悲觀的 2024 年展望，預測全球 GDP 成長率將下滑至 2.4%，連續第三年放緩，使減貧目標面臨風險。科扎克表示：「一年前對於全球許多地區將陷入衰退的可怕預測，並未在 2023 年發生。截至目前，全球經濟相對仍具韌性，我們預估這將持續到 2024 年。」但這不全然都是好消息，因為近期公布約 3%的經濟成長率，仍比疫情前約 3.8%的全球平均成長率還要低。

IMF 首席經濟學家古林查斯說，全球經濟繼續從新冠疫情、俄烏戰爭，以及去年的能源危機中復甦，但中期成長前景平平。疫情的持續影響、俄烏戰爭、利率上升、極端天氣事件和財政支持縮減，都是抑制經濟更強勁增長的因素。儘管全球經濟整體上朝向軟著陸，但 IMF 仍然擔心中國大陸房地產危機、大宗商品價格波動、地緣政治碎片化，及通膨高漲等風險。

經濟合作發展組織 2023/09(OECD)發布最新經濟預測，上調 2023 年全球經濟增長估值，但下調 2024 年增長預期。外電報導，OECD 預計繼 2022 年增長 3.3%之後，2023 年全球國內生產毛額(GDP)增速將放緩至 3.0%，但較 6 月預測的 2.7%有所提升，而 2024 年全球增速將放緩至 2.7%(圖 16)，且低於 6 月預測的 2.9%。

圖 16 全球與主要經濟體 2023~2024 GDP 預估



資料來源：OECD (2023/09)

OECD 首席經濟學家 Clare Lombardelli 表示，「儘管高通膨持續緩解，但全球經濟仍處於困境。我們正面臨通膨和低增長的雙重挑戰。」OECD 警告，全球各主要央行過去的加息可能產生比預期更大的影響，而且通膨可能持續存在，需要進一步收緊貨幣政策。

至於物價展望，市場普遍預期美國聯準會(Fed)將維持利率不變，但 OECD 呼籲央行不要過早放鬆貨幣政策，理由是儘管整體通膨有所下降，但

許多國家的核心通膨仍在頑固上漲。「貨幣政策需要保持限制性，直到有明顯跡象表明，潛在的通膨壓力已經持久減弱。」

(c)半導體產業與設備業未來發展

根據資策會產業情報研究所（MIC）觀測全球半導體產業趨勢，先進製程技術量產已推進到 3 奈米技術節點，在台積電、Samsung 領先的局勢之下，Intel 預期在 2024 年推出 Intel 3 製程產品，也使得全球半導體三巨頭 3 奈米製程競爭更趨於白熱化。關注 2 奈米製程，2024 年預期將展開試產與驗證，進展值得關注，整體而言，2024 年半導體產業焦點，將在於全球先進製程技術進展，並有三大觀測焦點，包含 3 奈米量產製程進度、3 奈米製程主要客戶與產品，以及 2 奈米製程試產進度。

展望總體環境發展，資策會 MIC 指出，近岸外包、強國加深對關鍵新興技術的保護力道，兩大主軸將會持續影響全球產業發展。全球化正在轉變形式，部分國家過去幾年曾嘗試藉由政策將產業移回本土，除了美國，許多國家也開始陸續提出對國內關鍵產業、科技保護的作法，全球興起一股科技民族主義氛圍，並產生兩大影響：一，產業、企業的全球發展勢必面對更多限制性政策，除了關稅，還有關鍵技術、企業與技術併購、取得、出口管制等；其次，產業上下游的關係將更強調信任。

資策會產業情報研究所（MIC）於 2023/10/30~11/2 舉辦第 36 屆 MIC FORUM Fall《智匯》研討會，發布台灣半導體產業預測，並展望第三類半導體台廠商機，同時關注電子業面臨全球淨零壓力，企業如何規劃短中長期的策略因應。綜觀全球半導體趨勢，2023 年以來總體經濟疲弱、終端需求低迷導致企業與消費市場買氣不佳，從終端系統廠到半導體供應鏈業者均面臨庫存水位過高、拉貨力道不足的影響。展望 2024 年，隨著記憶體大廠減產控制讓價格回穩，預期將成為全球半導體市場 2024~2026 年拉動成長的主要動能。資策會預估，2023 年台灣半導體產業產值為 3.77 兆新台幣，展望 2024 年，預估產值將達 4.29 兆新台幣，成長 13.7%，預期各次產業 2024 年將有一至二成的成長幅度，其中晶圓代工仍為主要成長動能，特別是先進製造部分；展望 2024 年，雖然第一季預期面臨傳統淡季狀況，但已較今年同期表現佳且回復成長，走出連續四季較前一年同期衰退的狀況。記憶體部分，由於國際記憶體大廠持續減產，短期記憶體價格回穩，供需可望恢復穩定；展望 IC 設計與 IC 封測產業，由於與終端消費性電子產品有較大關聯，未來兩季較難如同有先進製程助益的晶圓代工產值，有較好的復甦表現。

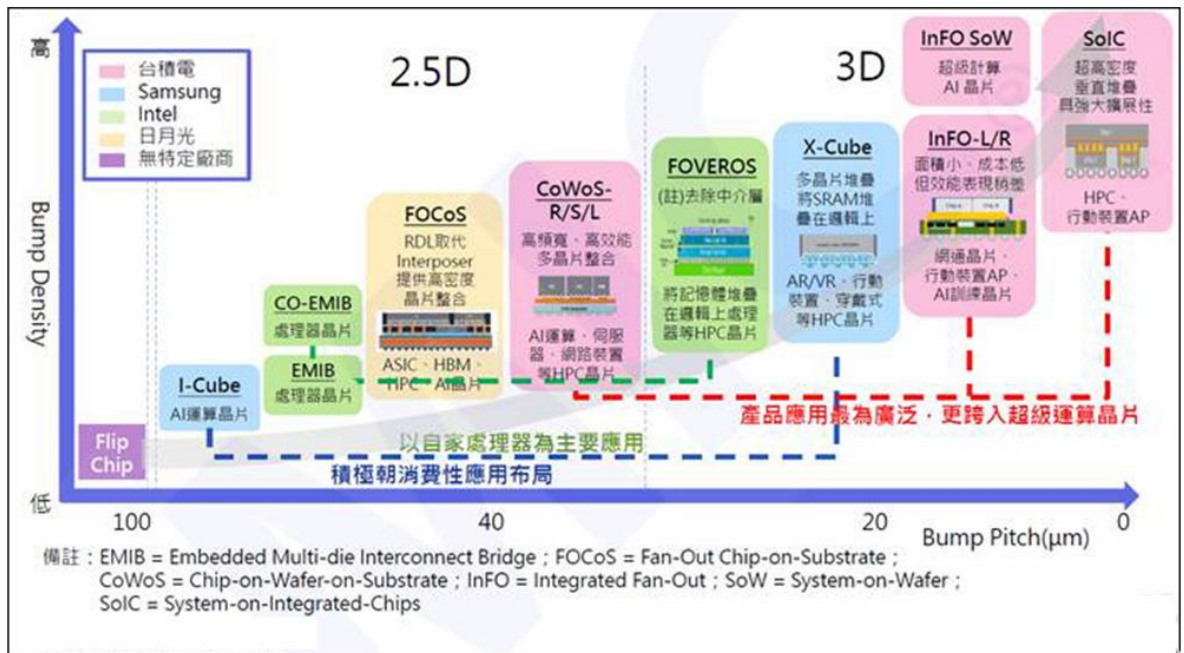
資策會 MIC 產業顧問潘建光表示，展望全球暨台灣半導體產業趨勢，由於主流產品市場復甦與成長不明朗，未來半導體市場成長動能將仰賴新興資訊服務、能源環保與技術整合等新興應用的刺激，特別是 AI、新能源與智慧聯網將成為主要成長動能。其中，AI 伺服器與電動車有機會在 2027 年達到倍數成長，躍升推動半導體成長的主力。此外，無線終端裝置受到數位化與智慧化趨勢驅動，從傳統產品領域擴大朝垂直市場應用發展。面對全球政經局勢衝擊，短期台灣半導體業者與客戶仍需保留充分彈性資源因應外部環

境變化風險；展望中長期，外部環境趨穩與傳統典範轉移或許能成為企業轉型突破的契機，無論是 AI 晶片在雲端與終端的發展、半導體晶片在電動車與自動駕駛的滲透，或節能訴求推動第三類半導體應用趨勢，全球半導體產業版圖將藉此持續加值、擴大。台灣半導體產業勢必加大布局、耕耘中長期成長動能，才有機會開創新局、維持優勢。隨著美中對抗長期化，美日歐產業在新興領域也面臨高度競爭，東南亞、印度也冀望在半導體領域崛起，預期未來全球半導體供應鏈將形成更為複雜的競合關係。

低碳轉型、5G 專網與車用電子新興應用為台廠第三類半導體帶來商機，資策會展望第三類半導體市況，2024 年 SiC 功率元件將有新成長動能，主要來自 8 吋新廠產能陸續開出、各車廠電動車規劃於 2025 年大量上市，以及再生能源需求。觀測 GaN 功率元件，中低電壓產品在資訊產品市場需求持續成長，另外，高電壓產品仍待車用充電市場發展。資深產業分析師周明德表示，各國 2050 年淨零碳排目標、產品電氣化趨勢驅動電動運輸等新興應用市場成長，帶動能源、工業製造高效轉型，加上 B5G/6G 需求等趨勢，皆驅動第三類半導體市場快速成長。觀測 GaN 通訊元件，2023 年因 5G 基地台建設趨緩而影響表現，有望在 5G 專網應用興起後好轉。資策會 MIC 表示，5G 專網需求預期帶動具有小型化與高功率特性的第三類半導體通訊元件成長，已有不少廠商為了讓第三類半導體通訊元件更被市場接受，開始開發新的 GaN on Si 通訊元件技術，期望打入毫米波手機市場。雖然短期全球 5G 市場成長趨緩，中長期仍看好 5G 專網需求發展，帶動小型基地台需求快速成長，為第三類半導體通訊元件帶來新的成長動能。國際大廠積極擴增產能搶占市場，往 8 吋製程開發，並透過發展新基板與製程技術降低產品成本，期望未來更多電氣產品改用第三類半導體功率元件。資深產業分析師周明德展望台廠商機，在技術方面，台灣有矽基半導體製程技術優勢，未來應以 GaN on Si 技術為主，並在 SiC 朝向超高電壓、高溫等特殊環境與應用產品發展。目前台廠於第三類半導體仍以晶圓代工為主，占產值高達 85% 以上，長遠來看，應持續加強 IC 設計產品與應用發展，鎖定低碳轉型、5G 專網與車用電子新興應用發展，積極促進國內外技術合作，強化產品設計能力。

確保先進製程與先進封裝技術領先，為台灣半導體產業關鍵課題，關注半導體技術趨勢，高效運算對於效能的要求使先進製程產能需求大幅增加，資策會 MIC 指出，如何確保先進製程與先進封裝技術領先，是 2023 年台灣半導體產業關鍵課題。資深產業分析師鄭凱安觀測先進製程，除了美系 IC 設計業者與 ICT 大廠，對於高階邏輯／運算晶片的需求持續成長，網通晶片也開始導入 7nm 製程，長期看來，先進製程在 3nm、5nm、7nm 都有對應需求。隨著三大半導體廠商競爭先進製程研發，技術節點已推進至 3nm 量產，2nm 量產將在 2024 年底至 2025 年登場。當技術節點不斷推進，也提升晶圓製造平均價格。鄭凱安表示，隨著 GAA 在 3nm 以下導入，半導體先進製程將再面臨成本與價格大漲。另外，曝光製程對先進製程至為關鍵，也使設備成本成為大廠擴建產能的主要挑戰(圖 17)。

圖 17 先進封裝技術從 2.5D 到 3D 應用示意圖



資料來源：IEEE，MIC 整理(2023/05)

資策會 MIC 在 2023 年 12 月發布「2024 年資通訊產業前景」，所長洪春暉表示，生成式 AI 將貫串 2024 年資通訊暨軟體產業發展，其已逐步落地至更多終端裝置，預期 2024 年 AI PC 與 AI 手機將成為終端消費市場成長新動力。生成式 AI 的高速發展帶動新一波 AI 推論伺服器需求，驅動 AI 晶片競爭白熱化。針對生成式 AI 發展，2024 年將朝向「AI Agent 化」，預期可帶動軟體系統工程革新，利於企業流程升級，展望未來，我們距離「人人成為 AI 工程師」的世界又更接近了，屆時全民皆可創建 AI App，將驅動新一代 AI 服務模式。

MIC 提出五大 AI 趨勢：(1) AI PC 點燃全球市場動能，看好搭載 AI 的個人電腦已成為下一代產品開發標配，主要大廠已認知到市場成長的關鍵，在於使用模式更貼近使用者需求，因此除了硬體效能，軟體應用工具對於使用者執行 AI 功能的情境配合，成為未來產業發展焦點。展望 2024 年，台灣 PC 產業將持續扮演協助尋覓使用情境與產品創新設計的角色，提升 AI PC 產品價值。(2) AI 手機服務生態系重新建構，走向大者恆大。2024 年手機品牌廠的 AI 布局能力將成為競逐的差異化關鍵，基於 AI 手機的服務生態系將重新建構，並走向大者恆大。主要手機品牌廠紛紛自研大型語言模型(LLM)並整合客製 OS 系統開發，試圖將 AI 大模型能力引入手機，使終端處理運算成為常態。手機晶片規格將大幅提升，GPU、NPU/APU 的重要性增加，主晶片規格與記憶體頻寬及容量也同步升級，以支援百億規模以上參數的 LLM 模型，進一步催生晶片面積設計優化、高階運算，以及軟體管理能耗等需求。預期 2024 年，對於先進製程、AI 手機晶片設計與測試、記憶體模組需求將更甚以往，刺激大廠挹注新技術研發與投資力道，為台廠供應鏈帶來商機。(3) 中小型生成式 AI 模型帶動 AI 伺服器出貨成企業端採購重點產品

，AI 推論伺服器由於價格較低、方便企業部署，加上多數企業已開始避免 AI 算力溢出、資源過度部署的問題，預期 AI 推論伺服器將成為企業端採購的重點產品，利於 AI 伺服器出貨。(4) 備戰生成式 AI 運算戰力，AI 晶片競爭白熱化，因生成式 AI 服務如 OpenAI ChatGPT、Google Gemini 備受關注，帶動服務業者積極布建 AI 運算資料中心以提升服務能量，也驅動晶片大廠推出更高運算效能的 AI 運算晶片，爭取服務業者採用，不僅如此，服務業者也開始著手開發符合自有 AI 運算需求的自研晶片，2024 年 AI 晶片競爭將更白熱化。2024 年全球生成式 AI 運算晶片的發展重點，將在於領導廠商 NVidia 晶片產品群、AMD 和 Intel 等競爭產品，以及 AI 服務業者自研晶片開發與導入狀況。(5) 生成式 AI 走向 AI Agent 化，帶動軟體系統工程革新與企業流程升級，AI Agent 開始結合 LLM、自主規劃能力、記憶與反饋情況能力，以及工具選擇與使用能力，此趨勢將大幅影響未來軟體工程設計與規劃原則，可輔助原有工程人員的開發速度與水準提升。長期而言，當帶有 AI Agent 能力的生成式 AI 更普及，將允許人人以 No code/Low code 型式，用命令說明角色及工作目的後，便可對系統工程的工作進行拆解、完成複雜工作的執行，甚至能改善企業內部流程與經營模型。

(d) 半導體產業產值現況與預估

台灣半導體產業協會 (TSIA) 2023 年 11 月公布第三季台灣整體 IC 產業產值達 1 兆 1,161 億元，季增 10%，為今年以來最顯著成長，預估第四季產值將進一步達 1 兆 1,580 億元，季增 3.8%，2023 年台灣整體 IC 產業產值約為 4 兆 2,975 億元，年減 11.2%，為近 12 年首見衰退。TSIA 引用工研院產科國際所 (IEK) 研究調查資料顯示，自 2020 年到 2022 年，受疫情與地緣政治影響，晶片短缺帶動台灣整體 IC 產業連續三年高成長，分別達年增 20.9%、26.7%、18.5% 成長幅度，今年受整體經濟下滑，高庫存消化影響需求疲軟，產業面臨近 5 年首度出現衰退。

TSIA 預估 2023 年台灣整體 IC 產業產值年減 11.2%。其中 IC 設計業產 1 兆 735 億元，年減 12.9%；IC 製造業為 2 兆 6,410 億元，年減 9.6%，其中晶圓代工為 2 兆 4,656 億元、年衰退 8.2%，記憶體與其他製造 1,754 億元、年衰退 25.6%，衰退幅最大；IC 封裝業產值為 3,926 億元，也減 15.8%，IC 測試業產值 1,904 億元，年減 12.9%。TSIA 公布第三季台灣整體 IC 產業產值，包含 IC 設計、IC 製造、IC 封裝、IC 測試共達 1 兆 1,161 億元，季增 10%，較第一季季減 15.8%、第二季小幅季增 0.7%，為 2023 年以來最顯著季成長幅，顯示仍多少有旺季效應，也反映個人電腦、手機等庫存水位下降，產業鏈補貨需求，帶動產業產值上升。第三季各次產業中，IC 製造產值達 6,756 億元，季增 11.2%、年減 11.6%，其中晶圓代工產值為 6,316 億元，季增 11.8%、年減 11.4%，記憶體與其他製造為 440 億元，季增 2.8%、年減 13.7%；IC 封裝業產值為 1,035 億元，季增 11.7%、年減 18.5%，IC 測試業為 490 億元，季增 5.8%、年減 11.7%；IC 設計業產值為 2,880 億元，季增 7.3%、年減 3%。TSIA 預估第四季整體 IC 產業產值將進一步達 1 兆 1,580 億元，季增 3.8%

，各次產業中較上季互有增減，IC 設計產值約為 2,770 億元，季減 3.8%、年增 6.5%；IC 製造產值達 7,330 億元，季增 8.1%、年減 5.2%，其中晶圓代工產值季增 8%，記憶體與其他製造季增 9.1%；IC 封裝產值 1,024 億元、季減 1.1%，測試業 486 億元、季減 0.8%(表 2)。

表 2 2023 年台灣 IC 產業產值統計結果

億新台幣	23Q1	季成長	年成長	23Q2	季成長	年成長	23Q3	季成長	年成長	23Q4(e)	季成長	年成長	2023(e)	年成長
IC 產業產值	10,084	-15.8%	-13.0%	10,150	0.7%	-18.0%	11,161	10.0%	-10.2%	11,580	3.8%	-3.3%	42,975	-11.2%
IC 設計業	2,400	-7.7%	-27.3%	2,685	11.9%	-22.2%	2,880	7.3%	-3.0%	2,770	-3.8%	6.5%	10,735	-12.9%
IC 製造業	6,279	-18.4%	-5.8%	6,075	-3.2%	-15.6%	6,756	11.2%	-11.6%	7,300	8.1%	-5.2%	26,410	-9.6%
晶圓代工	5,873	-18.8%	-1.6%	5,647	-3.8%	-13.3%	6,316	11.8%	-11.4%	6,820	8.0%	-5.7%	24,656	-8.2%
記憶體與其他製造	406	-12.7%	-41.8%	428	5.4%	-37.3%	440	2.8%	-13.7%	480	9.1%	3.2%	1,754	-25.6%
IC 封裝業	940	-17.5%	-14.5%	927	-1.4%	-19.4%	1,035	11.7%	-18.5%	1,024	-1.1%	-10.2%	3,926	-15.8%
IC 測試業	465	-12.6%	-11.4%	463	-0.4%	-19.5%	490	5.8%	-11.7%	486	-0.8%	-8.6%	1,904	-12.9%
IC 產品產值	2,806	-8.5%	-29.8%	3,113	10.9%	-24.7%	3,320	6.6%	-4.6%	3,250	-2.1%	6.0%	12,489	-14.9%
全球半導體市場(億美元)及成長率(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,161	-10.1%

資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2023/11)

世界半導體貿易統計協會(WSTS)2023 年 11 月 28 日公佈預測報告指出，因生成式 AI 普及、帶動相關半導體產品需求急增，且記憶體需求預估將呈現大幅復甦，因此將 2024 年全球半導體銷售額預估值自前次(2023 年 6 月 6 日)預估的 5,759.97 億美元上修至 5,883.64 億美元、將年增 13.1%，超越 2022 年的 5,740.84 億美元、創下歷史新高紀錄。就產品種類來看，WSTS 將 2024 年晶片(IC)全球銷售額自前次預估的 4,703.49 億美元上修至 4,874.54 億美元、將年增 15.5%。其中，2024 年記憶體(Memory)銷售額自前次預估的 1,203.26 億美元上修至 1,297.68 億美元、將暴增 44.8%；包含 CPU 等產品在內的邏輯(Logic)自前次預估的 1,852.66 億美元上修至 1,916.93 億美元、將年增 9.6%。

WSTS 調高今年及明年半導體營收預估，預期今年全球半導體營收將約 5,201.26 億美元，高於先前預估的 5,150.95 億美元，年減 9.4%；2024 年營收將達 5,883.64 億美元，高於原先預估的 5,759.97 億美元，年增 13.1%。

各區域表現，WSTS 預期 2023 年只有歐洲市場會成長，增幅將約 5.9%，美洲市場將減少 6.1%、日本將減少 2%、亞太地區將減少 14.4%。預期 2024 年全球半導體市場可望復甦，營收將強勁成長 13.1%，達 5,883.64 億美元，包括分離式半導體、光電子、感測器營收將全面成長個位數百分比，記憶體營收激增 44.8%，是推升半導體營收成長主要動能。2024 年所有市場都可望成長，歐洲及日本市場將分別成長 4.3%及 4.4%，美洲市場將成長 22.3%，亞太地區成長 12%(表 3)。

表 3 2022~2024 年全球半導體地區及產品類別銷售額

Fall 2023	Amounts in US\$M			Year on Year Growth in %		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Americas	141,136	132,536	162,154	16.2	-6.1	22.3
Europe	53,853	57,048	59,480	12.8	5.9	4.3
Japan	48,158	47,209	49,275	10.2	-2.0	4.4
Asia Pacific	330,937	283,333	317,455	-3.5	-14.4	12.0
Total World - \$M	574,084	520,126	588,364	3.3	-9.4	13.1
Discrete Semiconductors	33,993	35,951	37,459	12.0	5.8	4.2
Optoelectronics	43,908	42,583	43,324	1.2	-3.0	1.7
Sensors	21,782	19,417	20,127	13.7	-10.9	3.7
Integrated Circuits	474,402	422,174	487,454	2.5	-11.0	15.5
Analog	88,983	81,051	84,056	20.1	-8.9	3.7
Micro	79,073	76,579	81,937	-1.4	-3.2	7.0
Logic	176,578	174,944	191,693	14.0	-0.9	9.6
Memory	129,767	89,601	129,768	-15.6	-31.0	44.8
Total Products - \$M	574,084	520,126	588,364	3.3	-9.4	13.1

資料來源：WSTS（2023/11）

由大型晶片製造商組成的 WSTS，上修其對 2024 年半導體市場成長率預估，在 WSTS 發布樂觀展望之際，晶片業已開始出現需求復甦跡象，主要受到 ChatGPT 問世後生成式 AI 廣泛使用，以及個人電腦（PC）與智慧手機銷售持續改善帶動。美國晶片巨頭英特爾 2023 年 10 月預估，10 至 12 月的季度將出現兩年來首度營收成長，台積電、三星等大廠也都預測這段期間獲利表現將更佳。

關於先進封裝市場，小晶片（chiplet）架構帶動半導體先進封裝需求，預估晶圓代工廠及半導體整合元件廠先進封裝產值提升速度，將高於半導體後段專業封測廠。半導體製程接近摩爾定律的物理極限，半導體技術朝向次系統整合（sub system integration）階段發展，半導體製程到 3 奈米及 3 奈米以下，許多晶片設計將以小晶片（Chiplet）架構為主。小晶片帶動先進封裝需求，預估 2024 年全球小晶片市場規模將成長至 505 億美元，應用以伺服器及智慧型手機為主，小晶片帶動封裝技術從傳統打線封裝邁向覆晶封裝和 2.5D/3D 先進封裝，其中高速運算（HPC）晶片多採用 2.5D/3D 先進封裝。預估先進封裝市場規模從 2022 年到 2028 年的年複合成長率（CAGR）將超過 10%，成長性不僅高於傳統封裝，也高於整體半導體業，其中 2.5D/3D 先進封裝市場將由 92 億美元成長至 258 億美元，年複合成長率預估 18.7%。

英特爾和台積電積極投入先進封裝資本支出，預估晶圓代工廠及半導體整合元件廠（IDM）先進封裝產值提升速度，將高於半導體後段專業封測廠（OSAT）。半導體大廠布局先進封裝，晶圓製造廠台積電、韓國三星（Samsung）、美國英特爾（Intel）等研發先進封裝，布局多晶片整合，鎖定高階行動處理器和高效能運算晶片，封測大廠日月光投控提供高密度晶片整合解決方案。除了英特爾、三星、台積電、日月光投控外，艾克爾（Amkor）、中國江蘇長電等也積極切入先進封裝，前述 6 家廠商囊括全球超過 80% 的先進封裝晶圓產能。

(e)後新冠肺炎時期之景氣消長影響半導體產值興衰

疫情期間因台灣疫情控制得宜，國內半導體產業持續運作，同時，承接許多國際轉單到台灣半導體的生產線上進行生產，帶動台灣半導體產值近年高幅成長，市場研究機構《Yole》發表先進封裝市場報告，預測到 2026 年，先進封裝市場營收將大幅成長，並預計 3D 堆疊、ED 和 Fan-Out 營收年複合成長率最高。由於先進封裝市場持續發展，封裝市場市占率將不斷增加，到 2026 年成長將近 50%。以 12 吋晶圓市場看，雖然傳統封裝仍是主導地位，占比近 72%，先進封裝晶圓占比不斷增加，預計到 2026 年增加到 35%，達 5,000 萬片以上。Yole 指出，先進封裝晶圓價值幾乎是傳統封裝兩倍，為廠商帶來高利潤率。Flip-chip 2020 年約占先進封裝市場 80%，到 2026 年將達近 72%。3D/2.5D 堆疊和 Fan-Out 分別成長 22%和 16%，各種應用採用比例持續增加。

後摩爾定律時代對晶片性能持續提升需求推動下，半導體產業鏈日漸增加先進封裝領域投資。占 70%封測市場的 OSAT(委外封測代工)廠商藉大力投資先進封裝，以便在利潤豐厚的市場提升競爭力。OSAT 廠商仍主導先進封裝市場，然而高階傳統封裝 2.5D/3D 堆疊、高密度 Fan-Out 等領域，大型晶圓代工廠如台積電、IDM 廠商如英特爾和三星等，逐漸取得主導地位。參與者大力投資先進封裝技術，並推動封裝環節從基板轉移到晶圓或矽平台。總體而言，封裝市場業務開始轉變，傳統上屬於 OSAT 和 IDM 的領域，開始湧入不同商業模式的玩家，包括大型晶圓代工廠、基板/PCB 供應商、EMS/DM 等均進入封裝市場。有新參與者加入，雖然市場會更競爭，但也代表商機無限。

然而在 3 年的高度擴張後，因升息、戰爭等因素，包括俄烏戰爭、以巴衝突、紅海危機...等造成全球性通膨，惡化的經濟前景對智慧手機、個人電腦和消費電子產品產生負面影響，這將使得動態隨機存取記憶體（DRAM）市場、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場等供過於求，總體經濟環境惡化削弱消費需求，不過企業投資可望有助工業、電信基礎設施和數據中心等市場受影響較小。全球總體經濟受高通膨、戰爭等影響，削弱終端電子產品市場消費動力。根據 Gartner 數據顯示，2023 年全球 PC 出貨量總計 2.5 億台，相較 2022 年下滑 9.1%。IDC 預測，2023 年全球智慧手機出貨量預估將年減 4.7%至 11.5 億支。但隨時間接近 2024 年，庫存問題逐漸改善，預期明年手機市場將逐漸復甦為正成長。Gartner 預估，2026 年之前、全球企業中高達 8 成將在業務上活用生成式 AI，比重將較 2023 年的不到 5%呈現急增。德國 Statista 指出，2027 年 AI 晶片需求預估將擴大至 1,194 億美元、將達 2023 年的 2.2 倍水準。

(f)半導體設備投資趨勢

半導體產值高低除了受終端消費性電子產品供需之影響外，另一個影響關鍵因子仍係半導體大廠之資本支出，加拿大 TechInsights 負責半導體市場趨勢研究的 McClean Report 部門(原 IC Insights)公布了 2023 年銷售額排名前

25 位的半導體公司，其中台積電排名由第二升至第一，前 25 名企業的總銷售額為 5,168 億美元，較 2022 年下降 11%(表 4)。

表 4 2022~2023 年半導體大廠資本支出成長率

2023F Top 25 Semiconductor Sales Leaders (\$M, including Foundries)										
2023 Rank	2022 Rank	Company	Headquarters	2022 Total IC	2022 Total O-S-D	2022 Total Semi	2023 Total IC	2023 Total O-S-D	2023 Total Semi	23/22 % Change
1	2	TSMC (1) †	Taiwan	75,851	0	75,851	68,852	0	68,852	-9%
2	3	Intel †	U.S.	61,534	0	61,534	51,401	0	51,401	-16%
3	8	Nvidia (2) †	U.S.	24,503	0	24,503	49,565	0	49,565	102%
4	1	Samsung †	South Korea	73,002	3,843	76,845	45,938	2,366	48,304	-37%
5	4	Qualcomm (2) †	U.S.	36,722	0	36,722	30,483	0	30,483	-17%
6	6	Broadcom (2) -	U.S.	23,972	2,661	26,633	25,204	2,789	27,993	5%
7	5	SK hynix †	South Korea	33,292	1,613	34,905	21,334	2,588	23,922	-31%
8	9	AMD (2) †	U.S.	23,601	0	23,601	22,612	0	22,612	-4%
9	14	Infineon †	Europe	10,566	5,210	15,776	11,647	5,737	17,384	10%
10	13	ST †	Europe	10,765	5,337	16,102	11,734	5,527	17,261	7%
11	10	TI †	U.S.	17,818	1,175	18,993	15,631	1,040	16,671	-12%
12	12	Apple* (2) -	U.S.	17,824	0	17,824	16,414	0	16,414	-8%
13	7	Micron †	U.S.	25,637	0	25,637	16,200	0	16,200	-37%
14	11	MediaTek (2) †	Taiwan	18,506	0	18,506	13,709	0	13,709	-26%
15	15	NXP -	Europe	11,878	1,076	12,954	11,968	1,074	13,042	1%
16	16	Analog Devices -	U.S.	11,789	599	12,388	11,042	570	11,612	-6%
17	19	Sony †	Japan	837	9,021	9,858	1,065	9,588	10,653	8%
18	17	Renesas †	Japan	8,859	2,459	11,318	8,279	2,230	10,509	-7%
19	24	Microchip †	U.S.	6,757	1,126	7,883	7,314	1,220	8,534	8%
20	21	onsemi †	U.S.	3,582	4,745	8,327	3,614	4,621	8,235	-1%
21	22	GlobalFoundries (1) †	U.S.	8,108	0	8,108	7,388	0	7,388	-9%
22	20	UMC (1) †	Taiwan	9,362	0	9,362	7,129	0	7,129	-24%
23	18	Kioxia †	Japan	10,595	0	10,595	6,738	0	6,738	-36%
24	25	SMIC (1) †	China	7,273	0	7,273	6,296	0	6,296	-13%
25	23	Western Digital †	U.S.	8,022	0	8,022	5,920	0	5,920	-26%
—	—	Top-10 Total		373,808	18,664	392,472	338,770	19,007	357,777	-9%
—	—	Top-25 Total		540,655	38,865	579,520	477,477	39,350	516,827	-11%

(1) Foundry (2) Fabless

*Custom processors and ICs for internal use in systems products.

資料來源：TechInsights(IC Insights)，2024/01

IC Insights 統計 2023 年銷售額排名前 25 名的公司概况與前一年維持不變。2023 年前 10 名企業的總銷售額為 3,578 億美元，較上年下降 9%。台積電雖然銷售年減 9%，但由於原本排名居首的三星跌幅更大，負成長高達 37%，因此仍得以取得王座。英特爾(INTC-US)同樣為年減，幅度達 16%，但仍升至第二。輝達(NVDA-US)全年銷售大增 102%，由第八名快速上升至第三名。上年榜首三星退居第四，高通(QCOM-US)被擠至第五，年銷售負成長 14%。

前 25 大中，總計實現正成長的公司只有 7 家，除了輝達之外，分別是第 6 位的博通、第 9 位的英飛凌、第 10 位的意法半導體、第 15 位的恩智浦半導體、第 17 位的索尼、第 19 位的微芯科技。McClean Report 指出，許多負成長因素是由於「半導體需求下降」和「智慧型手機、個人電腦、資料中心伺服器和其他最終用途產品庫存增加」。2023 年以來，半導體業仍在面對需求側逆風困擾，科技大廠紛紛為此削減資本支出，削減最多的是記憶體公司，如 SK 海力士、美光、三星。

大幅削減資本支出的公司通常是與 PC 和智慧手機等消費電子市場相關度較高，而這兩個市場在 2023 年陷入低迷。個人電腦的衰退很大程度上影響了英特爾和記憶體公司、智慧手機的疲軟主要影響台積電（蘋果、高通、

聯發科等是其最大的客戶)以及記憶體公司。2023 年增加資本支出的 IDM 公司(如：義法半導體、英飛凌)與汽車和工業市場關係更大，這兩個市場相對健康。

自 1984 年以來，半導體市場增長的每個重要峰值(20%或以上)都與資本支出增長的重要峰值相匹配。幾乎在每一種情況下，半導體市場在高峰後一年的顯著放緩或下降，都導致了高峰後一兩年的資本支出下降。唯一的例外是 1988 年的高峰期，資本支出在第二年沒有下降，但在高峰期後兩年持平，這種模式加劇了半導體市場的波動。在繁榮的一年，公司大力增加資本支出以提高產量；當景氣崩潰時，公司會削減資本支出。這種模式往往導致繁榮年之後的產能過剩，這種產能過剩可能導致價格下降，並進一步加劇市場的衰退。一個更合理的方法是根據長期的產能需求，每年穩步增加資本支出。然而，這種方法可能很難被股東接受。在經濟繁榮的年份，強勁的資本支出增長通常會得到股東的支持。但在疲軟的年份，持續的資本支出增長則不會。

(g) AI 產業應用帶來 CoWoS 封裝爆發性成長

2024 年半導體產業將迎來復甦，AI 新科技將為半導體產業挹注更多活力。NVIDIA 將發表新一代 AI 晶片如 H200、B100，其他 AI 晶片也呈現百花齊放，包括 AMD 的 MI300、Intel 的 Gaudi2，以及 CSP 廠自研 ASIC 晶片。除了雲端外，Edge AI 趨勢也正在成形，聯發科及高通推出旗艦手機晶片內建 AI 引擎，微軟推出 Copilot AI 輔助工具，預期將帶來一些換機需求。在 AI 趨勢下，CoWoS/HBM 先進封裝更是重中之重。

CoWoS/HBM 先進封裝技術發展已久，直到 AI 趨勢形成才被大量使用。自晶圓代工製程微縮至 7nm 以來，「摩爾定律」速度開始放慢，為延續摩爾定律，各大晶圓廠及封裝廠龍頭積極發展先進封裝，包括 Fan-out、Chiplet (EMIB、CoWoS)、3D SoIC 等，不過客戶對先進封裝的用量一直無法放大。直到 2023 年初 CHAT GPT 橫空出世。OPEN AI 趨勢形成，才帶動對 CoWoS 及 SoIC 的大量採用。

AI 晶片均須搭配 HBM，帶動 CoWoS 多晶片封裝供不應求，就目前 AI 晶片架構來看，均需搭配超高頻寬記憶體 HBM，其中，NVIDIA H100 使用 6 顆 HBM3，A100 使用 6 顆 HBM2，AMD MI300 更是採用 8 顆 HBM3，因而必須採用多晶片封裝型態，帶動 CoWoS 需求暴增。目前台積電 CoWoS 產能約 1.2 萬片／月，隨著 CoWoS 相關設備於去年第四季～今年首季開始大量交機，台積電 CoWoS 產能也將於 2024 年逐季增加。台積電表示，2024 年 CoWoS 產能將比 2023 年翻 1 倍還多，即 2024 年底 CoWoS 產能至少達到 2.4 萬片／月以上水準，推估落在 2.5 萬～3 萬片／月之間。目前台積電 CoWoS 以搭載 interposer 中介層的 CoWoS-S 為主，2024～2025 年將往 CoWoS-R、CoWoS-LSI 發展。

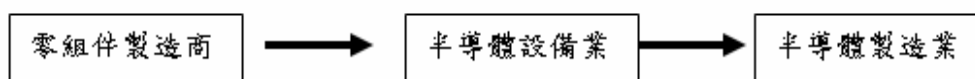
AI 趨勢發展與聯網裝置對 AI 的需求，為晶片產業帶來商機與挑戰。隨著 AI 技術從特定領域加速運算，進展到 ChatGPT 等通用型運算，推動資料

中心及高階伺服器，進而帶動如 CPU、GPU、FPG 與客製化 AI 晶片需求；不過產業顧問潘建光也指出，在進一步談到終端導入 AI 晶片時，可發現無論是智慧型手機臉部解鎖或語音辨識、智慧車輛先進輔助駕駛、全自動倉儲機器人，多是把 AI 元件內嵌在運算處理器，鮮少有獨立型 AI 晶片。

AI 需求締造新興晶片商機的同時，終端 AI 晶片仍面臨許多挑戰。潘建光表示，短期 AI 運算仍以現有處理器或內嵌 AI 單元為主，獨立 AI 運算晶片較難開拓規模市場；中期來看，隨著 AI 應用逐漸聚焦與拓展，針對影音、語音等特用 AI 運算需求將擴大為類 GPU 市場；展望長期，跨域、跨業的 AI 整合將最為關鍵，通用、特用 AI 需求將從服務遍及周邊，朝向跨域整合。

2. 產業上、中、下游之關聯性：

半導體設備業之產品為半導體製造機台，其上游為零組件製造商，下游為半導體製造業。其上中下游關係如下圖所示：



3. 產品之各種發展趨勢：

濕製程設備是半導體製造必須使用之工具，製程與設備為半導體製造技術之一體兩面，設備技術與製程技術有密不可分的關係。前瞻半導體產業製程技術的趨勢，分別是晶圓往大尺寸發展、線寬往細微發展、設計往整合發展及流程往自動化發展，因此濕製程設備也將朝向符合半導體製程技術的趨勢發展。

(a) 半導體製程技術

● 晶圓往大尺寸發展

晶圓尺寸增加的趨勢，自 60 年代的 2 吋晶圓開始，歷經 3 吋、4 吋、5 吋、6 吋、8 吋及目前 12 吋共 7 個世代。由 8 吋轉換至 12 吋，在晶圓週邊原先剩餘無法利用的零碎空間，將由於總面積增加而可以放入晶粒，所以在 12 吋晶圓上可以產出的晶粒可以達到 8 吋的 2.4~2.6 倍。濕製程設備在晶圓往大尺寸發展所產生的問題在於晶舟面積加大，清洗槽之體積必須加大，使用之藥液也增加，晶粒數目加多，要求更佳流場的設計以確保均勻度的一致。

● 封裝製程往 3D 發展

由於 3C 產品的需求，遵循摩耳(Moore)定律的半導體產品持續扮演元件集積化最重要的角色。現有的 IC 雖然仍以單價元件之特性進行設計製作，但是可攜式產品的高整合度與無線化的趨勢，已漸漸引導元件朝向模組化及系統化進行整合，最具代表即為 SoC (System on Chip)、3DIC 與 SiP (System in Package) 三大技術取向，前者主要將元件進行多功能化之設計製作，後者則提供產業最佳的 Time to Market 的整合性解決方案，而 3D-IC 技術則被視為具備兩者優點的整合方案。

●設計往整合製程發展

早年半導體設備廠商的產品開發焦點，集中於克服單元製程中來自於物理、化學過程的挑戰，而較無暇於將以單元製程為主的機台置於整合系統中運作來觀看。整個半導體廠的生產流程，就是由單元製程設備拼湊而成。這樣的生產組合，有許多因整合欠佳而產生的問題，例如每個機台的生產量相差甚大，廠房中的機台配置數容易因為機台產能的顆粒性，產生不具效益的成本。在單元製程設備成熟後，必將納入整合製程的設計，以形成較流暢的生產流程。就短期來言，可立即實施的手段是標準化，以標準的界面來聯絡各自為政的機台。長期來看，緊密結合製程前後順序相連的單元製程機台，也就是將可以處理模組製程(module process)的機台加以組合。未來在極深次微米製程下，晶圓在包括沈積、蝕刻及化學機械研磨各製程設備間來回進行一道又一道的製程已無法因應要求，唯有整合，才能最快掌握製程狀況或解決問題。

●流程往自動化發展

半導體製造有著相當精密、複雜的製程，機器設備成本又高，為了維持產品之穩定品質與提昇生產效率，對自動化之投入始終不遺餘力。事實上半導體業之所以如此重視自動化，也有其不得不然的理由，根據德國某著名半導體潔淨室設計公司對附著於矽晶圓(Wafer)上之微塵(Particle)來源作分析後指出，人體是微塵的最主要來源，而微塵又是影響半導體品質的最大殺手，因此要改善產品可靠度的最有效途徑便是盡量減少人與產品的直接接觸，高度自動化遂成為不二法門。半導體製造牽涉對微觀尺寸的精準控制，以及對鬆散連結的機台群動態、複雜的生產管理，半導體生產過程需要數量極為龐大的數據來管理、控制、檢驗及診斷。拜電腦及網路科技長足進步之賜，生產及工程的資訊整合將使得機台內的生產及工程活動達成較和諧、有效率的狀態，這也就是晶圓尺寸世代自動化的概念。依賴規模經濟遂行成本競爭優勢的廠商，可以利用資訊整合自動化的特性，降低生產成本對生產數量的彈性，也就是說，資訊整合自動化使得多樣化的彈性生產更有效率，少量生產和大量生產之間的成本差距縮小。此外，近年半導體廠商陸續興建完成 12 吋晶圓廠，在晶圓面積及重量較以往增加數倍的情況下，自動化也成為必需的作業流程。

台灣 12 吋晶圓產能持續領先全球，然而同時國際半導體領導廠商英特爾(Intel)已提出下一世代 18 吋晶圓廠的想法，帶動全球半導體廠佈局下世代晶圓技術研發。Intel 在 ISMI(國際半導體技術協會)下推動成立了 450mm(18 吋)推動小組，成員包括 Intel、Samsung、台積電、Toshiba 等公司。面對全球此 18 吋晶圓的發展，台灣半導體設備製造商應積極投入相關設備研發，提前佈局市場及提升競爭力，廣邀國際設備商在台灣建立耗材及零組件產業，期透過上下游合作機制，逐步建立台灣在半導體設備之產業能量。

(b)濕製程設備

單片晶圓濕製程設備具有較高的製程環境控制能力與微粒去除率，加上佔地面積小、化學品與純水耗量少、極富彈性的製程調整能力等優點，使其成為未來半導體濕製程設備的主流，其產品未來發展趨勢如下：

- 控制容易、良率高

在降低生產成本的考量下，未來晶圓尺寸將越趨於大型化，而積集度也將越高，每片晶圓的特性差異將越大，其加工製作所需條件也隨之改變，在此種特性下求取高良率，勢必得在一較小的高密閉環境中，予以嚴格的溫、溼度控制與高彈性化的製程條件或配方。

- 機台佔地面積小

因為旋轉清洗設備，藉由各種獨立化學品源的噴射機構，來取代傳統每一種化學液佔據一清洗槽的設計方式，不僅省略了清洗槽的設置，也直接減少機台的面積，這使得潔淨室的空間將能予以充分利用。

- 減少化學品、廢液與廢氣排放

由於僅處理單一晶圓，而且製程環境縮小，加上以噴嘴方式僅將化學液或純水直接噴灑於晶圓上，再利用回收過濾系統，大大降低化學品與純水消耗量，也減少廢液與廢氣量的排放，既降低生產成本也兼顧環保要求。

- 多項功能集於一身

由於旋轉設備的噴灑頭(Dispenser)能提供多樣獨立的化學品、純水與氮氣，再加上多槽式(Multiple chambers)設計，使得各種不同製程均能安排在同一機台上，增加彈性運作安排的空間。尤其再搭配晶片傳送自動化與化學品獨立回收再利用系統，旋轉清洗設備將構成一個完整的製程運作體系。

- 與分子力結合

隨著晶圓積集度以及 IO 數目的提高，使得層數越來越多、線寬越來越窄，遂造成高深寬比(Aspect ratio)的現象。當這個比值高到某一個程度，將使得離心力與壓力差無法把深溝中的化學液、反應產物或純水帶離，而造成髒污殘留或水痕，間接使 IC 元件電氣特性變差、生產良率降低。唯有再搭配分子力(Atomic force)或化學蒸氣等方法，例如表面張力、濃度差擴散、凡得瓦力(Van der Walls)與 Vapor HF、IPA，才有機會達成目標。

4. 產品競爭情形：

- (a)前段酸槽設備

由於本土設備商發展較晚，台灣市場目前幾乎為日本業者所壟斷，前幾大廠商分別為 S.E.S.、TEL、DNS、及 Kaijo，市場佔有率超過九成。本公司主要在 Wafer Reclaim 等中後段製程的市場上努力。

- (b)晶圓級封裝產業設備

本公司為主要的設備供應商，尤其在錫鉛凸塊(Solder bumping)的光阻乾膜去除(Dry Film Stripper)製程中，佔有率為最高。另外在凸塊底下金屬層蝕刻(under-bump metallization, UBM)中，亦為國內主要的設備供應商，2004

年起已逐漸出貨至各大廠。以製程技術而言，不但領先國內同業，相較於國外大廠，亦極具競爭力。

(三)技術及研發概況：

1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項 目	112 年度	刊印年度截至 3 月 31 日止
研發費用	267,088	註 1
營收淨額	3,543,994	註 1
佔營收淨額比例	7.54%	註 1

註 1：截至年報刊印日止，第一季財務報告尚未經會計師核閱完成，故暫不列示。

2.最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

年 度	開發成功之技術或產品
一一二年度	(1)Si Via 濕式蝕刻製程設備開發。 (2)Frame Wafer 鈦蝕刻製程與設備開發。 (3)Frame Wafer Polymer 清洗製程與設備開發。 (4)無金屬鹽類鈦蝕刻液開發。 (5)先進製程控制系統(FDC)產品開發。

(四)長、短期業務發展計畫：

1.短期業務發展計畫：

- (1)產品零件標準化，減少庫存及提高存貨週轉率，縮短應收帳款收現天數。
- (2)增設服務據點，提供即時售後支援，提昇客戶滿意度。

2.長期業務發展計畫：

- (1)與客戶共同開發製程機台，朝向產品多元化發展。
- (2)提昇產品品質，拓展行銷版圖。
- (3)加強技術研發，開發新產品應用。

二、市場及產銷概況：

(一)市場分析：

1.主要產品(服務)之銷售提供地區：

單位：新台幣仟元

銷售地區 \ 年度		111 年度		112 年度	
		銷售額	比率(%)	銷售額	比率(%)
內銷	台灣	2,614,496	70.22	2,140,751	60.41
外銷	亞洲/美洲等	1,108,880	29.78	1,403,243	39.59
合 計		3,723,376	100.00	3,543,994	100.00

2.市場佔有率：

本公司產品主要為半導體後段封裝濕式設備，目前專攻於 200 至 300mm 之酸槽設備及單晶圓旋轉設備。國內生產類似產品之同業如嵩展及辛耘等公司，皆僅有部分設備產品重疊，其他同業則為國外設備廠商如 SEZ(2009 年已被 LAM 併購)、SSEC 及 Semitool(2010 年已被 Apply Material 併購)等公司。

112 年度本公司營業收入淨額為新台幣 3,543,994 仟元，其中設備類製造與代理等收入為 2,493,740 仟元，佔全球半導體設備市場之市佔率約略為 1%，主因為半導體設備為前段設備屬於大宗且金額較大。本公司營運策略係以如何整合有限的人力資源，創造最大之經營績效，業務接單除了考量客戶之重要性外，訂單則係以高毛利率之機台為主，避免為了擴大市場佔有率，浪費有限資源，影響整體獲利率。

以個別應用產品之國內佔有率估計，據本公司自行觀察客戶端之機台採購情形，其酸槽設備(Wet Bench)在 12 吋晶圓級封裝中在台灣佔有率為六到八成，單晶片旋轉機台(UBM Etch)在 12 吋晶圓級封裝中在台灣佔有率約六成，至於化學品調配供應系統多屬配合客戶要求搭售，並非為本公司主力產品。

由 2023 年度全球前十大封測業者營收排名來看(表 5)，前十大較 2022 年衰退 10.29%，全球整體較 2022 年衰退 9.78%。戰爭、中國經濟疲軟、全球經濟衰退、消費性電子市場低迷，以及通貨膨脹等因素疊加下，上游智慧型手機與消費性電子景氣隨之下行，雖有 AI 應用、HPC 與新能源汽車等增長支柱，但仍無法填補消費性電子與智慧型手機的減量，下游封測整體呈現衰退。

表 5 2023 年度全球前十大封測業者營收排名

序号	公司名称	区域	2023 年营收 (亿元人民币)	2022 年营收 (亿元人民币)	2023 年同比 (%)	2023 年占比 (%)
1	日月光 (ASE)	中国台湾	740	855	-13.46	25.87
2	安靠科技 (Amkor)	美国	403	444	-9.22	14.09
3	长电科技 (JCET)	中国大陆	294	338	-13.01	10.27
4	通富微电 (TFME)	中国大陆	226	214	5.41	7.90
5	力成科技 (PTI)	中国台湾	165	193	-14.22	5.78
6	天水华天 (TSH)	中国大陆	114	119	-4.24	3.99
7	智路封测 (Wise Road)	中国大陆	105	119	-11.81	3.67
8	京元电 (KYEC)	中国台湾	76	84	-9.51	2.67
9	南茂科技 (ChipMOS)	中国台湾	50	54	-7.17	1.75
10	顾邦科技 (Chipbon)	中国台湾	47	55	-14.62	1.65
前十大企业合计			2220	2475	-10.29	77.65
其他企业			639	694	-7.97	22.35
全球总计			2859	3169	-9.78	100.00

資料來源：芯思想研究院，2024/03

3.市場未來之供需狀況與成長性：

根據工研院產科國際所 TSIA 預估，2023 年台灣 IC 產業產值達新台幣 42,975 億元(USD\$144.2B)，較 2022 年衰退 11.2%(表 2)。(請參閱本年報「伍、營運概況之一、業務內容(二)-產業概況 1.產業之現況與發展，第(d)段內容」。其中 IC 設計業產值為新台幣 10,735 億元(USD\$36.0B)，較 2022 年衰退 12.9%；IC 製造業為新台幣 26,410 億元(USD\$88.6B)，較 2022 年衰退 9.6%，其中晶圓代工為新台幣 24,656 億元(USD\$82.7B)，較 2022 年衰退 8.2%，記憶體與其他製造為新台幣 1,754 億元(USD\$5.9B)，較 2022 年衰退 25.6%；IC 封裝業為新台幣 3,926 億

元(USD\$13.2B)，較2022年衰退15.8%；IC測試業為新台幣1,904億元(USD\$6.4B)，較2022年衰退12.9%。近年IC產業產值由2019年之26,656億元成長至2023年的42,975億元，與本公司相關的封裝產業，2022年達近年高點4,660億元，2023年則因消費性電子需求不振，為衰退的一年(表6)。

表6 2019~2023年台灣IC產業產值統計(單位：新台幣億元)

億新臺幣	2019	2019 成長率	2020	2020 成長率	2021	2021 成長率	2022	2022 成長率	2023 (e)	2023 (e) 成長率
IC 產業產值	26,656	1.7%	32,222	20.9%	40,820	26.7%	48,370	18.5%	42,975	-11.2%
IC 設計業	6,928	8.0%	8,529	23.1%	12,147	42.4%	12,320	1.4%	10,735	-12.9%
IC 製造業	14,721	-0.9%	18,203	23.7%	22,289	22.4%	29,203	31.0%	26,410	-9.6%
晶圓代工	13,125	2.1%	16,297	2.1%	19,410	19.1%	26,847	38.3%	24,656	-8.2%
記憶體與其他製造	1,596	-20.4%	1,906	19.4%	2,879	51.0%	2,356	-18.2%	1,754	-25.6%
IC 封裝業	3,463	0.5%	3,775	9.0%	4,354	15.3%	4,660	7.0%	3,926	-15.8%
IC 測試業	1,544	4.0%	1,715	11.1%	2,030	18.4%	2,187	7.7%	1,904	-12.9%
IC 產品產值	8,524	1.3%	10,435	22.4%	15,026	44.0%	14,676	-2.3%	12,489	-14.9%
全球半導體市場(億美元)及成長率(%)	4,123	-12.0%	4,404	6.8%	5,559	26.2%	5,741	3.3%	5,161	-10.1%

資料來源：台灣半導體產業協會 TSIA；工研院產科國際所(IEK)，2023/11

2023年由於包括戰爭衝擊、全球通膨及升息等外在環境不確定因素，消費性電子產品出現庫存調整，對相關半導體生產鏈造成影響，雖然2022年下半年半導體生產鏈庫存去化情況恐較預期劇烈，所幸大客戶2023年營運成果優於預期，晶圓代工產值增幅優於預期，抵銷了IC設計、記憶體、封裝測試等產值衰退壓力。台灣半導體產業在2024年隨著庫存調整進入尾聲、終端消費市場需求回溫，加上AI、高效能運算等應用需求持續推升之下，IC設計、製造與封測產業都有望擺脫市況不佳的情勢，逐步恢復正成長態勢，預估IC產業產值將達新台幣4.9兆元，較2023年成長14.1%。

日本SEAJ與國際半導體產業協會(SEMI)根據全球80家以上半導體設備商每月提供的數據匯整而成。「日經新聞」分析指出，全球半導體設備投資停滯主因是智能手機等產品銷售不振，拖累全球晶片設備銷售額，在連續2季陷入萎縮後，也在第2季出現4年來最大的萎縮幅度(20%)。與此相反的是，大陸廠商採購意願非常強烈，大陸市場季度銷售額則創下歷史新高紀錄。今年三季度全球9大晶片製造設備商於大陸市場的營收合計約105億美元、較去年同期暴增70%。今年第3季9大晶片設備商在大陸市場營收占整體營收比重達44%、較去年同期23%呈現大幅增長。例如荷蘭曝光機大廠艾司摩爾(ASML)今年第3季來自大陸市場營收占比已經由上一季的24%大幅提高到46%，今年前三季來自大陸市場營收較去年同期暴漲約3倍；全球第一大半導體設備廠美國應用材料(AMAT)第4財季(截至2023年10月29日)來自大陸營收與上季相比大幅提升了17個百分點至44%，該公司預計未來在大陸營收占比仍將維持高位；科林研發集團(Lam Research Corporation)今年第3季來自大陸的營收占比也大幅提升了22個百分點至48%。

此外，日本半導體設備大廠東京電子(TEL)公布第3季財報數據也顯示，來自大陸市場的營收占比提高到43%，雖然大陸先進製程投資延遲，但成熟製程投資則大幅加速。科磊、Screen等半導體設備大廠今年3季來自大陸的營

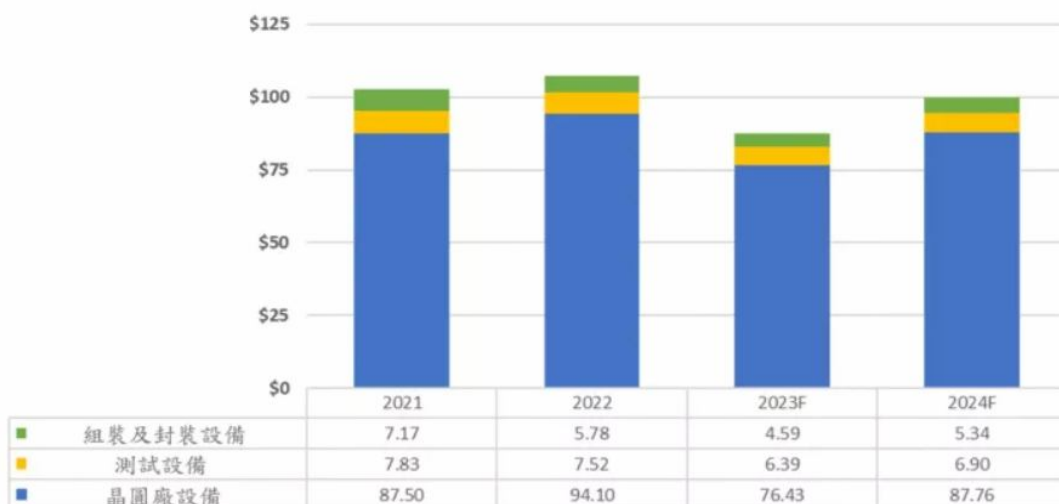
收占比分別達到了 43%和 48%。今年大陸半導體設備市場的需求的增長，主要是由於美、日、荷對先進晶片製造設備的實施出口管制，迫使大陸加強了對於成熟製程產能進行投資。市場研究機構集邦科技（TrendForce）統計，2023 年的全球成熟製程產能當中，大陸廠商的占比將達到 29%，預計到 2027 年這一占比將達到 33%。另據全球半導體觀察統計，除了 7 座已暫停擱置的晶圓廠，目前大陸建有 44 座晶圓廠，還有在建晶圓廠 22 座，計畫建設的晶圓廠 10 座。總體來看，大陸預計至 2024 年底，將建立 32 座大型晶圓廠，且全部鎖定成熟製程。

下述段落係根據 SEMI(國際半導體產業協會)2023 年 7 月發布的「2023 年中整體 OEM 半導體設備預測報告」(Mid-Year Total Semiconductor Equipment Forecast - OEM Perspective)，暨同一機構於 2023 年 12 月發布的「2023 年終整體 OEM 半導體設備預測報告」(Year-end Total Semiconductor Equipment Forecast - OEM Perspective)來說明設備業未來之供需狀況與成長性。

SEMI 國際半導體產業協會於北美國際半導體展 SEMICON West 2023 公布《年中整體 OEM 半導體設備預測報告》(Mid-Year Total Semiconductor Equipment Forecast - OEM Perspective)，預估全球半導體製造設備銷售總額將先蹲後跳，2023 年較 2022 年創紀錄的 1,074 億美元下滑 18.6%至 874 億美元，並預測將於 2024 年出現反彈力道，在前段及後段部門共同驅動下，再次回到 1,000 億美元水準。SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸分析：「半導體設備市場歷經多年歷史性榮景後，2023 年進入調整期，透過高效能運算和遍地開花的聯網商機領軍，將可望於 2024 年出現強勁反彈，對市場長期穩健成長預測保持不變。」

晶圓廠設備(包括晶圓加工、晶圓廠設施...等設備)銷售總額雖於 2023 年下降 18.8%至 764 億美元，幅度超過 SEMI 2022 年年底預測的 16.8%，但 2024 年全球半導體設備銷售將出現復甦跡象，重回千億美元，其中以晶圓廠設備為大宗，單一部門銷售即來到 878 億美元，成長 14.8%。後段製程設備則因總體經濟局勢發展放緩以及半導體需求疲軟等因素影響，使 2022 年的下滑走勢一路延續至 2023 年。2023 年半導體測試設備市場銷售額將減少 15%至 64 億美元，組裝及封裝設備下探幅度更大，預計減少 20.5%至 46 億美元。不過，測試設備和組裝及封裝設備銷售 2024 年都將好轉，可望分別成長 7.9%和 16.4%(圖 18)。

圖 18 2021~2024 年半導體設備(應用類別)預測-年中報告(單位：十億美元)



資料來源：SEMI，2023/07

SEMI 預測結果為綜合市場領先設備供應商回覆、SEMI《全球半導體設備市場報告》(Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics Report, WWSEMS)資料，以及備受業界肯定之 SEMI 全球晶圓廠預測報告(World Fab Forecast)資料庫數據分析而來。

SEMI 國際半導體產業協會於 SEMICON Japan 日本國際半導體展公布年終整體 OEM 半導體設備預測報告，顯示 2023 年全球半導體製造設備銷售總額全年預估將達 1,000 億美元水平，與 2022 年總額 1,074 億美元相比減少 6.1%；在前段及後段製程推動下，半導體製造設備銷售預期於 2024 年回升，並將在 2025 年創下 1,240 億美元新高(圖 19)。

圖 19 2022~2025 年半導體設備(應用類別)預測-年終報告(單位：十億美元)



資料來源：SEMI，2023/12

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「半導體設備市場歷經多年歷史性榮景，2023 年出現循環性調整，2024 年市場可望回溫，預估 2025 年受惠於新晶圓廠成立、產能擴張、以及先進技術和解決方案需求看漲的利基下，將迎來強勁反彈，帶動前段和後段製程設備需求成長。」

半導體前段設備銷售額（含晶圓製程、晶圓廠設施和光罩設備）繼去年達成 940 億美元新高後，2023 全年銷售預估將達 906 億美元，年減 3.7%，優於《年中整體 OEM 半導體設備預測報告》早先所發佈年減 18.8% 的全年預估值，預估值上調主因係中國市場高於預期的設備支出成長。2024 年記憶體產能增加有限，成熟產能擴張進入暫停狀態，基於上調後的 2023 年基準，晶圓廠設備銷售額預估僅小幅成長 3%。2025 年隨著新晶圓廠建成運轉、產能擴張和技術升級的帶動，需求成長加速，全年對於半導體前段設備的投資金額預估將近 1,100 億美元，成長 18%。

半導體後段製程設備，包括測試設備和組裝及封裝設備，受到經濟成長放緩以及半導體需求疲軟影響，2022 年起的下行走勢一路延續至今。2023 年，測試設備銷售額預估將出現 15.9% 的減幅，降至 63 億美元，組裝及封裝設備亦未

見好轉跡象，預估出貨金額縮減 31%，降至 40 億美元。不過，測試和組裝及封裝設備銷售至 2024 年可望迎來新局面，預估將分別成長 13.9%和 24.3%。2025 年需求預估將進一步提升，測試和組裝及封裝設備可望分別成長 17%和 20%。

依市場來看，中國、台灣和韓國至 2025 年仍將穩居設備支出的前三位；2023 年全年對中國市場的設備出貨量可望超越 300 億美元，使中國市場在設備支出穩居首位並持續拉大與其他市場的差距；然而，與其他多數市場 2024 年設備支出步上復甦軌道不同，中國市場較高的基期也使得 2024 年反而呈現略微下滑的表現。

2009 年因受金融風暴影響，使得原先半導體大廠之資本支出預算，在 2010 年景氣復甦的帶動下大幅成長 148%，成長持續到 2012 年，2013 年則在歐債風暴狀況不明下，呈現出二位數的衰退。依據國際半導體設備材料產業協會(SEMI)每年底之年終預測，2013 年整體半導體設備市場，因景氣復甦未如預期，較 2012 年下滑 13.8%，除了台灣仍為逆勢成長外，其他僅中國市場可看出有較明顯成長；2014 年因美國景氣復甦程度超出預期，除台灣因基期高而顯現衰退外，其他地區均有成長，尤以北美地區最為明顯。2015 年則因景氣能見度不明，故呈現出持平狀態，而 2016~2018 年全球經濟的不確定因素逐一消除後，可發現明顯成長，尤其是蘋果智慧型手機的成長/普及，帶動了整個供應鏈。2019 年景氣不明朗，經濟成長趨緩，且有貿易戰等不確定因素，導致資本預算衰退，反映出投資心態的保守。2020~2022 年因東亞區域控制新冠肺炎疫情得宜，且預測後新冠肺炎的景氣復甦，5G、車用、遠端教學/會議等新技術新應用推升需求，資本支出亦將隨之成長(請參閱本公司以前年度股東會年報)。2022~2023 年則因俄烏戰爭、台海軍演、以巴加薩走廊衝突、全球通膨及升息等外在環境不確定因素，消費性電子產品出現庫存調整、3C 終端需求也因通膨而不振，對相關半導體生產鏈造成影響。各家市調機構本來均預測 2023 年將是一個乏善可陳的年度，甚至悲觀預測必須到 2025 年上半年總體經濟才會明顯復甦，然而計畫不如變化大，Nvidia 2023 年逆風而上，AI 帶來半導體新應用、新商機，Nvidia 的 GPU 晶片因 AI 應用興起而供不應求，且至少將持續至 2025 年，說是一家公司拯救了半個半導體產業也不算過譽。

以上十餘年全球經濟大事件的演進，顯示半導體設備之成長力道與商機，與經濟成長力、新的產品應用，密不可分。

4.競爭利基：

(A)服務支援機動性高

由於貼近國內市場，可提供即時且彈性之售後支援服務，且在文化、語言溝通方面較無障礙，更容易接近客戶，目前除位於北台灣(新竹)之總部據點外，已建立中部(台中)，南部(高雄、台南)及中國(上海)之服務據點。

(B)優越的研發能力

本公司自成立後即投入濕製程設備之研發，為國內最早投入該產品領域之公司，在歷經多年之研究開發工作後，已累積厚實之自有技術智慧財產(IP)，能適時推出新產品獲得客戶採用。

(C)設備產品競爭力

比較美、日等國之國際大廠之產品，本公司生產之設備，已具有品質及價格競爭優勢，並得業界領導廠商之認可及購置。

(D)整合性高的週邊團隊支援

本公司透過策略結盟及產業串聯的合作，從重要上游零組件之取得，到成品應用設計，都有關係密切的合作伙伴，藉以增加市場推廣的成功率，降低新產品導入的風險成本，提升整體的競爭力。

(E)政府獎勵及國內客戶採購策略

本土化半導體製程設備是政府積極輔導產業之一，可享有多項優惠措施及科專經費補助，國內客戶採購策略開始較著重於建立國內製程設備供應商夥伴關係。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

A.有利因素

(A)台灣半導體設備市場之持續發展

台灣擁有從 IC 設計到半導體代工及封裝測試，完整之供應鏈產業，且世界級前幾大 CSP(Chip Scale Package)及 WLP(Wafer Level Package)封裝廠，如日月光、矽品、台積電、Amkor、星科金朋(SCT)、力成...等，多位於台灣設廠。雖 2008 年遭逢全球不景氣，連帶影響半導體產業景氣，惟自 2009 年第二季起產能利用率即大幅提升，在台灣，領先之封測公司更針對晶圓植凸塊(wafer bumping)和晶圓級晶片尺寸封裝(WLCSP)方面，修正年度資本支出計畫，後市成長可期。

(B)擁有領先同業之研發技術

本公司自設立初期即已投入半導體晶圓清洗設備之研發，1999 年即已開發出第一套 8 吋單晶圓濕式旋轉清洗設備，2002 年取得半導體設備業產品認證(Semi S2-200)，2011 年 12 吋酸槽設備取得 Semi S2-0310 與 S8-0308E 產品認證，2012 年 12 吋單晶片旋轉機台取得 Semi S2-0310 與 S8-0310 產品認證，使公司擁有出貨給半導體製造商之產品安全性認證，不僅在製程技術之研發及經驗累積完善，且擁有厚實之自有技術智慧財產權(IP)。在研發技術、產品改善速度及產品量產速度均可與國外同業抗衡。且已獲得台灣半導體領導廠商之認可，在後段晶圓級封裝市場中，本公司領先同業，為客戶在 CSP 及 WLP 之封裝領域，提供最佳解決方案。

(C)價格競爭優勢

本公司生產之設備就近於台灣生產組裝及提供台系半導體大廠售後維修服務。除製造成本較美、日等國際大廠低外，亦同步與客戶共同開發及設計製程設備。公司投入半導體設備行業時間逾 20 年，持續打入半導體代工或封測大廠之設備供應鏈，證明本公司之產品品質有相當之水準，有利其產品之銷售。

(D)深耕設備之系統整合能力，可滿足客戶不同需求

本公司透過與客戶技術共同開發，在設備方面，從重要上游零組件之取得，到設計應用，皆有密切合作之廠商。可快速設計出符合客戶需求之設備，以滿足各個客戶不同之需求。公司早已取得 ISO 9001 國際認證及 SEMI S2-200 安全認證，有助於半導體設備之市場推廣。且因其產品認證期長，進入門檻高，而本公司目前已與業界一級大廠建立密切之合作夥伴關係，有助於未來持續耕耘該市場。

(E)政府獎勵及國內客戶採購策略

本土化半導體製程設備是政府積極輔導產業之一，可享有多項優惠措施及科專經費補助，國內客戶採購策略開始較著重於建立國內製程設備供應商夥伴關係。

B.不利因素及因應對策

(A)需投入大量研發機台相關之驗證及檢測費用

面對晶圓製程及封裝科技日新月異，研發機台之相關驗證及檢測設備昂貴，且需持續投入資金於研發新技術及新產品上，以維持其競爭力。

因應措施：

- (a)本公司本著良好之財務結構及償債能力，再藉由公司上櫃以提高企業知名度，加強本公司於資本市場籌措資金之競爭力，以解決資金需求之問題。
- (b)與下游國際級客戶合作，以技術合作之方式同步為客戶設計及開發設備，不僅可轉嫁產品開發之風險，亦可節省產品開發完成後相關驗證及檢測之成本花費，且確保合作開發出之產品，由客戶直接採購，減少存貨呆滯風險。

(B)新競爭者的進入，使得售價降低

國內高階封裝設備市場仍屬寡佔，因此吸引國外其他競爭者欲切入此市場，使得部份設備價格下降。

因應措施：

- (a)本公司致力於開發如高附加價值與特殊應用類之新產品，以期因應競爭者加入時，持續維持其競爭利基。
- (b)利用整合協力廠商資源之方式，並藉由製造外包以增加產能彈性。而本公司之人力則專注於研發及掌握關鍵之系統整合技術，提高核心競爭力，增加公司獲利。
- (c)為拓展市場，於中國大陸設立行銷據點，配合大陸半導體市場發展需求，取得市場先佔商機，增加獲利來源。
- (d)製程能力之提升：該公司之產品客製化程度高，除基礎研究能力提升外，藉由配合客戶就新產品或製程採需求而共同開發之模式，提供較國外廠商靈活性高之客製化機台，以因應同業競爭。
- (e)提升作業品質：以改良機台設計及提高產能利用率降低設備生產成本。在改良機台設計方面，依客戶需求檢視機台之設計及組裝程序，以減少重工之花費；另藉由未來逐漸獲得客戶認證及下單，提高產能稼動，降低機台生產之平均成本。

本公司之產品係因應客戶需求規格開發，原則上設備廠商之產品皆係依客戶製程規格設計開發。現就本公司與國外設備商之差異比較如下：

比較項目	弘塑科技	國外設備商
市場區格與差異	1.國內自製，當地技術支援及維修容易。 2.運送及成本較低，使相較國外競爭者為低。 3.可就近服務台灣半導體廠，且設備交貨迅速。	1.技術支援及維修需仰賴國外原廠支援。 2.因運送及成本高，使其售價偏高。 3.本身不一定於客戶所在地設有服務據點，需由代理商服務，交貨及服務速度慢。
競爭優勢	1.可根據客戶需求進行共同開發及特別設計。 2.長期貼近客戶服務之經驗，能以較有效率之方式，瞭解客戶真正需求。	1.生產設備之經驗豐富且經多年認證及使用，信賴度較佳。 2.擁有較佳之國際視野。

(C)研發人才養成不易

該產業之設備複雜度日益增加，需靠有經驗之研發人員，方能因應不同客戶之設計需求，且要培養調整產品流程及設計能力之人才，需累積相當時間及經驗，因此研發人員培養不易。

因應措施：

- (a)藉由公司上櫃以提高企業知名度，進一步吸收優秀人才；另提高員工福利，並配合實施相關員工激勵制度，以期留住人才。
- (b)與國際級客戶配合，共同開發，以提升技術人才之研發能力。

(D)銷貨客戶及產業集中

由於全世界前五大半導體封裝廠集中於國內，其持續擴廠計劃較為積極，其他業者資本支出之投入相對保守，導致短期銷貨客戶集中情形無法改善。

因應措施：

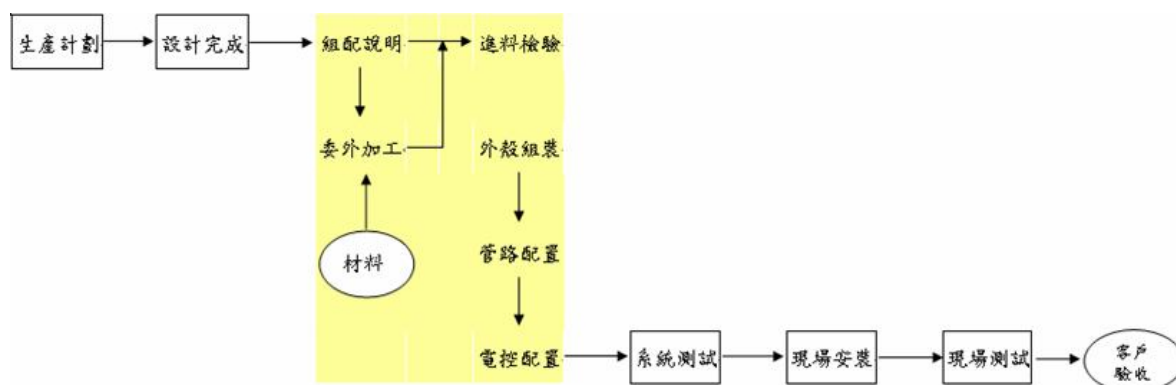
- (a)除持續拓展國內商機外，亦積極爭取大陸設備市場需求，以增加銷售客戶，降低對單一市場銷售風險。
- (b)以半導體封裝設備之技術為基礎，期能跨足 LED、太陽能及 LCD 產業，增加產品運用範圍，降低對單一產業銷售風險。

(二)主要產品之重要用途及產製過程：

1.主要產品之重要用途：

提供半導體 IC 封裝製程之濕式設備。濕製程機台包括清洗、顯影、蝕刻、去光阻、電鍍、化鍍等製程。

2.產製過程：



(三)主要原料之供應狀況：

主要原料	主要供應商	供應狀況
工 程 件	RORZE/樂華、視動自動化、TAZMO、Aime Tech、華福、導航電、英磊、均瑞、常誠、台陽實業、晶凱、順緯	穩定、良好
加 工 件	名超、暉陽、唐毅機械、協宏、大洋、廣銖、立晟、潤太、耀順、奕豐、鑫塑	穩定、良好
市 購 件	IWAKI/億昇、賢昇、彰京、Levitronix、汎達 SMC、Staubli/史陶比爾、崇越 CO2、ABB/艾波比、鼎岳、建誼、和椿	穩定、良好

本公司主要原料皆可由多家廠商供應，且品質及廠商交期穩定。本公司已與供應商建立良好之合作關係，並且分散採購來源，以確保供貨來源之穩定，降低缺貨之風險。

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶/供應商名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

1.最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例：

單位：新台幣仟元

年度 項目	111 年度				112 年度				113 年度截至第一季止			
	名稱	金額	占全年進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至第一季止進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	無	無	無	無	無	無	無	無	註 1	註 1	註 1	
	其他	1,902,744	100.00	無	其他	1,779,587	100.00	無	註 1	註 1	註 1	
	進貨淨額	1,902,744	100.00		進貨淨額	1,779,587	100.00		進貨淨額	註 1	註 1	

註 1：截至年報刊印日止，第一季財務報告尚未經會計師核閱完成，故暫不列示。

增減變動原因說明：

與供應商交易金額與比率之變動均為因應公司業務需求；112 年度因受到全球景氣及半導體需求下滑影響，業務接單量減少，進貨淨額亦隨之減少。

2.最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例：

單位：新台幣仟元

年度 項目	111 年度				112 年度				113 年度截至第一季止			
	名稱	金額	占全年 度銷貨 淨額比 率〔%〕	與發 行人之 關係	名稱	金額	占全年 度銷貨 淨額比 率〔%〕	與發 行人之 關係	名稱	金額	占全年 度銷貨 淨額比 率〔%〕	與發 行人之 關係
1	F客戶	923,770	24.81	無	F客戶	578,917	16.34	無	註 1	註 1	註 1	
	其他	2,799,606	75.19	無	其他	2,965,077	83.66	無	註 1	註 1	註 1	
	銷貨 淨額	3,723,376	100.00		銷貨 淨額	3,543,994	100.00		銷貨 淨額	註 1	註 1	

註 1：截至年報刊印日止，第一季財務報告尚未經會計師核閱完成，故暫不列示。

增減變動原因說明：

1.F 客戶：因 112 年度半導體業庫存調整問題，導致產能擴增放緩。

(五)最近二年度生產量值：

1.最近二年度生產量值表：

單位：新台幣仟元/台

生產 量值 主要商品	年度	111 年度			112 年度		
		產能	產量	產值	產能	產量	產值
機台設備產品		註 1	63	1,190,286	註 1	55	1,304,586
化學產品		註 2	註 3	592,885	註 2	註 3	491,449
維修服務及其它		註 2	註 3	267,683	註 2	註 3	176,028
軟體銷售及安裝		註 2	註 3	33,300	註 2	註 3	44,479
存貨跌價及呆滯損失		不適用	不適用	21,413	不適用	不適用	39,519
合計		註 1	不適用	2,105,567	註 1	不適用	2,056,061

註 1：本公司係採客戶訂製而生產，且各機台隨著其產品複雜度所須耗費之生產時間亦不同，故無法依各產品別估計產能。

註 2：為子公司或金額較低之營收項目，或產業性質不同，故不羅列產能。

註 3：為子公司或金額較低之營收項目，或產業不同、出貨單位差異甚大且不一致，故無法揭露產量。

(六)最近二年度銷售量值：

1.最近二年度銷售量值表：

單位：新台幣仟元/台

銷 售 量 值 主要商品	年度	111 年度				112 年度			
		內銷		外銷		內銷		外銷	
		量	值	量	值	量	值	量	值
機台設備產品		42	1,304,898	21	578,395	39	1,028,462	16	480,381
化學產品		不適用	851,994	不適用	157,168	不適用	665,509	不適用	207,907
維修服務及其它		不適用	120,868	不適用	2,760	不適用	108,665	不適用	6,847
軟體銷售及安裝		不適用	15,985	不適用	54,786	不適用	31,806	不適用	28,420
半導體及電子設備銷售代理		不適用	320,751	不適用	315,771	不適用	306,309	不適用	679,688
合 計		不適用	2,614,496	不適用	1,108,880	不適用	2,140,751	不適用	1,403,243

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料：

項目 \ 年度		111 年度	112 年度	刊印年度截至 3 月 31 日止
員工 人數 (人)	直接員工	87	83	82
	間接員工	252	247	245
	研發人員	86	88	89
	合計	425	418	416
平均年歲(歲)		42.7	43.6	43.7
平均服務年資(年)		9.3	10.1	10.2
學歷分 布比率 (%)	博士	1.6	1.9	1.9
	碩士	21.2	19.9	19.5
	大專	69.2	70.8	71.1
	高中	3.8	3.3	3.4
	高中以下	4.2	4.1	4.1

四、環保支出資訊：

(一)依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形：本公司非屬法令規範之環境污染事業，故本項不適用。

(二)防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：無。

(三)最近二年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：無。

(四)最近二年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失、處分之總額，並揭露其未來因應對策及可能之支出：無。

(五)目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及未來二年度預計之重大環保資本支出：無。

五、勞資關係：

(一)員工福利措施與實施情形：

本公司為增進員工福利，依法成立職工福利委員會按期提撥福利金，目前本公司福利措施要點如下：

- A.公司法定福利措施：全民健康保險、勞工保險、提撥勞工退休準備金、提撥提撥積欠工資墊償基金、提撥職業災害保險、提繳勞工退休金。
- B.公司特別提供：員工酬勞及認股、年節及績效獎金、員工教育訓練計劃、員工子女獎學金、人身及意外保險及定期健康檢查。
- C.福利委員會提供：三節禮金、生日禮金、婚喪喜慶補助金、傷病慰問金、生育津貼、社團活動、定期員工旅遊活動、定期慶生會及其他各種便利優惠活動等。

(二)員工進修與訓練：

- A.公司內部不定期舉行訓練課程，依實際需要請員工參加。
- B.員工得視工作需要參加外部訓練課程，其費用則由公司給予補助。
- C.員工進修與訓練需依據本公司「教育訓練作業程序」辦理。

112 年度員工進修實際施行狀況如下表(部分時數、費用採估計)：

課程類別	課程次數	總人次	總時數	總費用
1.新進人員訓練	4	4	24	0
2.專業職能/工程類訓練	5	5	116	68,419
3.勞安衛訓練/工安類	51	51	306	47,057
4.主管職能訓練	8	17	84	57,357
5.其他自我提升課程	0	0	0	0
總 計	68	77	530	172,833

(三)退休制度與其實施情形：

為了增進勞工退休生活保障，加強勞雇關係，本公司依法執行退休金提撥。

- A.適用舊制員工：本公司之退休制度依據勞基法相關規定辦理，並依法按月提撥退休金存入中央信託局，交由勞工退休準備金監督委員會管理。
- B.適用新制員工：依據勞工退休金條例，由公司按月給付薪資總額 6%提撥退休準備金，存入勞保局管理專戶。

(四)勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司成立以來，有關勞資關係之一切規定措施，均依相關法令辦理。公司對於員工意見極為重視，並本著共存共榮之經營理念與明確的管理政策，內部溝

通管道通暢，維持良好和諧的勞資關係。

(五)最近二年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失及目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

(六)工作環境與員工人身安全的保護措施：

項目	內 容
門禁安全	1. 24 小時設有嚴密門禁監視系統。 2. 與保全公司簽約，24 小時維護廠房安全。 3. 與當地警察治安單位密切聯繫。
各項設備之維護及檢查	1. 依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定，每二年委託專業公司進行公共安全檢查。 2. 依據消防法規定，每年委外進行消防檢查。 3. 依據本公司「勞工安全衛生工作守則」等辦法規定，每日、每月、每季、半年或每年等週期，對高、低壓電氣設備、升降機(客梯、貨梯)、空調、飲水機、汽車、機車、消防器具等各項設備進行維護及檢查。
災害防範措施與應變	1. 本公司訂有「勞工安全衛生工作守則」、「危害物通識管理辦法」、「廢棄物處理作業管理程序」、「系統災難復原辦法」、「勞工安全衛生管理規章」、「勞工安全衛生管理計畫」、「自動檢查計畫」、「意外事件通報機制管理辦法」等災害防止、搶救注意事項及事故職災通報程序，明確規範本公司各級人員事前及事後因應重大事件如天災及事故等重大突發狀況之應負責任及任務內容。 2. 本公司成立消防編組，每年兩次聘請消防主管機關辦理消防防災講習。 3. 為維護員工安全與衛生，本公司設有安全衛生部門，推展安全衛生業務，編制有甲種勞工安全衛生業務主管一人(專任)及勞工安全衛生管理員一人(專任)，已向北區勞動檢查所辦理登錄在案。
生理及心理衛生	1. 健康檢查：新進人員報到前須先辦理身體健康檢查，在職人員每年定期健康檢查。 2. 工作環境衛生：工作場所依規定全面禁菸、不定期舉辦健康講座、定期進行辦公室環境清潔、消毒。 3. 意見表達：員工意見可向人資單位表達、或向部門主管、總經理表達。 4. 性騷擾防治：訂有「性騷擾防治措施暨申訴作業辦法」。
承攬商作業危害因素告知	本公司訂有「承攬商管理辦法」，並要求廠商確實遵行。
保險及醫療慰問	1. 依法投保勞保(含職災保險)、健保，另有辦理員工團體險。 2. 由本公司職福會辦理醫療慰問。

六、資通安全管理：

(一)資通安全風險管理架構：

(1)本公司設有專責資訊部門及配置適當人數之專責資訊人員：未設置資安長此職位，但有一位專責資安主管，另配置兩位專責資安資訊人員，依本公司規模及行業別非屬金融、資訊、網路交易等行業，人力配置屬於適當。

(2)本公司專責資訊部門隸屬於總經理。

(二)資通安全政策：

(1)本公司訂有各類資訊安全管理辦法，例如：「系統災難復原辦法」、「網路使用規則」、「資訊安全管理規則」、「資訊系統權限管理辦法」、「電腦軟硬體使用及公司網站管理辦法」、「伺服器檔案使用規則」...等。

(2)違反資安行為，依「獎懲規定」處理。

(三)具體管理方案及投入資通安全管理之資源：

(1)本公司每年均經會計師事務所查核資訊環境、帳號控管、軟硬體配置、防毒軟體、防火牆、ERP系統...等，評核結果為適切。

(2)本公司內稽人員每年定期內部稽核，資訊環境尚無內控重大缺失。

(3)本公司資訊人員得依工作需求參加外部資安訓練課程，其費用則由公司全額負擔。

(4)本公司每年固定與專責資安廠商簽訂相關軟硬體合約，例如：電腦系統軟硬體維護合約、主機維護合約、防毒軟體合約...等，本年度投入金額約新台幣100~150萬。

(5)本公司本年度更新伺服器、主機、電腦機房...等相關硬體設備，例如：異地備援專案更新軟硬體、郵件過濾主機，本年度投入金額為新台幣358萬。

(6)本公司資訊人員定期向所有同仁宣導資安重要性，例如：勿使用或安裝非法軟體、注意網路(上網)使用的安全、勿下載不明軟體或程式...等。

(四)最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

七、重要契約：

截至年報刊印日止仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約(請參閱本年報後附之財務報告段落：六、重要會計項目之說明)及其他足以影響股東權益之重要契約如下：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
委任合約	林志崧建築師事務所	111~完工(日期略)	新竹廠辦二期新建工程 常駐監造委任契約書	無
營建合約	暉順營造	112~完工(日期略)	新竹廠辦二期新建工程	無
保全合約	誼光保全	每年續約	門禁保全駐廠服務	無
維護合約	士強電腦資訊	每年續約	資安/軟硬體維護	無
法律顧問	碩彥法律事務所	每年續約	常年法律顧問	無
智財顧問	翼勝智慧資產管理	每年續約	常年智財顧問	無
責任險	新加坡商美國國際產物保險	每年續約	董事責任險	無
火險	華南產物保險	每年續約	產物保險	無

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及損益表：

(一)簡明資產負債表-合併財務報告

單位：新台幣仟元

年 度 項 目		最 近 五 年 度 財 務 資 料					刊印年度截至 3 月 31 日止 財務資料(註 1)
		108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	
流 動 資 產		2,658,926	3,344,107	4,261,109	4,800,415	4,944,478	註 1
不動產、廠房及 設 備		1,091,273	1,046,236	1,049,154	1,234,819	1,866,317	註 1
無 形 資 產		519,805	488,358	458,583	423,939	394,552	註 1
其 他 資 產		629,953	564,642	380,525	454,966	486,305	註 1
資 產 總 額		4,899,957	5,443,343	6,149,371	6,914,139	7,691,652	註 1
流 動 負 債	分配前	1,667,898	2,092,461	2,603,914	2,896,557	2,885,588	註 1
	分配後	1,901,626	2,413,837	3,100,586	3,422,445	3,353,044	註 1
非 流 動 負 債		452,355	413,127	385,254	612,203	1,091,309	註 1
負 債 總 額	分配前	2,120,253	2,505,588	2,989,168	3,508,760	3,976,897	註 1
	分配後	2,353,981	2,826,964	3,485,840	4,034,648	4,444,353	註 1
歸屬於母公司業 主 之 權 益		2,745,917	2,905,551	3,126,918	3,368,582	3,681,004	註 1
股 本		292,160	292,160	292,160	292,160	292,160	註 1
資 本 公 積		1,096,802	1,102,358	1,111,458	1,123,265	1,177,591	註 1
保 留 盈 餘	分配前	1,155,599	1,372,253	1,767,905	1,852,513	2,071,792	註 1
	分配後	921,871	1,050,877	1,271,233	1,326,625	1,604,336	註 1
其 他 權 益		284,004	221,428	38,043	183,292	208,424	註 1
庫 藏 股 票		(82,648)	(82,648)	(82,648)	(82,648)	(68,963)	註 1
非 控 制 權 益		33,787	32,204	33,285	36,797	33,751	註 1
權 益 總 額	分配前	2,779,704	2,937,755	3,160,203	3,405,379	3,714,755	註 1
	分配後	2,545,976	2,616,379	2,663,531	2,879,491	3,247,299	註 1

註 1：截至年報刊印日止，第一季財務報告尚未經會計師核閱完成，故暫不列示。

(二)簡明資產負債表-個體財務報告

單位：新台幣仟元

年 度 項 目		最 近 五 年 度 財 務 資 料					刊印年度截至 3 月 31 日止 財務資料(註 1)
		108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	
流 動 資 產		1,757,916	2,202,548	3,014,769	3,279,756	3,430,584	不適用
不動產、廠房及 設 備		378,000	348,382	312,562	261,982	256,948	不適用
無 形 資 產		9,277	5,705	1,918	1,876	2,072	不適用
其 他 資 產		1,978,226	1,975,314	1,833,279	2,077,463	2,143,105	不適用
資 產 總 額		4,123,419	4,531,949	5,162,528	5,621,077	5,832,709	不適用
流動負債	分配前	1,183,531	1,448,777	1,866,853	1,979,240	1,698,144	不適用
	分配後	1,417,259	1,770,153	2,363,525	2,505,128	2,165,600	不適用
非 流 動 負 債		193,971	177,621	168,757	273,255	453,561	不適用
負債總額	分配前	1,377,502	1,626,398	2,035,610	2,252,495	2,151,705	不適用
	分配後	1,611,230	1,947,774	2,532,282	2,778,383	2,619,161	不適用
歸屬於母公司業 主 之 權 益		2,745,917	2,905,551	3,126,918	3,368,582	3,681,004	不適用
股 本		292,160	292,160	292,160	292,160	292,160	不適用
資 本 公 積		1,096,802	1,102,358	1,111,458	1,123,265	1,177,591	不適用
保留盈餘	分配前	1,155,599	1,372,253	1,767,905	1,852,513	2,071,792	不適用
	分配後	921,871	1,050,877	1,271,233	1,326,625	1,604,336	不適用
其 他 權 益		284,004	221,428	38,043	183,292	208,424	不適用
庫 藏 股 票		(82,648)	(82,648)	(82,648)	(82,648)	(68,963)	不適用
非 控 制 權 益		0	0	0	0	0	不適用
權 益 總 額	分配前	2,745,917	2,905,551	3,126,918	3,368,582	3,681,004	不適用
	分配後	2,512,189	2,584,175	2,630,246	2,842,694	3,213,548	不適用

註 1：年報刊印年度，截至 3 月 31 日止無須編列個體財務報告，故不適用。

(三)簡明綜合損益表-合併財務報告

單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘為仟元

項 目 \ 年 度	最近五年度財務資料					刊印年度截至3月31日止 財務資料(註1)
	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	
營業收入	2,061,387	2,487,671	3,657,699	3,723,376	3,543,994	註 1
營業毛利	948,697	1,126,320	1,563,393	1,617,809	1,487,933	註 1
營業損益	414,798	533,120	824,256	759,276	694,962	註 1
營業外收入及支出	(10,743)	(23,083)	10,244	174,925	53,700	註 1
稅前淨利	404,055	510,037	834,500	934,201	748,662	註 1
繼續營業單位 本期淨利	312,756	397,358	670,674	725,495	615,406	註 1
停業單位損失	0	0	0	0	0	註 1
本期淨利（損）	312,756	397,358	670,674	725,495	615,406	註 1
本期其他綜合損益 （稅後淨額）	175,885	(8,628)	(135,950)	4,546	123,610	註 1
本期綜合損益總額	488,641	388,730	534,724	730,041	739,016	註 1
淨利歸屬於 母公司業主	309,970	396,873	669,510	722,106	616,340	註 1
淨利歸屬於非控制 權益	2,786	485	1,164	3,389	(934)	註 1
綜合損益總額歸屬 於母公司業主	486,138	387,806	533,643	726,529	739,839	註 1
綜合損益總額歸屬 於非控制權益	2,503	924	1,081	3,512	(823)	註 1
每股盈餘	11.11	13.92	23.47	25.32	21.56	註 1

註 1：截至年報刊印日止，第一季財務報告尚未經會計師核閱完成，故暫不列示。

(四)簡明綜合損益表-個體財務報告

單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘為仟元

項 目 \ 年 度	最近五年度財務資料					刊印年度截至3月31日止財務資料(註1)
	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	
營業收入	995,351	1,199,430	2,036,614	2,014,757	1,626,367	不適用
營業毛利	441,823	497,847	815,058	853,714	762,033	不適用
營業損益	191,556	231,394	440,749	394,778	358,484	不適用
營業外收入及支出	160,385	216,837	316,380	437,770	317,527	不適用
稅前淨利	351,941	448,231	757,129	832,548	676,011	不適用
繼續營業單位本期淨利	309,970	396,873	669,510	722,106	616,340	不適用
停業單位損失	0	0	0	0	0	不適用
本期淨利(損)	309,970	396,873	669,510	722,106	616,340	不適用
本期其他綜合損益(稅後淨額)	176,168	(9,067)	(135,867)	4,423	123,499	不適用
本期綜合損益總額	486,138	387,806	533,643	726,529	739,839	不適用
淨利歸屬於母公司業主	309,970	396,873	669,510	722,106	616,340	不適用
淨利歸屬於非控制權益	0	0	0	0	0	不適用
綜合損益總額歸屬於母公司業主	486,138	387,806	533,643	726,529	739,839	不適用
綜合損益總額歸屬於非控制權益	0	0	0	0	0	不適用
每股盈餘	11.11	13.92	23.47	25.32	21.56	不適用

註1：年報刊印年度，截至3月31日止無須編列個體財務報告，故不適用。

(五)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年 度	會計師事務所	會計師姓名	查 核 意 見
108 年度	勤業眾信聯合會計師事務所	方蘇立、葉東輝	無保留意見
109 年度	勤業眾信聯合會計師事務所	方蘇立、鍾鳴遠	無保留意見
110 年第 1 季	勤業眾信聯合會計師事務所	方蘇立、鍾鳴遠	無保留意見
110 年第 2~4 季	資誠聯合會計師事務所	李典易、謝智政	無保留意見
111 年度	資誠聯合會計師事務所	李典易、謝智政	無保留意見
112 年度	資誠聯合會計師事務所	李典易、謝智政	無保留意見

二、最近五年度財務分析：

(一)財務分析-合併財務報告

年 度 分析項目 (註 2)		最 近 五 年 度 財 務 分 析					刊印年度截至 3 月 31 日止 財務資料(註 1)
		108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	
財務結構 (%)	負債占資產比率	43.27	46.03	48.61	50.75	51.70	註 1
	長期資金占不動產、 廠房及設備比率	285.24	309.54	326.34	311.60	248.67	註 1
償債能力	流動比率(%)	159.42	159.82	163.64	165.73	171.35	註 1
	速動比率(%)	97.38	96.21	100.38	95.25	108.28	註 1
	利息保障倍數(倍)	51	87	144	110	60	註 1
經營能力	應收款項週轉率 (次)	6.31	7.50	7.88	7.00	7.78	註 1
	平均收現日數	57.84	48.66	46.31	52.14	46.91	註 1
	存貨週轉率 (次)	1.22	1.19	1.45	1.21	1.13	註 1
	應付款項週轉率 (次)	3.80	3.43	3.74	3.59	4.13	註 1
	平均銷貨日數	299.18	306.72	251.72	301.65	323.01	註 1
	不動產、廠房及設備 週轉率 (次)	1.89	2.38	3.49	3.02	1.90	註 1
	總資產週轉率(次)	0.42	0.46	0.59	0.54	0.46	註 1
獲利能力	資產報酬率 (%)	7.06	7.76	11.63	11.16	8.58	註 1
	權益報酬率 (%)	12.96	14.04	22.20	22.23	17.49	註 1
	稅前純益占實收資本 額比率(%)	138.30	174.57	285.63	319.76	256.25	註 1
	純益率 (%)	15.04	15.95	18.30	19.39	17.39	註 1
	每股(虧損)盈餘(元)	11.11	13.92	23.47	25.32	21.62	註 1
現金流量(%)	現金流量比率	20.06	29.46	24.25	28.24	26.49	註 1
	淨現金流量允當比率	75.83	80.90	83.58	79.48	81.28	註 1
	現金再投資比率	3.05	10.62	7.95	7.68	4.79	註 1
槓桿度	營運槓桿度	1.24	1.21	1.13	1.14	1.14	註 1
	財務槓桿度	1.02	1.01	1.01	1.01	1.02	註 1

註 1：截至年報刊印日止，第一季財務報告尚未經會計師核閱完成，故暫不列示。

註 2：財務分析之計算公式說明：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設

備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／平均資產總額。

(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)。

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)。

(二)財務分析-個體財務報告

年 度 分析項目（註2）		最 近 五 年 度 財 務 分 析					刊印年度截至3月31日止財務資料(註1)
		108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	
財務結構(%)	負債占資產比率	33.41	35.89	39.43	40.07	36.89	不適用
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	758.83	864.77	1,029.80	1,363.45	1582.06	不適用
償債能力	流動比率(%)	148.53	152.03	161.49	165.71	202.02	不適用
	速動比率(%)	81.74	83.99	88.36	90.36	121.23	不適用
	利息保障倍數(倍)	112	206	318	257	99	不適用
經營能力	應收款項週轉率(次)	7.80	15.05	15.70	11.68	13.36	不適用
	平均收現日數	46.79	24.25	23.24	31.25	27.32	不適用
	存貨週轉率(次)	0.72	0.79	1.04	0.82	0.61	不適用
	應付款項週轉率(次)	2.78	2.99	3.47	3.22	2.79	不適用
	平均銷貨日數	506.94	462.03	350.96	445.12	598.36	不適用
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	2.63	3.44	6.52	7.69	6.33	不適用
	總資產週轉率(次)	0.24	0.26	0.39	0.36	0.28	不適用
獲利能力	資產報酬率(%)	8.27	9.21	13.85	13.44	10.86	不適用
	權益報酬率(%)	12.96	14.04	22.20	22.23	17.49	不適用
	稅前純益占實收資本額比率(%)	120.46	153.42	259.15	284.96	231.38	不適用
	純益率(%)	31.14	33.09	32.87	35.84	37.90	不適用
	每股(虧損)盈餘(元)	11.11	13.92	23.47	25.32	21.56	不適用
現金流量(%)	現金流量比率	8.51	21.29	27.48	26.58	44.04	不適用
	淨現金流量允當比率	40.18	42.13	52.31	58.65	86.02	不適用
	現金再投資比率	(4.40)	2.34	5.59	0.79	5.26	不適用
槓桿度	營運槓桿度	1.17	1.17	1.08	1.05	1.06	不適用
	財務槓桿度	1.02	1.01	1.01	1.01	1.02	不適用

註1：年報刊印年度，截至3月31日止無須編列個體財務報告，故不適用。

註2：財務分析之計算公式說明：請參閱(一)財務分析-合併財務報告之註2。

(三)最近二年度各項財務比率變動原因

A.合併財務報告

1.財務結構：

112 年度負債占資產比率較 111 年度上升 1.87%，係因 112 年度資產總額較 111 年度增加 777,513 仟元及 112 年度負債總額較 111 年度增加 468,137 仟元。

112 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率較 111 年度減少 20.20%，係因 112 年度權益總額較 111 年增加 312,422 仟元，112 年長期借款較 111 年度增加 480,811 仟元，112 年不動產、廠房及設備較 111 年度增加 631,498 仟元。

2.償債能力：

112 年度流動比率與速動比率較 111 年度上升 3.39%及上升 13.68%，係因本公司 112 年度現金及約當現金較 111 年度增加 249,112 仟元、112 年度按攤銷後成本衡量之金融資產-流動較 111 年度增加 173,113 仟元、112 年度應收帳款淨額較 111 年度減少 56,899 仟元、112 年度存貨較 111 年度減少 102,409 仟元、112 年度合約負債-流動較 111 年度減少 136,035 仟元、112 年度應付帳款較 111 年度減少 21,912 仟元及 112 年度其他應付款較 111 年度減少 82,348 仟元、112 年度負債準備-流動較 111 年度減少 45,254 仟元所致。

112 年度利息保障倍數較 111 年度下降 45.45%，係因本公司 112 年度稅前息前純益較 111 年度減少 185,539 仟元、112 年度利息支出較 111 年度增加 4,020 仟元所致。

3.經營能力：

112 年度應收款項週轉率較 111 年度上升 11.14%，週轉天數較 111 年度減少約 5 天，係因 112 年度銷貨淨額較 111 年度銷貨淨額減少 179,382 仟元及 112 年度應收帳款款項較 111 年度減少 56,033 仟元所致。

112 年度應付款項週轉率(次)與 111 年度所產生之變動，係因 112 年度銷貨成本較 111 年度減少 49,506 仟元及 112 年度應付帳款款項較 111 年度減少 18,205 仟元。

112 年度不動產、廠房及設備週轉率較 111 年度下降 37.09%，係因 112 年度銷貨淨額較 111 年度銷貨淨額減少 179,382 仟元及 112 年度不動產、廠房及設備淨額較 111 年度增加 631,498 仟元所致。

112 年度總資產週轉率較 111 年度下降 14.81%，係因 112 年度銷貨淨額較 111 年度銷貨淨額減少 179,382 仟元及 112 年度資產總額較 111 年度增加 777,513 仟元所致。

4.獲利能力：

資產報酬率及權益報酬率分別下降 23.12%及下降 21.32%，主因為 112 年稅後淨利較 111 年減少 110,089 仟元及 112 年資產總額較 111 年增加 777,513 仟元及 112 年權益總額較 111 年增加 312,422 仟元所致。

純益率下降 10.31%、每股盈餘下降 14.61%，主要原因係因 112 年度銷貨淨額較 111 年度銷貨淨額減少 179,382 仟元及 112 年度銷貨成本較 111 年度減少 49,506 仟元所致。

5.現金流量：

112 年度現金流量比率較 111 年度下降 6.20%，主係因 112 年度營業活動淨現金流量入較 111 年度減少 53,513 仟元；112 年度流動負債較 111 年度減少 10,969 仟元。

112 年度淨現金流量允當比率較 111 年度上升 2.26%，主係因 112 年度最近五年度營業活動淨現金流量較 111 年度增加 593,966 仟元；112 年度最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)較 111 年度增加 659,118 仟元所致。

112 年度現金再投資比率較 111 年度下降 37.63%，主係因 112 年度營業活動淨現金流入較 111 年度減少 53,513 仟元，112 年度現金股利較 111 年度增加發放 32,815 仟元；112 年度不動產、廠房及設備毛額及營運資金較 111 年度增加 808,091 仟元所致。

B.個體財務報告

1.財務結構：

112 年度負債占資產比率較 111 年度下降 7.94%，係因 112 年度資產總額較 111 年度增加 211,632 仟元及 112 年度負債總額較 111 年度減少 100,790 仟元。

112 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率較 111 年度上升 16.03%，係因 112 年度不動產、廠房及設備較 111 年度減少 5,034 仟元，112 年度長期借款較 111 年度增加 180,651 仟元，112 年度遞延所得稅負債較 111 年度增加 5,282 仟元及 112 年度權益總額較 111 年度增加 312,422 仟元所致。

2.償債能力：

112 年度流動比率與速動比率較 111 年度上升 21.91%及 34.16%，因本公司 112 年度現金及約當現金較 111 年度增加 339,136 仟元、112 年度存貨較 111 年度減少 117,882 仟元、112 年度合約負債較 111 年度減少 72,372 仟元、112 年度其他應付帳款較 111 年減少 54,573 仟元、112 年度負債準備-流動較 111 年度減少 53,397 仟元。

112 年度利息保障倍數較 111 年度下降 61.48%，係因本公司 112 年度稅前息前純益較 111 年度減少 156,537 仟元、112 年度利息支出較 111 年度增加 3,630 仟元所致。

3.經營能力：

112 年度應收款項週轉率較 111 年度增加 14.38%，週轉天數較 112 年度減少 3 天，係因 112 年度銷貨淨額較 111 年度銷貨淨額減少 388,390 仟元及 112 年度應收帳款款項較 111 年度減少 68,994 仟元所致。

112 年度存貨週轉率較 111 年度減少 25.61%，係因 112 年度銷貨成本較 111 年度減少 296,709 仟元，112 年度平均存貨較 111 年度增加 4,521 仟元所致。

112 年度應付款項週轉率(次)與 111 年度所產生之變動，係因 112 年度銷貨成本較 111 年度減少 296,709 仟元及 112 年度應付帳款款項較 111 年度增加 54,461 仟元。

112 年度不動產、廠房及設備週轉率較 111 年度下降 17.69%，係因 112 年度銷貨淨額較 111 年度銷貨淨額減少 388,390 仟元，112 年度不動產、廠房

及設備淨額較 111 年度減少 5,034 仟元所致。

112 年度總資產週轉率較 111 年度下降 22.22%，係因 112 年度銷貨淨額較 111 年度銷貨淨額減少 388,390 仟元及 112 年度資產總額較 111 年度增加 211,632 仟元所致。

4.獲利能力：

資產報酬率及權益報酬率分別下降 19.20%及下降 21.32%，主因為 112 年度稅後淨利較 111 年度減少 105,766 仟元及 112 年度資產總額較 111 年度增加 211,632 仟元及 112 年度權益總額較 111 年度增加 312,422 仟元所致。

純益率增加 5.75%與每股盈餘下降 14.85%，主要原因係因 112 年度銷貨淨額較 111 年度銷貨淨額減少 388,390 仟元及 112 年度銷貨成本較 111 年度減少 296,709 仟元所致。

5.現金流量：

112 年度現金流量比率較 111 年度上升 65.69%，主係因 112 年度營業活動淨現金流量入較 111 年度增加 221,784 仟元；112 年度流動負債較 111 年度減少 281,096 仟元。

112 年度淨現金流量允當比率較 111 年度上升 46.67%，主係因 112 年度最近五年度營業活動淨現金流量較 111 年度增加 721,606 仟元；112 年度最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)較 111 年度增加 38,620 仟元所致。

112 年度現金再投資比率較 111 年度上升 565.82%，主係因 112 年度營業活動淨現金流入較 111 年度增加 221,784 仟元，112 年度現金股利較 111 年度增加發放 29,216 仟元；112 年度(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金)較 111 年度增加 498,926 仟元所致。

三、最近年度財務報告之監察人或審計委員會審查報告：請參閱第 101 頁。

四、最近年度財務報告，含會計師查核報告、兩年對照之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及附註或附表：請參閱第 102~168 頁。

五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告，但不含重要會計項目明細表：請參閱第 169~220 頁。

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，是否有發生財務週轉困難情事：無。

弘塑科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司一一二年度營業報告書、財務報告（含合併財務報告）及盈餘分派之議案，其中財務報告（含合併財務報告）業經資誠聯合會計師事務所李典易會計師、謝智政會計師查核竣事，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告（含合併財務報告）及盈餘分派之議案等，業經本審計委員會查核完竣認為尚無不符，爰依證券交易法及公司法之相關規定，繕具報告如上，敬請 鑒察。

此致

弘塑科技股份有限公司一一三年股東常會

審計委員會召集人：陳俊合

陳俊合

中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 八 日

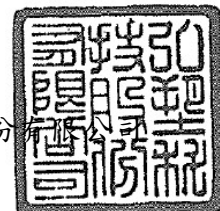
弘塑科技股份有限公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國 112 年度（自民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：弘塑科技股份有限公司



負責人：張鴻森



中華民國 113 年 3 月 8 日

會計師查核報告

(113)財審報字第 23004905 號

弘塑科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

弘塑科技股份有限公司及子公司(以下簡稱「弘塑集團」)民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達弘塑集團民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與弘塑集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對弘塑集團民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

弘塑集團民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

銷貨收入認列

事項說明

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(二十四)；營業收入會計項目之說明請詳合併財務報告附註六(十九)。

弘塑集團主要係製造並銷售半導體及積體電路製造設備、零件及相關化學原料產品。主要收入係依客戶確認簽收後認列，涉及判斷銷售商品之移轉時點正確性且銷貨收入對整體財務報表有重大影響，故列為查核最重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序如下：

1. 評估銷貨收入認列時點政策之適當性。
2. 評估及測試與銷貨收入認列時點攸關之內部控制制度設計及執行之有效性。
3. 選取樣本對銷貨收入交易執行核對客戶訂單及客戶簽回之佐證文件，確認係已完成合約約定事項後，始為收入認列時點。
4. 對資產負債表日前後一段期間之銷貨收入交易執行截止測試。

其他事項—個體財務報告

弘塑科技股份有限公司已編製民國 112 年度及 111 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製準則編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估弘塑集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算弘塑集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

弘塑集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對弘塑集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使弘塑集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致弘塑集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於弘塑集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對弘塑集團民國 112 年度合併財務報表

查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李典易

會計師

謝智政

李典易



謝智政



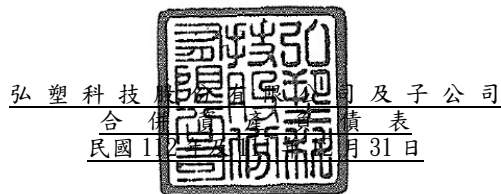
金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號

前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042599 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 8 日



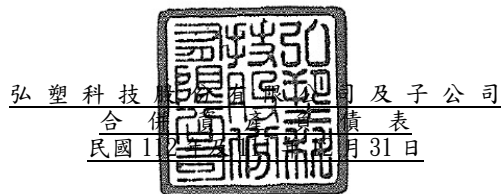
弘塑科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國112年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	112 年 12 月 31 日	111 年 12 月 31 日
			金 額 %	金 額 %
流動資產				
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 2,170,234 28	\$ 1,921,122 28
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	六(四)及八	517,955 7	344,842 5
1150	應收票據淨額	六(五)	9,624 -	8,758 -
1170	應收帳款淨額	六(五)	415,664 5	472,563 7
1200	其他應收款		5,584 -	7,246 -
130X	存貨	六(六)	1,776,134 23	1,878,543 27
1410	預付款項		43,819 1	162,765 2
1470	其他流動資產		5,464 -	4,576 -
11XX	流動資產合計		4,944,478 64	4,800,415 69
非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(二)	37,960 1	- -
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(三)	304,822 4	294,221 5
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八	1,866,317 24	1,234,819 18
1755	使用權資產	六(八)	59,879 1	61,648 1
1780	無形資產	六(九)	394,552 5	423,939 6
1840	遞延所得稅資產	六(二十六)	67,609 1	83,913 1
1975	淨確定福利資產—非流動	六(十三)	9,183 -	- -
1990	其他非流動資產—其他		6,852 -	15,184 -
15XX	非流動資產合計		2,747,174 36	2,113,724 31
1XXX	資產總計		\$ 7,691,652 100	\$ 6,914,139 100

(續次頁)

(續次頁)



弘塑科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國112年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2100	短期借款	六(十)	\$	317,133 4	\$	281,925 4
2130	合約負債－流動	六(十九)		1,178,014 15		1,314,049 19
2150	應付票據			3,970 -		263 -
2170	應付帳款			484,205 6		506,117 7
2200	其他應付款	六(十一)		387,833 5		470,181 7
2230	本期所得稅負債			206,989 3		161,729 3
2250	負債準備－流動	六(十四)		107,573 2		152,827 2
2280	租賃負債－流動			6,799 -		6,088 -
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十二)		190,034 3		- -
2399	其他流動負債－其他			3,038 -		3,378 -
21XX	流動負債合計			<u>2,885,588 38</u>		<u>2,896,557 42</u>
非流動負債						
2540	長期借款	六(十二)		959,966 12		479,155 7
2550	負債準備－非流動	六(十四)		19,780 -		24,402 -
2570	遞延所得稅負債	六(二十六)		50,573 1		46,792 1
2580	租賃負債－非流動			51,380 1		53,373 1
2640	淨確定福利負債－非流動	六(十三)		1,938 -		8,481 -
2670	其他非流動負債－其他	六(十三)		7,672 -		- -
25XX	非流動負債合計			<u>1,091,309 14</u>		<u>612,203 9</u>
2XXX	負債總計			<u>3,976,897 52</u>		<u>3,508,760 51</u>
權益						
歸屬於母公司業主之權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十五)		292,160 4		292,160 4
資本公積						
3200	資本公積	六(十六)		1,177,591 15		1,123,265 16
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十七)		518,443 7		460,315 7
3320	特別盈餘公積			1,386 -		1,386 -
3350	未分配盈餘			1,551,963 20		1,390,812 20
其他權益						
3400	其他權益	六(十八)		208,424 3		183,292 3
3500	庫藏股票	六(十五)	(	68,963) (1)	(	82,648) (1)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>3,681,004 48</u>		<u>3,368,582 49</u>
36XX	非控制權益			<u>33,751 -</u>		<u>36,797 -</u>
3XXX	權益總計			<u>3,714,755 48</u>		<u>3,405,379 49</u>
重大承諾及或有事項						
重大之期後事項						
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>7,691,652 100</u>	\$	<u>6,914,139 100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張鴻森



經理人：石本立

石本立

會計主管：曾繁斌



弘 塑 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 損 益 表
民 國 112 年 及 111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	112 年 度 金 額 %	111 年 度 金 額 %
4000 營業收入	六(十九)	\$ 3,543,994 100	\$ 3,723,376 100
5000 營業成本	六(六)	(2,056,061) (58)	(2,105,567) (57)
5900 營業毛利		1,487,933 42	1,617,809 43
營業費用	六(二十四) (二十五)		
6100 推銷費用		(212,173) (6)	(227,115) (6)
6200 管理費用		(318,330) (9)	(335,257) (9)
6300 研究發展費用		(267,088) (7)	(292,966) (8)
6450 預期信用減損利益(損失)	十二(二)	4,620 -	(3,195) -
6000 營業費用合計		(792,971) (22)	(858,533) (23)
6900 營業利益		694,962 20	759,276 20
營業外收入及支出			
7100 利息收入	六(二十)	51,248 1	19,565 -
7010 其他收入	六(二十一)	34,401 1	25,632 1
7020 其他利益及損失	六(二十二)	(19,383) (1)	138,274 4
7050 財務成本	六(二十三)	(12,566) -	(8,546) -
7000 營業外收入及支出合計		53,700 1	174,925 5
7900 稅前淨利		748,662 21	934,201 25
7950 所得稅費用	六(二十六)	(133,256) (4)	(208,706) (5)
8200 本期淨利		\$ 615,406 17	\$ 725,495 20

(續 次 頁)

弘 塑 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 損 益 表
民 國 112 年 及 前 年 度 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	112 年 度 金 額 %	111 年 度 金 額 %
其他綜合損益			
不重分類至損益之項目			
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十三)	\$ 2,459 -	\$ 7,097 -
8316 透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評 價損益	六(三)	153,150 5 (	4,856) -
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十六)	(30,630) (1)	971 -
8310 不重分類至損益之項目總額		124,979 4	3,212 -
後續可能重分類至損益之項目			
8361 國外營運機構財務報表換算之 兌換差額		(1,369) -	1,334 -
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 123,610 4	\$ 4,546 -
8500 本期綜合損益總額		\$ 739,016 21	\$ 730,041 20
淨利歸屬於：			
8610 母公司業主		\$ 616,340 17	\$ 722,106 20
8620 非控制權益		(\$ 934) -	\$ 3,389 -
綜合損益總額歸屬於：			
8710 母公司業主		\$ 739,839 21	\$ 726,529 20
8720 非控制權益		(\$ 823) -	\$ 3,512 -
基本每股盈餘			
9750 基本每股盈餘	六(二十七)	\$ 21.56	\$ 25.32
稀釋每股盈餘			
9850 稀釋每股盈餘	六(二十七)	\$ 21.45	\$ 24.99

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張鴻泰



經理人：石本立

石本立

會計主管：曾繁斌



弘塑科技股份有限公司及子公司

合併財務報表

民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

歸屬於本公司業主之權益

保留盈餘其他權益

透過其他綜合

損益按公允價

國外營運機構

財務報表換算

值衡量之金融

資產未實現評

附註 普通股股本 資本公積 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 之兌換差額 價損益 庫藏股票 總計 非控制權益 權益總額

111 年度

111 年 1 月 1 日		\$ 292,160	\$ 1,111,458	\$ 388,612	\$ 1,386	\$ 1,377,907	(\$ 2,181)	\$ 40,224	(\$ 82,648)	\$ 3,126,918	\$ 33,285	\$ 3,160,203
本期淨利		-	-	-	-	722,106	-	-	-	722,106	3,389	725,495
本期其他綜合損益	六(十八)	-	-	-	-	6,977	1,331	(3,885)	-	4,423	123	4,546
本期綜合損益總額		-	-	-	-	729,083	1,331	(3,885)	-	726,529	3,512	730,041
110 年度盈餘指撥及分配	六(十七)											
法定盈餘公積		-	-	71,703	-	(71,703)	-	-	-	-	-	-
現金股利		-	-	-	-	(496,672)	-	-	-	(496,672)	-	(496,672)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	六(三)(十八)	-	-	-	-	(147,803)	-	147,803	-	-	-	-
發放予子公司股利調整資本公積	六(十六)	-	11,807	-	-	-	-	-	-	11,807	-	11,807
111 年 12 月 31 日		\$ 292,160	\$ 1,123,265	\$ 460,315	\$ 1,386	\$ 1,390,812	(\$ 850)	\$ 184,142	(\$ 82,648)	\$ 3,368,582	\$ 36,797	\$ 3,405,379

112 年度

112 年 1 月 1 日		\$ 292,160	\$ 1,123,265	\$ 460,315	\$ 1,386	\$ 1,390,812	(\$ 850)	\$ 184,142	(\$ 82,648)	\$ 3,368,582	\$ 36,797	\$ 3,405,379
本期淨利		-	-	-	-	616,340	-	-	-	616,340	(934)	615,406
本期其他綜合損益	六(十八)	-	-	-	-	2,341	(1,362)	122,520	-	123,499	111	123,610
本期綜合損益總額		-	-	-	-	618,681	(1,362)	122,520	-	739,839	(823)	739,016
111 年度盈餘指撥及分配	六(十七)											
法定盈餘公積		-	-	58,128	-	(58,128)	-	-	-	-	-	-
現金股利		-	-	-	-	(525,888)	-	-	-	(525,888)	-	(525,888)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	六(三)(十八)	-	-	-	-	126,486	-	(96,026)	-	30,460	-	30,460
子公司發放現金股利給非控制權益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,223)	(2,223)
發放予子公司股利調整資本公積	六(十六)	-	10,431	-	-	-	-	-	-	10,431	-	10,431
逾時效未領取之股利轉列資本公積	六(十六)	-	194	-	-	-	-	-	-	194	-	194
子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	六(十五)(十六)	-	43,701	-	-	-	-	-	13,685	57,386	-	57,386
112 年 12 月 31 日		\$ 292,160	\$ 1,177,591	\$ 518,443	\$ 1,386	\$ 1,551,963	(\$ 2,212)	\$ 210,636	(\$ 68,963)	\$ 3,681,004	\$ 33,751	\$3,714,755

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張鴻泰



經理人：石本立

會計主管：曾繁斌



弘 塑 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 財 務 報 告
民國 112 年 及 111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<u>營業活動之現金流量</u>			
本期稅前淨利		\$ 748,662	\$ 934,201
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(七)(八) (二十四)	68,579	69,371
攤銷費用	六(九)(二十四)	33,117	33,035
預期信用(回升利益)減損損失	十二(二) (	4,620)	3,195
利息費用	六(二十三)	12,566	8,546
利息收入	六(二十) (	51,248)	(19,565)
股利收入	六(二十一) (	3,882)	(3,070)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	六(二十二)	434 (	29,295)
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收票據	(	866)	2,828
應收帳款		61,519	89,146
其他應收款		522	2,044
存貨		102,409 (	267,626)
預付款項		118,946 (	126,400)
其他流動資產	(	888)	(1,369)
其他非流動資產	(	59)	(491)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債	(	136,035)	417,717
應付票據		3,707	50
應付帳款	(	21,912)	(159,165)
其他應付款	(	87,336)	39,545
負債準備	(	49,876)	42,246
其他流動負債	(	340)	(3,079)
淨確定福利負債	(	5,594)	(1,337)
營運產生之現金流入		787,805	1,030,527
收取之利息		52,389	19,294
支付之利息	(	11,540)	(8,494)
收取之股利		3,882	3,070
支付之所得稅	(	68,081)	(226,429)
營業活動之淨現金流入		764,455	817,968

(續次頁)

弘 塑 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 財 務 報 表
民 國 112 年 及 111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<u>投資活動之現金流量</u>			
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	六(二)	(\$ 37,960)	\$ -
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		-	(4,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	六(三)	142,549	6,971
(取得)出售按攤銷後成本衡量之金融資產		(173,113)	591,845
購置不動產、廠房及設備	六(二十八)	(690,082)	(251,443)
處分不動產、廠房及設備價款		-	83,793
購置無形資產	六(九)	(3,730)	(5,429)
存出保證金減少(增加)		9,014	(989)
投資活動之淨現金(流出)流入		(753,322)	420,748
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款增加	六(二十九)	1,048,000	1,422,209
短期借款減少	六(二十九)	(1,012,792)	(1,478,978)
舉借長期借款	六(二十九)	670,845	479,155
償還長期借款	六(二十九)	-	(338,273)
租賃負債本金償還	六(二十九)	(6,652)	(6,852)
發放現金股利	六(十七)	(517,680)	(484,865)
逾時效未領取之股利轉列資本公積	六(十六)	194	-
庫藏股交易	六(十五)	57,386	-
籌資活動之淨現金流入(流出)		239,301	(407,604)
匯率影響數		(1,322)	1,578
本期現金及約當現金增加數		249,112	832,690
期初現金及約當現金餘額	六(一)	1,921,122	1,088,432
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 2,170,234	\$ 1,921,122

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張鴻泰



經理人：石本立

石本立

會計主管：曾繁斌



弘塑科技股份有限公司及子公司
合併財務報表附註
民國 112 年度及 111 年度

單位：新台幣仟元
(除特別註明者外)

一、公司沿革

弘塑科技股份有限公司（以下稱「本公司」）係於民國 82 年 5 月設立，所營業務主要為各種塑膠機械安裝工程設計，五金、機械、塑膠管、泵線、槽、樹脂、塗料、化工原料貯槽工程承包買賣，前各項有關產品之進出口貿易業務，半導體及積體電路製造設備及其材料、零件之代理、買賣及其技術諮詢顧問業務。

弘塑科技股份有限公司於民國 107 年 11 月及 108 年 3 月，為加強異業整合，併購太引資訊股份有限公司及佳霖科技股份有限公司，太引資訊股份有限公司所營業務為各類製造設備軟體設計，佳霖科技股份有限公司所營業務為半導體及積體電路製造設備及其材料、零件之代理、買賣及其技術諮詢顧問業務。

本公司股票自民國 100 年 1 月起在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告已於民國 113 年 3 月 8 日經董事會通過後發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一) 已採用金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)認可並發布生效之新發布、修正後國際財務報導準則會計準則之影響

下表彙列金管會認可並發布生效之民國 112 年適用之國際財務報導準則會計準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	國際會計準則理事會 發布之生效日
國際會計準則第1號之修正「會計政策之揭露」	民國112年1月1日
國際會計準則第8號之修正「會計估計值之定義」	民國112年1月1日
國際會計準則第12號之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」	民國112年1月1日
國際會計準則第12號之修正「國際租稅變革—支柱二規則範本」	民國112年5月23日

本集團經評估上述準則及解釋對本集團財務狀況與財務績效並無重大影響。

(二) 尚未採用金管會認可之新發布、修正後國際財務報導準則會計準則之影響

下表彙列金管會認可之民國 113 年適用之國際財務報導準則會計準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	國際會計準則理事會 發布之生效日
國際財務報導準則第16號之修正「售後租回中之租賃負債」	民國113年1月1日
國際會計準則第1號之修正「負債之流動或非流動分類」	民國113年1月1日
國際會計準則第1號之修正「具合約條款之非流動負債」	民國113年1月1日
國際會計準則第7號及國際財務報導準則第7號之修正「供應商融資安排」	民國113年1月1日

本集團經評估上述準則及解釋對本集團財務狀況與財務績效並無重大影響。

(三) 國際會計準則理事會已發布但尚未經金管會認可之國際財務報導準則會計準則之影響

下表彙列國際會計準則理事會已發布但尚未納入金管會認可之國際財務報導準則會計準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	國際會計準則理事會 發布之生效日
國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	待國際會計準則理事會決定
國際財務報導準則第17號「保險合約」	民國112年1月1日
國際財務報導準則第17號「保險合約」之修正	民國112年1月1日
國際財務報導準則第17號之修正「初次適用國際財務報導準則第17號及國際財務報導準則第9號—比較資訊」	民國112年1月1日
國際會計準則第21號之修正「缺乏可兌換性」	民國114年1月1日

本集團經評估上述準則及解釋對本集團財務狀況與財務績效並無重大影響。

四、重大會計政策之彙總說明

編製本合併財務報告所採用之主要會計政策說明如下。除另有說明外，此等政策在所有報導期間一致地適用。

(一) 遵循聲明

本合併財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則與金管會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱 IFRSs)編製。

(二) 編製基礎

1. 除下列重要項目外，本集團財務報告係按歷史成本編製：

- (1) 按公允價值衡量之透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債(包括衍生工具)。
- (2) 按公允價值衡量之透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產。
- (3) 按退休基金資產減除確定福利義務現值之淨額認列之確定福利負債(資產)。

2. 編製符合 IFRSs 之財務報告需要使用一些重要會計估計值，在應用本集團的會計政策過程中亦需要管理階層運用其判斷，涉及高度判斷或複雜性之項目，或涉及合併財務報告之重大假設及估計之項目，請詳附註五說明。

(三) 合併基礎

1. 合併財務報告編製原則

- (1) 本集團將所有子公司納入合併財務報告編製之個體。子公司指受本集團控制之個體，當本集團暴露於來自對該個體之參與之變動報酬或對該等變動報酬享有權利，且透過對該個體之權力有能力影響該等報酬時，本集團即控制該個體。子公司自本集團取得控制之日起納入合併財務報告，於喪失控制之日起終止合併。
- (2) 集團內公司間之交易、餘額及未實現損益業已銷除。子公司之會計政策已作必要之調整，與本集團採用之政策一致。
- (3) 損益及其他綜合損益各組成部分歸屬於母公司業主及非控制權益；綜合損益總額亦歸屬於母公司業主及非控制權益，即使因而導致非控制權益發生虧損餘額。
- (4) 對子公司持股之變動若未導致喪失控制(與非控制權益之交易)，係作為權益交易處理，亦即視為與業主間進行之交易。非控制權益之調整金額與所支付或收取對價之公允價值間之差額係直接認列於權益。
- (5) 當集團喪失對子公司之控制，對前子公司之剩餘投資係按公允價值重新衡量，並作為原始認列金融資產之公允價值或原始認列投資關聯企業或合資之成本，公允價值與帳面金額之差額認列為當期損益。對於先前認列於其他綜合損益與該子公司有關之所有金額，其會計處理與本集團若直接處分相關資產或負債之基礎相同，亦即如先前認列為其他綜合損益之利益或損失，於處分相關資產或負債時將被重分類為損益，則當喪失對子公司之控制時，將該利益或損失自權益重分類為損益。

2. 列入合併財務報告之子公司：

投資公司 名 稱	子公司 名 稱	業務性質	所持股權百分比		說明
			112年12月31日	111年12月31日	
本公司	添鴻科技股份 有限公司	化學原料 製造	100	100	
本公司	Grand Plastic Technology Limited	投資業務	100	100	
本公司	太引資訊系統 股份有限公司	軟體銷售 及安裝	78.1	78.1	
本公司	佳霖科技股份 有限公司	半導體及 電子設備 銷售代理	100	100	
Grand Plastic Technology Limited	弘懋光電（上海） 有限公司	經營半導 體機台買 賣及維修	100	100	
添鴻科技股份有限 公司	AQUA Talent Co., Ltd.	投資業務	100	100	
AQUA Talent Co., Ltd.	添鴻化學科技（上海） 有限公司	化學原料 製造及銷售	100	100	
太引資訊系統股份 有限公司	太引信息科技（南京） 有限公司	軟體銷售 及安裝	100	100	
佳霖科技股份 有限公司	Challenge Tech. Corp.	投資業務	100	100	
Challenge Tech. Corp.	佳霖電子（上海）有限 公司	半導體及 電子設備 銷售代理	100	100	

3. 未列入合併財務報告之子公司：無。

4. 子公司會計期間不同之調整及處理方式：無。

5. 重大限制：無。

6. 對本集團具重大性之非控制權益之子公司：無。

(四) 外幣換算

本集團之財務報告所列之項目，均係以本集團營運所處主要經濟環境之貨幣（即功能性貨幣）衡量。本合併財務報告係以本公司之功能性貨幣「新台幣」作為表達貨幣列報。

1. 外幣交易及餘額

- (1) 外幣交易採用交易日或衡量日之即期匯率換算為功能性貨幣，換算此等交易產生之換算差額認列為當期損益。
- (2) 外幣貨幣性資產及負債餘額，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之換算差額認列為當期損益。
- (3) 外幣非貨幣性資產及負債餘額，屬透過損益按公允價值衡量者，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之兌換差額認列為當期損益；屬透過其他綜合損益按公允價值衡量者，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之兌換差額認列於其他綜合損益項目；屬非按公允價值衡量者，則按初始交易日之歷史匯率衡量。
- (4) 所有其他兌換損益按交易性質在損益表之「其他利益及損失」列報。

2. 國外營運機構之換算

功能性貨幣與表達貨幣不同之所有公司個體、關聯企業及聯合協議，其經營結果和財務狀況以下列方式換算為表達貨幣：

- (1) 表達於每一資產負債表之資產及負債係以該資產負債表日之收盤匯率換算；
- (2) 表達於每一綜合損益表之收益及費損係以當期平均匯率換算；及
- (3) 所有因換算而產生之兌換差額認列為其他綜合損益。

(五) 資產負債區分流動及非流動之分類標準

1. 資產符合下列條件之一者，分類為流動資產：

- (1) 預期將於正常營業週期中實現該資產，或意圖將其出售或消耗者。
- (2) 主要為交易目的而持有者。
- (3) 預期於資產負債表日後十二個月內實現者。
- (4) 現金或約當現金，但於資產負債表日後至少十二個月交換或用以清償負債受到限制者除外。

本集團將所有不符合上述條件之資產分類為非流動。

2. 負債符合下列條件之一者，分類為流動負債：

- (1) 預期將於正常營業週期中清償者。
- (2) 主要為交易目的而持有者。
- (3) 預期於資產負債表日後十二個月內到期清償者。
- (4) 不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少十二個月者。負債之條款，可能依交易對方之選擇，以發行權益工具而導致清償者，不影響其分類。

本集團將所有不符合上述條件之負債分類為非流動。

(六) 約當現金

約當現金係指短期並具高度流動性之投資，該投資可隨時轉換成定額現金且價值變動之風險甚小。定期存款符合前述定義且其持有目的係為滿足營運上之短期現金承諾者，分類為約當現金。

(七) 透過損益按公允價值衡量之金融資產

1. 係指非屬按攤銷後成本衡量或透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產。
2. 本集團對於符合慣例交易之透過損益按公允價值衡量之金融資產係採用交易日。
3. 本集團於原始認列時按公允價值衡量，相關交易成本認列於損益，後續按公允價值衡量，其利益或損失認列於損益。
4. 當收取股利之權利確立，與股利有關之經濟效益很有可能流入，及股利金額能可靠衡量時，本集團於損益認列股利收入。

(八) 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

1. 係指原始認列時作一不可撤銷之選擇，將非持有供交易之權益工具投資的公允價值變動列報於其他綜合損益。
2. 本集團對於符合交易慣例之透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產係採用交易日會計。
3. 本集團於原始認列時按其公允價值加計交易成本衡量，後續按公允價值衡量。
屬權益工具之公允價值變動認列於其他綜合損益，於除列時，先前認列於其他綜合損益之累積利益或損失後續不得重分類至損益，轉列至保留盈餘項下。當收取股利之權利確立，與股利有關之經濟效益很有可能流入，及股利金額能可靠衡量時，本集團於損益認列股利收入。

(九) 按攤銷後成本衡量之金融資產

1. 係指同時符合下列條件者：
 - (1) 在以收取合約現金流量為目的之經營模式下持有該金融資產。
 - (2) 該金融資產之合約條款產生特定日期之現金流量，完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。
2. 本集團對於符合交易慣例之按攤銷後成本衡量之金融資產係採用交易日會計。

3. 本集團於原始認列時按其公允價值加計交易成本衡量，後續採有效利息法按攤銷程序於流通期間內認列利息收入，及認列減損損失，並於除列時，將其利益或損失認列於損益。
4. 本集團持有不符合約當現金之定期存款，因持有期間短，折現之影響不重大，係以投資金額衡量。

(十) 應收帳款及票據

1. 指依合約約定，已具無條件收取因移轉商品或勞務所換得對價金額權利之帳款及票據。
2. 屬未付息之短期應收帳款及票據，因折現之影響不大，本集團係以原始發票金額衡量。

(十一) 金融資產減損

本集團於每一資產負債表日，就按攤銷後成本衡量之金融資產，考量所有合理且可佐證之資訊(包括前瞻性者)後，對自原始認列後信用風險並未顯著增加者，按 12 個月預期信用損失金額衡量備抵損失；對自原始認列後信用風險已顯著增加者，按存續期間預期信用損失金額衡量備抵損失；就不包含重大財務組成部分之應收帳款或合約資產，按存續期間預期信用損失金額衡量備抵損失。

(十二) 存貨

存貨按成本與淨變現價值孰低者衡量，成本依加權平均法決定。存貨包括在製品。比較成本與淨變現價值孰低時，採逐項比較法，淨變現價值係指在正常營業過程中之估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。

(十三) 不動產、廠房及設備

1. 不動產、廠房及設備係以取得成本為入帳基礎，並將購建期間之有關利息資本化。
2. 後續成本只有在與該項目有關之未來經濟效益很有可能流入本集團，且該項目之成本能可靠衡量時，才包括在資產之帳面金額或認列為一項單獨資產。被重置部分之帳面金額應除列。所有其他維修費用於發生時認列為當期損益。
3. 不動產、廠房及設備之後續衡量採成本模式，除土地不提折舊外，其他按估計耐用年限以直線法計提折舊。不動產、廠房及設備各項組成若屬重大，則單獨提列折舊。

4. 本集團於每一財務年度結束對各項資產之殘值、耐用年限及折舊方法進行檢視，若殘值及耐用年限之預期值與先前之估計不同時，或資產所含之未來經濟效益之預期消耗型態已有重大變動，則自變動發生日起依國際會計準則第 8 號「會計政策、會計估計值變動及錯誤」之會計估計值變動規定處理。各項資產之耐用年限如下：

房屋及建築

廠房主建物	43 年	～	50 年
電梯			15 年
其他	4 年	～	10 年
機器設備	1 年	～	10 年
試驗設備	3 年	～	8 年
其他設備	2 年	～	15 年

(十四) 承租人之租賃交易－使用權資產/租賃負債

1. 租賃資產於可供本集團使用之日認列為使用權資產及租賃負債。當租賃合約係屬短期租賃或低價值標的資產之租賃時，將租賃給付採直線法於租賃期間認列為費用。
2. 租賃負債於租賃開始日將尚未支付之租賃給付按本公司增額借款利率折現後之現值認列，租賃給付包括固定給付，減除可收取之任何租賃誘因，後續採利息法按攤銷後成本法衡量，於租賃期間提列利息費用。當非屬合約修改造造成租賃期間或租賃給付變動時，將重評估租賃負債，並將再衡量數調整使用權資產。
3. 使用權資產於租賃開始日按成本認列，成本包括：
 - (1)租賃負債之原始衡量金額；
 - (2)於開始日或之前支付之任何租賃給付；
 - (3)發生之任何原始直接成本；及
 - (4)為拆卸、移除標的資產及復原其所在地點，或將標的資產復原至租賃之條款及條件中所要求之狀態之估計成本。後續採成本模式衡量，於使用權資產之耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者，提列折舊費用。當租賃負債重評估時，使用權資產將調整租賃負債之任何再衡量數。

(十五) 無形資產

1. 電腦軟體及專利權以取得成本認列，依直線法按估計耐用年限攤銷。
2. 客戶關係、核心技術、專門技術及開發中專案，係因企業合併按收購法而產生，依直線法按估計耐用年限攤銷。
3. 商譽，係因企業合併按收購法而產生。
4. 各項資產之耐用年限如下：

客戶關係	10 年～12 年 6 個月
核心技術	12 年
專門技術	9 年
電腦軟體	1 年～5 年
專利權	10 年

(十六) 非金融資產減損

1. 本集團於資產負債表日針對有減損跡象之資產，估計其可回收金額，當可回收金額低於其帳面價值時，則認列減損損失。可回收金額係指一項資產之公允價值減處分成本或其使用價值，兩者較高者。除商譽外，當以前年度已認列資產減損之情況不存在或減少時，則迴轉減損損失，惟迴轉減損損失而增加之資產帳面金額，不超過該資產若未認列減損損失情況下減除折舊或攤銷後之帳面金額。
2. 商譽定期估計其可回收金額。當可回收金額低於其帳面價值時，則認列減損損失。商譽減損之減損損失於以後年度不予迴轉。
3. 商譽為減損測試之目的，分攤至現金產生單位。此項分攤是依據營運部門辨認，將商譽分攤至預期可從產生商譽之企業合併而受益之現金產生單位或現金產生單位群組。

(十七) 借款

1. 係指向銀行借入之長、短期款項。本集團於原始認列時按其公允價值減除交易成本衡量，後續就減除交易成本後之價款與贖回價值之任何差額，採有效利息法按攤銷程序於流通期間內認列利息費用於損益。
2. 設立借款額度時支付之費用，當很有可能提取部分或全部額度，則該費用認列為借款之交易成本，予以遞延至動支發生時認列為有效利率之調整；當不太可能提取部分或全部額度，則認列該費用為預付款項，並在額度相關之期間內攤銷。

(十八) 應付帳款及票據

1. 係指因賒購原物料、商品或勞務所發生之債務及因營業與非因營業而發生之應付票據。
2. 屬未付息之短期應付帳款及票據，因折現之影響不大，本集團係以原始發票金額衡量。

(十九) 負債準備

負債準備(包含保固)係因過去事件而負有現時法定或推定義務，很有可能需要流出具經濟效益之資源以清償該義務，且該義務之金額能可靠估計時認列。負債準備之衡量係以資產負債表日清償該義務所需支出之最佳估計現值衡量，折現率採用反映目前市場對貨幣時間價值及負債特定風險之評估之稅前折現率，折現之攤銷認列為利息費用。未來營運損失不得認列負債準備。

(二十) 員工福利

1. 短期員工福利

短期員工福利係以預期支付之非折現金額衡量，並於相關服務提供時認列為費用。

2. 退休金

(1) 確定提撥計畫

對於確定提撥計畫，係依權責發生基礎將應提撥之退休基金數額認列為當期之退休金成本。預付提撥金於可退還現金或減少未來給付之範圍內認列為資產。

(2) 確定福利計畫

A. 確定福利計畫下之淨義務係以員工當期或過去服務所賺得之未來福利金額折現計算，並以資產負債表日之確定福利義務現值減除計畫資產之公允價值。確定福利淨義務每年由精算師採用預計單位福利法計算，折現率係使用資產負債表日與確定福利計畫之貨幣及期間一致之政府公債（於資產負債表日）之市場殖利率。

B. 確定福利計畫產生之再衡量數於發生當期認列於其他綜合損益，並表達於保留盈餘。

C. 前期服務成本之相關費用立即認列為損益。

3. 員工酬勞及董監酬勞

員工酬勞及董監事酬勞係於具法律或推定義務且金額可合理估計時，認列為費用及負債。嗣後決議實際配發金額與估列金額有差異時，則按會計估計值變動處理。

(二十一) 所得稅

1. 所得稅費用包含當期及遞延所得稅。除與列入其他綜合損益或直接列入權益之項目有關之所得稅分別列入其他綜合損益或直接列入權益外，所得稅係認列於損益。
2. 本集團依據營運及產生應課稅所得之所在國家在資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率計算當期所得稅。管理階層就適用所得稅相關法規定期評估所得稅申報之狀況，並在適用情況下根據預期須向稅捐機關支付之稅款估列所得稅負債。未分配盈餘依所得稅法加徵之所得稅，嗣盈餘產生年度之次年度於股東會通過盈餘分派案後，始就實際盈餘之分派情形，認列未分配盈餘所得稅費用。
3. 遞延所得稅採用資產負債表法，按資產及負債之課稅基礎與其於個體資產負債表之帳面金額所產生之暫時性差異認列。源自於原始認列之商譽所產生之遞延所得稅負債則不予認列，若遞延所得稅源自於交易（不包括企業合併）中對資產或負債之原始認列，且在交易當時未影響會計利潤或課稅所得（課稅損失）亦未產生相等之應課稅及可減除暫時性差異，則不予認列。若投資子公司產生之暫時性差異，本公司可以控制暫時性差異迴轉之時點，且暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者則不予認列。遞延所得稅採用在資產負債表日已立法或已實質性立法，並於有關之遞延所得稅資產實現或遞延所得稅負債清償時預期適用之稅率（及稅法）為準。
4. 遞延所得稅資產於暫時性差異很有可能用以抵減未來應課稅所得之範圍內認列，並於每一資產負債表日重評估未認列及已認列之遞延所得稅資產。
5. 當有法定執行權將所認列之當期所得稅資產及負債金額互抵且有意圖以淨額基礎清償或同時實現資產及清償負債時，始將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵；當有法定執行權將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵，且遞延所得稅資產及負債由同一稅捐機關課徵所得稅之同一納稅主體、或不同納稅主體產生但各主體意圖以淨額基礎清償或同時實現資產及清償負債時，始將遞延所得稅資產及負債互抵。
6. 因購置設備或技術及研究發展支出等而產生之未使用所得稅抵減遞轉後期部分，係在很有可能未來課稅所得以供未使用所得稅抵減使用之範圍內，認列遞延所得稅資產。

(二十二)股本

1. 普通股分類為權益。直接歸屬於發行新股或認股權之增額成本以扣除所得稅後之淨額於權益中列為價款減項。
2. 本公司買回已發行股票時，將所支付之對價包括任何可直接歸屬之增額成本以稅後淨額認列為股東權益之減項。買回之股票後續再發行時，所收取之對價扣除任何可直接歸屬之增額成本及所得稅影響後與帳面價值之差額認列為股東權益之調整。

(二十三)股利分配

分派予本公司股東之股利於本公司董事會決議分派股利時於財務報告認列，分派現金股利認列為負債。分派股票股利則認列為待分配股票股利，且於發行新股基準日時轉列普通股。

(二十四)收入認列

1. 商品銷貨收入

商品銷貨收入主要來自於半導體機台及產品之銷售等。銷貨收入於產品之控制移轉予客戶時認列，即當產品被交付予客戶，且本集團並無尚未履行之履約義務可能影響客戶接受該產品時。當產品被運送至指定地點，陳舊過時及滅失之風險已移轉予客戶，且客戶依據銷售合約接受產品，或有客觀證據證明所有接受標準皆已滿足時，商品交付方屬發生。

2. 勞務收入

本集團提供軟體開發工程及設備維修業務，軟體開發工程合約中包含軟體銷售及安裝服務。本集團提供之安裝服務重大客製化，故軟體銷售及安裝不可區分，辨認為一個隨時間逐步滿足之履約義務。本集團以投入成本占估計總成本之比例認列收入，已認列收入金額若尚未請款，係認列合約資產，對於該對價有無條件之權利時，將合約資產轉列應收帳款，若客戶應付款超過本集團已提供之服務時則認列為合約負債。本集團對收入、成本及完工程度之估計隨情況改變進行修正。任何導因於估計變動之估計收入、成本增加或減少，於導致修正之情況被管理階層所知悉之期間內反映於損益。設備維修服務係於勞務提供完成時認列。

(二十五) 政府補助

政府補助於可合理確信企業將遵循政府補助所附加之條件，且將可收到該項補助時，按公允價值認列。若政府補助之性質係補償本集團發生之費用，則在相關費用發生期間依有系統之基礎將政府補助認列為當期損益。

(二十六) 企業合併

1. 本集團採用收購法進行企業合併。合併對價根據所移轉之資產、所產生或承擔之負債及所發行之權益工具之公允價值計算，所移轉之對價包括或有對價約定所產生之任何資產和負債之公允價值。與收購有關之成本於發生時認列為費用。企業合併中所取得可辨認之資產及所承擔之負債，按收購日之公允價值衡量。本集團以個別收購交易為基準，非控制權益之組成部分屬現時所有權權益且其持有者有權於清算發生時按比例份額享有企業淨資產者，選擇按收購日公允價值或按非控制權益占被收購者可辨認淨資產之比例衡量；非控制權益之所有其他組成部分則按收購日公允價值衡量。
2. 移轉對價、被收購者非控制權益，及先前已持有被收購者之權益之公允價值總額，若超過所取得可辨認資產及承擔之負債之公允價值，於收購日認列為商譽；所取得可辨認資產及承擔之負債之公允價值，若超過移轉對價、被收購者非控制權益，及先前已持有被收購者之權益之公允價值總額，該差額於收購日認列為當期損益。

(二十七) 營運部門

本集團營運部門資訊與提供給主要營運決策者之內部管理報告採一致之方式報導。主要營運決策者負責分配資源予營運部門並評估其績效。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本集團編製本合併財務報告時，管理階層已運用其判斷以決定所採用之會計政策，並依據資產負債表日當時之情況對於未來事件之合理預期以作出會計估計值及假設。所作出之重大會計估計值與假設可能與實際結果存有差異，將考量歷史經驗及其他因子持續評估及調整。該等估計及假設具有導致資產及負債帳面金額於下個財務年度重大調整之風險。請詳下列對重大會計判斷、估計與假設不確定性之說明：

(一) 會計政策採用之重要判斷

無。

(二) 重要會計估計值及假設

存貨之評價

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低者計價，故本集團必須運用判斷及估計決定資產負債表日存貨之淨變現價值。由於科技快速變遷，本集團評估資產負債表日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。此存貨評價未來可能產生重大變動。

民國 112 年 12 月 31 日，本集團存貨之帳面金額為\$1,776,134。

六、重要會計項目之說明

(一) 現金及約當現金

	112年12月31日	111年12月31日
庫存現金	\$ 563	\$ 394
支票存款及活期存款	1,688,861	1,097,050
定期存款	480,810	823,678
合計	<u>\$ 2,170,234</u>	<u>\$ 1,921,122</u>

1. 本集團往來之金融機構信用品質良好，且本集團與多家金融機構往來以分散信用風險，預期發生違約之可能性甚低。

2. 本集團未有將現金及約當現金提供質押之情形。

(二) 透過損益按公允價值衡量之金融資產

項 目	112年12月31日	111年12月31日
非流動項目：		
債務工具		
可轉換債券	<u>\$ 37,960</u>	<u>\$ -</u>

相關透過損益按公允價值衡量之金融資產公允價值資訊請詳附註十二、(三)。

(三) 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

項 目	112年12月31日	111年12月31日
非流動項目：		
權益工具		
上市(櫃)公司股票	\$ 45,520	\$ 72,831
非上市(櫃)公司股票	<u>4,000</u>	<u>4,000</u>
小計	49,520	76,831
評價調整	<u>255,302</u>	<u>217,390</u>
合計	<u>\$ 304,822</u>	<u>\$ 294,221</u>

1. 本集團於民國 112 年及 111 年度因公允價值變動認列於其他綜合損益之金額分別為\$153,150 及(\$4,856)。認列於損益之股利收入分別為\$3,882 及\$3,070。
2. 本集團選擇將屬策略性投資之中長期投資分類為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，該等投資於民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之公允價值分別為\$304,822 及\$294,221。
3. 因已完成策略聯盟階段性任務，故本集團分別於民國 112 年及 111 年度出售公允價值\$142,549 及\$6,971 之投資，並將累積處分利益分別為\$96,026 及\$4,497 轉列保留盈餘。
4. 本集團所投資之部分非上市(櫃)公司，因已於民國 111 年度完成清算程序，故本集團除列其投資並將累積損失\$152,300 轉列保留盈餘。
5. 相關透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產公允價值資訊請詳附註十二、(三)。

(四) 按攤銷後成本衡量之金融資產

項目	112年12月31日	111年12月31日
流動項目：		
定期存款	\$ 517,955	\$ 344,842

1. 按攤銷後成本衡量之金融資產認列於損益之明細如下：

	112年度	111年度
利息收入	\$ 6,889	\$ 4,231

2. 在不考慮所持有之擔保品或其他信用增強之情況下，最能代表本集團持有按攤銷後成本衡量之金融資產，於民國 112 年及 111 年 12 月 31 日信用風險最大之暴險金額分別為\$517,955 及\$344,842。
3. 相關按攤銷後成本衡量之金融資產信用風險資訊請詳附註十二、(二)。本集團投資定期存單之交易對象為信用品質良好之金融機構，預期發生違約之可能性甚低。
4. 以按攤銷後成本衡量之金融資產提供擔保之資訊，請詳附註八之說明。

(五) 應收票據及帳款

	112年12月31日	111年12月31日
應收票據	\$ 9,624	\$ 8,758
應收帳款	\$ 415,781	\$ 477,300
減：備抵損失	(117)	(4,737)
	\$ 415,664	\$ 472,563

1. 應收帳款及應收票據之帳齡分析如下：

	112年12月31日		111年12月31日	
	應收帳款	應收票據	應收帳款	應收票據
未逾期	\$ 394,489	\$ 9,624	\$ 452,589	\$ 8,758
60天內	9,262	-	13,662	-
60-120天	3,172	-	423	-
120天以上	8,858	-	10,626	-
	<u>\$ 415,781</u>	<u>\$ 9,624</u>	<u>\$ 477,300</u>	<u>\$ 8,758</u>

以上係以逾期天數為基準進行之帳齡分析。

- 民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之應收帳款及應收票據餘額均為客戶合約所產生，另於民國 111 年 1 月 1 日客戶合約之應收款餘額為\$578,032。
- 在不考慮所持有之擔保品或其他信用增強之情況下，最能代表本集團應收票據於民國 112 年及 111 年 12 月 31 日信用風險最大之暴險金額分別為\$9,624 及\$8,758；最能代表本集團應收帳款於民國 112 年及 111 年 12 月 31 日信用風險最大之暴險金額分別為\$415,664 及\$472,563。
- 相關應收帳款及應收票據信用風險資訊請詳附註十二、(二)。

(六) 存貨

	112年12月31日	111年12月31日
原物料	\$ 416,761	\$ 515,248
在製品	1,074,846	1,110,033
製成品	41,280	58,378
商品	243,247	194,884
合計	<u>\$ 1,776,134</u>	<u>\$ 1,878,543</u>

本集團當期認列為費損之存貨成本：

	112年度	111年度
已出售存貨成本	\$ 2,016,542	\$ 2,084,154
跌價損失	39,519	21,413
	<u>\$ 2,056,061</u>	<u>\$ 2,105,567</u>

(七)不動產、廠房及設備

		112年						
		土地	房屋及建築	機器設備	試驗設備	其他設備	未完工程及待驗設備	合計
1月1日								
成本	\$	532,614	\$ 540,293	\$ 63,755	\$ 20,470	\$ 119,955	\$ 280,692	\$ 1,557,779
累計折舊及減損		—	(211,561)	(29,747)	(12,841)	(68,811)	—	(322,960)
	\$	532,614	\$ 328,732	\$ 34,008	\$ 7,629	\$ 51,144	\$ 280,692	\$ 1,234,819
1月1日	\$	532,614	\$ 328,732	\$ 34,008	\$ 7,629	\$ 51,144	\$ 280,692	\$ 1,234,819
增添		—	23,304	1,259	178	6,880	661,799	693,420
處分		—	—	(427)	—	(7)	—	(434)
重分類		—	49,220	4,223	—	4,259	(57,731)	(29)
折舊費用		—	(29,940)	(9,607)	(3,942)	(17,951)	—	(61,440)
淨兌換差額		—	—	(1)	—	(18)	—	(19)
12月31日	\$	532,614	\$ 371,316	\$ 29,455	\$ 3,865	\$ 44,307	\$ 884,760	\$ 1,866,317
12月31日								
成本	\$	532,614	\$ 596,854	\$ 62,863	\$ 12,973	\$ 118,619	\$ 884,760	\$ 2,208,683
累計折舊及減損		—	(225,538)	(33,408)	(9,108)	(74,312)	—	(342,366)
	\$	532,614	\$ 371,316	\$ 29,455	\$ 3,865	\$ 44,307	\$ 884,760	\$ 1,866,317

		111年						
		土地	房屋及建築	機器設備	試驗設備	其他設備	未完工程及待驗設備	合計
1月1日								
成本	\$	533,795	\$ 551,461	\$ 51,852	\$ 127,038	\$ 109,808	\$ 33,043	\$ 1,406,997
累計折舊及減損		<u>—</u>	<u>(192,826)</u>	<u>(20,458)</u>	<u>(73,428)</u>	<u>(71,131)</u>	<u>—</u>	<u>(357,843)</u>
	\$	<u>533,795</u>	<u>358,635</u>	<u>31,394</u>	<u>53,610</u>	<u>38,677</u>	<u>33,043</u>	<u>1,049,154</u>
1月1日	\$	533,795	\$ 358,635	\$ 31,394	\$ 53,610	\$ 38,677	\$ 33,043	\$ 1,049,154
增添		—	7,812	9,409	1,494	22,560	261,328	302,603
處分	(	1,181)	(14,158)	—	(39,414)	(60)	—	(54,813)
重分類		—	1,622	2,056	2,736	7,297	(13,679)	32
折舊費用	—	(25,179)	(8,861)	(10,797)	(17,359)		—	(62,196)
淨兌換差額		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>10</u>	<u>—</u>	<u>29</u>	<u>—</u>	<u>39</u>
12月31日	\$	<u>532,614</u>	<u>328,732</u>	<u>34,008</u>	<u>7,629</u>	<u>51,144</u>	<u>280,692</u>	<u>1,234,819</u>
12月31日								
成本	\$	532,614	\$ 540,293	\$ 63,755	\$ 20,470	\$ 119,955	\$ 280,692	\$ 1,557,779
累計折舊及減損		<u>—</u>	<u>(211,561)</u>	<u>(29,747)</u>	<u>(12,841)</u>	<u>(68,811)</u>	<u>—</u>	<u>(322,960)</u>
	\$	<u>532,614</u>	<u>328,732</u>	<u>34,008</u>	<u>7,629</u>	<u>51,144</u>	<u>280,692</u>	<u>1,234,819</u>

1. 不動產、廠房及設備借款成本資本化金額及利率區間：

	112年度	111年度
資本化金額	\$ 8,357	\$ -
資本化利率區間	1.63%~1.92%	-

2. 以不動產、廠房及設備提供擔保之資訊，請詳附註八之說明。

(八)租賃交易－承租人

1. 本集團租賃之標的資產包括土地、辦公設備及建築物，租賃合約之期間通常介於 1 到 20 年。租賃合約是採個別協商並包含各種不同的條款及條件，除租賃之資產不得用作借貸擔保外，未有加諸其他之限制。
2. 本集團承租之倉庫、員工宿舍及辦公設備等之租賃期間不超過 12 個月。
3. 使用權資產之帳面價值與認列之折舊費用資訊如下：

	112年12月31日	111年12月31日
	帳面金額	帳面金額
土地	\$ 52,573	\$ 55,519
辦公設備	7,199	6,023
建築物	107	106
	<u>\$ 59,879</u>	<u>\$ 61,648</u>

	112年度	111年度
	折舊費用	折舊費用
土地	\$ 2,945	\$ 1,797
辦公設備	4,052	3,681
建築物	142	1,697
	<u>\$ 7,139</u>	<u>\$ 7,175</u>

4. 本集團於民國 112 年及 111 年度使用權資產之增添分別為\$5,370 及\$61,785。

5. 與租賃合約有關之損益項目資訊如下：

	112年度	111年度
<u>影響當期損益之項目</u>		
租賃負債之利息費用	\$ 721	\$ 446
屬短期租賃合約之費用	6,595	6,691

6. 民國 112 年及 111 年度租賃現金流出總額為\$13,968 及\$13,989。

(九) 無形資產

		112年							
		客戶關係	核心技術	專門技術	電腦軟體	專利權	商譽	其他	合計
1月1日									
成本	\$ 177,943	\$ 56,900	\$ 23,258	\$ 46,998	\$ 5,000	\$ 315,970	\$ 27,644	\$ 653,713	
累計攤銷	(110,121)	(47,417)	(10,336)	(41,678)	(1,792)	—	(18,430)	(229,774)	
	<u>\$ 67,822</u>	<u>\$ 9,483</u>	<u>\$ 12,922</u>	<u>\$ 5,320</u>	<u>\$ 3,208</u>	<u>\$ 315,970</u>	<u>\$ 9,214</u>	<u>\$ 423,939</u>	
1月1日	\$ 67,822	\$ 9,483	\$ 12,922	\$ 5,320	\$ 3,208	\$ 315,970	\$ 9,214	\$ 423,939	
增添	—	—	—	3,730	—	—	—	3,730	
攤銷費用	(15,752)	(4,742)	(2,584)	(4,932)	(500)	—	(4,607)	(33,117)	
12月31日	<u>\$ 52,070</u>	<u>\$ 4,741</u>	<u>\$ 10,338</u>	<u>\$ 4,118</u>	<u>\$ 2,708</u>	<u>\$ 315,970</u>	<u>\$ 4,607</u>	<u>\$ 394,552</u>	
12月31日									
成本	\$ 177,943	\$ 56,900	\$ 23,258	\$ 50,728	\$ 5,000	\$ 315,970	\$ 27,644	\$ 657,443	
累計攤銷	(125,873)	(52,159)	(12,920)	(46,610)	(2,292)	—	(23,037)	(262,891)	
	<u>\$ 52,070</u>	<u>\$ 4,741</u>	<u>\$ 10,338</u>	<u>\$ 4,118</u>	<u>\$ 2,708</u>	<u>\$ 315,970</u>	<u>\$ 4,607</u>	<u>\$ 394,552</u>	

		111年							
		客戶關係	核心技術	專門技術	電腦軟體	專利權	商譽	其他	合計
1月1日									
成本		\$ 177,943	\$ 56,900	\$ 23,258	\$ 41,569	\$ 5,000	\$ 315,970	\$ 27,644	\$ 648,284
累計攤銷		(94,369)	(42,675)	(7,752)	(36,829)	(1,292)	—	(13,822)	(196,739)
		<u>\$ 83,574</u>	<u>\$ 14,225</u>	<u>\$ 15,506</u>	<u>\$ 4,740</u>	<u>\$ 3,708</u>	<u>\$ 315,970</u>	<u>\$ 13,822</u>	<u>\$ 451,545</u>
1月1日		\$ 83,574	\$ 14,225	\$ 15,506	\$ 4,740	\$ 3,708	\$ 315,970	\$ 13,822	\$ 451,545
增添		—	—	—	5,429	—	—	—	5,429
攤銷費用		(15,752)	(4,742)	(2,584)	(4,849)	(500)	—	(4,608)	(33,035)
12月31日		<u>\$ 67,822</u>	<u>\$ 9,483</u>	<u>\$ 12,922</u>	<u>\$ 5,320</u>	<u>\$ 3,208</u>	<u>\$ 315,970</u>	<u>\$ 9,214</u>	<u>\$ 423,939</u>
12月31日									
成本		\$ 177,943	\$ 56,900	\$ 23,258	\$ 46,998	\$ 5,000	\$ 315,970	\$ 27,644	\$ 653,713
累計攤銷		(110,121)	(47,417)	(10,336)	(41,678)	(1,792)	—	(18,430)	(229,774)
		<u>\$ 67,822</u>	<u>\$ 9,483</u>	<u>\$ 12,922</u>	<u>\$ 5,320</u>	<u>\$ 3,208</u>	<u>\$ 315,970</u>	<u>\$ 9,214</u>	<u>\$ 423,939</u>

1. 無形資產攤銷明細如下：

	112年度	111年度
營業成本	\$ 1,318	\$ 1,236
推銷費用	1,488	1,372
管理費用	28,935	28,985
研究發展費用	1,376	1,442
	<u>\$ 33,117</u>	<u>\$ 33,035</u>

2. 商譽主要係本公司因企業合併所產生之合併商譽。於資產負債表日進行減損測試，可回收金額依據使用價值進行評估，民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之相關折現率分別為 8.09%~37.42%及 5.39%~28.38%。使用價值之計算，係以未來 5 年度之財務預算之現金流量作為估計基礎，關鍵假設包括營收成長率、毛利率及營業費用率等，各假設皆是參考相關產業未來趨勢評估並考量內外歷史資訊而得。

依上述關鍵假設計算之可回收金額與現金產生單位可辨認資產之帳面價值及商譽合計數相較結果，本集團之商譽於民國 112 年及 111 年度無減損。

(十) 短期借款

借款性質	112年12月31日	利率區間	擔保品
銀行借款			
信用借款	<u>\$ 317,133</u>	1.63%~5.0%	無
借款性質	111年12月31日	利率區間	擔保品
銀行借款			
信用借款	<u>\$ 281,925</u>	1.25%~5.1%	無

(十一) 其他應付款

	112年12月31日	111年12月31日
應付薪資及獎金	\$ 169,246	\$ 226,303
應付員工酬勞	92,486	111,630
應付董監事酬勞	15,782	20,198
應付營業稅	6,627	3,617
應付工程款	55,122	51,160
其他	48,570	57,273
	<u>\$ 387,833</u>	<u>\$ 470,181</u>

(十二) 長期借款

借款性質	借款期間及還款方式	112年12月31日
擔保借款(註)		
銀行借款	126年5月18日前分期償還	\$ 103,405
銀行借款	126年12月12日前分期償還	100,000
銀行借款	127年3月1日前分期償還	136,595
銀行借款	126年4月26日前分期償還	195,750
銀行借款	123年12月6日前分期償還	80,000
銀行借款	127年1月11日前分期償還	20,000
銀行借款	127年2月9日前分期償還	194,250
銀行借款	117年12月20日前分期償還	70,000
無擔保借款		
銀行借款	127年3月1日前分期償還	50,000
銀行借款	113年9月12日到期一次償還	51,160
銀行借款	113年10月12日到期一次償還	40,929
銀行借款	113年11月14日到期一次償還	67,911
銀行借款	114年2月13日到期前一次償還	40,000
小計		1,150,000
減：一年或一營業週期內到期之長期借款		(190,034)
		\$ 959,966
利率區間		1.745%~1.92%
借款性質	借款期間及還款方式	111年12月31日
擔保借款(註)		
銀行借款	126年5月18日前分期償還	\$ 103,405
銀行借款	126年12月12日前分期償還	100,000
銀行借款	126年4月26日前分期償還	195,750
銀行借款	123年12月6日前分期償還	80,000
小計		479,155
減：一年或一營業週期內到期之長期借款		-
		\$ 479,155
利率區間		1.50%

註：擔保品請詳附註八之說明。

(十三) 退休金

1. (1) 本公司及國內子公司依據「勞動基準法」之規定，訂有確定福利之退休辦法，適用於民國 94 年 7 月 1 日實施「勞工退休金條例」前所有正式員工之服務年資，以及於實施「勞工退休金條例」後選擇繼續適用勞動基準法員工之後續服務年資。員工符合退休條件者，退休金之支付係根據服務年資及退休前 6 個月之平均薪資計算，15 年以內(含)的服務年資每滿一年給予兩個基數，超過 15 年之服務年資每滿一年給予一個基數，惟累積最高以 45 個基數為限。本公司按月就薪資總額 2%提撥退休基金，以勞工退休準備金監督委員會之名義專戶儲存於台灣銀行。另本公司於每年年度終了前，估算前項勞工退休準備金專戶餘額，若該餘額不足給付次一年度內預估符合退休條件之勞工依前述計算之退休金數額，本公司將於次年度三月底前一次提撥其差額。

(2) 資產負債表認列之金額如下：

	112年12月31日	111年12月31日
確定福利義務現值	\$ 16,911	\$ 36,022
計畫資產公允價值	(24,156)	(27,541)
淨確定福利(資產)負債	(\$ 7,245)	\$ 8,481

(3) 淨確定福利負債之變動如下：

	112年		
	確定福利義務現值	計畫資產公允價值	淨確定福利負債
1月1日	(\$ 36,022)	\$ 27,541	(\$ 8,481)
利息(費用)收入	(747)	647	(100)
	(36,769)	28,188	(8,581)
再衡量數：			
計畫資產報酬(不包括包含於利息收入或費用之金額)	-	419	419
財務假設變動影響數	(101)	-	(101)
經驗調整	2,141	-	2,141
	2,040	419	2,459
提撥退休基金	-	1,413	1,413
支付退休金	10,146	(5,864)	4,282
企業轉調(轉列其他非流動負債)	7,672	-	7,672
12月31日	(\$ 16,911)	\$ 24,156	\$ 7,245

	111年		
	確定福利義務現值	計畫資產公允價值	淨確定福利負債
1月1日	(\$ 39,231)	\$ 22,317	(\$ 16,914)
利息(費用)收入	(314)	232	(82)
	(39,545)	22,549	(16,996)
再衡量數：			
計畫資產報酬(不包括包含於利息收入或費用之金額)	-	3,574	3,574
財務假設變動影響數	2,220	-	2,220
經驗調整	1,303	-	1,303
	3,523	3,574	7,097
提撥退休基金	-	1,418	1,418
支付退休金	-	-	-
12月31日	(\$ 36,022)	\$ 27,541	(\$ 8,481)

(4) 本公司及國內子公司之確定福利退休計畫基金資產，係由臺灣銀行按該基金年度投資運用計畫所定委託經營項目之比例及金額範圍內，依勞工退休基金收支保管及運用辦法第六條之項目（即存放國內外之金融機構，投資國內外上市、上櫃或私募之權益證券及投資國內外不動產之證券化商品等）辦理委託經營，相關運用情形係由勞工退休基金監理會進行監督。該基金之運用，其每年決算分配之最低收益，不得低於依當地銀行二年定期存款利率計算之收益，若有不足，則經主管機關核准後由國庫補足。因本公司無權參與該基金之運作及管理，故無法依國際會計準則第 19 號第 142 段規定揭露計畫資產公允價值之分類。民國 112 年及 111 年 12 月 31 日構成該基金總資產之公允價值，請詳政府公告之各年度之勞工退休基金運用報告。

(5) 有關退休金之精算假設彙總如下：

	112年度	111年度
折現率	1.25%	1.25%-1.30%
未來薪資增加率	2.75%-3.50%	2.75%-3.50%

對於未來死亡率之假設係按照各國已公布的統計數字及經驗估計。

因採用之主要精算假設變動而影響之確定福利義務現值分析如下：

	折現率		未來薪資增加率	
	增加0.25%	減少0.25%	增加1%	減少1%
112年12月31日				
對確定福利義務現值之影響	(\$ 869)	\$ 899	\$ 3,703	(\$ 3,318)
111年12月31日				
對確定福利義務現值之影響	(\$ 1,274)	\$ 1,318	\$ 5,460	(\$ 4,877)

上述之敏感度分析係基於其他假設不變的情況下分析單一假設變動之影響。實務上許多假設的變動則可能是連動的。敏感度分析係與計算資產負債表之淨退休金負債所採用的方法一致。

本期編製敏感度分析所使用之方法與假設與前期相同。

(6) 本集團於民國 113 年度預計支付予退休計畫之提撥金為\$817。

(7) 截至民國 112 年 12 月 31 日，該退休計畫之加權平均存續期間為 6.8 年至 18.4 年。

2. (1) 自民國 94 年 7 月 1 日起，本公司及國內子公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。本公司及國內子公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，每月按薪資之 6% 提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。

(2) 民國 112 年及 111 年度，本集團依上開退休金辦法認列之退休金成本分別為\$20,700 及\$19,887。

(十四) 負債準備

	112年	111年
1月1日餘額	\$ 177,229	\$ 134,983
本期新增之負債準備	83,893	97,579
本期使用之負債準備	(22,930)	(19,817)
本期迴轉之未使用金額	(110,839)	(35,516)
12月31日餘額	<u>\$ 127,353</u>	<u>\$ 177,229</u>

負債準備分析如下：

	112年12月31日	111年12月31日
流動	<u>\$ 107,573</u>	<u>\$ 152,827</u>
非流動	<u>\$ 19,780</u>	<u>\$ 24,402</u>

保固負債準備係依銷售商品合約約定，本集團管理階層對於因保固義務所導致未來經濟效益流出最佳估計數之現值。該估計係以歷史保固經驗為基礎，並考量新原料、製程變動或其他影響產品品質等因素調整。

(十五)股本

1. 民國 112 年 12 月 31 日，本公司額定資本額為\$500,000，分為50,000 仟股，實收資本額為\$292,160，每股面額 10 元。本公司已發行股份之股款均已收訖。

本公司普通股期初與期末流通在外股數調節如下：

單位：仟股

	112年	111年
1月1日	28,521	28,521
子公司處分本公司股份	115	-
12月31日	28,636	28,521

2. 庫藏股

股份收回原因及其數量：

持有股份之公司名稱	收回原因	112年12月31日	
		股數(仟股)	帳面金額
子公司-佳霖科技股份有限公司	投資目的	580	\$ 68,963
持有股份之公司名稱	收回原因	111年12月31日	
		股數(仟股)	帳面金額
子公司-佳霖科技股份有限公司	投資目的	695	\$ 82,648

(十六)資本公積

依公司法規定，超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得之資本公積，除得用於彌補虧損外，於公司無累積虧損時，按股東原有股份之比例發給新股或現金。另依證券交易法之相關規定，以上開資本公積撥充資本時，每年以其合計數不超過實收資本額百分之十為限。公司非於盈餘公積填補資本虧損仍有不足時，不得以資本公積補充之。

	112年					
	發行溢價	庫藏股票 交易	員工 認股權	合併發行 新股溢價	其他	合計數
1月1日	\$ 114,000	\$ 30,559	\$ 654	\$ 976,592	\$ 1,460	\$ 1,123,265
發放予子公司股利 調整資本公積	-	10,431	-	-	-	10,431
逾時效未領取之股 利轉列資本公積	-	-	-	-	194	194
子公司處分母公司 股票視同庫藏股交 易	-	43,701	-	-	-	43,701
12月31日	\$ 114,000	\$ 84,691	\$ 654	\$ 976,592	\$ 1,654	\$ 1,177,591

	111年					合計數
	發行溢價	庫藏股票 交易	員工 認股權	合併發行 新股溢價	其他	
1月1日	\$ 114,000	\$ 18,752	\$ 654	\$ 976,592	\$ 1,460	\$1,111,458
發放予子公司股利 調整資本公積	-	11,807	-	-	-	11,807
12月31日	<u>\$ 114,000</u>	<u>\$ 30,559</u>	<u>\$ 654</u>	<u>\$ 976,592</u>	<u>\$ 1,460</u>	<u>\$1,123,265</u>

(十七) 保留盈餘

1. 依本公司章程之盈餘分派政策規定，年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10% 為法定盈餘公積，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。
2. 法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止。法定盈餘公積得用以彌補虧損。公司無虧損時，法定盈餘公積超過實收股本總額 25% 之部分除得撥充股本外，尚得以現金分配。
3. 本公司依金管證發字第 1010012865 號函、金管證發字第 1010047490 號函、金管證發字第 1030006415 號及「採用國際財務報導準則（IFRSs）後，提列特別盈餘公積之適用疑義問答」等規定提列及迴轉特別盈餘公積。
4. 本公司於民國 112 年 6 月 21 日及 111 年 6 月 23 日經股東會決議民國 111 年度及 110 年度之盈餘分派案如下：

	111年度		110年度	
	金額	每股股利(元)	金額	每股股利(元)
法定盈餘公積	\$ 58,128		\$ 71,703	
現金股利	<u>525,888</u>	\$ 18	<u>496,672</u>	\$ 17
	<u>\$ 584,016</u>		<u>\$ 568,375</u>	

5. 本公司於民國 113 年 3 月 8 日經董事會通過擬議 112 年盈餘分配案如下，該案尚待股東會決議通過：

	盈餘分配案	每股股利(元)
法定盈餘公積	\$ 74,517	
現金股利	<u>467,456</u>	\$ 16
	<u>\$ 541,973</u>	

6. 民國 112 年度及 111 年度盈餘分派案之現金股利分派金額，業已分別於民國 113 年 3 月 8 日及 112 年 3 月 20 日經董事會決議通過。

(十八) 其他權益項目

	外幣換算	未實現評價損益	總計
112年1月1日	(\$ 850)	\$ 184,142	\$ 183,292
集團外幣換算差異數	(1,362)	-	(1,362)
集團評價調整	-	122,520	122,520
集團處分轉出至保留盈餘	-	(96,026)	(96,026)
112年12月31日	<u>(\$ 2,212)</u>	<u>\$ 210,636</u>	<u>\$ 208,424</u>

	外幣換算	未實現評價損益	總計
111年1月1日	(\$ 2,181)	\$ 40,224	\$ 38,043
集團外幣換算差異數	1,331	-	1,331
集團評價調整	-	(3,885)	(3,885)
集團處分轉出至保留盈餘	-	147,803	147,803
111年12月31日	<u>(\$ 850)</u>	<u>\$ 184,142</u>	<u>\$ 183,292</u>

(十九) 營業收入

	112年度	111年度
客戶合約之收入	<u>\$ 3,543,994</u>	<u>\$ 3,723,376</u>

1. 客戶合約收入之細分

商品銷售收入主要來自於銷售半導體機台及化學產品。收入可細分如下：

	112年度	111年度
客戶合約之收入		
機台設備產品銷售收入	\$ 2,084,530	\$ 2,045,967
化學產品銷售收入	904,880	1,064,799
維修服務及其他收入	451,369	480,818
軟體銷售及安裝收入	66,351	70,771
半導體及電子設備銷售代理收入	36,864	61,021
	<u>\$ 3,543,994</u>	<u>\$ 3,723,376</u>

2. 合約負債

產品銷售之預收款項，於機台驗收前係認列為合約負債。本集團認列客戶合約收入相關之合約負債如下：

	112年12月31日	111年12月31日	111年1月1日
合約負債：			
商品銷售	<u>\$ 1,178,014</u>	<u>\$ 1,314,049</u>	<u>\$ 896,332</u>

3. 期初合約負債本期認列收入

	112年度	111年度
合約負債期初餘額本期認列收入	\$ 1,020,446	\$ 792,115

(二十) 利息收入

	112年度	111年度
銀行存款利息	\$ 42,456	\$ 15,331
按攤銷後成本衡量之金融資產利息收入	6,889	4,231
其他利息收入	1,903	3
	<u>\$ 51,248</u>	<u>\$ 19,565</u>

(二十一) 其他收入

	112年度	111年度
租金收入	\$ 241	\$ 275
股利收入	3,882	3,070
政府補助收入(註)	22,000	8,000
其他收入—其他	8,278	14,287
	<u>\$ 34,401</u>	<u>\$ 25,632</u>

註：本集團因進行製程設備開發計畫而取得政府補助收入。

(二十二) 其他利益及損失

	112年度	111年度
處分不動產、廠房及設備(損失)利益	(\$ 434)	\$ 29,295
外幣兌換(損失)利益	(17,714)	109,456
其他	(1,235)	(477)
	<u>(\$ 19,383)</u>	<u>\$ 138,274</u>

(二十三) 財務成本

	112年度	111年度
銀行借款利息	\$ 11,845	\$ 8,100
租賃負債之利息	721	446
	<u>\$ 12,566</u>	<u>\$ 8,546</u>

(二十四) 費用性質之額外資訊

	112年度	111年度
員工福利費用	\$ 723,756	\$ 795,400
折舊費用	68,579	69,371
攤銷費用	33,117	33,035

(二十五)員工福利費用

	112年度	111年度
薪資費用	\$ 634,799	\$ 718,859
勞健保費用	43,587	35,436
退休金費用	20,800	19,969
其他用人費用	24,570	21,136
	<u>\$ 723,756</u>	<u>\$ 795,400</u>

1. 依本公司章程規定，本公司依當年度獲利狀況扣除累計虧損後，如尚有餘額，應提撥員工酬勞不低於 7.5%，董監酬勞不高於 3%。

2. 本公司民國 112 年及 111 年度員工酬勞估列金額分別為 \$59,824 及 \$73,677；董監酬勞估列金額分別為 \$11,965 及 \$14,735，前述金額帳列薪資費用科目。

民國 112 年度係依截至當期止之獲利情況，分別以 8%及 1.6% 估列。

經董事會決議之民國 111 年度員工酬勞及董監酬勞與民國 111 年度財務報告認列之金額一致。

本公司董事會通過之員工及董監酬勞相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。

(二十六)所得稅

1. 所得稅費用

(1)所得稅費用組成部分：

	112年度	111年度
當期所得稅：		
當期所得產生之所得稅	\$ 147,441	\$ 201,950
未分配盈餘加徵	840	18,058
以前年度所得稅(高)低估	(23,691)	489
當期所得稅總額	<u>124,590</u>	<u>220,497</u>
遞延所得稅：		
暫時性差異之原始產生及迴轉	8,666	(11,791)
遞延所得稅總額	<u>8,666</u>	<u>(11,791)</u>
所得稅費用	<u>\$ 133,256</u>	<u>\$ 208,706</u>

(2)與其他綜合損益相關之所得稅金額：

	112年度	111年度
透過其他綜合損益按公允價值變動之金融資產公允價值變動	\$ 30,630	(\$ 971)

(3)直接借記或貸記權益之所得稅金額：

	112年度	111年度
透過其他綜合損益按公允 價值衡量之金融資產	\$ 19,211	\$ 837

2. 所得稅費用與會計利潤關係

	112年度	111年度
稅前淨利按法定稅率計算之所得稅	\$ 208,582	\$ 252,874
按稅法規定免課稅之所得	(52,475)	(60,538)
遞延所得稅評估變動	-	(2,871)
以前年度所得稅(高)低估數	(23,691)	489
分離課稅稅額	-	296
未認列之可減除暫時性差異	-	398
未分配盈餘加徵	840	18,058
所得稅費用	\$ 133,256	\$ 208,706

3. 因暫時性差異而產生之各遞延所得稅資產或負債金額如下：

	112年				
	1月1日	認列於損益	認列於其他綜合損益	直接認列於權益	12月31日
遞延所得稅資產：					
- 暫時性差異：					
負債準備	\$ 41,805	(\$ 9,975)	\$ -	\$ -	\$ 31,830
未實現暫估費用	22,472	(13,199)	-	-	9,273
未實現存貨跌價損失	14,034	7,042	-	-	21,076
確定福利退休計畫	6,535	-	-	-	6,535
未實現兌換損失	228	(207)	-	-	21
其他	2,670	35	-	-	2,705
國外營運機構兌換差額	(3,831)	-	-	-	(3,831)
小計	\$ 83,913	(\$ 16,304)	\$ -	\$ -	\$ 67,609
- 遞延所得稅負債：					
透過其他綜合損益按公允 價值衡量之金融資產	(33,248)	-	(30,630)	19,211	(44,667)
未實現兌換利益	(9,037)	7,406	-	-	(1,631)
未實現國外營運機構投資 利益	(4,430)	232	-	-	(4,198)
其他	(77)	-	-	-	(77)
小計	(\$ 46,792)	\$ 7,638	(\$ 30,630)	\$ 19,211	(\$ 50,573)
合計	\$ 37,121	(\$ 8,666)	(\$ 30,630)	\$ 19,211	\$ 17,036

	111年				
	1月1日	認列於損益	認列於其他綜合損益	直接認列於權益	12月31日
遞延所得稅資產：					
- 暫時性差異：					
負債準備	\$ 26,997	\$ 14,808	\$ -	\$ -	\$ 41,805
未實現暫估費用	15,151	7,321	-	-	22,472
未實現存貨跌價損失	10,917	3,117	-	-	14,034
確定福利退休計畫	6,535	-	-	-	6,535
未實現兌換損失	7,163	(6,935)	-	-	228
其他	1,840	830	-	-	2,670
國外營運機構兌換差額	(3,831)	-	-	-	(3,831)
小計	\$ 64,772	\$ 19,141	\$ -	\$ -	\$ 83,913
- 遞延所得稅負債：					
透過其他綜合損益按公允					
價值衡量之金融資產	(35,056)	-	971	837	(33,248)
未實現兌換利益	-	(9,037)	-	-	(9,037)
未實現國外營運機構投資	(6,117)	1,687	-	-	(4,430)
利益					
其他	(77)	-	-	-	(77)
小計	(\$ 41,250)	(\$ 7,350)	\$ 971	\$ 837	(\$ 46,792)
合計	\$ 23,522	\$ 11,791	\$ 971	\$ 837	\$ 37,121

4. 本公司、添鴻科技股份有限公司、太引資訊系統股份有限公司及佳霖科技股份有限公司營利事業所得稅業經稅捐稽徵機關核定至民國 110 年度。

(二十七) 每股盈餘

	112年度	
	加權平均流通 稅後金額 在外股數(仟股)	每股盈餘 (元)
<u>基本每股盈餘</u>		
歸屬於母公司普通股股東之本期淨利	\$ 616,340	28,589
	<u>\$ 616,340</u>	<u>\$ 21.56</u>
<u>稀釋每股盈餘</u>		
歸屬於母公司普通股股東之本期淨利	616,340	28,589
具稀釋作用之潛在普通股之影響		
員工酬勞	-	149
歸屬於母公司普通股股東之本期淨利	\$ 616,340	28,738
加潛在普通股之影響	<u>\$ 616,340</u>	<u>\$ 21.45</u>

	111年度		
	加權平均流通		每股盈餘
	稅後金額	在外股數(仟股)	(元)
<u>基本每股盈餘</u>			
歸屬於母公司普通股股東之本期淨利	\$ 722,106	28,521	\$ 25.32
<u>稀釋每股盈餘</u>			
歸屬於母公司普通股股東之本期淨利	722,106	28,521	
具稀釋作用之潛在普通股之影響			
員工酬勞	-	371	
歸屬於母公司普通股股東之本期淨利			
加潛在普通股之影響	\$ 722,106	28,892	\$ 24.99

(二十八) 現金流量補充資訊

僅有部分現金收付之投資活動：

	112年度	111年度
購置不動產、廠房及設備	\$ 693,420	\$ 302,603
加：期初應付工程款	51,160	-
加：期末預付設備款	624	
減：期末應付工程款	(55,122)	(51,160)
本期支付現金	\$ 690,082	\$ 251,443

(二十九) 來自籌資活動之負債之變動

	112年			來自籌資活動 之負債總額
	短期借款	租賃負債	長期借款 (含一年內到期)	
1月1日	\$ 281,925	\$ 59,461	\$ 479,155	\$ 820,541
籌資現金流量之變動	35,208	(7,373)	670,845	698,680
租賃負債利息費用	-	721	-	721
租賃負債新增數	-	5,370	-	5,370
12月31日	\$ 317,133	\$ 58,179	\$ 1,150,000	\$ 1,525,312
	111年			來自籌資活動 之負債總額
	短期借款	租賃負債	長期借款 (含一年內到期)	
1月1日	\$ 338,694	\$ 4,528	\$ 338,273	\$ 681,495
籌資現金流量之變動	(56,769)	(7,298)	140,882	76,815
租賃負債利息費用	-	446	-	446
租賃負債新增數	-	61,785	-	61,785
12月31日	\$ 281,925	\$ 59,461	\$ 479,155	\$ 820,541

七、關係人交易

(一)關係人之名稱及關係

無。

(二)與關係人間之重大交易事項

無。

(三)主要管理階層薪酬資訊

	112年度	111年度
短期員工福利	\$ 80,318	\$ 80,960
退職後福利	1,529	1,179
總計	<u>\$ 81,847</u>	<u>\$ 82,139</u>

八、質押之資產

本集團之資產提供擔保明細如下：

資產項目	帳面價值		擔保用途
	112年12月31日	111年12月31日	
質押定存單(帳列按攤銷後成本 衡量之金融資產-流動)	\$ 32,455	\$ 32,592	為他人背書保證、貨物 關稅擔保函質押保證金
土地	532,614	470,564	銀行借款擔保
房屋及建築物-淨額	366,030	233,261	銀行借款擔保
	<u>\$ 931,099</u>	<u>\$ 736,417</u>	

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

(一)或有事項

無。

(二)承諾事項

已簽約但尚未發生之資本支出

	112年12月31日	111年12月31日
不動產、廠房及設備	<u>\$ 278,774</u>	<u>\$ 316,707</u>

十、重大之災害損失

無。

十一、重大之期後事項

民國 112 年度盈餘分派議案，請詳附註六(十七)說明。

十二、其他

(一) 資本管理

本集團進行資本管理以確保能夠於繼續經營之前提下，藉由將債務及權益餘額最適化，使資本有效之運用，並確保各公司順利營運。本集團之資本結構係由淨負債及權益所組成，毋需遵守其他外部資本規定。本集團主要管理階層定期重新檢視資本結構，其檢視內容包括考量各類資本之成本及相關風險，目前資本結構中權益項目遠大於負債項目，將用以支應未來所需之營運資金、資本支出及股利支出等需求。

(二) 金融工具

1. 金融工具之種類

	<u>112年12月31日</u>	<u>111年12月31日</u>
<u>金融資產</u>		
透過損益按公允價值衡量之金融資產		
強制透過損益按公允價值衡量之債務工具投資	\$ 37,960	\$ -
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		
選擇指定之權益工具投資	304,822	294,221
	<u>\$ 342,782</u>	<u>\$ 294,221</u>
按攤銷後成本衡量之金融資產		
現金及約當現金	\$ 2,170,234	\$ 1,921,122
按攤銷後成本衡量之金融資產	517,955	344,842
應收票據	9,624	8,758
應收帳款	415,664	472,563
其他應收款	5,584	7,246
存出保證金	5,514	14,528
	<u>\$ 3,124,575</u>	<u>\$ 2,769,059</u>

	112年12月31日	111年12月31日
<u>金融負債</u>		
按攤銷後成本衡量之金融負債		
短期借款	\$ 317,133	\$ 281,925
應付票據	3,970	263
應付帳款	484,205	506,117
其他應付款	387,833	470,181
長期借款(包含一年或一營業週期 內到期)	1,150,000	479,155
	<u>\$ 2,343,141</u>	<u>\$ 1,737,641</u>
租賃負債	<u>\$ 58,179</u>	<u>\$ 59,461</u>

2. 風險管理政策

- (1) 本集團主要金融工具包括權益及債務工具投資、應收帳款、借款、應付帳款及租賃負債。本集團財務風險管理目標，係為管理營運活動相關之市場風險（包含匯率風險、利率風險及其他價格風險）、信用風險及流動性風險。為降低相關財務風險，本集團致力於辨認、評估並規避市場之不確定性，以降低市場變動對公司財務績效之潛在不利影響。
- (2) 本集團之重要財務活動，係經董事會或權責主管依相關規範及內部控制制度進行覆核。於財務計劃執行期間，本集團必須恪遵關於整體財務風險管理及權責劃分之相關財務操作程序。

3. 重大財務風險之性質及程度

(1) 市場風險

匯率風險

- A. 本集團係跨國營運，因此受相對與本公司及各子公司功能性貨幣不同的交易所產生之匯率風險，主要為美元、人民幣及日幣。相關匯率風險來自未來之商業交易及已認列之資產與負債。
- B. 本集團管理階層已訂定政策，規定集團內各公司管理相對其功能性貨幣之匯率風險。各公司應透過集團財務部就其整體匯率風險進行避險。
- C. 本集團從事之業務涉及若干非功能性貨幣，故受匯率波動之影響，具重大匯率波動影響之外幣資產及負債資訊如下：

112年12月31日			
	外幣(仟元)	匯率	帳面金額 (新台幣)
(外幣:功能性貨幣)			
<u>金融資產</u>			
<u>貨幣性項目</u>			
美金：新台幣	\$ 25,696	30.71	\$ 789,124
日幣：新台幣	877,984	0.22	193,156
人民幣：新台幣	31,047	4.42	137,228
<u>金融負債</u>			
<u>貨幣性項目</u>			
美金：新台幣	\$ 1,435	30.71	\$ 44,069
日幣：新台幣	51,798	0.22	11,396

111年12月31日			
	外幣(仟元)	匯率	帳面金額 (新台幣)
(外幣:功能性貨幣)			
<u>金融資產</u>			
<u>貨幣性項目</u>			
美金：新台幣	\$ 49,486	30.71	\$ 1,519,715
日幣：新台幣	340,389	0.23	78,289
人民幣：新台幣	17,888	4.41	78,886
<u>金融負債</u>			
<u>貨幣性項目</u>			
美金：新台幣	\$ 2,054	30.71	\$ 63,078
日幣：新台幣	50,038	0.23	11,509
人民幣：新台幣	4,345	4.41	19,161

D. 本集團貨幣性項目因匯率波動具重大影響於民國112年及111年度之全部兌換(損)益(含已實現及未實現)分別為\$(17,714)及\$109,456。

E. 本集團因重大匯率波動影響之外幣市場風險分析如下：

		112年度		
		敏感度分析		
	變動幅度	影響損益	影響其他綜合損益	
(外幣:功能性貨幣)				
<u>金融資產</u>				
<u>貨幣性項目</u>				
美金：新台幣	1%	\$ 7,891	\$	-
日幣：新台幣	1%	1,932		-
人民幣：新台幣	1%	1,372		-
<u>金融負債</u>				
<u>貨幣性項目</u>				
美金：新台幣	1%	(441)	\$	-
日幣：新台幣	1%	(114)		-

		111年度		
		敏感度分析		
	變動幅度	影響損益	影響其他綜合損益	
(外幣:功能性貨幣)				
<u>金融資產</u>				
<u>貨幣性項目</u>				
美金：新台幣	1%	\$ 15,197	\$	-
日幣：新台幣	1%	783		-
人民幣：新台幣	1%	789		-
<u>金融負債</u>				
<u>貨幣性項目</u>				
美金：新台幣	1%	(\$ 631)	\$	-
日幣：新台幣	1%	(115)		-
人民幣：新台幣	1%	(192)		-

價格風險

- A. 本集團因上市櫃及非上市櫃權益證券投資而產生權益價格暴險。該權益投資非持有供交易而係屬策略性投資。本集團並未積極交易該等投資。本集團權益價格風險主要集中於日本及美國地區之權益工具。
- B. 本集團主要投資於國外公司發行之權益工具，此等權益工具之價格會因該投資標的未來價值之不 a 確定性而受影響。若該等權益工具價格上升或下跌 1%，而其他所有因素維持不變之情況下，對民國 112 年及 111 度之稅後淨利因來自透過損益按公允價值衡量之權益工具之利益或損失將分別增加或減少 \$380 及 \$0；其他綜合損益因分類為透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益投資之利益或損失分別增加或減少 \$3,048 及 \$2,942。

現金流量及公允價值利率風險

本集團之利率風險來自短期及長期借款。按浮動利率發行之借款使本集團承受現金流量利率風險，部分風險被按浮動利率持有之現金及約當現金抵銷。按固定利率發行之借款則使本集團承受之公允價值利率風險。民國 112 年及 111 年度，本集團按浮動利率計算之借款係以新台幣計價，當市場利率每增加 0.25%，本公司將增加之現金流出分別為\$2,934 及 \$1,522。

(2) 信用風險

- A. 本集團之信用風險係因客戶或金融工具之交易對手無法履行合約義務而導致本集團財務損失之風險，主要來自交易對手無法清償按收款條件支付之應收帳款，及按攤銷後成本衡量之金融資產的合約現金流量。
- B. 本集團係以集團角度建立信用風險之管理。對於往來之銀行及金融機構，設定僅有獲獨立信評等級優良，始可被接納為交易對象。依內部明定之授信政策，集團內各營運個體與每一新客戶於訂定付款及提出交貨之條款與條件前，須對其進行管理及信用風險分析。內部風險控管係透過考慮其財務狀況、過往經驗及其他因素，以評估客戶之信用品質。個別風險之限額係董事會依內部或外部之評等而制訂，並定期監控信用額度之使用。
- C. 本集團採用 IFRS9 提供前提假設，當合約款項按約定之支付條款逾期超過 120 天，視為已發生違約。
- D. 本集團當合約款項按約定之支付條款逾期超過 30 天，視為金融資產自原始認列後信用風險已顯著增加。
- E. 本集團用以判定債務工具投資為信用減損之指標如下：
 - (A) 發行人發生重大財務困難，或將進入破產或其他財務重整之可能性大增；
 - (B) 發行人由於財務困難而使該金融資產之活絡市場消失；
 - (C) 發行人延滯或不償付利息或本金；
 - (D) 導致發行人違約有關之全國性或區域性經濟情況不利之變化。
- F. 本集團按貿易信用風險之特性將對客戶之應收帳款分組，採用簡化作法以準備矩陣為基礎估計預期信用損失。
- G. 本集團經追索程序後，對無法合理預期可回收金融資產之金額予以沖銷，惟本集團仍會持續進行追索之法律程序以保全債權之權利。

H. 本集團納入客戶過去違約紀錄與現時財務狀況、產業經濟情勢，並同時考量 GDP 預測及產業展望。對未來前瞻性的考量調整按特定期間歷史及現時資訊所建立之損失率，以估計應收帳款的備抵損失，民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之準備矩陣如下：

	未逾期	逾期1~60天	逾期61~120天	逾期120天以上	合計
<u>112年12月31日</u>					
預期損失率	0.01%	0.01%	10%-20%	20%-100%	
帳面價值總額	\$ 394,489	\$ 9,262	\$ 3,172	\$ 8,858	\$ 415,781
備抵損失	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117	\$ 117

	未逾期	逾期1~60天	逾期61~120天	逾期120天以上	合計
<u>111年12月31日</u>					
預期損失率	0.01%	0.01%	10%-20%	20%-100%	
帳面價值總額	\$ 452,589	\$ 13,662	\$ 423	\$ 10,626	\$ 477,300
備抵損失	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,737	\$ 4,737

I. 本集團採簡化作法之應收帳款備抵損失變動表如下：

	112年	111年
	應收帳款	應收帳款
1月1日	\$ 4,737	\$ 1,542
提列減損損失	-	3,195
減損損失迴轉	(4,620)	-
12月31日	\$ 117	\$ 4,737

(3) 流動性風險

- A. 現金流量預測是由集團內各營運個體執行，並由集團財務部予以彙總。集團財務部監控集團流動資金需求之預測，確保其有足夠資金得以支應營運需要。
- B. 各營運個體所持有之剩餘現金，在超過營運資金之管理所需時，將轉撥回集團財務部。集團財務部則將剩餘資金投資於付息之活期存款、定期存款，其所選擇之工具具有適當之到期日或足夠流動性，以因應上述預測並提供充足之調度水位。於民國 112 年及 111 年 12 月 31 日，本集團持有貨幣市場部位分別為 \$2,687,626 及 \$2,265,570，預期可即時產生現金流量以管理流動性風險。

C. 本集團未動用借款額度明細如下：

	112年12月31日	111年12月31日
無擔保銀行透支額度 (每年重新檢視)		
—已動用金額	\$ 567,355	\$ 281,925
—未動用金額	837,645	713,075
	<u>\$ 1,405,000</u>	<u>\$ 995,000</u>
有擔保銀行借款額度 (雙方同意下得展期)		
—已動用金額	\$ 900,000	\$ 479,155
—未動用金額	240,740	691,625
	<u>\$ 1,140,740</u>	<u>\$ 1,170,780</u>

D. 下表係本集團之非衍生金融負債，按相關到期日予以分組，依據資產負債表日至合約到期日之剩餘期間進行分析。下表所揭露之合約現金流量金額係未折現之金額。

112年12月31日	一年以內(含)	1~5年	5年以上
<u>非衍生金融負債：</u>			
短期借款	\$ 317,878	\$ -	\$ -
應付票據	3,970	-	-
應付款項	484,205	-	-
其他應付款	387,833	-	-
租賃負債	7,479	15,467	41,338
長期借款	207,738	443,151	608,441
財務保證合約	530,000	-	-
111年12月31日	一年以內(含)	1~5年	5年以上
<u>非衍生金融負債：</u>			
短期借款	\$ 282,738	\$ -	\$ -
應付票據	263	-	-
應付款項	506,117	-	-
其他應付款	470,181	-	-
租賃負債	6,643	15,078	44,431
長期借款	7,739	196,920	337,302
財務保證合約	470,000	-	-

(三) 公允價值資訊

1. 為衡量金融及非金融工具之公允價值所採用評價技術的各等級定義如下：

第一等級：企業於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場之報價(未經調整)。活絡市場係指有充分頻率及數量之資產或負債交易發生，以在持續基礎上提供定價資訊之市場。本公司投資之上市櫃股票投資的公允價值屬之。

第二等級：資產或負債直接或間接之可觀察輸入值，但包括於第一等級之報價者除外。

第三等級：資產或負債之不可觀察輸入值。本集團投資之無活絡市場之權益工具屬之。

2. 非以公允價值衡量之金融工具

包括現金及約當現金、應收票據、應收帳款、其他應收款、存出保證金、短期借款、應付帳款、其他應付款及長期借款的帳面金額係公允價值之合理近似值。

3. 以公允價值衡量之金融工具，本集團依資產及負債之性質、特性及風險及公允價值等級之基礎分類，相關資訊如下：

(1) 本集團依資產及負債之性質分類，相關資訊如下：

112年12月31日	第一等級	第二等級	第三等級	合計
資產				
重複性公允價值				
透過損益按公允價值衡量之金融資產				
債務證券	\$ -	\$ -	\$ 37,960	\$ 37,960
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產				
權益證券	\$ 300,822	\$ -	\$ 4,000	\$ 304,822
111年12月31日	第一等級	第二等級	第三等級	合計
資產				
重複性公允價值				
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產				
權益證券	\$ 290,221	\$ -	\$ 4,000	\$ 294,221

(2) 本集團用以衡量公允價值所使用之方法及假設說明如下：

- A. 本集團採用市場報價作為公允價輸入值(即第一等級)者，依工具之特性屬國內外上市股票係以資產負債表日公開市價之收盤價。
- B. 除上述有活絡市場之金融工具外，其餘金融工具之公允價值係以評價技術或參考交易對手報價取得。透過評價技術所取得之公允價值可參照其他實質上條件及特性相似之金融工具之現時公允價值、現金流量折現法或以其他評價技術，包括以合併資產負債表日可取得之市場資訊運用模型計算而得。

C. 評價模型之產出係預估之概算值，而評價技術可能無法反映本公司持有金融工具及非金融工具之所有攸關因素。因此評價模型之預估值會適當地根據額外之參數予以調整，例如模型風險或流動性風險等。根據本公司之公允價值評價模型管理政策及相關之控制程序，管理階層相信為允當表達合併資產負債表中金融工具及非金融工具之公允價值，評價調整係屬適當且必要。在評價過程中所使用之價格資訊及參數係經審慎評估，且適當地根據目前市場狀況調整。

4. 民國 112 年及 111 年度無第一等級與第二等級間之任何移轉。

5. 下表列示民國 112 年及 111 年度第三等級之變動：

	112年	111年
	權益工具	權益工具
1月1日	\$ 4,000	\$ -
本期購買	37,960	4,000
12月31日	\$ 41,960	\$ 4,000

6. 民國 112 年及 111 年度無自第三等級轉入及轉出之情形。

7. 本集團對於公允價值歸類於第三等級之評價流程係由外部評價機構負責進行金融工具之獨立公允價值驗證，藉獨立來源資料使評價結果貼近市場狀態，確認資料來源資料係獨立、可靠、與其他資源一致以及代表可執行價格，並定期校準評價模型、進行回溯測試、更新評價模型所需輸入值及資料及其他任何必要之公允價值調整，以確保評價結果係屬合理。

8. 有關屬第三等級公允價值衡量項目所使用評價模型之重大不可觀察輸入值之量化資訊及重大不可觀察輸入值變動之敏感度分析說明如下：

	112年12月31日		重大不可	區間	輸入值與
	公允價值	評價技術	觀察輸入值	(加權平均)	公允價值關係
非衍生權益工具：					
非上市公司					
股票及債券	\$ 41,960	市場法	不適用	不適用	不適用
	111年12月31日		重大不可	區間	輸入值與
	公允價值	評價技術	觀察輸入值	(加權平均)	公允價值關係
非衍生權益工具：					
非上市公司					
股票	\$ 4,000	市場法	不適用	不適用	不適用

9. 本集團經審慎評估選擇採用之評價模型及評價參數，惟當使用不同之評價模型或評價參數可能導致評價之結果不同。針對分類為第三等級之金融資產及金融負債，若評價參數變動，則對本期損益或其他綜合損益之影響如下：

				112年12月31日			
				認列於損益		認列於其他綜合損益	
	輸入值	變動		有利變動	不利變動	有利變動	不利變動
金融資產							
權益工具	市場價格	±1%	\$	-	\$ -	\$ 40	\$ 40
債務工具	市場價格	±1%		380	380	-	-
合計			\$	380	380	40	40

				111年12月31日			
				認列於損益		認列於其他綜合損益	
	輸入值	變動		有利變動	不利變動	有利變動	不利變動
金融資產							
權益工具	市場價格	±1%	\$	-	\$ -	\$ 40	\$ 40

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

1. 資金貸與他人：無。
2. 為他人背書保證：請詳附表一。
3. 期末持有有價證券情形（不包含投資子公司、關聯企業及合資控制部分）：請詳附表二。
4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：請詳附表三。
5. 取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：請詳附表四。
6. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。
8. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。
9. 從事衍生工具交易：無。
10. 母公司與子公司及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額：請詳附表五。

(二) 轉投資事業相關資訊

被投資公司名稱、所在地區等相關資訊（不包含大陸被投資公司）：請詳附表六。

(三) 大陸投資資訊

1. 基本資料：請詳附表七。

2. 直接或間接經由第三地區事業與轉投資大陸之被投資公司所發生之重大交易事項：請詳附表五及附表七。

(四) 主要股東資訊：

主要股東資訊：請詳附表八。

十四、部門資訊

(一) 一般性資訊

本集團管理階層已依據董事會於制定決策所使用之報導資訊辨認應報導部門。本集團董事會以產品別之角度經營業務。

(二) 部門資訊之衡量

本集團營運決策者係根據合併財務報表之營業利益評估營運部門之績效。營運部門之會計政策皆與附註四所述之重大會計政策之彙總說明相同。

(三) 部門之資訊

提供予主要營運決策者之應報導部門資訊如下：

112年度	設備製造 部門	化學原料 製造部門	軟體銷售 部門	設備銷售 代理部門	其他部門	總計
外部收入	\$ 1,507,948	\$ 873,441	\$ 60,226	\$ 985,792	\$ 116,587	\$ 3,543,994
部門間收入	895	65,216	18,181	38,171	3,561	126,024
部門收入	<u>\$ 1,508,843</u>	<u>\$ 938,657</u>	<u>\$ 78,407</u>	<u>\$ 1,023,963</u>	<u>\$ 120,148</u>	3,670,018
內部沖銷						(126,024)
合併收入						<u>\$ 3,543,994</u>
部門損益	<u>\$ 302,952</u>	<u>\$ 219,218</u>	<u>(\$ 5,524)</u>	<u>\$ 149,710</u>	<u>\$ 28,606</u>	\$ 694,962
利息收入						51,248
租金收入						241
股利收入						3,882
其他收入						30,278
其他利益及損失						(19,383)
財務成本						(12,566)
稅前淨利						<u>\$ 748,662</u>
部門損益包含：						
折舊費用						<u>\$ 68,579</u>
攤銷費用						<u>\$ 33,117</u>

111年度	設備製造 部門	化學原料 製造部門	軟體銷售 部門	設備銷售 代理部門	其他部門	總計
外部收入	\$ 1,881,843	\$ 1,021,810	\$ 56,690	\$ 621,678	\$ 141,355	\$ 3,723,376
部門間收入	1,450	27,451	14,081	36,734	31,030	110,746
部門收入	<u>\$ 1,883,293</u>	<u>\$ 1,049,261</u>	<u>\$ 70,771</u>	<u>\$ 658,412</u>	<u>\$ 172,385</u>	3,834,122
內部沖銷						(110,746)
合併收入						<u>\$ 3,723,376</u>
部門損益	<u>\$ 359,707</u>	<u>\$ 281,549</u>	<u>\$ 15,472</u>	<u>\$ 103,326</u>	<u>(\$ 778)</u>	\$ 759,276
利息收入						19,565
租金收入						275
股利收入						3,070
其他收入						22,287
其他利益及損失						138,274
財務成本						(8,546)
稅前淨利						<u>\$ 934,201</u>
部門損益包含：						
折舊費用						<u>\$ 69,371</u>
攤銷費用						<u>\$ 33,035</u>

(四) 部門損益之調節資訊

部門間之銷售係按公允交易原則進行。向主要營運決策者呈報之外部收入，與損益表內之收入採用一致之衡量方式。

(五) 地區別資訊

本集團民國 112 年及 111 年度地區別資訊如下：

	112年度		111年度	
	收入	非流動資產	收入	非流動資產
台灣	\$ 2,140,750	\$ 2,331,269	\$ 2,614,496	\$ 1,721,062
中國	1,282,620	-	925,879	-
新加坡	34,597	-	91,741	-
歐洲	32,279	-	34,190	-
美國	39,778	-	45,525	-
亞洲	13,970	-	11,545	-
合計	<u>\$ 3,543,994</u>	<u>\$ 2,331,269</u>	<u>\$ 3,723,376</u>	<u>\$ 1,721,062</u>

(六) 重要客戶資訊

本集團民國 112 年及 111 年度重要客戶資訊如下：

	112年度		111年度	
	收入	部門	收入	部門
		設備銷售、化學原料製造及其他		設備銷售、化學原料製造及其他
客戶F	<u>\$ 578,917</u>	部門	<u>\$ 923,770</u>	部門

註：其餘客戶收入金額未達本集團收入總額之 10%。

弘塑科技股份有限公司及子公司
為他人背書保證
民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表一

單位：新台幣仟元
(除特別註明者外)

編號	背書保證者	被背書保證對象		對單一企業	本期最高	期末背書	實際動支	以財產擔保	累計背書保證金	背書保證	屬母公司對	屬子公司對	屬對大陸地	
		關係	背書保證限額	背書保證餘額	保證餘額	金額	之背書保證	額佔最近期財務	最高限額	子公司背書	母公司背書	區背書保證		
(註2)	公司名稱	公司名稱	(註3)	(註4)	(註5)	(註7)	(註8)	金額(註9)	報表淨值之比率	(註4)	保證(註10)	保證(註10)	(註10)	備註
0	弘塑科技股份有限公司	添鴻科技股份有限公司	2	\$ 736,201	\$ 420,000	\$ 420,000	\$ 300,000	\$ -	11.41%	\$ 1,472,402	Y	N	N	註11
0	弘塑科技股份有限公司	佳霖電子(上海)有限公司	2	736,201	5,000	5,000	-	4,408	0.14%	1,472,402	Y	N	Y	註11
0	弘塑科技股份有限公司	添鴻化學科技(上海)有限公司	2	736,201	60,000	60,000	15,355	21,990	1.63%	1,472,402	Y	N	Y	註12
0	弘塑科技股份有限公司	太引資訊系統股份有限公司	2	736,201	45,000	45,000	2,737	-	1.22%	1,472,402	Y	N	N	註12

註1：本表所稱之「餘額、金額」，除實際動支金額(註7)乙項外皆指依據處理準則第7條規定於事實發生日(董事會決議日、交易簽約日、付款日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者)所發生之為他人背書保證額度或金額。

註2：編號欄之說明如下：

1. 本公司輸入0

2. 被投資公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號，同一公司編碼應相同。

註3：背書保證者與被背書保證對象之關係有下列7種，標示種類即可：

1. 有業務往來之公司。

2. 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

3. 直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

4. 公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間。

5. 基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保之公司。

6. 因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對其背書保證之公司。

7. 同業間依消費者保護法規範從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保。

註4：應輸入公司依為他人背書保證作業程序，所訂定對個別對象背書保證之限額及背書保證最高限額，並於備註欄說明其計算方式。

註5：累計當年度至申報月份止為他人背書保證之最高餘額。

註6：應輸入從事背書保證之各子公司(即編號非為「0」者)本月增減之背書保證額度/金額，本公司背書保證額度增減數則不必輸入。

註7：應填列董事會通過之金額。但董事會依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第十二條第八款授權董事長決行者，係指董事長決行之金額。(應輸入迄申報月份止仍存續之為他人背書保證額度/金額。)

註8：應輸入被背書保證公司於該背書保證額度/金額範圍內之實際動支金額。

註9：應輸入該筆背書保證中以財產擔保之金額。

註10：屬本公司對子公司背書保證者、屬子公司對本公司背書保證者、屬對大陸地區背書保證者始需輸入Y。

註11：對單一企業背書保證責任限額，以不超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值之20%。

註12：對外背書保證責任總額以不超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值40%。

弘塑科技股份有限公司及子公司
期末持有有價證券情形（不包含投資子公司、關聯企業及合資控制部分）
民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表二

單位：新台幣仟元
(除特別註明者外)

持有之公司	有價證券種類及名稱（註1）	與有價證券發行人之關係（註2）	帳列科目	期		末		備註
				股 數	帳面金額（註3）	持股比例	公允價值	
弘塑科技股份有限公司	TAZMO CO., LTD	無	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	500,000	\$ 300,822	3.4%	\$ 300,822	
弘塑科技股份有限公司	趨勢照明股份有限公司	無	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	400,000	4,000	18%	4,000	
佳霖科技股份有限公司	弘塑科技股份有限公司	本公司之母公司	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	579,520	68,963	2%	345,394	註5
弘塑科技股份有限公司	Sigary Inc.	無	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	-	37,960	-	37,960	

註1：本表所稱有價證券，係指屬國際財務報導準則第9號「金融工具」範圍之股票、債券、受益憑證及上述項目所衍生之有價證券。

註2：有價證券發行人非屬關係人者，該欄免填。

註3：按公允價值衡量者，帳面金額乙欄請填公允價值評價調整後及扣除累計減損之帳面餘額；非屬按公允價值衡量者，帳面金額乙欄請填原始取得成本或攤銷後成本扣除累計減損之帳面餘額。

註4：所列有價證券有因提供擔保、質押借款或其他依約定而受限制使用者，應於備註欄註明提供擔保或質借股數、擔保或質借金額及限制使用情形。

註5：係揭露弘塑集團庫藏股帳面金額。

弘塑科技股份有限公司及子公司
累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上
民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表三

單位：新台幣仟元

(除特別註明者外)

買、賣之公司	有價證券種類及 名稱 (註1)	帳列科目	交易對象 (註2)	關係 (註2)	期初		買入 (註3)		賣出 (註3)				期 末	
					股數	金 額	股數	金 額	股數	售價	帳面成本	處分損益	股數	金額(註)
弘塑科技股份 有限公司	TAZMO CO., LTD	透過其他綜合損益按公允 價值衡量之金融資產-非流 動	不適用	不適用	800,000	\$ 290,221	-	\$ -	300,000	\$ 142,549	\$ 142,549	\$ -	500,000	\$ 300,822

註：係民國112年12月31日之帳面金額。

弘塑科技股份有限公司及子公司
取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上
民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表四

單位：新台幣仟元

(除特別註明者外)

取得不動產之 公司	財產名稱	事實發生日	交易金額	價款支付情形	交易對象	關係	交易對象為關係人者，其前次移轉資料				價格決定之參考 依據	取得目的及 使用情形	其他約定 事項
							所有人	與發行人之關係	移轉日期	金額			
添鴻科技股份有 限公司	房屋及建築	112年3月6日	354,016	\$ 303,352	翔天科技事業有 限公司	無	不適用	不適用	不適用	不適用	按市場行情	營運使用	無
弘塑科技股份有 限公司	房屋及建築	112年10月1日	240,952	10,842	暉順營造股份有 限公司	無	不適用	不適用	不適用	不適用	按市場行情	營運使用	無

弘塑科技股份有限公司及子公司
 母公司與子公司及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額
 民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表五

單位：新台幣仟元
 (除特別註明者外)

編號 (註1)	交易人名稱	交易往來對象	與交易人之關係 (註2)	交易往來情形			佔合併總營收或總資產 之比率 (註3)
				科目	金額(註4)	交易條件	
1	添鴻科技股份有限公司	添鴻化學科技(上海)有限公司	1	銷貨收入	63,211	雙方議定	2%
1	添鴻科技股份有限公司	添鴻化學科技(上海)有限公司	1	應收帳款	41,895	雙方議定	0%
2	太引資訊系統股份有限公司	太引信息科技(南京)有限公司	1	銷貨收入	18,179	雙方議定	1%

註1：母公司及子公司相互間之業務往來資訊應分別於編號欄註明，編號之填寫方法如下：

- (1). 母公司填0。
- (2). 子公司依公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2：與交易人之關係有以下三種，標示種類即可(若係母子公司間或各子公司間之同一筆交易，則無須重複揭露。如：母公司對子公司之交易，若母公司已揭露，則子公司部分無須重複揭露；

子公司對子公司之交易，若其一子公司已揭露，則另一子公司無須重複揭露)：

- (1). 母公司對子公司。
- (2). 子公司對母公司。
- (3). 子公司對子公司。

註3：交易往來金額佔合併總營收或總資產比率之計算，若屬資產負債項目者，以期末餘額佔合併總資產之方式計算；若屬損益項目者，以期中累積金額佔合併總營收之方式計算。

註4：本表之重要交易往來情形得由公司依重大性原則決定是否須列示。

弘塑科技股份有限公司及子公司
被投資公司名稱、所在地區等相關資訊（不包含大陸被投資公司）
民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表六

單位：新台幣仟元
(除特別註明者外)

投資公司名稱	被投資公司名稱（註1、2）	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司	本期認列之	
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額	本期損益	投資損益	備註
弘塑科技股份有限公司	Grand Plastic Technology Limited	香港	投資業務	\$ 19,470	\$ 19,470	600,000	100%	\$ 17,780	\$ 21	\$ 21	
弘塑科技股份有限公司	添鴻科技股份有限公司	台灣	化學原料 製造及銷售	513,956	513,956	10,000,000	100%	987,509	170,905	157,996	註3
弘塑科技股份有限公司	太引資訊系統股份有限公司	台灣	軟體銷售及 安裝	160,783	160,783	2,831,000	78.1%	116,982	(4,266)	(10,523)	註3
弘塑科技股份有限公司	佳霖科技股份有限公司	台灣	半導體及電子 設備銷售代理	534,796	534,796	20,000,000	100%	618,082	126,655	108,640	註3
佳霖科技股份有限公司	Challenge Technology Corporation	薩摩亞	投資業務	19,069	19,069	1,000,000	100%	33,534	(1,179)	(1,179)	
添鴻科技股份有限公司	AQUA Talent Co., Ltd.	賽席爾	投資業務	23,097	23,097	350,000	100%	20,985	82	82	

註1：係有限公司無股數。

註2：大陸被投資公司相關資訊請參閱附表七。

註3：含企業合併產生之無形資產攤銷數。

弘塑科技股份有限公司及子公司
大陸投資資訊—基本資料
民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表七

單位：新台幣仟元
(除特別註明者外)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式 (註1)	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資損益 (註2)	期末投資帳面金額	截至本期止已匯回投資收益	備註
					匯出	收回							
弘懋光電(上海)有限公司	經營半導體機台買賣及維修	\$ 16,210 (美金500仟元)	2	\$ 16,210 (美金500仟元)	-	-	\$ 16,210 (美金500仟元)	\$ 101	100%	\$ 101	\$ 15,290	-	
添鴻化學科技(上海)有限公司	化學原料製造及銷售	8,927 (美金300仟元)	2	26,587 (美金870仟元)	-	-	26,587 (美金870仟元)	109	100%	109	18,951	-	
太引信息科技(南京)有限公司	軟體銷售及安裝	2,254 (美金74仟元)	1	2,254 (美金74仟元)	-	-	2,254 (美金74仟元)	632	78.1%	632	1,716	-	
佳霖電子(上海)有限公司	半導體及電子設備銷售代理	24,393 (美金600仟元)	2	24,393 (美金600仟元)	-	-	24,393 (美金600仟元)	(1,150)	100%	(1,150)	33,131	-	

公司名稱	本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額
弘懋光電(上海)有限公司	\$ 16,210	\$ 16,210	\$ 2,228,853
添鴻化學科技(上海)有限公司	26,587	26,587	2,228,853
太引信息科技(南京)有限公司	2,254	2,254	2,228,853
佳霖電子(上海)有限公司	24,393	24,393	2,228,853

註1：投資方式區分為下列三種，標示種類別即可：

- (1). 直接赴大陸地區從事投資
- (2). 透過第三地區公司再投資大陸(請註明該第三地區之投資公司)
- (3). 其他方式

註2：本期認列投資損益欄中：

- (1)若屬籌備中，尚無投資損益者，應予註明
- (2)投資損益認列基礎分為下列三種，應予註明
 - A. 經與中華民國會計師事務所所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報告
 - B. 經台灣母公司簽證會計師查核簽證之財務報告
 - C. 其他。

弘塑科技股份有限公司及子公司
主要股東資訊
民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

附表八

<u>主 要 股 東 名 稱</u>	<u>持 有 股 數</u>	<u>持 股 比 例</u>
張鴻泰	3,625,338	12.40%
定業投資股份有限公司	2,182,000	7.46%

會計師查核報告

(113)財審報字第 23004728 號

弘塑科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

弘塑科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達弘塑科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與弘塑科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對弘塑科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

弘塑科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

銷貨收入認列

事項說明

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(二十四)；營業收入會計項目之說明請詳個體財務報告附註六(二十)。

弘塑科技股份有限公司主要係製造並銷售半導體及積體電路製造設備產品。主要收入係依客戶確認簽收後認列，涉及判斷銷售商品之移轉時點正確性且銷貨收入對整體財務報表有重大影響，故列為查核最重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序如下：

1. 評估銷貨收入認列時點政策之適當性。
2. 評估及測試與銷貨收入認列時點攸關之內部控制制度設計及執行之有效性。
3. 選取樣本對銷貨收入交易執行核對客戶訂單及客戶簽回之佐證文件，確認係已完成合約約定事項，始為收入認列時點。
4. 對資產負債表日前後一段期間之銷貨收入交易執行截止測試。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估弘塑科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算弘塑科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

弘塑科技股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或

錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對弘塑科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使弘塑科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致弘塑科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於弘塑科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對弘塑科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李典易

會計師

謝智政

李典易



謝智政



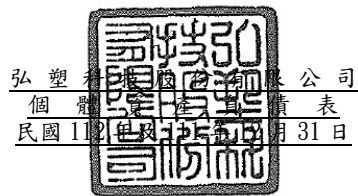
金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號

前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042599 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 8 日

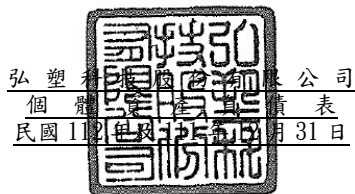


弘塑科技股份有限公司
個體資產負債表
民國112年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,651,219	28	\$ 1,312,083	23
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	六(四)及八	316,455	5	316,592	6
1170	應收帳款淨額	六(五)及十二(二)	87,100	2	155,416	3
1180	應收帳款—關係人淨額	六(五)及七	37	-	715	-
1200	其他應收款		3,445	-	3,502	-
130X	存貨	六(六)	1,369,030	24	1,486,912	26
1410	預付款項		2,940	-	4,484	-
1470	其他流動資產	八	358	-	52	-
11XX	流動資產合計		3,430,584	59	3,279,756	58
非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(二)	37,960	1	-	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六(三)	304,822	5	294,221	5
1550	採用權益法之投資	六(七)	1,740,353	30	1,700,007	31
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及八	256,948	4	261,982	5
1755	使用權資產	六(九)	4,593	-	2,880	-
1780	無形資產	六(十)	2,072	-	1,876	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十七)	52,963	1	68,571	1
1920	存出保證金		2,414	-	11,784	-
15XX	非流動資產合計		2,402,125	41	2,341,321	42
1XXX	資產總計		\$ 5,832,709	100	\$ 5,621,077	100

(續次頁)



弘塑塑膠工業股份有限公司
個體財務報告表
民國112年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動負債						
2100	短期借款	六(十一)	\$ -	-	\$ 180,000	3
2130	合約負債—流動	六(二十)	971,638	17	1,044,010	18
2170	應付帳款		333,362	6	280,257	5
2180	應付帳款—關係人	七	3,850	-	2,494	-
2200	其他應付款	六(十二)	176,276	3	230,536	4
2220	其他應付款項—關係人	七	244	-	557	-
2230	本期所得稅負債		110,136	2	91,547	2
2250	負債準備—流動	六(十五)	94,543	1	147,940	3
2280	租賃負債—流動		2,032	-	1,713	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十三)	5,944	-	-	-
2399	其他流動負債—其他		119	-	186	-
21XX	流動負債合計		<u>1,698,144</u>	<u>29</u>	<u>1,979,240</u>	<u>35</u>
非流動負債						
2540	長期借款	六(十三)	384,056	7	203,405	4
2550	負債準備—非流動	六(十五)	17,884	-	24,402	-
2570	遞延所得稅負債	六(二十七)	47,146	1	41,864	1
2580	租賃負債—非流動		2,581	-	1,181	-
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十四)	1,894	-	2,403	-
25XX	非流動負債合計		<u>453,561</u>	<u>8</u>	<u>273,255</u>	<u>5</u>
2XXX	負債總計		<u>2,151,705</u>	<u>37</u>	<u>2,252,495</u>	<u>40</u>
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十六)	292,160	5	292,160	5
資本公積						
3200	資本公積	六(十七)	1,177,591	20	1,123,265	20
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十八)	518,443	9	460,315	8
3320	特別盈餘公積		1,386	-	1,386	-
3350	未分配盈餘		1,551,963	26	1,390,812	25
其他權益						
3400	其他權益	六(十九)	208,424	4	183,292	3
3500	庫藏股票	六(十六)	(68,963)	(1)	(82,648)	(1)
3XXX	權益總計		<u>3,681,004</u>	<u>63</u>	<u>3,368,582</u>	<u>60</u>
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 5,832,709</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,621,077</u>	<u>100</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張鴻泰



經理人：石本立

石本立

會計主管：曾繁斌



弘 塑 利 有 限 公 司
個 體 綜 合 損 益 表
民國 112 年 及 111 年 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	112 年 度	111 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(二十)及七	\$ 1,626,367 100	\$ 2,014,757 100
5000 營業成本	六(六)及七	(864,334) (53)	(1,161,043) (58)
5900 營業毛利		762,033 47	853,714 42
營業費用	六(二十五) (二十六)及七		
6100 推銷費用		(77,579) (5)	(89,810) (5)
6200 管理費用		(126,427) (8)	(143,932) (7)
6300 研究發展費用		(199,543) (12)	(225,083) (11)
6450 預期信用減損損失		- -	(111) -
6000 營業費用合計		(403,549) (25)	(458,936) (23)
6900 營業利益		358,484 22	394,778 19
營業外收入及支出			
7100 利息收入	六(二十一)	43,962 3	16,940 1
7010 其他收入	六(二十二)	33,779 2	24,988 1
7020 其他利益及損失	六(二十三)	(9,476) (1)	107,938 5
7050 財務成本	六(二十四)	(6,872) -	(3,242) -
7070 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資損益之份額	六(七)	256,134 16	291,146 15
7000 營業外收入及支出合計		317,527 20	437,770 22
7900 稅前淨利		676,011 42	832,548 41
7950 所得稅費用	六(二十七)	(59,671) (4)	(110,442) (5)
8200 本期淨利		\$ 616,340 38	\$ 722,106 36
其他綜合損益			
不重分類至損益之項目			
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十四)	\$ 190 -	\$ 3,267 -
8316 透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評 價損益	六(三)	153,150 9	(4,856) -
8330 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資之其他綜合損益 之份額-不重分類至損益之項 目		2,151 -	3,710 -
8349 與不重分類之項目相關之所得 稅	六(二十七)	(30,630) (2)	971 -
8310 不重分類至損益之項目總額		124,861 7	3,092 -
後續可能重分類至損益之項目			
8361 國外營運機構財務報表換算之 兌換差額		(1,362) -	1,331 -
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 123,499 7	\$ 4,423 -
8500 本期綜合損益總額		\$ 739,839 45	\$ 726,529 36
基本每股盈餘	六(二十八)		
9750 基本每股盈餘		\$ 21.56	\$ 25.32
稀釋每股盈餘	六(二十八)		
9850 稀釋每股盈餘		\$ 21.45	\$ 24.99

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張鴻泰



經理人：石本立

石本立

會計主管：曾繁斌



弘 塑 科 技 有 限 公 司
個 體 財 務 報 表
民國 112 年 及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		保	留	盈	餘	其	他	權	益	
								透過其他綜合 損益按公允價 值衡量之金融 資產未實現評 價 損 益		
附 註	普 通 股 股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額			庫 藏 股 票	權 益 總 額
<u>111 年度</u>										
111 年 1 月 1 日	\$ 292,160	\$ 1,111,458	\$ 388,612	\$ 1,386	\$ 1,377,907	(\$ 2,181)	\$ 40,224	(\$ 82,648)	\$ 3,126,918	
本期淨利	-	-	-	-	722,106	-	-	-	722,106	
本期其他綜合損益	六(十九)	-	-	-	6,977	1,331	(3,885)	-	4,423	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	729,083	1,331	(3,885)	-	726,529	
110 年度盈餘指撥及分配	六(十八)									
法定盈餘公積	-	-	71,703	-	(71,703)	-	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	(496,672)	-	-	-	(496,672)	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	六(三)(十九)	-	-	-	(147,803)	-	147,803	-	-	
發放予子公司股利調整資本公積	六(十七)	-	11,807	-	-	-	-	-	11,807	
111 年 12 月 31 日	\$ 292,160	\$ 1,123,265	\$ 460,315	\$ 1,386	\$ 1,390,812	(\$ 850)	\$ 184,142	(\$ 82,648)	\$ 3,368,582	
<u>112 年</u>										
112 年 1 月 1 日	\$ 292,160	\$ 1,123,265	\$ 460,315	\$ 1,386	\$ 1,390,812	(\$ 850)	\$ 184,142	(\$ 82,648)	\$ 3,368,582	
本期淨利	-	-	-	-	616,340	-	-	-	616,340	
本期其他綜合損益	六(十九)	-	-	-	2,341	(1,362)	122,520	-	123,499	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	618,681	(1,362)	122,520	-	739,839	
111 年度盈餘指撥及分配	六(十八)									
法定盈餘公積	-	-	58,128	-	(58,128)	-	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	(525,888)	-	-	-	(525,888)	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	六(三)(十九)	-	-	-	126,486	-	(96,026)	-	30,460	
發放予子公司股利調整資本公積	六(十七)	-	10,431	-	-	-	-	-	10,431	
逾時效未領取之股利轉列資本公積	六(十七)	-	194	-	-	-	-	-	194	
子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	六(十六)(十七)	-	43,701	-	-	-	-	13,685	57,386	
112 年 12 月 31 日	\$ 292,160	\$ 1,177,591	\$ 518,443	\$ 1,386	\$ 1,551,963	(\$ 2,212)	\$ 210,636	(\$ 68,963)	\$ 3,681,004	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張鴻泰

經理人：石本立

會計主管：曾繁斌

 弘 塑 科 技 股 份 有 限 公 司
 個 體 獨 立 財 務 報 告
 民國 112 年 及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<u>營業活動之現金流量</u>			
本期稅前淨利		\$ 676,011	\$ 832,548
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(八)(九)		
	(二十五)	19,027	18,485
攤銷費用	六(十)(二十五)	964	634
利息費用	六(二十四)	6,872	3,242
採用權益法之子公司損益份額	六(七)	(256,134)	(291,146)
利息收入	六(二十一)	(43,962)	(16,940)
股利收入	六(二十二)	(3,882)	(3,070)
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十三)	-	(19,264)
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收帳款		68,994	32,699
其他應收款	(	782)	(2,646)
存貨		117,882	(126,923)
預付款項		1,544	764
其他流動資產	(	306)	(2)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債	(	72,372)	231,396
應付帳款		54,461	(155,475)
其他應付款	(	66,178)	27,285
負債準備	(	59,915)	41,140
其他流動負債	(	67)	56
淨確定福利負債	(	319)	(319)
營運產生之現金流入		441,838	572,464
收取之利息		44,802	16,346
支付之利息	(	6,652)	(3,176)
收取之股利		288,276	78,070
支付之所得稅	(	20,363)	(137,587)
營業活動之淨現金流入		747,901	526,117

(續次頁)

弘 塑 科 技 股 份 有 限 公 司
個 體 財 務 報 表
民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	111 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
投資活動之現金流量		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 37,960)	\$ -
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(4,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 六(三)	142,549	6,971
出售按攤銷後成本衡量之金融資產	137	526,145
購置不動產、廠房及設備 六(二十九)	(697)	(5,777)
處分不動產、廠房及設備價款	-	58,680
購置無形資產 六(十)	(1,160)	(2,173)
存出保證金減少	9,370	441
投資活動之淨現金流入	112,239	580,287
籌資活動之現金流量		
短期借款增加 六(三十)	101,000	830,000
短期借款減少 六(三十)	(281,000)	(840,000)
舉借長期借款 六(三十)	186,595	203,405
償還長期借款 六(三十)	-	(107,168)
租賃負債本金償還 六(三十)	(1,905)	(1,539)
現金股利 六(十八)	(525,888)	(496,672)
逾時效未領取之股利轉列資本公積 六(十七)	194	-
籌資活動之淨現金流出	(521,004)	(411,974)
本期現金及約當現金增加數	339,136	694,430
期初現金及約當現金餘額	1,312,083	617,653
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,651,219	\$ 1,312,083

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張鴻泰



經理人：石本立

石本立

會計主管：曾繁斌



弘塑科技股份有限公司
個 體 財 務 報 表 附 註
民國 112 年度及 111 年度

單位：新台幣仟元
(除特別註明者外)

一、公司沿革

弘塑科技股份有限公司（以下稱「本公司」）係於民國 82 年 5 月設立，所營業務主要為各種塑膠機械安裝工程設計，五金、機械、塑膠管、泵線、槽、樹脂、塗料、化工原料貯槽工程承包買賣，前各項有關產品之進出口貿易業務，半導體及積體電路製造設備及其材料、零件之代理、買賣及其技術諮詢顧問業務。本公司股票自民國 100 年 1 月起在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣。

二、通過財務報告之日期及程序

本個體財務報告已於民國 113 年 3 月 8 日經董事會通過。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)認可並發布生效之新發布、修正後國際財務報導準則會計準則之影響

下表彙列金管會認可並發布生效之民國 112 年適用之國際財務報導準則會計準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

<u>新發布/修正/修訂準則及解釋</u>	<u>國際會計準則理事會 發布之生效日</u>
國際會計準則第1號之修正「會計政策之揭露」	民國112年1月1日
國際會計準則第8號之修正「會計估計值之定義」	民國112年1月1日
國際會計準則第12號之修正「與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」	民國112年1月1日
國際會計準則第12號之修正「國際租稅變革－支柱二規則範本」	民國112年5月23日

本公司經評估上述準則及解釋對本公司財務狀況與財務績效並無重大影響。

(二)尚未採用金管會認可之新發布、修正後國際財務報導準則會計準則之影響

下表彙列金管會認可之民國 113 年適用之國際財務報導準則會計準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	國際會計準則理事會 發布之生效日
國際財務報導準則第16號之修正「售後租回中之租賃負債」	民國113年1月1日
國際會計準則第1號之修正「負債之流動或非流動分類」	民國113年1月1日
國際會計準則第1號之修正「具合約條款之非流動負債」	民國113年1月1日
國際會計準則第7號及國際財務報導準則第7號之修正「供應商融資安排」	民國113年1月1日

本公司經評估上述準則及解釋對本公司財務狀況與財務績效並無重大影響。

(三) 國際會計準則理事會已發布但尚未經金管會認可之國際財務報導準則會計準則之影響

下表彙列國際會計準則理事會已發布但尚未納入金管會認可之國際財務報導準則會計準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋：

新發布/修正/修訂準則及解釋	國際會計準則理事會 發布之生效日
國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	待國際會計準則理事會決定
國際財務報導準則第17號「保險合約」	民國112年1月1日
國際財務報導準則第17號「保險合約」之修正	民國112年1月1日
國際財務報導準則第17號之修正「初次適用國際財務報導準則第17號及國際財務報導準則第9號—比較資訊」	民國112年1月1日
國際會計準則第21號之修正「缺乏可兌換性」	民國114年1月1日

本公司經評估上述準則及解釋對本公司財務狀況與財務績效並無重大影響。

四、重大會計政策之彙總說明

編製本個體財務報告所採用之主要會計政策說明如下。除另有說明外，此等政策在所有報導期間一致地適用。

(一) 遵循聲明

本個體財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則編製。

(二) 編製基礎

1. 除下列重要項目外，本個體財務報告係按歷史成本編製：

- (1) 按公允價值衡量之透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債(包括衍生工具)。
- (2) 按公允價值衡量之透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產。
- (3) 按退休基金資產減除確定福利義務現值之淨額認列之確定福利負債。

2. 編製符合金管會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱 IFRSs)之財務報告需要使用一些重要會計估計，在應用本公司的會計政策過程中亦需要管理階層運用其判斷，涉及高度判斷或複雜性之項目，或涉及個體財務報告之重大假設及估計之項目，請詳附註五說明。

(三) 外幣換算

本公司之財務報告所列之項目，均係以本公司營運所處主要經濟環境之貨幣(即功能性貨幣)衡量。本個體財務報告係以本公司之功能性貨幣「新台幣」作為表達貨幣列報。

1. 外幣交易及餘額

- (1) 外幣交易採用交易日或衡量日之即期匯率換算為功能性貨幣，換算此等交易產生之換算差額認列為當期損益。
- (2) 外幣貨幣性資產及負債餘額，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之換算差額認列為當期損益。
- (3) 外幣非貨幣性資產及負債餘額，屬透過損益按公允價值衡量者，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之兌換差額認列為當期損益；屬透過其他綜合損益按公允價值衡量者，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之兌換差額認列於其他綜合損益項目；屬非按公允價值衡量者，則按初始交易日之歷史匯率衡量。
- (4) 所有其他兌換損益按交易性質在損益表之「其他利益及損失」列報。

2. 國外營運機構之換算

功能性貨幣與表達貨幣不同之所有公司個體、關聯企業及聯合協議，其經營結果和財務狀況以下列方式換算為表達貨幣：

- (1) 表達於每一資產負債表之資產及負債係以該資產負債表日之收盤匯率換算；
- (2) 表達於每一綜合損益表之收益及費損係以當期平均匯率換算；及
- (3) 所有因換算而產生之兌換差額認列為其他綜合損益。

(四) 資產負債區分流動及非流動之分類標準

1. 資產符合下列條件之一者，分類為流動資產：

- (1)預期將於正常營業週期中實現該資產，或意圖將其出售或消耗者。
- (2)主要為交易目的而持有者。
- (3)預期於資產負債表日後十二個月內實現者。
- (4)現金或約當現金，但於資產負債表日後至少十二個月交換或用以清償負債受到限制者除外。

本公司將所有不符合上述條件之資產分類為非流動。

2. 負債符合下列條件之一者，分類為流動負債：

- (1)預期將於正常營業週期中清償者。
- (2)主要為交易目的而持有者。
- (3)預期於資產負債表日後十二個月內到期清償者。
- (4)不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少十二個月者。負債之條款，可能依交易對方之選擇，以發行權益工具而導致清償者，不影響其分類。

本公司將所有不符合上述條件之負債分類為非流動。

(五) 約當現金

約當現金係指短期並具高度流動性之投資，該投資可隨時轉換成定額現金且價值變動之風險甚小。定期存款符合前述定義且其持有目的係為滿足營運上之短期現金承諾者，分類為約當現金。

(六) 透過損益按公允價值衡量之金融資產

- 1. 係指非屬按攤銷後成本衡量或透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產。
- 2. 本公司對於符合慣例交易之透過損益按公允價值衡量之金融資產係採用交易日。
- 3. 本公司於原始認列時按公允價值衡量，相關交易成本認列於損益，後續按公允價值衡量，其利益或損失認列於損益。
- 4. 當收取股利之權利確立，與股利有關之經濟效益很有可能流入，及股利金額能可靠衡量時，本公司於損益認列股利收入。

(七) 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

1. 係指原始認列時作一不可撤銷之選擇，將非持有供交易之權益工具投資的公允價值變動列報於其他綜合損益。
2. 本公司對於符合交易慣例之透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產係採用交易日會計。
3. 本公司於原始認列時按其公允價值加計交易成本衡量，後續按公允價值衡量。

屬權益工具之公允價值變動認列於其他綜合損益，於除列時，先前認列於其他綜合損益之累積利益或損失後續不得重分類至損益，轉列至保留盈餘項下。當收取股利之權利確立，與股利有關之經濟效益很有可能流入，及股利金額能可靠衡量時，本公司於損益認列股利收入。

(八) 按攤銷後成本衡量之金融資產

1. 係指同時符合下列條件者：
 - (1) 在以收取合約現金流量為目的之經營模式下持有該金融資產。
 - (2) 該金融資產之合約條款產生特定日期之現金流量，完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。
2. 本公司對於符合交易慣例之按攤銷後成本衡量之金融資產係採用交易日會計。
3. 本公司於原始認列時按其公允價值加計交易成本衡量，後續採有效利息法按攤銷程序於流通期間內認列利息收入，及認列減損損失，並於除列時，將其利益或損失認列於損益。
4. 本公司持有不符合約當現金之定期存款，因持有期間短，折現之影響不重大，係以投資金額衡量。

(九) 應收帳款及票據

1. 指依合約約定，已具無條件收取因移轉商品或勞務所換得對價金額權利之帳款及票據。
2. 屬未付息之短期應收帳款及票據，因折現之影響不大，本公司係以原始發票金額衡量。

(十) 金融資產減損

本公司於每一資產負債表日，就按攤銷後成本衡量之金融資產，考量所有合理且可佐證之資訊(包括前瞻性者)後，對自原始認列後信用風險並未顯著增加者，按 12 個月預期信用損失金額衡量備抵損失；對自原始認列後信用風險已顯著增加者，按存續期間預期信用損失金額衡量備抵損失；就不包含重大財務組成部分之應收帳款或合約資產，按存續期間預期信用損失金額衡量備抵損失。

(十一) 存貨

存貨按成本與淨變現價值孰低者衡量，成本依加權平均法決定。在製品之成本包括原料、直接人工、其他直接成本及生產相關之製造費用(按正常產能分攤)，惟不包括借款成本。比較成本與淨變現價值孰低時，採逐項比較法，淨變現價值係指在正常營業過程中之估計售價減除至完工尚須投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。

(十二) 採用權益法之投資—子公司

1. 子公司指受本公司控制之個體，當本公司暴露於來自對該個體之參與之變動報酬或對該等變動報酬享有權利，且透過對該個體之權力有能力影響該等報酬時，本公司即控制該個體。
2. 本公司與子公司間交易所產生之未實現損益業已銷除。子公司之會計政策已作必要之調整，與本公司採用之政策一致。
3. 本公司對子公司取得後之損益份額認列為當期損益，對其取得後之其他綜合損益份額則認列為其他綜合損益。如本公司對子公司所認列之損失份額等於或超過在該子公司之權益時，本公司繼續按持股比例認列損失。
4. 對子公司持股之變動若未導致喪失控制(與非控制權益之交易)，係作為權益交易處理，亦即視為與業主間進行之交易。非控制權益之調整金額與所支付或收取對價之公允價值間之差額係直接認列為權益。
5. 當本公司喪失對子公司之控制，對前子公司之剩餘投資係按公允價值重新衡量，並作為原始認列金融資產之公允價值或原始認列投資關聯企業或合資之成本，公允價值與帳面金額之差額認列為當期損益。對於先前認列於其他綜合損益與該子公司有關之所有金額，其會計處理與本公司若直接處分相關資產或負債之基礎相同，亦即如先前認列為其他綜合損益之利益或損失，於處分相關資產或負債時將被重分類為損益，則當喪失對子公司之控制時，將該利益或損失自權益重分類為

損益。

(十三) 不動產、廠房及設備

1. 不動產、廠房及設備係以取得成本為入帳基礎，並將購建期間之有關利息資本化。
2. 後續成本只有在與該項目有關之未來經濟效益很有可能流入本公司，且該項目之成本能可靠衡量時，才包括在資產之帳面金額或認列為一項單獨資產。被重置部分之帳面金額應除列。所有其他維修費用於發生時認列為當期損益。
3. 不動產、廠房及設備之後續衡量採成本模式，除土地不提折舊外，其他按估計耐用年限以直線法計提折舊。不動產、廠房及設備各項組成若屬重大，則單獨提列折舊。
4. 本公司於每一財務年度結束對各項資產之殘值、耐用年限及折舊方法進行檢視，若殘值及耐用年限之預期值與先前之估計不同時，或資產所含之未來經濟效益之預期消耗型態已有重大變動，則自變動發生日起依國際會計準則第 8 號「會計政策、會計估計變動及錯誤」之會計估計變動規定處理。各項資產之耐用年限如下：

房屋及建築

廠房主建物	43 年 ~ 50 年
電梯	15 年
其他	4 年 ~ 10 年
機器設備	6 年 ~ 8 年
試驗設備	3 年 ~ 8 年
其他設備	3 年 ~ 8 年

(十四) 承租人之租賃交易－使用權資產/租賃負債

1. 租賃資產於可供本公司使用之日認列為使用權資產及租賃負債。當租賃合約係屬短期租賃或低價值標的資產之租賃時，將租賃給付採直線法於租賃期間認列為費用。
2. 租賃負債於租賃開始日將尚未支付之租賃給付按本公司增額借款利率折現後之現值認列，租賃給付包括固定給付，減除可收取之任何租賃誘因，後續採利息法按攤銷後成本法衡量，於租賃期間提列利息費用。當非屬合約修改造造成租賃期間或租賃給付變動時，將重評估租賃負債，並將再衡量數調整使用權資產。

3. 使用權資產於租賃開始日按成本認列，成本包括：

- (1) 租賃負債之原始衡量金額；
- (2) 於開始日或之前支付之任何租賃給付；
- (3) 發生之任何原始直接成本；及
- (4) 為拆卸、移除標的資產及復原其所在地點，或將標的資產復原至租賃之條款及條件中所要求之狀態之估計成本。

後續採成本模式衡量，於使用權資產之耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者，提列折舊費用。當租賃負債重評估時，使用權資產將調整租賃負債之任何再衡量數。

(十五) 無形資產

電腦軟體以取得成本認列，依直線法按估計耐用年限 3 年攤銷。

(十六) 非金融資產減損

本公司於資產負債表日針對有減損跡象之資產，估計其可回收金額，當可回收金額低於其帳面價值時，則認列減損損失。可回收金額係指一項資產之公允價值減處分成本或其使用價值，兩者較高者。當以前年度已認列資產減損之情況不存在或減少時，則迴轉減損損失，惟迴轉減損損失而增加之資產帳面金額，不超過該資產若未認列減損損失情況下減除折舊或攤銷後之帳面金額。

(十七) 借款

1. 係指向銀行借入之長、短期款項。本公司於原始認列時按其公允價值減除交易成本衡量，後續就減除交易成本後之價款與贖回價值之任何差額，採有效利息法按攤銷程序於流通期間內認列利息費用於損益。
2. 設立借款額度時支付之費用，當很有可能提取部分或全部額度，則該費用認列為借款之交易成本，予以遞延至動支發生時認列為有效利率之調整；當不太可能提取部分或全部額度，則認列該費用為預付款項，並在額度相關之期間內攤銷。

(十八) 應付帳款及票據

1. 係指因賒購原物料、商品或勞務所發生之債務及因營業與非因營業而發生之應付票據。
2. 屬未付息之短期應付帳款及票據，因折現之影響不大，本公司係以原始發票金額衡量。

(十九) 負債準備

負債準備(包含保固)係因過去事件而負有現時法定或推定義務，很有可能需要流出具經濟效益之資源以清償該義務，且該義務之金額能可靠估計時認列。負債準備之衡量係以資產負債表日清償該義務所需支出之最佳估計現值衡量，折現率採用反映目前市場對貨幣時間價值及負債特定風險之評估之稅前折現率，折現之攤銷認列為利息費用。未來營運損失不得認列負債準備。

(二十) 員工福利

1. 短期員工福利

短期員工福利係以預期支付之非折現金額衡量，並於相關服務提供時認列為費用。

2. 退休金

(1) 確定提撥計畫

對於確定提撥計畫，係依權責發生基礎將應提撥之退休基金數額認列為當期之退休金成本。預付提撥金於可退還現金或減少未來給付之範圍內認列為資產。

(2) 確定福利計畫

A. 確定福利計畫下之淨義務係以員工當期或過去服務所賺得之未來福利金額折現計算，並以資產負債表日之確定福利義務現值減除計畫資產之公允價值。確定福利淨義務每年由精算師採用預計單位福利法計算，折現率係使用資產負債表日與確定福利計畫之貨幣及期間一致之政府公債（於資產負債表日）之市場殖利率。

B. 確定福利計畫產生之再衡量數於發生當期認列於其他綜合損益，並表達於保留盈餘。

C. 前期服務成本之相關費用立即認列為損益。

3. 員工酬勞及董監酬勞

員工酬勞及董監事酬勞係於具法律或推定義務且金額可合理估計時，認列為費用及負債。嗣後決議實際配發金額與估列金額有差異時，則按會計估計變動處理。

(二十一) 所得稅

1. 所得稅費用包含當期及遞延所得稅。除與列入其他綜合損益或直接列入權益之項目有關之所得稅分別列入其他綜合損益或直接列入權益外，所得稅係認列於損益。

2. 本公司依據營運及產生應課稅所得之所在國家在資產負債表日已立法或已實質性立法之稅率計算當期所得稅。管理階層就適用所得稅相關法規定期評估所得稅申報之狀況，並在適用情況下根據預期須向稅捐機關支付之稅款估列所得稅負債。未分配盈餘依所得稅法加徵之所得稅，嗣盈餘產生年度之次年度於股東會通過盈餘分派案後，始就實際盈餘之分派情形，認列未分配盈餘所得稅費用。
3. 遞延所得稅採用資產負債表法，按資產及負債之課稅基礎與其於個體資產負債表之帳面金額所產生之暫時性差異認列。源自於原始認列之商譽所產生之遞延所得稅負債則不予認列，若遞延所得稅源自於交易（不包括企業合併）中對資產或負債之原始認列，且在交易當時未影響會計利潤或課稅所得（課稅損失），則不予認列。若投資子公司產生之暫時性差異，本公司可以控制暫時性差異迴轉之時點，且暫時性差異很有可能於可預見之未來不會迴轉者則不予認列。遞延所得稅採用在資產負債表日已立法或已實質性立法，並於有關之遞延所得稅資產實現或遞延所得稅負債清償時預期適用之稅率（及稅法）為準。
4. 遞延所得稅資產於暫時性差異很有可能用以抵減未來應課稅所得之範圍內認列，並於每一資產負債表日重評估未認列及已認列之遞延所得稅資產。
5. 因購置設備或技術及研究發展支出等而產生之未使用所得稅抵減遞轉後期部分，係在很有可能有未來課稅所得以供未使用所得稅抵減使用之範圍內，認列遞延所得稅資產。

（二十二）股本

1. 普通股分類為權益。直接歸屬於發行新股或認股權之增額成本以扣除所得稅後之淨額於權益中列為價款減項。
2. 本公司買回已發行股票時，將所支付之對價包括任何可直接歸屬之增額成本以稅後淨額認列為股東權益之減項。買回之股票後續再發行時，所收取之對價扣除任何可直接歸屬之增額成本及所得稅影響後與帳面價值之差額認列為股東權益之調整。

（二十三）股利分配

分派予本公司股東之股利於本公司董事會決議分派股利時於財務報告認列，分派現金股利認列為負債。分派股票股利則認列為待分配股票股利，且於發行新股基準日時轉列普通股。

(二十四) 收入認列

1. 商品銷貨收入

商品銷貨收入主要來自於半導體機台及產品之銷售等。銷貨收入於產品之控制移轉予客戶時認列，即當產品被交付予客戶，且本公司並無尚未履行之履約義務可能影響客戶接受該產品時。當產品被運送至指定地點，陳舊過時及滅失之風險已移轉予客戶，且客戶依據銷售合約接受產品，或有客觀證據證明所有接受標準皆已滿足時，商品交付方屬發生。

2. 勞務收入

本公司提供軟體開發工程及設備維修業務，軟體開發工程合約中包含軟體銷售及安裝服務。本公司提供之安裝服務重大客製化，故軟體銷售及安裝不可區分，辨認為一個隨時間逐步滿足之履約義務。本公司以投入成本占估計總成本之比例認列收入，已認列收入金額若尚未請款，係認列合約資產，對於該對價有無條件之權利時，將合約資產轉列應收帳款，若客戶應付款超過本公司已提供之服務時則認列為合約負債。本公司對收入、成本及完工程度之估計隨情況改變進行修正。任何導因於估計變動之估計收入、成本增加或減少，於導致修正之情況被管理階層所知悉之期間內反映於損益。設備維修服務係於勞務提供完成時認列。

(二十五) 政府補助

政府補助於可合理確信企業將遵循政府補助所附加之條件，且將可收到該項補助時，按公允價值認列。若政府補助之性質係補償本公司發生之費用，則在相關費用發生期間依有系統之基礎將政府補助認列為當期損益。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本公司編製本個體財務報告時，管理階層已運用其判斷以決定所採用之會計政策，並依據資產負債表日當時之情況對於未來事件之合理預期以作出會計估計及假設。所作出之重大會計估計與假設可能與實際結果存有差異，將考量歷史經驗及其他因子持續評估及調整。該等估計及假設具有導致資產及負債帳面金額於下個財務年度重大調整之風險。請詳下列對重大會計判斷、估計與假設不確定性之說明：

(一) 會計政策採用之重要判斷

無。

(二) 重要會計估計及假設

存貨之評價

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低者計價，故本公司必須運用判斷及估計決定資產負債表日存貨之淨變現價值。由於科技快速變遷，本公司評估資產負債表日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。此存貨評價未來可能產生重大變動。

民國 112 年 12 月 31 日，本公司存貨之帳面金額為\$1,369,030。

六、重要會計項目之說明

(一) 現金及約當現金

	112年12月31日	111年12月31日
庫存現金及週轉金	\$ 43	\$ 11
活期存款	1,234,948	609,746
定期存款	416,228	702,326
合計	<u>\$ 1,651,219</u>	<u>\$ 1,312,083</u>

1. 本公司往來之金融機構信用品質良好，且本公司與多家金融機構往來以分散信用風險，預期發生違約之可能性甚低。
2. 本公司未有將現金及約當現金提供質押之情形。

(二) 透過損益按公允價值衡量之金融資產

項 目	112年12月31日	111年12月31日
非流動項目：		
債務工具		
可轉換債券	<u>\$ 37,960</u>	<u>\$ -</u>

相關透過損益按公允價值衡量之金融資產公允價值資訊請詳附註十二、(三)。

(三) 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

項 目	112年12月31日	111年12月31日
非流動項目：		
權益工具		
上市(櫃)公司股票	\$ 45,520	\$ 72,831
非上市(櫃)公司股票	<u>4,000</u>	<u>4,000</u>
小計	49,520	76,831
評價調整	<u>255,302</u>	<u>217,390</u>
合計	<u>\$ 304,822</u>	<u>\$ 294,221</u>

1. 本公司於民國 112 年及 111 年度因公允價值變動認列於其他綜合(損)益之金額分別為\$153,150 及(\$4,856)。認列於損益之股利收入分別為\$3,882 及\$3,070。
2. 本公司選擇將屬策略性投資之中長期投資分類為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，該等投資於民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之公允價值分別為\$304,822 及\$294,221。
3. 因已完成策略聯盟階段性任務，故本公司分別於民國 112 年及 111 年度出售公允價值為\$142,549 及\$6,971 之投資，並將累積處分利益分別為\$96,026 及\$4,497 轉列保留盈餘。
4. 本公司所投資之部分非上市(櫃)公司，因已於民國 111 年度完成清算程序，故本公司除列其投資並將累積損失\$152,300 轉列保留盈餘。
5. 相關透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產公允價值資訊請詳附註十二、(三)。

(四) 按攤銷後成本衡量之金融資產

項目	112年12月31日	111年12月31日
流動項目：		
定期存款	\$ 316,455	\$ 316,592
1. 按攤銷後成本衡量之金融資產認列於損益之明細如下：		
	112年度	111年度
利息收入	\$ 5,138	\$ 3,708

2. 在不考慮所持有之擔保品或其他信用增強之情況下，最能代表本公司持有按攤銷後成本衡量之金融資產，於民國 112 年及 111 年 12 月 31 日信用風險最大之暴險金額分別為\$316,455 及\$316,592。
3. 相關按攤銷後成本衡量之金融資產信用風險資訊請詳附註十二、(二)。本公司投資定期存單之交易對象為信用品質良好之金融機構，預期發生違約之可能性甚低。
4. 以按攤銷後成本衡量之金融資產提供擔保之資訊，請詳附註八之說明。

(五) 應收帳款

	112年12月31日	111年12月31日
應收帳款	\$ 87,211	\$ 155,527
減：備抵損失	(111)	(111)
小計	87,100	155,416
應收帳款－關係人	37	715
合計	\$ 87,137	\$ 156,131

1. 應收帳款之帳齡分析如下：

	112年12月31日	111年12月31日
	應收帳款	應收帳款
未逾期	\$ 85,410	\$ 152,940
60天內	1,604	152
60-120天	114	181
120天以上	120	2,969
	<u>\$ 87,248</u>	<u>\$ 156,242</u>

以上係以逾期天數為基準進行之帳齡分析。

2. 民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之應收帳款餘額均為客戶合約所產生，另於民國 111 年 1 月 1 日客戶合約之應收款餘額為\$188,830。

3. 在不考慮所持有之擔保品或其他信用增強之情況下，最能代表本公司應收帳款於民國 112 年及 111 年 12 月 31 日信用風險最大之暴險金額分別為\$87,137 及\$156,131。

4. 相關應收帳款信用風險資訊請詳附註十二、(二)。

(六) 存貨

	112年12月31日	111年12月31日
原料	\$ 353,766	\$ 414,769
在製品	1,015,264	1,072,143
合計	<u>\$ 1,369,030</u>	<u>\$ 1,486,912</u>

本公司當期認列為費損之存貨成本：

	112年度	111年度
已出售存貨成本	\$ 827,274	\$ 1,144,555
跌價損失	37,060	16,488
	<u>\$ 864,334</u>	<u>\$ 1,161,043</u>

(七) 採用權益法之投資

	112年	111年
1月1日	\$ 1,700,007	\$ 1,467,013
子公司處分本公司股票	57,386	-
採用權益法之投資損益份額	256,134	291,146
收取子公司股利	(284,394)	(75,000)
確認福利計畫之再衡量數	2,151	3,710
發放予子公司股利	10,431	11,807
換算調整數	(1,362)	1,331
12月31日	<u>\$ 1,740,353</u>	<u>\$ 1,700,007</u>

1. 子公司之基本資訊如下：

子公司名稱	主要 營業活動	112年12月31日		111年12月31日	
		所有權權益及 表決權百分比	帳面金額	所有權權益及 表決權百分比	帳面金額
添鴻科技股份有限公司	化學原料 製造	100%	\$ 987,509	100%	\$ 1,026,387
佳霖科技股份有限公司	半導體及 電子設備 銷售代理	100%	618,082	100%	520,511
太引資訊系統股份有限公司	軟體銷售 及安裝	78.1%	116,982	78.1%	135,032
Grand Plastic Technology Limited.	投資業務	100%	17,780	100%	18,077

2. 本公司間接持有之投資子公司明細，請參閱附註十三及合併財務報告附註四、(三)。

(八)不動產、廠房及設備

	112年						
	土地	房屋及建築	機器設備	試驗設備	其他設備	未完工程及待驗設備	合計
1月1日							
成本	\$ 95,187	\$ 225,118	\$ 1,510	\$ 7,737	\$ 12,319	\$ -	\$ 341,871
累計折舊	<u>-</u>	<u>(66,845)</u>	<u>(1,035)</u>	<u>(5,263)</u>	<u>(6,746)</u>	<u>-</u>	<u>(79,889)</u>
	<u>\$ 95,187</u>	<u>\$ 158,273</u>	<u>\$ 475</u>	<u>\$ 2,474</u>	<u>\$ 5,573</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 261,982</u>
1月1日	\$ 95,187	\$ 158,273	\$ 475	\$ 2,474	\$ 5,573	\$ -	\$ 261,982
增添	-	109	-	-	1,050	10,923	12,082
折舊費用	<u>-</u>	<u>(13,415)</u>	<u>(117)</u>	<u>(993)</u>	<u>(2,591)</u>	<u>-</u>	<u>(17,116)</u>
12月31日	<u>\$ 95,187</u>	<u>\$ 144,967</u>	<u>\$ 358</u>	<u>\$ 1,481</u>	<u>\$ 4,032</u>	<u>\$ 10,923</u>	<u>\$ 256,948</u>
12月31日							
成本	\$ 95,187	\$ 217,645	\$ 1,510	\$ 6,287	\$ 11,483	\$ 10,923	\$ 343,035
累計折舊	<u>-</u>	<u>(72,678)</u>	<u>(1,152)</u>	<u>(4,806)</u>	<u>(7,451)</u>	<u>-</u>	<u>(86,087)</u>
	<u>\$ 95,187</u>	<u>\$ 144,967</u>	<u>\$ 358</u>	<u>\$ 1,481</u>	<u>\$ 4,032</u>	<u>\$ 10,923</u>	<u>\$ 256,948</u>

		111年					
		土地	房屋及建築	機器設備	試驗設備	其他設備	合計
1月1日							
成本	\$	95,187	\$ 235,723	\$ 1,600	\$ 101,326	\$ 9,662	\$ 443,498
累計折舊		—	(70,500)	(1,121)	(53,173)	(6,142)	(130,936)
	\$	<u>95,187</u>	<u>\$ 165,223</u>	<u>\$ 479</u>	<u>\$ 48,153</u>	<u>\$ 3,520</u>	<u>\$ 312,562</u>
1月1日	\$	95,187	\$ 165,223	\$ 479	\$ 48,153	\$ 3,520	\$ 312,562
增添		—	308	145	500	4,824	5,777
處分		—	—	—	(39,416)	—	(39,416)
折舊費用		—	(7,258)	(149)	(6,763)	(2,771)	(16,941)
12月31日	\$	<u>95,187</u>	<u>\$ 158,273</u>	<u>\$ 475</u>	<u>\$ 2,474</u>	<u>\$ 5,573</u>	<u>\$ 261,982</u>
12月31日							
成本	\$	95,187	\$ 225,118	\$ 1,510	\$ 7,737	\$ 12,319	\$ 341,871
累計折舊		—	(66,845)	(1,035)	(5,263)	(6,746)	(79,889)
	\$	<u>95,187</u>	<u>\$ 158,273</u>	<u>\$ 475</u>	<u>\$ 2,474</u>	<u>\$ 5,573</u>	<u>\$ 261,982</u>

以不動產、廠房及設備提供擔保之資訊，請詳附註八之說明。

(九)租賃交易－承租人

1. 本公司租賃之標的資產包括辦公設備，租賃合約之期間通常介於 1 到 5 年。租賃合約是採個別協商並包含各種不同的條款及條件，除租賃之資產不得用作借貸擔保外，未有加諸其他之限制。
2. 本公司承租之倉庫、員工宿舍及辦公設備等之租賃期間不超過 12 個月。
3. 使用權資產之帳面價值與認列之折舊費用資訊如下：

	112年12月31日	111年12月31日
	帳面金額	帳面金額
辦公設備	\$ 4,593	\$ 2,880
	112年度	111年度
	折舊費用	折舊費用
辦公設備	\$ 1,911	\$ 1,544

4. 本公司於民國 112 年及 111 年度使用權資產之增添分別為\$3,624 及 \$2,843。

5. 與租賃合約有關之損益項目資訊如下：

	112年度	111年度
<u>影響當期損益之項目</u>		
租賃負債之利息費用	\$ 42	\$ 26
屬短期租賃合約之費用	1,099	1,082

6. 本公司於民國 112 年及 111 年度租賃現金流出總額為\$3,046 及\$2,647。

(十)無形資產

	112年	111年
	電腦軟體	電腦軟體
1月1日		
成本	\$ 18,575	\$ 16,402
累計攤銷	(16,699)	(16,065)
12月31日	\$ 1,876	\$ 337
1月1日	\$ 1,876	\$ 337
增添	1,160	2,173
攤銷費用	(964)	(634)
12月31日	\$ 2,072	\$ 1,876
12月31日		
成本	\$ 19,735	\$ 18,575
累計攤銷	(17,663)	(16,699)
	\$ 2,072	\$ 1,876

無形資產攤銷明細如下：

	112年度	111年度
營業成本	\$ 279	\$ 179
推銷費用	115	74
管理費用	204	147
研究發展費用	366	234
	<u>\$ 964</u>	<u>\$ 634</u>

(十一) 短期借款

民國 112 年 12 月 31 日：無。

借款性質	111年12月31日	利率區間	擔保品
銀行借款			
信用借款	<u>\$ 180,000</u>	1.25%~1.30%	無

(十二) 其他應付款

	112年12月31日	111年12月31日
應付薪資及獎金	\$ 69,072	\$ 122,198
應付員工酬勞	59,824	73,677
應付董監事酬勞	11,965	14,735
應付營業稅	4,336	-
應付工程款	11,385	-
其他	19,694	19,926
	<u>\$ 176,276</u>	<u>\$ 230,536</u>

(十三) 長期借款

借款性質	借款期間及還款方式	112年12月31日
擔保借款(註)		
銀行借款	126年5月18日前分期償還	\$ 103,405
銀行借款	126年12月12日前分期償還	100,000
銀行借款	127年3月1日前分期償還	136,595
信用借款		
銀行借款	127年3月1日前分期償還	<u>50,000</u>
小計		390,000
減：一年或一營業週期內到期之長期借款		(<u>5,944</u>)
		<u>\$ 384,056</u>
利率區間		<u>1.745%</u>

借款性質	借款期間及還款方式	111年12月31日
擔保借款(註)		
銀行借款	126年5月18日前分期償還	\$ 103,405
銀行借款	126年12月12日前分期償還	100,000
減：一年或一營業週期內到期之長期借款		-
		<u>\$ 203,405</u>
利率區間		<u>1.50%</u>

註：擔保品請詳附註八之說明。

(十四) 退休金

1.(1) 本公司依據「勞動基準法」之規定，訂有確定福利之退休辦法，適用於民國 94 年 7 月 1 日實施「勞工退休金條例」前所有正式員工之服務年資，以及於實施「勞工退休金條例」後選擇繼續適用勞動基準法員工之後續服務年資。員工符合退休條件者，退休金之支付係根據服務年資及退休前 6 個月之平均薪資計算，15 年以內(含)的服務年資每滿一年給予兩個基數，超過 15 年之服務年資每滿一年給予一個基數，惟累積最高以 45 個基數為限。本公司按月就薪資總額 2%提撥退休基金，以勞工退休準備金監督委員會之名義專戶儲存於台灣銀行。另本公司於每年年度終了前，估算前項勞工退休準備金專戶餘額，若該餘額不足給付次一年度內預估符合退休條件之勞工依前述計算之退休金數額，本公司將於次年度三月底前一次提撥其差額。

(2) 資產負債表認列之金額如下：

	112年12月31日	111年12月31日
確定福利義務現值	(\$ 18,715)	(\$ 18,533)
計畫資產公允價值	16,821	16,130
淨確定福利負債	<u>(\$ 1,894)</u>	<u>(\$ 2,403)</u>

(3) 淨確定福利負債之變動如下：

112年			
	確定福利義務現值	計畫資產公允價值	淨確定福利負債
1月1日	(\$ 18,533)	\$ 16,130	(\$ 2,403)
利息(費用)收入	(241)	212	(29)
	(18,774)	16,342	(2,432)
再衡量數：			
計畫資產報酬 (不包括包含於 利息收入或費 用之金額)	-	131	131
財務假設變動 影響數	(101)	-	(101)
經驗調整	160	-	160
	59	131	190
提撥退休基金	-	348	348
支付退休金	-	-	-
12月31日	(\$ 18,715)	\$ 16,821	(\$ 1,894)
111年			
	確定福利義務現值	計畫資產公允價值	淨確定福利負債
1月1日	(\$ 20,525)	\$ 14,536	(\$ 5,989)
利息(費用)收入	(103)	74	(29)
	(20,628)	14,610	(6,018)
再衡量數：			
計畫資產報酬 (不包括包含於 利息收入或費 用之金額)	-	1,172	1,172
財務假設變動 影響數	1,750	-	1,750
經驗調整	345	-	345
	2,095	1,172	3,267
提撥退休基金	-	348	348
支付退休金	-	-	-
12月31日	(\$ 18,533)	\$ 16,130	(\$ 2,403)

(4) 本公司之確定福利退休計畫基金資產，係由臺灣銀行按該基金年度投資運用計畫所定委託經營項目之比例及金額範圍內，依勞工退休基金收支保管及運用辦法第六條之項目（即存放國內外之金融機構，投資國內外上市、上櫃或私募之權益證券及投資國內外不動產之證券化商品等）辦理委託經營，相關運用情形係由勞工退休基金監理會進行監督。該基金之運用，其每年決算分配之最低收益，不得

低於依當地銀行二年定期存款利率計算之收益，若有不足，則經主管機關核准後由國庫補足。因本公司無權參與該基金之運作及管理，故無法依國際會計準則第 19 號第 142 段規定揭露計劃資產公允價值之分類。民國 112 年及 111 年 12 月 31 日構成該基金總資產之公允價值，請詳政府公告之各年度之勞工退休基金運用報告。

(5)有關退休金之精算假設彙總如下：

	112年度	111年度		
折現率	1.25%	1.30%		
未來薪資增加率	3.50%	3.50%		
對於未來死亡率之假設係按照各國已公布的統計數字及經驗估計。因採用之主要精算假設變動而影響之確定福利義務現值分析如下：				
	折現率		未來薪資增加率	
	增加0.25%	減少0.25%	增加1%	減少1%

112年12月31日

對確定福利義務現值之影響 (\$ 496) \$ 514 \$ 2,131 (\$ 1,892)

111年12月31日

對確定福利義務現值之影響 (\$ 527) \$ 547 \$ 2,240 (\$ 1,976)

上述之敏感度分析係基於其他假設不變的情況下分析單一假設變動之影響。實務上許多假設的變動則可能是連動的。敏感度分析係與計算資產負債表之淨退休金負債所採用的方法一致。

本期編製敏感度分析所使用之方法與假設與前期相同。

(6)本公司於民國 113 年度預計支付予退休計畫之提撥金為\$348。

(7)截至民國 112 年 12 月 31 日，該退休計畫之加權平均存續期間為 12.6 年。

2.(1)自民國 94 年 7 月 1 日起，本公司及國內子公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。本公司及國內子公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，每月按薪資之 6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。

(2)民國 112 年及 111 年度，本公司依上開退休金辦法認列之退休金成本分別為\$9,820 及\$9,408。

(十五)負債準備

	112年	111年
1月1日餘額	\$ 172,342	\$ 131,202
本期新增之負債準備	70,494	92,705
本期使用之負債準備	(22,810)	(19,777)
本期迴轉之未使用金額	(107,599)	(31,788)
12月31日餘額	\$ 112,427	\$ 172,342

負債準備分析如下：

	112年12月31日	111年12月31日
流動	\$ 94,543	\$ 147,940
非流動	\$ 17,884	\$ 24,402

保固負債準備係依銷售商品合約約定，本公司管理階層對於因保固義務所導致未來經濟效益流出最佳估計數之現值。該估計係以歷史保固經驗為基礎，並考量新原料、製程變動或其他影響產品品質等因素調整。

(十六)股本

- 民國 112 年 12 月 31 日，本公司額定資本額為\$500,000，分為 50,000 仟股，實收資本額為\$292,160，每股面額 10 元。本公司已發行股份之股款均已收訖。

本公司普通股期初與期末流通在外股數調節如下：

	112年	單位:仟股 111年
1月1日/12月31日	28,521	\$ 28,521
子公司處分本公司股份	115	-
12月31日	28,636	28,521

2. 庫藏股

股份收回原因及其數量：

持有股份之公司名稱	收 回 原 因	112年12月31日	
		股數(仟股)	帳面金額
子公司-佳霖科技股份有限公司	投資目的	580	\$ 68,963
持有股份之公司名稱	收 回 原 因	111年12月31日	
		股數(仟股)	帳面金額
子公司-佳霖科技股份有限公司	投資目的	695	\$ 82,648

(十七)資本公積

依公司法規定，超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得之資本公積，除得用於彌補虧損外，於公司無累積虧損時，按股東原有股份之比例發給新股或現金。另依證券交易法之相關規定，以上開資本公積撥充資本時，每年以其合計數不超過實收資本額百分之十為限。公司非於盈餘公積填補資本虧損仍有不足時，不得以資本公積補充之。

112年						
	發行溢價	庫藏股票 交易	員工 認股權	合併發行 新股溢價	其他	合計數
1月1日	\$ 114,000	\$ 30,559	\$ 654	\$ 976,592	\$ 1,460	\$ 1,123,265
發放予子公司股利						
調整資本公積	-	10,431	-	-	-	10,431
逾時效未領取之股 利轉列資本公積	-	-	-	-	194	194
子公司處分母公司 股票視同庫藏股交 易	-	43,701	-	-	-	43,701
12月31日	<u>\$ 114,000</u>	<u>\$ 84,691</u>	<u>\$ 654</u>	<u>\$ 976,592</u>	<u>\$ 1,654</u>	<u>\$ 1,177,591</u>
111年						
	發行溢價	庫藏股票 交易	員工 認股權	合併發行 新股溢價	其他	合計數
1月1日	\$ 114,000	\$ 18,752	\$ 654	\$ 976,592	\$ 1,460	\$ 1,111,458
發放予子公司股利						
調整資本公積	-	11,807	-	-	-	11,807
12月31日	<u>\$ 114,000</u>	<u>\$ 30,559</u>	<u>\$ 654</u>	<u>\$ 976,592</u>	<u>\$ 1,460</u>	<u>\$ 1,123,265</u>

(十八) 保留盈餘

1. 依本公司章程之盈餘分派政策規定，年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10% 為法定盈餘公積，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。
2. 法定盈餘公積應提撥至其餘額達公司實收股本總額時為止。法定盈餘公積得用以彌補虧損。公司無虧損時，法定盈餘公積超過實收股本總額 25% 之部分除得撥充股本外，尚得以現金分配。
3. 本公司依金管證發字第 1010012865 號函、金管證發字第 1010047490 號函、金管證發字第 1030006415 號及「採用國際財務報導準則（IFRSs）後，提列特別盈餘公積之適用疑義問答」等規定提列及迴轉特別盈餘公積。
4. 本公司於民國 112 年 6 月 21 日及 111 年 6 月 23 日經股東會決議民國 111 年度及 110 年度之盈餘分派案如下：

	111年度		110年度	
	金額	每股股利(元)	金額	每股股利(元)
法定盈餘公積	\$ 58,128		\$ 71,703	
現金股利	525,888	\$ 18	496,672	\$ 17
	<u>\$ 584,016</u>		<u>\$ 568,375</u>	

5. 本公司於民國 113 年 3 月 8 日經董事會通過擬議 112 年盈餘分配案如下，該案尚待股東會決議通過：

	盈餘分配案	每股股利(元)
法定盈餘公積	\$ 74,517	
現金股利	467,456	\$ 16
	<u>\$ 541,973</u>	

6. 民國 112 年度及 111 年度盈餘分派案之現金股利分派金額，業已分別於民國 113 年 3 月 8 日及 112 年 3 月 20 日經董事會決議通過。

(十九) 其他權益項目

	外幣換算	未實現評價損益	總計
112年1月1日	(\$ 850)	\$ 184,142	\$ 183,292
外幣換算差異數	(1,362)	-	(1,362)
評價調整	-	122,520	122,520
出售轉出至保留盈餘	-	(96,026)	(96,026)
112年12月31日	<u>(\$ 2,212)</u>	<u>\$ 210,636</u>	<u>\$ 208,424</u>
	外幣換算	未實現評價損益	總計
111年1月1日	(\$ 2,181)	\$ 40,224	\$ 38,043
外幣換算差異數	1,331	-	1,331
評價調整	-	(3,885)	(3,885)
出售轉出至保留盈餘	-	147,803	147,803
111年12月31日	<u>(\$ 850)</u>	<u>\$ 184,142</u>	<u>\$ 183,292</u>

(二十) 營業收入

	112年度	111年度
客戶合約之收入	<u>\$ 1,626,367</u>	<u>\$ 2,014,757</u>

1. 客戶合約收入之細分

本公司之收入源於提供於某一時點移轉之商品及勞務，收入可區分如下：

	112年度	111年度
客戶合約之收入		
機台設備產品銷售收入	\$ 1,508,843	\$ 1,883,293
維修服務及其他收入	117,524	131,464
	<u>\$ 1,626,367</u>	<u>\$ 2,014,757</u>

2. 合約負債

產品銷售之預收款項，於機台驗收前係認列為合約負債。本公司認列客戶合約收入相關之合約負債如下：

	112年12月31日	111年12月31日	111年1月1日
合約負債：			
商品銷售	<u>\$ 971,638</u>	<u>\$ 1,044,010</u>	<u>\$ 812,614</u>

3. 期初合約負債本期認列收入

	112年度	111年度
合約負債期初餘額本		
期認列收入	\$ 774,553	\$ 709,867
(二十一) <u>利息收入</u>		
	112年度	111年度
銀行存款利息	\$ 36,925	\$ 13,232
按攤銷後成本衡量之金融資產		
利息收入	5,138	3,708
其他利息收入	1,899	-
	\$ 43,962	\$ 16,940
(二十二) <u>其他收入</u>		
	112年度	111年度
股利收入	\$ 3,882	\$ 3,070
政府補助收入(註)	22,000	8,000
其他收入—其他	7,897	13,918
	\$ 33,779	\$ 24,988
註：本公司因進行製程設備開發計畫而取得政府補助收入。		
(二十三) <u>其他利益及損失</u>		
	112年度	111年度
處分不動產、廠房及設備利益	\$ -	\$ 19,264
外幣兌換(損失)利益	(9,476)	88,674
	(\$ 9,476)	\$ 107,938
(二十四) <u>財務成本</u>		
	112年度	111年度
銀行借款利息	\$ 6,830	\$ 3,216
租賃負債之利息	42	26
	\$ 6,872	\$ 3,242
(二十五) <u>費用性質之額外資訊</u>		
	112年度	111年度
員工福利費用	\$ 346,410	\$ 438,470
折舊費用	19,027	18,485
攤銷費用	964	634

(二十六) 員工福利費用

	112年度	111年度
薪資費用	\$ 310,749	\$ 404,794
勞健保費用	16,791	15,956
退休金費用	9,849	9,437
其他用人費用	9,021	8,283
	<u>\$ 346,410</u>	<u>\$ 438,470</u>

1. 依本公司章程規定，本公司依當年度獲利狀況扣除累計虧損後，如尚有餘額，應提撥員工酬勞不低於 7.5%，董監酬勞不高於 3%。
2. 本公司民國 112 年及 111 年度員工酬勞估列金額分別為 \$59,824 及 \$73,677；董事酬勞估列金額分別為 \$11,965 及 \$14,735，前述金額帳列薪資費用科目。

民國 112 年度係依截至當期止之獲利情況，分別以 8% 及 1.6% 估列。

經董事會決議之民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞與民國 111 年度財務報告認列之金額一致。

本公司董事會通過之員工及董監酬勞相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。

(二十七) 所得稅

1. 所得稅費用

(1) 所得稅費用組成部分：

	112年度	111年度
當期所得稅：		
當期所得產生之所得稅	\$ 75,200	\$ 117,089
未分配盈餘加徵	-	7,433
以前年度所得稅高估	(25,000)	-
當期所得稅總額	<u>50,200</u>	<u>124,522</u>
遞延所得稅：		
暫時性差異之原始產生及迴轉	9,471	(14,080)
遞延所得稅總額	<u>9,471</u>	<u>(14,080)</u>
所得稅費用	<u>\$ 59,671</u>	<u>\$ 110,442</u>

(2) 與其他綜合損益相關之所得稅金額：

	112年12月31日	111年12月31日
透過其他綜合損益按公允價值變動之金融資產公允價值變動	<u>\$ 30,630</u>	<u>(\$ 971)</u>

(3) 直接借記或貸記權益之所得稅金額：

	112年度	111年度
透過其他綜合損益按公 允價值變動之金融資 產公允價值變動	\$ 19,211	\$ 837
2. 所得稅費用與會計利潤關係		
	112年度	111年度
稅前淨利按法定稅率計算之所得稅	\$ 135,202	\$ 166,510
按稅法規定免課稅之所得	(50,531)	(58,177)
遞延所得稅評估變動	-	(5,324)
以前年度所得稅高估數	(25,000)	-
未分配盈餘加徵	-	7,433
所得稅費用	\$ 59,671	\$ 110,442

3. 因暫時性差異而產生之各遞延所得稅資產或負債金額如下：

	112年				
	1月1日	認列於損益	其他綜合損益	直接認列於權益	12月31日
遞延所得稅資產：					
-暫時性差異：					
未實現暫估費用	\$ 15,513	(\$ 10,175)	\$ -	\$ -	\$ 5,338
負債準備	40,826	(11,983)	-	-	28,843
未實現存貨跌價損失	11,185	6,550	-	-	17,735
確定福利退休計畫	4,789	-	-	-	4,789
未實現其他收入	89	-	-	-	89
國外營運機構兌換差 額	(3,831)	-	-	-	(3,831)
小計	\$ 68,571	(\$ 15,608)	\$ -	\$ -	\$ 52,963
-遞延所得稅負債：					
透過其他綜合損益按 公允價值衡量之金 融資產	(33,248)	-	(30,630)	19,211	(44,667)
未實現兌換利益	(7,771)	6,141	-	-	(1,630)
未實現權益法投資損 益	(845)	(4)	-	-	(849)
小計	(\$ 41,864)	\$ 6,137	(\$ 30,630)	\$ 19,211	(\$ 47,146)
合計	\$ 26,707	(\$ 9,471)	(\$ 30,630)	\$ 19,211	\$ 5,817

	111年				
	1月1日	認列於損益	認列於其他綜合損益	直接認列於權益	12月31日
遞延所得稅資產：					
-暫時性差異：					
未實現暫估費用	\$ 9,967	\$ 5,546	\$ -	\$ -	\$ 15,513
負債準備	26,240	14,586	-	-	40,826
未實現存貨跌價損失	9,053	2,132	-	-	11,185
確定福利退休計畫	4,789	-	-	-	4,789
未實現兌換損失	5,685	(5,685)	-	-	-
未實現其他收入	89	-	-	-	89
國外營運機構兌換差額	(3,831)	-	-	-	(3,831)
小計	\$ 51,992	\$ 16,579	\$ -	\$ -	\$ 68,571
-遞延所得稅負債：					
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(35,056)	-	971	837	(33,248)
未實現兌換利益	-	(7,771)	-	-	(7,771)
未實現權益法投資損益	(6,117)	5,272	-	-	(845)
小計	(\$ 41,173)	(\$ 2,499)	\$ 971	\$ 837	(\$ 41,864)
合計	\$ 10,819	\$ 14,080	\$ 971	\$ 837	\$ 26,707

4. 本公司營利事業所得稅業經稅捐稽徵機關核定至民國 110 年度。

(二十八) 每股盈餘

	112年度		
	稅後金額	加權平均流通 在外股數(仟股)	每股盈餘 (元)
<u>基本每股盈餘</u>			
歸屬於普通股股東之本期淨利	\$ 616,340	28,589	\$ 21.56
<u>稀釋每股盈餘</u>			
歸屬於普通股股東之本期淨利	616,340		
具稀釋作用之潛在普通股之影響			
員工酬勞	-	149	
歸屬於普通股股東之本期 淨利加潛在普通股之影響	\$ 616,340	28,738	\$ 21.45

	111年度		
	稅後金額	加權平均流通 在外股數(仟股)	每股盈餘 (元)
<u>基本每股盈餘</u>			
歸屬於普通股股東之本期淨利	\$ 722,106	28,521	\$ 25.32
<u>稀釋每股盈餘</u>			
歸屬於普通股股東之本期淨利	722,106		
具稀釋作用之潛在普通股之影響			
員工酬勞	-	371	
歸屬於普通股股東之本期 淨利加潛在普通股之影響	\$ 722,106	28,892	\$ 24.99

(二十九) 現金流量補充資訊

僅有部分現金支付之投資活動：

	112年度	111年度
購置不動產、廠房及設備	\$ 12,082	\$ 5,777
加：期初應付設備款	-	-
減：期末應付設備款	(11,385)	-
本期支付現金	\$ 697	\$ 5,777

(三十) 來自籌資活動之負債之變動

	112年			來自籌資活動 之負債總額
	短期借款	租賃負債	長期借款 (含一年內到期)	
1月1日	\$ 180,000	\$ 2,894	\$ 203,405	\$ 386,299
籌資現金流量之變動	(180,000)	(1,947)	186,595	4,648
租賃負債利息費用	-	42	-	42
租賃負債新增數	-	3,624	-	3,624
12月31日	\$ -	\$ 4,613	\$ 390,000	\$ 394,613
	111年			來自籌資活動 之負債總額
	短期借款	租賃負債	長期借款 (含一年內到期)	
1月1日	\$ 190,000	\$ 1,590	\$ 107,168	\$ 298,758
籌資現金流量之變動	(10,000)	(1,565)	96,237	84,672
租賃負債利息費用	-	26	-	26
租賃負債新增數	-	2,843	-	2,843
12月31日	\$ 180,000	\$ 2,894	\$ 203,405	\$ 386,299

七、關係人交易

(一)關係人之名稱及關係

關係人名稱	與本公司關係
添鴻科技股份有限公司	子公司
弘懋光電科技(上海)有限公司	孫公司
佳霖科技股份有限公司	子公司
佳霖電子(上海)有限公司	孫公司
太引資訊系統股份有限公司	子公司

(二)與關係人間之重大交易事項

1. 營業收入

	112年度	111年度
商品銷售：		
佳霖電子(上海)有限公司	\$ 870	\$ 1,624
添鴻科技股份有限公司	25	533
	<u>\$ 895</u>	<u>\$ 2,157</u>

商品銷售之交易價格與收款條件與非關係人並無重大差異。

2. 進貨

	112年度	111年度
商品購買：		
太引資訊系統股份有限公司	\$ 314	\$ -
佳霖科技股份有限公司	6,615	17,711
	<u>\$ 6,929</u>	<u>\$ 17,711</u>

進貨之交易價格與付款條件與非關係人並無重大差異。

3. 應收關係人款項

	112年12月31日	111年12月31日
應收帳款：		
佳霖電子(上海)有限公司	\$ 37	\$ 362
添鴻科技股份有限公司	-	353
	<u>\$ 37</u>	<u>\$ 715</u>

應收關係人款項主要來自銷售交易。該應收款項並無抵押及附息。

4. 應付關係人款項

	112年12月31日	111年12月31日
應付帳款：		
佳霖科技股份有限公司	\$ 3,745	\$ 2,494
太引資訊系統股份有限公司	105	-
小計	\$ 3,850	\$ 2,494
其他應付款：		
弘懋光電科技(上海)有限公司	244	488
添鴻科技股份有限公司	-	69
	244	557
	\$ 4,094	\$ 3,051

應付關係人款項主要來自進貨交易。該應付款項並無附息。

5. 提供背書保證

	112年12月31日	111年12月31日
添鴻科技股份有限公司	\$ 420,000	\$ 360,000
太引資訊系統股份有限公司	45,000	45,000
佳霖電子(上海)有限公司	5,000	5,000
添鴻化學科技(上海)有限公司	60,000	60,000
	\$ 530,000	\$ 470,000

6. 佣金支出

	112年度	111年度
佳霖電子(上海)有限公司	\$ 5,882	\$ 7,378

7. 服務費

	112年度	111年度
添鴻科技股份有限公司	\$ -	\$ 66
弘懋光電科技(上海)有限公司	2,576	1,820
	\$ 2,576	\$ 1,886

8. 勞務費

	112年度	111年度
佳霖科技股份有限公司	\$ 11,268	\$ -

(三) 主要管理階層薪酬資訊

	112年度	111年度
短期員工福利	\$ 32,321	\$ 32,814
退職後福利	216	216
	\$ 32,537	\$ 33,030

八、質押之資產

本公司之資產提供擔保明細如下：

資產項目	帳面價值		擔保用途
	112年12月31日	111年12月31日	
質押定存單 (帳列按攤銷後成本衡量 之金融資產－流動)	\$ 28,955	\$ 29,092	為他人背書保證、貨 物關稅擔保函質押保 證金
土地	95,187	95,187	銀行借款擔保
房屋及建築物－淨額	141,177	144,685	銀行借款擔保
	<u>\$ 265,319</u>	<u>\$ 268,964</u>	

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

(一)或有事項: 無。

(二)承諾事項

已簽約但尚未發生之資本支出

	112年12月31日	111年12月31日
不動產、廠房及設備	<u>\$ 230,110</u>	<u>\$ -</u>

十、重大之災害損失

無。

十一、重大之期後事項

民國 112 年度盈餘分派議案，請詳附註六(十八)說明。

十二、其他

(一)資本管理

本公司進行資本管理以確保能夠於繼續經營之前提下，藉由將債務及權益餘額最適化，使資本有效之運用，並確保各公司順利營運。本公司之資本結構係由淨負債及權益所組成，毋需遵守其他外部資本規定。本公司主要管理階層定期重新檢視資本結構，其檢視內容包括考量各類資本之成本及相關風險，目前資本結構中權益項目遠大於負債項目，將用以支應未來所需之營運資金、資本支出及股利支出等需求。

(二) 金融工具

1. 金融工具之種類

	112年12月31日	111年12月31日
<u>金融資產</u>		
透過損益按公允價值衡量之金融資產		
選擇指定之債務工具投資	\$ 37,960	\$ -
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		
選擇指定之權益工具投資	304,822	294,221
	<u>\$ 342,782</u>	<u>\$ 294,221</u>
按攤銷後成本衡量之金融資產		
現金及約當現金	\$ 1,651,219	\$ 1,312,083
按攤銷後成本衡量之金融資產	316,455	316,592
應收帳款(含關係人)	87,137	156,131
其他應收款	3,445	3,502
存出保證金	2,414	11,784
	<u>\$ 2,060,670</u>	<u>\$ 1,800,092</u>
	112年12月31日	111年12月31日
<u>金融負債</u>		
按攤銷後成本衡量之金融負債		
短期借款	\$ -	\$ 180,000
應付帳款(含關係人)	337,212	282,751
其他應付款(含關係人)	176,520	231,093
長期借款(包含一年或一營業週期內到期)	390,000	203,405
	<u>\$ 903,732</u>	<u>\$ 897,249</u>
租賃負債	<u>\$ 4,613</u>	<u>\$ 2,894</u>

2. 風險管理政策

- (1) 本公司主要金融工具包括權益及債務工具投資、應收帳款、借款、應付帳款及租賃負債。本公司財務風險管理目標，係為管理營運活動相關之市場風險（包含匯率風險、利率風險及其他價格風險）、信用風險及流動性風險。為降低相關財務風險，本公司致力於辨認、評估並規避市場之不確定性，以降低市場變動對公司財務績效之潛在不利影響。
- (2) 本公司之重要財務活動，係經董事會或權責主管依相關規範及內部控制制度進行覆核。於財務計劃執行期間，本公司必須恪遵關於整體財務風險管理及權責劃分之相關財務操作程序。

3. 重大財務風險之性質及程度

(1) 市場風險

匯率風險

- A. 本公司係跨國營運，因此受相對與本公司及各子公司功能性貨幣不同的交易所產生之匯率風險，主要為美元、人民幣及日幣。相關匯率風險來自未來之商業交易及已認列之資產與負債。
- B. 本公司管理階層已訂定政策，規定公司內各公司管理相對其功能性貨幣之匯率風險。各公司應透過公司財務部就其整體匯率風險進行避險。
- C. 本公司從事之業務涉及若干非功能性貨幣，故受匯率波動之影響，具重大匯率波動影響之外幣資產及負債資訊如下：

112年12月31日			
	外幣(仟元)	匯率	帳面金額 (新台幣)
(外幣:功能性貨幣)			
<u>金融資產</u>			
<u>貨幣性項目</u>			
美金：新台幣	\$ 19,754	30.71	\$ 606,645
日幣：新台幣	840,049	0.22	184,811
人民幣：新台幣	20,979	4.33	90,839
<u>金融負債</u>			
<u>貨幣性項目</u>			
美金：新台幣	\$ 193	30.71	\$ 5,927
日幣：新台幣	42,462	0.22	9,342
111年12月31日			
	外幣(仟元)	匯率	帳面金額 (新台幣)
(外幣:功能性貨幣)			
<u>金融資產</u>			
<u>貨幣性項目</u>			
美金：新台幣	\$ 41,315	30.71	\$1,268,784
日幣：新台幣	284,623	0.23	65,463
人民幣：新台幣	8,393	4.41	37,013
<u>金融負債</u>			
<u>貨幣性項目</u>			
美金：新台幣	\$ 267	30.71	\$ 8,200
日幣：新台幣	32,561	0.23	7,489
D. 本公司貨幣性項目因匯率波動具重大影響於民國112年及111年度之全部兌換(損)益(含已實現及未實現)分別為(\$9,476)及\$88,674。			

E. 本公司因重大匯率波動影響之外幣市場風險分析如下：

		112年度		
		敏感度分析		
	變動幅度	影響損益	影響其他綜合損益	
(外幣:功能性貨幣)				
<u>金融資產</u>				
<u>貨幣性項目</u>				
美金：新台幣	1%	\$ 6,066	\$	-
日幣：新台幣	1%	1,848		-
人民幣：新台幣	1%	908		-
<u>金融負債</u>				
<u>貨幣性項目</u>				
美金：新台幣	1%	(59)	\$	-
日幣：新台幣	1%	(93)		-
		111年度		
		敏感度分析		
	變動幅度	影響損益	影響其他綜合損益	
(外幣:功能性貨幣)				
<u>金融資產</u>				
<u>貨幣性項目</u>				
美金：新台幣	1%	\$ 12,688	\$	-
日幣：新台幣	1%	655		-
人民幣：新台幣	1%	370		-
<u>金融負債</u>				
<u>貨幣性項目</u>				
美金：新台幣	1%	(82)	\$	-
日幣：新台幣	1%	(75)		-

價格風險

- A. 本公司因上市櫃及非上市櫃權益證券投資而產生權益價格暴險。該權益投資非持有供交易而係屬策略性投資。本公司並未積極交易該等投資。本公司權益價格風險主要集中於日本及美國地區之權益工具。
- B. 本公司主要投資於國外公司發行之權益工具，此等權益工具之價格會因該投資標的未來價值之不確定性而受影響。若該等權益工具價格上升或下跌1%，而其他所有因素維持不變之情況下，對民國112年及111年度之稅後淨利因來自透過損益按公允價值衡量之金融資產之利益或損失將分別增加或減少\$380及\$0；對其他綜合損益因分類為透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益投資投資之利益或損失分別增加或減少\$3,048及\$2,942。

現金流量及公允價值利率風險

本公司之利率風險來自短期及長期借款。按浮動利率發行之借款使本公司承受現金流量利率風險，部分風險被按浮動利率持有之現金及約當現金抵銷。按固定利率發行之借款則使本公司承受之公允價值利率風險。民國 112 年及 111 年度，本公司按浮動利率計算之借款係以新台幣計價，當市場利率每增加 0.25%，本公司將增加之現金流出分別為\$780 及\$767。

(2)信用風險

- A. 本公司之信用風險係因客戶或金融工具之交易對手無法履行合約義務而導致本公司財務損失之風險，主要來自交易對手無法清償按收款條件支付之應收帳款，及按攤銷後成本衡量之金融資產的合約現金流量。
- B. 本公司係以公司角度建立信用風險之管理。對於往來之銀行及金融機構，設定僅有獲獨立信評等級優良，始可被接納為交易對象。依內部明定之授信政策，公司內各營運個體與每一新客戶於訂定付款及提出交貨之條款與條件前，須對其進行管理及信用風險分析。內部風險控管係透過考慮其財務狀況、過往經驗及其他因素，以評估客戶之信用品質。個別風險之限額係董事會依內部或外部之評等而制訂，並定期監控信用額度之使用。
- C. 本公司採用 IFRS9 提供前提假設，當合約款項按約定之支付條款逾期超過 120 天，視為已發生違約。
- D. 本公司當合約款項按約定之支付條款逾期超過 30 天，視為金融資產自原始認列後信用風險已顯著增加。
- E. 本公司用以判定債務工具投資為信用減損之指標如下：
 - (A)發行人發生重大財務困難，或將進入破產或其他財務重整之可能性大增；
 - (B)發行人由於財務困難而使該金融資產之活絡市場消失；
 - (C)發行人延滯或不償付利息或本金；
 - (D)導致發行人違約有關之全國性或區域性經濟情況不利之變化。
- F. 本公司按貿易信用風險之特性將對客戶之應收帳款分組，採用簡化作法以準備矩陣為基礎估計預期信用損失。
- G. 本公司經追索程序後，對無法合理預期可回收金融資產之金額予以沖銷，惟本公司仍會持續進行追索之法律程序以保全債權之權利。
- H. 本公司納入客戶過去違約紀錄與現時財務狀況、產業經濟情勢，並同時考量 GDP 預測及產業展望。對未來前瞻性的考量調整按特定期間歷史及現時資訊所建立之損失率，以估計應收帳款的備抵損失，民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之準備矩陣如下：

	未逾期	逾期1~60天	逾期61~120天	逾期120天以上	合計
<u>112年12月31日</u>					
預期損失率	0%	0%	0%	10%-100%	
帳面價值總額	\$ 85,410	\$ 1,604	\$ 114	\$ 120	\$ 87,248
備抵損失	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111	\$ 111

<u>111年12月31日</u>					
預期損失率	0%	0%	0%	10%-20%	
帳面價值總額	\$ 152,940	\$ 152	\$ 181	\$ 2,969	\$ 156,242
備抵損失	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111	\$ 111

I. 本公司採簡化作法之應收帳款備抵損失變動表如下：

	112年	111年
	應收帳款	應收帳款
1月1日	\$ 111	\$ -
提列減損損失	-	111
12月31日	\$ 111	\$ 111

(3) 流動性風險

- A. 現金流量預測是由公司內各營運個體執行，並由公司財務部予以彙總。公司財務部監控公司流動資金需求之預測，確保其有足夠資金得以支應營運需要。
- B. 各營運個體所持有之剩餘現金，在超過營運資金之管理所需時，將轉撥回公司財務部。公司財務部則將剩餘資金投資於付息之活期存款、定期存款，其所選擇之工具具有適當之到期日或足夠流動性，以因應上述預測並提供充足之調度水位。於民國 112 年及 111 年 12 月 31 日，本公司持有貨幣市場部位分別為\$1,967,631 及\$1,628,664，預期可即時產生現金流量以管理流動性風險。
- C. 本公司未動用借款額度明細如下：

	112年12月31日	111年12月31日
無擔保銀行透支額度 (每年重新檢視)		
—已動用金額	\$ 50,000	\$ 180,000
—未動用金額	530,000	400,000
	<u>\$ 580,000</u>	<u>\$ 580,000</u>
有擔保銀行借款額度 (雙方同意下得展期)		
—已動用金額	\$ 340,000	\$ 203,405
—未動用金額	50,000	186,595
	<u>\$ 390,000</u>	<u>\$ 390,000</u>

- D. 下表係本公司之非衍生金融負債，按相關到期日予以分組，依據資產負債表日至合約到期日之剩餘期間進行分析。下表所揭露之合約現金流量金額係未折現之金額：

112年12月31日	一年以內(含)	1~5年	5年以上
<u>非衍生金融負債：</u>			
應付款項(含關係人)	\$ 337,212	\$ -	\$ -
其他應付款(含關係人)	176,520	-	-
租賃負債	2,090	2,626	-
長期借款	10,644	133,465	280,922
財務保證合約	530,000	-	-
111年12月31日	一年以內(含)	1~5年	5年以上
<u>非衍生金融負債：</u>			
短期借款	\$ 180,234	\$ -	\$ -
應付款項(含關係人)	282,751	-	-
其他應付款(含關係人)	231,093	-	-
租賃負債	1,602	1,335	-
長期借款	3,291	82,610	144,394
財務保證合約	470,000	-	-

(三)公允價值資訊

1. 為衡量金融及非金融工具之公允價值所採用評價技術的各等級定義如下：

第一等級：企業於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場之報價(未經調整)。活絡市場係指有充分頻率及數量之資產或負債交易發生，以在持續基礎上提供定價資訊之市場。本公司投資之上市櫃股票投資的公允價值屬之。

第二等級：資產或負債直接或間接之可觀察輸入值，但包括於第一等級之報價者除外。

第三等級：資產或負債之不可觀察輸入值。本公司投資之無活絡市場之權益工具屬之。

2. 非以公允價值衡量之金融工具

包括現金及約當現金、應收帳款、其他應收款、存出保證金、短期借款、應付帳款、其他應付款及長期借款的帳面金額係公允價值之合理近似值。

3. 以公允價值衡量之金融工具，本公司依資產及負債之性質、特性及風險及公允價值等級之基礎分類，相關資訊如下：

(1)本公司依資產及負債之性質分類，相關資訊如下：

112年12月31日	<u>第一等級</u>	<u>第二等級</u>	<u>第三等級</u>	<u>合計</u>
資產				
<u>重複性公允價值</u>				
透過損益按公允價值				
衡量之金融資產				
債務證券	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 37,960</u>	<u>\$ 37,960</u>
透過其他綜合損益按				
公允價值衡量之				
金融資產				
權益證券	<u>\$ 300,822</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4,000</u>	<u>\$ 304,822</u>
111年12月31日	<u>第一等級</u>	<u>第二等級</u>	<u>第三等級</u>	<u>合計</u>
資產				
<u>重複性公允價值</u>				
透過其他綜合損益按				
公允價值衡量之				
金融資產				
權益證券	<u>\$ 290,221</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4,000</u>	<u>\$ 294,221</u>

(2) 本公司用以衡量公允價值所使用之方法及假設說明如下：

- A. 本公司採用市場報價作為公允價輸入值(即第一等級)者，依工具之特性屬國內外上市股票係以資產負債表日公開市價之收盤價。
- B. 除上述有活絡市場之金融工具外，其餘金融工具之公允價值係以評價技術或參考交易對手報價取得。透過評價技術所取得之公允價值可參照其他實質上條件及特性相似之金融工具之現時公允價值、現金流量折現法或以其他評價技術，包括以合併資產負債表日可取得之市場資訊運用模型計算而得。
- C. 評價模型之產出係預估之概算值，而評價技術可能無法反映本公司持有金融工具及非金融工具之所有攸關因素。因此評價模型之預估值會適當地根據額外之參數予以調整，例如模型風險或流動性風險等。根據本公司之公允價值評價模型管理政策及相關之控制程序，管理階層相信為允當表達合併資產負債表中金融工具及非金融工具之公允價值，評價調整係屬適當且必要。在評價過程中所使用之價格資訊及參數係經審慎評估，且適當地根據目前市場狀況調整。

4. 民國 112 年及 111 年度無第一等級與第二等級間之任何移轉。

5. 下表列示民國 112 年及 111 年度第三等級之變動：

	112年	111年
	權益工具	權益工具
1月1日	\$ 4,000	\$ -
本期購買	37,960	4,000
12月31日	\$ 41,960	\$ 4,000

6. 民國 112 年及 111 年度無自第三等級轉入及轉出之情形。

7. 本公司對於公允價值歸類於第三等級之評價流程係由外部評價機構負責進行金融工具之獨立公允價值驗證，藉獨立來源資料使評價結果貼近市場狀態，確認資料來源資料係獨立、可靠、與其他資源一致以及代表可執行價格，並定期校準評價模型、進行回溯測試、更新評價模型所需輸入值及資料及其他任何必要之公允價值調整，以確保評價結果係屬合理。

8. 有關屬第三等級公允價值衡量項目所使用評價模型之重大不可觀察輸入值之量化資訊及重大不可觀察輸入值變動之敏感度分析說明如下：

	112年12月31日	重大不可	區間	輸入值與
	公允價值	觀察輸入值	(加權平均)	公允價值關係
非衍生權益工具：				
非上市公司				
股票及債券	\$ 41,960	市場法	不適用	不適用
	111年12月31日	重大不可	區間	輸入值與
	公允價值	觀察輸入值	(加權平均)	公允價值關係
非衍生權益工具：				
非上市公司				
股票	\$ 4,000	市場法	不適用	不適用

9. 本公司經審慎評估選擇採用之評價模型及評價參數，惟當使用不同之評價模型或評價參數可能導致評價之結果不同。針對分類為第三等級之金融資產及金融負債，若評價參數變動，則對本期損益或其他綜合損益之影響如下：

			112年12月31日			
			認列於損益		認列於其他綜合損益	
	輸入值	變動	有利變動	不利變動	有利變動	不利變動
金融資產						
權益工具	市場價格	±1%	\$ -	\$ -	\$ 40	\$ 40
債務工具	市場價格	±1%	380	380	-	-
合計			\$ 380	\$ 380	\$ 40	\$ 40

111年12月31日

			認列於損益		認列於其他綜合損益	
			有利變動	不利變動	有利變動	不利變動
金融資產	輸入值	變動				
權益工具	市場價格	±1%	\$ -	\$ -	\$ 40	\$ 40

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

1. 資金貸與他人：無。
2. 為他人背書保證：請詳附表一。
3. 期末持有有價證券情形（不包含投資子公司、關聯企業及合資控制部分）：請詳附表二。
4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：請詳附表三。
5. 取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：請詳附表四。
6. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。
8. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。
9. 從事衍生工具交易：無。
10. 母公司與子公司及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額：請詳附表五。

(二)轉投資事業相關資訊

被投資公司名稱、所在地區等相關資訊（不包含大陸被投資公司）：請詳附表六。

(三)大陸投資資訊

1. 基本資料：請詳附表七。
2. 直接或間接經由第三地區事業與轉投資大陸之被投資公司所發生之重大交易事項：請詳附表五及附表七。

(四)主要股東資訊

主要股東資訊：請詳附表八。

十四、部門資訊

不適用。

《個體財報之附表一~八，同合併財報附表一~八，請參閱合併財報。》

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：

(一)最近二年度財務狀況比較分析：

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年度	112 年度	111 年度	差異	
			金額	%
流動資產	4,944,478	4,800,415	144,063	3.00
非流動資產	2,747,174	2,113,724	633,450	29.97
流動負債	2,885,588	2,896,557	(10,969)	(0.38)
非流動負債	1,091,309	612,203	479,106	78.26
歸屬於母公司業主之權益	3,681,004	3,368,582	312,422	9.27
茲就各科目前後期變動達百分之二十，且變動金額達新台幣 10,000 仟元，增減變動之主要原因及其影響及未來因應計畫，說明如下：				
變動說明：				
1.非流動資產：				
主係因不動產、廠房及設備增加所致，變動原因主要是添鴻南科建廠為了因應客戶訂單需求。				
2.非流動負債：				
主係因長期借款增加所致，變動原因主要是添鴻南科建廠所需資金運用。				

二、財務績效：

(一)最近二年度經營結果分析：

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年度	112 年度	111 年度	增(減)金額	變動比例(%)	變動分析
銷貨收入	3,543,994	3,723,376	(179,382)	(4.82)	
營業成本	2,056,061	2,105,567	(49,506)	(2.35)	
營業毛利	1,487,933	1,617,809	(129,876)	(8.03)	
營業費用	792,971	858,533	(65,562)	(7.64)	
營業淨利	694,962	759,276	(64,314)	(8.47)	
營業外收入及支出	53,700	174,925	(121,225)	(69.30)	1
繼續營業單位稅前淨利	748,662	934,201	(185,539)	(19.86)	
所得稅費用	133,256	208,706	(75,450)	(36.15)	2
本期淨利-母公司業主	616,340	722,106	(105,766)	(14.65)	
其他綜合損益	123,610	4,546	119,064	2,619.09	3
變動原因說明：					
1.主要係 112 年較 111 年因處分不動、廠房及設備利益減少 29,729 仟元，以及 112 年較 111 年外幣兌換損失增加 127,170 仟元所致。					
2.係因稅前淨利減少故所得稅費用亦減少所致。					
3.係因 112 年較 111 年度出售 TAZMO 股票及金融評價調整增加所致。					

(二)預期銷售數量與其依據：

因本公司未編列一一二年度財務預測，故不予以預測營業額。整體而言係依據產業環境、客戶產品與產能需求、市場供需、競爭狀況而定。

(三)對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

公司隨著業務的成長，經營規模穩定提升但不盲目擴張產能，財務方面目前帳上可供運用資金尚稱充足，並持續與往來銀行維持穩定合作關係，使公司體質更為健全。

三、現金流量：

(一)最近年度現金流量變動情形分析：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	112 年度	111 年度	增（減）變動	
			金額	%
營業活動之淨現金流入	764,455	817,968	(53,513)	(6.54)
投資活動之淨現金流(出)入	(753,322)	420,748	(1,174,070)	(279.04)
籌資活動之淨現金流入(出)	239,301	(407,604)	646,905	158.71
現金及約當現金增加數	249,112	832,690	(583,578)	(70.08)
增減比例變動分析說明(變動達百分之二十)：				
1.投資活動之淨現金由流入轉為流出：主係取得透過損益按公允價值衡量之金融資產現金流出增加 37,960 仟元，處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產現金流入增加 135,578 仟元，取得按攤銷後成本衡量之金融資產現金流出增加 764,958 仟元，購置不動產、廠房現金流出增加 438,639 仟元。				
2.籌資活動之淨現金由流出轉為流入：主係舉借短期借款減少 374,209 仟元，償還短期借款減少 466,186 仟元、舉借長期借款現金流入增加 191,690 仟元及償還長期借款現金流出減少 338,273 仟元，發放現金股利流出增加 32,815 仟元及庫藏股交易現金流入增加 57,386 仟元。				

(二)流動性不足之改善計畫：

本公司因業績成長，營業活動現金流量為正數，足以因應營運所需，尚無資金流動性不足之情況。本公司與銀行關係向來良好，未來若有流動性不足情況時，將以中短期融資計畫因應之。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	113 年度預計淨現金流量(預估數)			預計期末現金餘額 (預估數)
	營業活動	投資活動	籌資活動	
2,170,234	641,403	(474,288)	(480,993)	1,856,356
1.未來一年現金流量變動情形分析：				
(1)營業活動：係因 113 年營業獲利所致。				
(2)投資活動：係因 113 年度購置設備、增建廠房所致。				
(3)籌資活動：係因 113 年度發放現金股利及長期借款所致。				
2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。				

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

(一)最近年度轉投資政策：

本公司對於轉投資事業之業務管理政策係依據內部控制制度之「投資循環」、「子公司營運管理辦法」及「取得或處分資產處理程序」，作為轉投資事業經營管理之依循規範。各轉投資事業並依規定定期提供其財務資料予本公司，使本公司能及時了解其財務或業務狀況。另本公司內部稽核單位亦不定期查核各轉投資事業之營運狀況及內部控執行情形，並於董事會報告其結果，協助經營階層與董事會了解轉投資事業經營之狀況。

(二)最近年度獲利或虧損之主要原因、改善計畫：

單位：新台幣仟元

轉投資事業	投資金額	關係	獲利或虧損之主要原因	112 年度投資(損)益	改善計畫
Grand Plastic Technology Limited	19,470	本公司持股 100% 之子公司	112 年度營業淨利	21	不適用
添鴻科技(股)公司	513,956	本公司持股 100% 之子公司	112 年度營業淨利	157,996	不適用
太引資訊系統(股)公司	160,783	本公司持股 78.1% 之子公司	112 年度營業淨(損)	(10,523)	不適用
佳霖科技(股)公司	534,796	本公司持股 100% 之子公司	112 年度營業淨利	108,640	不適用

(三)未來一年投資計畫：請參閱六、(八)擴充廠房之預期效益。

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

單位：新台幣仟元

項目	112 年度(註 1)		刊印年度截至 3 月 31 日止(註 2)	
	金額	佔稅前純益比率	金額	佔稅前純益比率
利息收入	51,248	6.85%	註 2	註 2
利息支出	12,566	1.68%	註 2	註 2
淨匯兌利益(損失)	(17,714)	(2.37%)	註 2	註 2

註 1：會計師查核簽證之財務報告。

註 2：截至年報刊印日止，第一季財務報告尚未經會計師核閱完成，故暫不列示。

1.利率變動：

本公司近兩年度利息支出甚低，故利率變動對本公司影響尚屬有限。此外，本公司 112 年底帳上「現金及約當現金」及「按攤銷後成本衡量之

金融資產一流動」分別為 2,170,234 仟元及 517,955 仟元，因此於資金運用上尚屬寬裕，故利率變動對本公司損益之影響並不大。截至年報刊印日止，年報刊印年度第一季財務報告尚未經會計師核閱完成。

本公司亦隨時注意利率變動情形，採取必要因應措施，以降低利率變化對本公司損益產生影響。

2. 匯率變動：

本公司進貨廠商及銷貨客戶以國內居多，111~112 年度因美元匯率變動較大，分別產生較高的淨匯兌利益、淨匯兌損失，屬於特殊情形。除此之外，近年淨兌換利益(損失)平均值相對不高，匯率變動對本公司之營收及獲利尚無太大影響。本公司在外幣資金管理上採穩健保守原則，盡力規避匯率變動所可能造成之不利影響，本公司財務人員也隨時與銀行保持密切聯繫，並蒐集匯率相關資訊，以期充分掌握匯率走勢。

3. 通貨膨脹：

本公司並無因受通貨膨脹而有重大影響之情形，且本公司對客戶及供應商之報價，以市場之機動調整者居多，故對本公司損益影響有限。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司一向秉持專注本業及務實原則經營事業，財務政策以穩健保守為原則，並無從事高風險、高槓桿之投資，另本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無從事資金貸與他人、對子公司以外之人背書保證及衍生性金融商品交易之情事。

本公司未來將以專注本業經營為主，有關資金貸與他人、背書保證及衍生性金融商品交易之政策，未來將以符合本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業辦法」及「從事衍生性金融商品交易處理程序」相關辦法規定，並考量財務業務需要辦理。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1. 本公司秉持提供客戶客製化及高品質之產品為原則，主要目標仍以持續改善原有之 Wet Bench 與 Single Wafer Spin processor(UFO)等設備產品為主。隨著 3D IC 構裝技術之發展，發展功能達到與國外無電鍍鍍金設備商相同水準之 3D IC 無電鍍金屬化製程設備；因應客戶新製程所需，製程設備需要新應用研發，並與客戶共同開發新製程機台、化學品及關鍵零組件等，例如：Square Fanout UBM Etcher、Square Fanout RP Stripper、UFO 300 4CH Al/Ti UBM Etchin，朝向產品多元化發展。

本公司針對後段封裝在未來趨勢與公司產品發展方向如下：

- (1)3D 封裝：除原已成熟之設備外，本公司有競爭力之設備為 Via Clean 及化鍍等。Via Clean 主要以 Single Wafer tool 搭配特殊化學配方。化學鍍膜設備則必須與鍍液廠商作聯盟，目前公司與外商公司及子公司添鴻科技合作，就化鍍液特性，進行機台設計開發。設計之關鍵在於溫度之均勻與穩定性及化鍍液之管理。

- (2)Fine Pitch Bump：後段封裝在極小元件尺度之挑戰上，主要在於凸塊間距變小，其挑戰為乾膜 Residue(殘餘物)。必須配合 Strip Chemical 廠商，針對化學品特性持續作機構設計變化。
- (3)Lead free(無鉛製程)：主要挑戰在於Stripper配方的變化導致乾膜 Residue(殘餘物)及銅氧化。設備之設計必須以不同概念發展新的機構因應。
- (4)Thin Wafer 薄片(厚度小於 6mil)：3D IC 堆疊必然須將晶圓磨薄，薄化後晶圓厚度可小於 6mil，其 warpage 可大於 2mm。晶圓傳送操作及製程處理必然是機構設計者挑戰。
- (5)本公司針對客戶的 SoIC 製程開發濕式光阻去除設備，挑戰線寬與線距小於 $2\mu\text{m}$ 導線光阻去除製程。由於客戶採用的銅導線之線寬與線距皆小於 $2\mu\text{m}$ 且互連密度高，因此製程條件接近前段晶片製造等級。本研發案對於製程精密度與潔淨度要求超越先前研發的封裝製程設備規格。本研發案從：「製程先期模擬測試→製程設備設計與製作→客戶端整機終端驗證」，有助於日後發展半導體前段濕製程設備技術，並強化布局 3D IC 製程與設備的智慧財產權。本研發案並已申請經濟部科專-「SoIC 濕式銅導線製程設備開發計畫」，計畫期間為 110~112 年，業已經經濟部審核通過。

2.本公司 113 年度預計投入之研發費用為 275,439 仟元。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司日常營運均遵循國內外相關法令辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法令變動情形，以隨時調整營運策略。最近年度及截至年報刊印日止並未受到國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務及業務之情事。

(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司為國內專業半導體設備製造商，所生產之產品除已取得多項專利保障外，並獲得國內半導體、封測大廠之高度評價與認同，足見本公司之研發實力與因應科技改變及產業變化之能力。未來本公司仍將持續增加研發投入外，並密切掌握市場之趨勢與脈動，以順應相關產業之演變與變化，故科技改變與產業變化對本公司財務業務尚不致產生重大影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向秉持專業、誠信之永續經營原則，並重視企業形象和風險控管，最近年度及截至年報刊印日止並無企業形象改變造成企業危機管理之情事。惟企業危機一旦發生即可能對企業產生相當之損害，故本公司將持續遵守盡力落實各項公司治理要求，適時請相關專家提供諮詢意見並遵從之，以降低該等風險之發生及該等風險對於本公司財務業務之影響力。

(七)進行併購之預期效益及可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止尚無新的併購計畫，未來若從事相關計畫之評估及執行時，亦將依相關法令及本公司內部各項管理辦法辦

理，以保障原有股東權益及落實資訊公開程序。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：

本公司因業務量漸漸擴增，為因應本公司營運規模成長之需求，除 99~101 年購地並興建廠房及遷址，子公司添鴻科技亦於 105~107 年購地自建廠房並遷廠完成。本公司及子公司添鴻科技將於 111~113 年分別規劃，弘塑科技於 112 年動工興建二期廠房、及添鴻科技南科擴廠(路竹廠)，該二項投資計畫原則將依進度執行之，未來執行完畢後，對集團未來的營運規劃及發展具有正面的效益。本公司及子公司之自地建廠/南科擴廠計畫，將評估自有資金動向，如自有資金不足時，則以銀行中長期借款支應，並將持續注意利率走勢並定期評估，據以訂定適當的融資政策以因應建廠資本支出需求。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1.進貨集中風險：

本公司與各供應商間往來行之有年，除維持良好之合作關係外，供貨來源尚屬穩定，且未有供貨短缺或中斷致影響生產作業之情事。本公司除與主要供應商維持穩定之合作關係外，並持續進行各種相關可行性評估，考量品質、產品良率、交期及供貨穩定性等條件，積極尋找新供應廠商，以避免產生進貨集中之風險。

2.銷貨集中風險：

本公司主要銷售對象為國內半導體、封測製造業者等均為知名上市櫃公司，然設備廠產業特性所造成之系統風險，實為發展過程難以避免之問題。本公司將盡力維持現有良好客戶關係並積極開發新產品及拓展新客戶，分散產品結構，以擴展不同產品別客戶及訂單，避免銷貨集中之市場風險。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，於最近年度及截至年報刊印日止，尚無股權之大量移轉或更換情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司經營團隊均致力於公司之永續發展，最近年度及截至年報刊印日止，並無經營權改變之情事。

(十二)公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無此情形，故不適用。

(十三)其他重要風險及因應措施：

1.各月營收認列波動較大：

本公司為設備製造商，設備生產期間約 3 至 6 個月、單筆訂單金額大

，加上本公司待客戶驗收完畢後一次全額認列銷貨收入，從在製品至製成品完工生產期間約需 3 至 6 個月，客戶驗收完工約 3 至 6 個月，合計營業週期約為 9 至 12 個月，若當月設備驗收台數較低時，總合併營收來源則為維修服務、材料買賣之業務以及合併子公司之營收，可能發生每月營收及短期累積營收變動起伏較大之情形。另外，在 2020 年下半年~2022 年第三季、2023 年下半年起訂單滿載、供應鏈供料吃緊、海空運的運輸瓶頸、整體半導體產業供不應求...等因素的影響下，產品總工期則較前述所云 9 至 12 個月之平均值更長。

因應措施：無。

2. 資訊安全對公司之風險及影響：

資訊安全經公司評估後係屬營運風險之一環，對本公司影響為一般。

因應措施：

- (1)本公司設有資訊部門及配置適當人數之專責資訊人員。
- (2)本公司每年均經會計師事務所查核資訊環境、帳號控管、軟硬體配置、防毒軟體、防火牆、ERP 系統...等，評核結果為適切。
- (3)本公司訂有各類資訊安全管理辦法，並不定期向所有同仁宣導資安重要性。
- (4)本公司資安委員會均會召開資安每季會議，檢討/改善資訊安全。

七、其他重要事項：無。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一)關係企業合併營業報告書：請參閱第 229~234 頁。

(二)關係企業合併財務報告：

1.關係企業合併財務報告聲明書：請參閱第 102 頁。

2.關係企業合併財務報告會計師查核報告：請參閱本年報：陸、財務概況-四、最近年度財務報告，含會計師查核報告、兩年對照之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及附註或附表。

(三)關係企業報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由及自股款或價款收足後迄資金運用計畫完成，私募有價證券之資金運用情形及計畫執行進度：不適用。

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：

本公司之股東佳霖科技股份有限公司，為本公司原始股東之一，其持有之弘塑科技股票，係於本公司公開發行前即取得。於 108 年 3 月 1 日，本公司併購後，佳霖科技方成為本公司 100%持股之子公司。其帳上投資本公司股數，係為本公司民國 97 年公開發行前所取得，自 108 年 3 月 1 日至 111 年 12 月 31 日均未曾處分本公司股票。

佳霖科技最近年度及截至年報刊印日止，處分本公司股票情形如下表：

單位：新台幣仟元；股；%

子公司名稱	實收資本額	資金來源	本公司持股比例	取得或處分日期	取得股數及金額	處分股數及金額	投資損益	截至年報刊印日止持有股數及金額	設定質權情形	本公司為子公司背書保證金額	本公司貸與子公司金額
佳霖科技股份有限公司	200,000	不適用	100%	處分期間：112 年 5 月 29 日~113 年 5 月 1 日	無	689,520 股 589,542 仟元	582,030 仟元 (列為股東權益)	5,000 股 5,500 仟元 (帳列：「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」)	無	無	無

對公司財務績效及財務狀況之影響：挹注子公司營運資金，對合併財報之股東權益為正面影響。

四、其他必要補充說明事項：無。

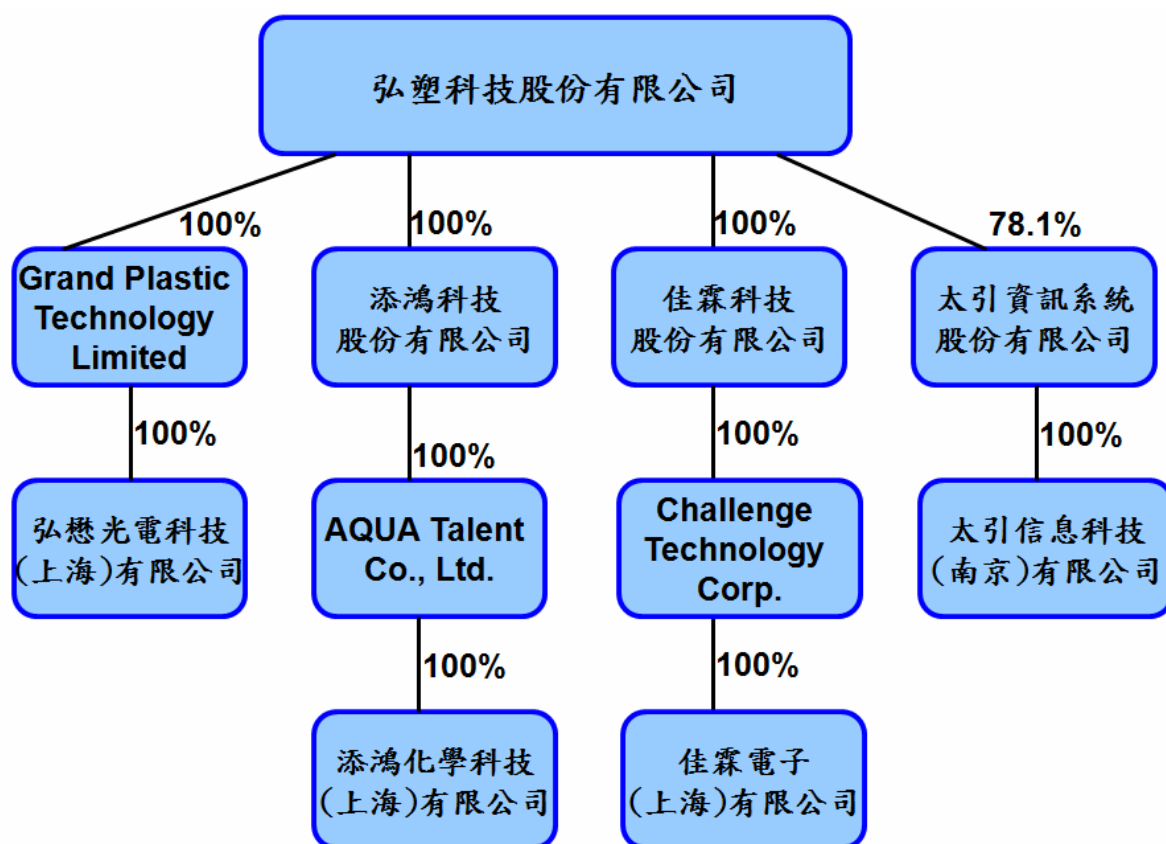
玖、對股東權益或證券價格有重大影響之事項

最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

弘塑科技股份有限公司
關係企業合併營業報告書
民國一一二年度

一、關係企業概況

(一)關係企業組織圖



(二)各關係企業基本資料

112 年 12 月 31 日

企 業 名 稱	設 立 日 期	地 址	實收資本額	主要營業項目
<u>控制公司</u> ： 弘塑科技股份有限公司	82.05.07	30095 新竹市香山區 中華路六段 89 號	新台幣 292,160 仟元	半導體及積體電路製造 設備之工程承包、製造、 買賣及維修工程；半導體 相關之機械安裝、電子零 組件製造。
<u>從屬公司</u> ： Grand Plastic Technology Limited	97.05.16	香港中環租庇利街 1 號喜訊大廈 706 室	美金 600 仟元	一般性投資。
弘懋光電科技 (上海)有限公司	97.11.27	中國（上海）自由貿 易試驗區盛夏路 169 號、張東路 1658 號 1 幢 4 層 409 室	美金 500 仟元	半導體光電工程技術產 品及相關零部件和軟體 的安裝維護及相關技術 諮詢服務、設備及零件、 軟體批發進出口與代理。
添鴻科技股份有限 公司	91.11.06	新竹縣湖口鄉光復 路 4-2 號	新台幣 100,000 仟元	工業級、試藥級、電子級 混酸（蝕刻液）、電鑄藥 液、工業級及電子級化學 品代客分裝暨各類膠製 造與開發買賣等。
AQUA Talent Co., Ltd.	97.06.16	No.24, Lesperance Complex, Providence Industrial Estate, Mahe, Seychelles	美金 350 仟元	一般性投資。
添鴻化學科技 (上海)有限公司	98.05.07	上海市金山區漕涇 鎮亭衛公路 3318 號 2 幢 201 室	美金 300 仟元	化學原料製造及銷售等。
太引資訊系統股份 有限公司	91.05.08	新竹市東區東光路 55 號 4 樓之 1	新台幣 36,250 仟元	軟體銷售及安裝等。
太引信息科技 (南京)有限公司	106.02.15	南京市麒麟科技創 新園智匯路 300 號-B 單元二樓	美金 74 仟元	軟體銷售及安裝等。
佳霖科技股份有限 公司	76.09.07	新竹縣竹北市泰和 里泰和路 21 號	新台幣 200,000 仟元	測試儀器設備及零件、分 析實驗儀器設備及零件 、工業用儀器設備零件... 等組合加工買賣業務、進 出口貿易及售後維修等。
Challenge Technology Corp.	92.01.12	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	美金 600 仟元	一般性投資。
佳霖電子(上海)有 限公司	93.03.10	中國（上海）自由貿 易試驗區盛夏路 169 號 1 幢 503 室	美金 600 仟元	同佳霖科技業務，為其在 中國大陸之據點。

(三)推定為有控制與從屬關係者，其相同股東資料：無。

(四)營業關係說明：

公司名稱	集團之職務分工	主要營業項目
弘塑科技股份有限公司	1.集團之營運總部。 2.新產品應用領域之研發與設計。 3.統籌集團之財務、業務之運作。 4.負責台灣及海外客戶之銷售業務。	半導體及積體電路製造設備之工程承包、製造、買賣及維修工程；半導體相關之機械安裝、電子零組件製造。
Grand Plastic Technology Limited	母公司 100%持有之子公司，負責轉投資海外設立子公司事宜。	投資控股。
弘懋光電科技(上海)有限公司	位於中國大陸華東地區，主要負責出售給大陸客戶機台的安裝維護、維修及相關技術諮詢服務。	半導體光電工程技術產品及相關零部件和軟體的安裝維護及相關技術諮詢服務、設備及零件、軟體批發進出口與代理。
添鴻科技股份有限公司	母公司 100%持有之子公司，主要產品為工業級化學蝕刻液。	工業級、試藥級、電子級混酸（蝕刻液）、電鑄藥液、工業級及電子級化學品代客分裝暨各類膠製造與開發買賣等。
AQUA Talent Co., Ltd.	添鴻科技 100%持有之子公司，負責轉投資海外設立子公司事宜。	投資控股。
添鴻化學科技(上海)有限公司	位於中國大陸華東地區，主要負責出售給大陸客戶工業級化學蝕刻液。	化學原料製造及銷售等。
太引資訊系統股份有限公司	母公司持股 78.1%之子公司，主要產品為軟體銷售及安裝等。	軟體銷售及安裝等。
太引信息科技(南京)有限公司	太引資訊 100%持有之子公司，位於中國大陸南京，主要負責大陸客戶的軟體銷售及安裝等。	軟體銷售及安裝等。
佳霖科技股份有限公司	母公司 100%持有之子公司，主要業務為設備、零組件等產品之買賣、代理、售後服務等。	測試儀器設備及零件、分析實驗儀器設備及零件、工業用儀器設備零件...等組合加工買賣業務、進出口貿易及售後維修等。
Challenge Technology Corp.	佳霖科技 100%持有之子公司，負責轉投資海外設立子公司事宜。	投資控股。
佳霖電子(上海)有限公司	位於中國大陸華東地區，主要支援佳霖科技業務，為其在中國大陸之據點。	同佳霖科技業務，為其在中國大陸之據點。

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料

112 年 12 月 31 日

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
Grand Plastic Technology Limited	董事長	弘塑科技股份有限公司代表人：張鴻泰	600,000 股	100.00%
弘懋光電科技(上海)有限公司	董事長 監 事	弘塑科技股份有限公司代表人：石本立 弘塑科技股份有限公司代表人：黃富源	不適用	由 Grand Plastic Technology Limited 持股 100.00%
添鴻科技股份有限公司	董事長 董 事 董 事 董 事 董 事 監察人 監察人 總經理	弘塑科技股份有限公司代表人：石本立 弘塑科技股份有限公司代表人：鍾時俊 弘塑科技股份有限公司代表人：黃富源 弘塑科技股份有限公司代表人：梁勝銓 弘塑科技股份有限公司代表人：顏榮偉 弘塑科技股份有限公司代表人：曾繁斌 弘塑科技股份有限公司代表人：張泰山 鍾時俊	10,000,000 股	100.00%
AQUA Talent Co., Ltd.	董事長	添鴻科技股份有限公司代表人：石本立	350,000 股	由添鴻科技持股 100.00%
添鴻化學科技(上海)有限公司	董事長 監 事 總經理	添鴻科技股份有限公司代表人：鍾時俊 添鴻科技股份有限公司代表人：葉啟欽 鍾時俊	不適用	由 AQUA Talent Co., Ltd. 持股 100.00%
太引資訊系統股份有限公司	董事長 董 事 董 事 監察人 總經理	弘塑科技股份有限公司代表人：石本立 弘塑科技股份有限公司代表人：周沁怡 雲勉投資有限公司代表人：邱康勉 曾繁斌 周沁怡	2,831,000 股	78.10%
太引信息科技(南京)有限公司	董事長 監 事	太引資訊系統(股)公司代表人：周沁怡 太引資訊系統(股)公司代表人：李瑞欽	不適用	由太引資訊系統持股 100.00%
佳霖科技股份有限公司	董事長 董 事 董 事 董 事 董 事 監察人 總經理	弘塑科技股份有限公司代表人：張泰山 弘塑科技股份有限公司代表人：張鴻泰 弘塑科技股份有限公司代表人：石本立 弘塑科技股份有限公司代表人：楊銘和 弘塑科技股份有限公司代表人：周雲程 弘塑科技股份有限公司代表人：曾繁斌 石本立	20,000,000 股	100.00%
Challenge Technology Corp.	董事長	佳霖科技股份有限公司代表人：張鴻泰	1,000,000 股	由佳霖科技持股 100.00%
佳霖電子(上海)有限公司	董事長 董 事 董 事 監 事	佳霖科技股份有限公司代表人：石本立 佳霖科技股份有限公司代表人：張泰山 佳霖科技股份有限公司代表人：楊銘和 佳霖科技股份有限公司代表人：蔡素滿	不適用	由 Challenge Technology Corp. 持股 100.00%

(六)各關係企業營運概況

112 年 12 月 31 日

單位：除特別標示者外為新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產 總值	負債 總值	淨值	營業 收入	營業 利益	本期 損益 (稅後)	每股盈 餘(元) (稅後)
Grand Plastic Technology Limited	美金 600 仟元	18,077	0	18,077	0	(45)	21	0.04
弘懋光電科技 (上海)有限公司	美金 500 仟元	15,348	58	15,290	2,407	106	101	不適用
添鴻科技股份有限 公司	100,000	2,127,892	1,367,531	760,361	757,423	217,581	170,905	17.09
AQUA Talent Co., Ltd.	美金 350 仟元	20,041	0	20,041	0	(42)	82	0.23
添鴻化學科技 (上海)有限公司	美金 300 仟元	163,472	144,521	18,951	180,351	585	109	不適用
太引資訊系統股份 有限公司	36,250	85,511	22,696	62,815	56,137	(5,678)	(4,266)	(1.18)
太引信息科技 (南京)有限公司	美金 74 仟 元	13,962	12,247	1,715	22,132	155	632	不適用
佳霖科技股份有限 公司	200,000	1,284,887	393,096	891,791	954,887	150,175	126,655	6.33
Challenge Technology Corp.	美金 600 仟元	33,534	0	33,534	0	(35)	(1,179)	(1.18)
佳霖電子(上海)有 限公司	美金 600 仟元	42,880	9,749	33,131	69,076	(589)	(1,150)	不適用

匯率說明：匯率係採 112 年 12 月 31 日資料：

資產/負債： 台幣：美金= 30.705：1

損益： 台幣：美金= 31.154：1

附件一

弘塑科技股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：一一三年三月八日

本公司民國一一二年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一二年十二月三十一日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一三年三月八日董事會通過，出席董事七人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。



弘塑科技股份有限公司

董事長：張鴻泰 簽章



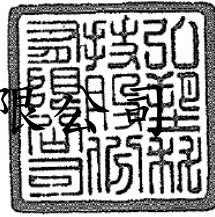
總經理：石本立 簽章

石本立

謝謝您參加股東常會！

歡迎您隨時批評指教！

弘塑科技股份有限公司



董 事 長：張 鴻



領導品牌

A close-up photograph of a robotic gripper, likely from a KUKA robot, positioned against a background of blue concentric circles. The gripper is made of polished metal and has a yellow and black warning label. It is holding a small, dark, rectangular object. The background consists of several overlapping blue circles of varying shades, creating a sense of depth and motion.

Multi-functions Flexibility



Flexible Modularized System



Excellent for Advanced Process



Large Size Development



Fully Customize

